本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

重庆宇隆光电科技股份有限公司

Chongqing E-ong Optoelectronics Technology Co., Ltd.

（住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号）

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

（注册稿）

本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者的声明

一、发行人上市的目的

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。

历经数十载的沉淀和积累，通过持续的投入和创新，新型半导体显示面板已成为我国现代化产业体系的优势产业之一，逐步实现了国产化替代。自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕 LCD 显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro LED 等显示领域新技术的发展应用。作为国内显示用智能控制卡的龙头企业，公司现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商显示用智能控制卡的主要供应商。

现阶段，人类已进入以 AI 人工智能引领的新一次技术革命浪潮之中，人机交互的边界将被重新定义，人工智能的高速发展将给终端应用市场带来革命性的发展和提升，而显示技术作为人工智能的重要交付界面，也将成为全球科技产业竞争的“新锚点”。现阶段，我国新型显示行业正在全方位、多层次发力，通过政策引导、企业创新、产品升级、产学研协同等行动，坚定推进人工智能与新型显示技术深度融合，为全球新型显示产业智能化发展贡献中国力量，引领产业发展新潮流。

通过本次发行上市，公司希望能够牢牢把握 AI 技术引领下的新型半导体显示产业以及整个消费电子行业的历史性发展机遇，持续扩大产能规模、布局前沿技术，从而提升向下游半导体显示领域行业龙头企业的供货能力及自身的核心竞争力。通过本次上市，公司将进一步完善自身业务体系、提高服务能力的现代化水平，助力我国新型半导体显示面板产业先进科技成果实现高水平应用，夯实我国现代化产业体系的建设成果，不断加强我国新型半导体显示面板行业的“自主可控”能力，促进我国电子制造业新质生产力、新动能的不断发展壮大。

二、发行人现代企业制度的建立健全情况

发行人已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，形成了运作规范的现代公司治理体系，保障发行人内部控制制度健全并有效运行，有效提升了公司治理水平。

三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划

近年来，半导体显示面板行业发展迅速，TFT-LCD、AMOLED、Mini/Micro LED 等新型显示技术逐步成熟，其下游消费电子终端产品亦随着新技术的更迭而加速升级换代，新能源汽车智能座舱、现代通讯等领域的发展亦将打开广阔的市场增量需求。基于此，公司在深耕新型半导体显示领域的同时，亦正积极向汽车电子、光通信模块等应用领域进行开拓。

面向未来，AI 技术的发展和进步已逐步重塑电子产品的交互方式，必将为消费电子行业带来新的历史性发展机遇。新型半导体显示行业是支撑我国电子信息产业持续发展的重要战略新兴产业，也是 AI 技术革命中的先锋产业之一。因此，作为实现人机交互的直接平台，公司所处的新型半导体显示面板产业亦将迎来历史性的发展机遇。

公司本次募集资金投资项目系围绕现有核心业务展开，主要投向包括合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目和补充流动资金项目，募投项目的投建落地将有效扩大公司现有业务规模并增强核心竞争力，以深刻把握 AI 技术引领下的新型半导体显示及消费电子等行业的发展机遇，符合国家产业政策要求和行业发展趋势。通过募集资金投资项目的实施，公司的综合实力将得到有效提高，助力公司更好地把握市场机遇，是公司未来经营战略的重要保障。本次融资完成后，公司资本结构将得到优化，资金实力将有效增强，从而提升公司的财务稳健性和抗风险能力，符合公司中长期发展战略的需要，具有必要性。

四、发行人持续经营能力及未来发展规划

自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕 LCD 显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro

LED 等显示领域新技术的应用发展，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的技术研发、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，全面覆盖目前主流及未来新型显示技术路线。

伴随下游消费电子行业的持续发展，以及新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术的不断进步，公司经营业绩实现稳步增长。报告期内，发行人营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78 万元和 13,329.07 万元，主要来源于发行人的核心技术及相应产品。

截至报告期末，公司已广泛覆盖目前国内主流新型半导体显示面板厂商的高世代产线，终端产品应用于全球主流终端品牌厂商的消费电子产品，体现了公司一流的技术水平和创新能力。截至目前，公司已为京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内主流半导体显示面板厂商供应超过千款显示用智能控制卡产品，覆盖了 TFT-LCD、AMOLED 等主流显示技术类型，并已实现 Mini LED/Micro LED 等下一代显示技术产品的前瞻性布局。

展望未来，公司将全力以赴把握 AI 技术革命所带来的业务增量和新型应用需求，确保公司现有市场份额、产能规模和技术实力的领先优势；同时，公司也将通过持续的研发投入和技术创新，以自身核心技术体系为依托，不断完善自身产业链布局。在此基础上，公司将进一步挖掘下游客户、终端市场的新业务机会，拓展业务和产品边界，持续增强自身核心竞争力和抗风险能力，为股东及社会创造更大的价值，为我国现代化产业体系的不断完善和新质生产力的创新发展而奋斗不息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《致投资者的声明》之签署页）

董事长签字：

王亚龙

实际控制人签字：

王亚龙　　李红燕

重庆宇隆光电科技股份有限公司

2026 年 3 月 6 日

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数/股东公开发售股数（如有）	本次拟公开发行人民币普通股不低于43,033,616股，且不超过129,100,845股。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形
每股面值	人民币1.00元
每股发行价格	【●】元
预计发行日期	【●】年【●】月【●】日
拟上市的证券交易所和板块	深圳证券交易所创业板
发行后的总股本	不低于430,336,153股，不超过516,403,382股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人、主承销商	中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【●】年【●】月【●】日

目 录

声 明.....1
致投资者的声明.....2
一、发行人上市的目的.....2
二、发行人现代企业制度的建立健全情况.....3
三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划.....3
四、发行人持续经营能力及未来发展规划.....3
本次发行概况.....6
目 录.....7
第一节 释义.....12
一、一般释义.....12
二、专业释义.....18
第二节 概览.....22
一、重大事项提示.....22
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....29
三、本次发行概况.....30
四、发行人主营业务经营情况.....31
五、发行人板块定位情况.....39
六、发行人主要财务数据和财务指标.....41
七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况.....41
八、发行人选择的具体上市标准.....43
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....44
十、募集资金运用与未来发展规划.....44
十一、其他对发行人有重大影响的事项.....45
第三节 风险因素.....46
一、与发行人相关的风险.....46
二、与行业相关的风险.....53
三、其他风险.....55
第四节 发行人基本情况.....58

一、发行人基本资料.....58
二、发行人设立情况及报告期内股本、股东变化情况.....58
三、发行人股权结构.....74
四、发行人控股子公司、参股公司情况.....75
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 84
六、发行人股本情况.....85
七、发行人特别表决权股份或类似安排.....96
八、发行人协议控制架构.....96
九、控股股东、实际控制人合规情况.....96
十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 96
十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排..... 111
十二、员工及社会保障情况.....117
第五节 业务和技术 120
一、公司主营业务、主要产品或服务及演变的情况.....120
二、公司所属行业的基本情况.....148
三、公司销售情况及主要客户.....190
四、公司采购情况及主要供应商.....197
五、公司的主要固定资产、无形资产情况.....200
六、公司技术与研发情况.....219
七、环境保护情况.....231
八、公司境外经营情况.....235
第六节 财务会计信息与管理层分析 236
一、财务报表.....236
二、财务会计信息.....240
三、主要会计政策和会计估计.....243
四、非经常性损益.....265
五、税项.....266
六、本公司主要财务指标.....268
七、影响公司经营成果和财务状况的主要因素.....270

八、经营成果分析.....272
九、资产质量分析.....298
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....321
十一、重大资本性支出分析.....339
十二、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况.....339
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.....339
十四、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况.....340
十五、盈利预测.....343
第七节 募集资金运用与未来发展规划.....345
一、本次募集资金投资项目及其使用计划.....345
二、本次募集资金运用情况.....348
三、业务发展规划.....353
第八节 公司治理与独立性.....356
一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.....356
二、发行人内部控制情况.....356
三、报告期内重大违法违规行为情况.....357
四、报告期内资金占用及对外担保情况.....357
五、发行人独立运行情况.....357
六、发行人同业竞争情况.....359
七、关联方及关联关系.....364
八、关联交易情况.....368
第九节 投资者保护.....375
一、本次发行前滚存利润分配方案.....375
二、本次发行后的股利分配政策.....375
三、本次发行前后股利分配政策差异情况.....380
四、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏损的投资者保护措施.....381
第十节 其他重要事项.....382
一、重大合同.....382
二、对外担保情况.....389

三、重大诉讼与仲裁事项.....389
第十一节 声明 390
发行人全体董事、高级管理人员声明.....390
发行人全体审计委员会委员声明.....392
发行人控股股东、实际控制人声明.....393
保荐人（主承销商）声明.....394
保荐人董事长声明.....395
保荐人总经理声明.....396
发行人律师声明.....397
会计师事务所声明.....398
资产评估机构声明.....399
验资复核机构声明.....401
第十二节 附件 402
一、备查文件.....402
二、文件查阅时间、地点.....402
三、招股说明书其他附件.....403
附件一 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 404
一、落实投资者关系管理相关规定的安排.....404
二、股利分配决策程序.....404
三、股东投票机制建立情况.....406
附件二 与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 408
一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺.....408
二、关于股东持股及减持股份意向的承诺.....412
三、关于稳定股价的措施和承诺.....413
四、关于依法承担赔偿责任的承诺.....418
五、关于对欺诈发行上市的股份回购承诺.....420
六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺.....420

七、关于利润分配政策的承诺.....423
八、关于控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺.....424
九、关于未能履行承诺时约束措施的承诺.....425
十、关于减少和规范关联交易的承诺.....429
十一、关于股东信息披露事宜的承诺.....431
十二、关于社会保险和住房公积金的承诺.....431
十三、关于避免资金占用的承诺.....432
十四、关于保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立的承诺.....432
十五、关于在审期间不进行现金分红的承诺.....433
十六、关于发行人业绩下滑延长股份锁定期限的承诺.....434
十七、关于税收优惠的承诺.....434
附件三 股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 435
一、股东会制度的建立健全及运行情况.....435
二、董事会制度的建立健全及运行情况.....435
三、监事会制度的建立健全及运行情况.....436
四、独立董事制度的建立健全及运行情况.....437
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....437
附件四 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 438
一、战略委员会的构成与职责.....438
二、审计委员会的构成与职责.....438
三、提名委员会的构成与职责.....438
四、薪酬与考核委员会的构成与职责.....438
五、董事会专门委员会的运作情况.....439
附件五 募集资金具体运用情况 440
一、合肥宇隆生产基地项目.....440
二、重庆宇隆二期项目.....442
三、补充流动资金.....444
附件六 子公司、参股公司简要情况 445

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：

一、一般释义

本公司、公司、发行人、宇隆科技	指	重庆宇隆光电科技股份有限公司，系由重庆宇隆光电科技有限公司整体变更设立，根据上下文也可指宇隆有限
宇隆有限	指	重庆宇隆光电科技有限公司，系发行人的前身
本次发行	指	公司本次在境内首次公开发行人民币普通股（A股）的行为
本招股说明书	指	重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市招股说明书
重庆升越达	指	重庆升越达光电科技有限公司
安徽灿宇	指	安徽灿宇光电科技有限公司
西安宇隆	指	西安宇隆光电科技有限公司
武汉宇隆	指	武汉宇隆光电科技有限公司
福州宇隆	指	福州宇隆光电科技有限公司
北海宇隆	指	北海宇隆光电科技有限公司
合肥宇隆	指	合肥宇隆光电科技有限公司
河北宇隆	指	河北宇隆光电科技有限公司
青岛宇隆	指	青岛宇隆光电科技有限公司
成都宇隆	指	成都宇隆光电有限公司
宇隆研究院	指	重庆宇隆电子技术研究院有限公司
隆美卡机器人	指	重庆隆美卡智能机器人有限公司
香港宇隆	指	香港宇隆科技有限公司
越南宇隆	指	越南宇隆科技有限公司，英文名称为Vietnam E-ong Technology Company Limited
纽禄美卡	指	Neuromeka Co.,Ltd.（韩国上市公司，股票代码：348340.KS），根据上下文也可指纽禄美卡及其子公司
扬州光洋	指	扬州光洋世一智能科技有限公司
光洋股份	指	常州光洋轴承股份有限公司
莱特光电	指	陕西莱特光电材料股份有限公司
朗晨光电	指	西安朗晨光电材料有限公司
莱特电子	指	陕西莱特电子科技有限公司
莱特迈思	指	陕西莱特迈思光电材料有限公司
蒲城莱特	指	蒲城莱特光电新材料有限公司
城固莱特	指	城固莱特光电新材料有限公司

莱特众成	指	莱特众成光电科技有限公司
北京莱特	指	北京莱特众成光电材料科技有限公司
夸石投资	指	西安夸石投资合伙企业（有限合伙）
莱特夸石	指	陕西莱特夸石材料有限公司
鲲鹏半导体	指	蒲城鲲鹏半导体材料有限公司
西安麒麟	指	西安麒麟投资有限公司，现用名“宁波高展自有资金投资有限公司”
龙翔四海	指	西安龙翔四海投资合伙企业（有限合伙）
艾利特贸易	指	陕西艾利特贸易有限公司
晓荷智能	指	陕西晓荷智能科技有限公司，曾用名“陕西莱特智能科技有限公司”
晓荷生物	指	陕西晓荷生物科技有限公司
美辰照明	指	西安美辰照明有限公司，曾用名“西安莱特半导体照明有限公司”
西安裕隆、盘石精密	指	西安裕隆电子有限公司，现用名“西安盘石精密设备有限责任公司”
陕西磐久	指	陕西磐久精密设备有限责任公司
海南磐久	指	海南磐久投资合伙企业（有限合伙）
共青城瑞麟	指	共青城瑞麟投资合伙企业（有限合伙）
共青城君成	指	共青城君成投资合伙企业（有限合伙）
共青城晓荷	指	共青城晓荷投资合伙企业（有限合伙）
共青城高展	指	共青城高展投资合伙企业（有限合伙）
共青城麒麟	指	共青城麒麟投资合伙企业（有限合伙），现用名“宁波君成自有资金投资合伙企业（有限合伙）”
共青城青荷	指	共青城青荷投资合伙企业（有限合伙），现用名“宁波青荷自有资金投资合伙企业（有限合伙）”
海南瑞麟壹号	指	海南瑞麟壹号投资合伙企业（有限合伙）
海南瑞麟贰号	指	海南瑞麟贰号投资合伙企业（有限合伙）
海南瑞麟叁号	指	海南瑞麟叁号投资合伙企业（有限合伙）
海南瑞麟肆号	指	海南瑞麟肆号投资合伙企业（有限合伙）
海南瑞麟伍号	指	海南瑞麟伍号投资合伙企业（有限合伙）
海南高展投资	指	海南高展投资合伙企业（有限合伙）
上海特莱晶	指	上海特莱晶科技有限公司
蒲城特莱晶	指	蒲城特莱晶科技有限责任公司
西安特莱晶	指	西安特莱晶材料科技有限公司
陕西特莱晶	指	陕西特莱晶科技有限公司
渭南特莱晶	指	渭南市卤阳湖特莱晶科技有限公司
陕西特晶源	指	陕西特晶源石英制品有限公司

西安特晶源	指	西安特晶源石英制品有限公司
西咸特晶源	指	西咸新区特晶源石英拉管有限公司
中鑫光电	指	新沂市中鑫光电科技有限公司
中大石英	指	新沂市中大石英科技有限公司
江苏晶辉	指	江苏晶辉新材料科技有限公司
徐州晶辉	指	徐州晶辉新材料研究院有限公司
江苏晶泉	指	江苏晶泉新材料有限公司
合肥鲲鹏	指	合肥鲲鹏半导体材料有限公司
鄂尔多斯鲲鹏	指	鄂尔多斯市鲲鹏半导体材料有限公司
蒲城鲲鹏	指	蒲城鲲鹏液冷科技有限公司
宇隆企业管理	指	重庆宇隆企业管理有限公司
SUNSHINE	指	SUNSHINE INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED
河北捷盈	指	河北捷盈光电子器件有限公司
达广商务	指	北京达广商务发展有限公司
西安畅快	指	西安畅快货运代理有限公司
重庆勤励	指	勤励（重庆）货运代理有限公司
中金科元	指	重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
君联景诚	指	珠海君联景诚创业投资企业（有限合伙）
华祥智瑞	指	嘉兴华祥智瑞股权投资合伙企业（有限合伙）
青岛华控	指	青岛华控成长股权投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴华控	指	嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）”
赟汇股权投资	指	上海赟汇股权投资管理有限公司
两江承为股权基金	指	重庆两江新区承为私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
两江战新服务基金	指	重庆两江新区战新服务业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名“重庆两江新区战新服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”
两江渝地股权基金	指	重庆两江渝地股权投资基金合伙企业（有限合伙）
华昆创投	指	海南华昆创业投资合伙企业（有限合伙）
乾升秦瑞	指	苏州乾升秦瑞企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“济南乾升秦瑞企业管理合伙企业（有限合伙）”
鼎量弘益	指	青岛鼎量弘益贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
西高投凤石基金	指	宝鸡西高投凤石高技术产业投资基金（有限合伙）
西高投基石基金	指	西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）
潮江春涌	指	杭州潮江春涌企业管理合伙企业（有限合伙）
容安健康	指	深圳容安健康信息科技有限公司

鼎量广隆	指	苏州鼎量广隆创业投资合伙企业（有限合伙）
盒中滋味	指	盒中滋味网络科技（北京）有限公司
鼎量永益	指	济南鼎量永益投资合伙企业（有限合伙）
鸿鹄恒通	指	共青城鸿鹄恒通投资合伙企业（有限合伙）
荣新基金	指	重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
天祺投资	指	共青城天祺股权投资合伙企业（有限合伙）
赢能鼎秀	指	嘉兴赢能鼎秀股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金通四号	指	重庆金通四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
鼎祥投资	指	四川鼎祥股权投资基金有限公司
汇誉投资	指	西安汇誉投资基金合伙企业（有限合伙）
燕赵保险	指	燕赵财产保险股份有限公司
鑫享致联	指	淄博鑫享致联股权投资合伙企业（有限合伙）
量子实益	指	济南量子实益股权投资管理中心（有限合伙）
泓鑫投资	指	深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）
陕西新材料基金	指	陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙）
榕数投资	指	榕数投资（珠海）有限公司
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司，根据上下文也可指京东方科技集团股份有限公司及其子公司
TCL	指	TCL科技集团股份有限公司
联想	指	联想集团，根据上下文也可指联想集团及其子公司
戴尔	指	戴尔股份有限公司（Dell Technologies Inc.）
惠普	指	惠普公司（Hewlett-Packard Inc）
华硕	指	华硕电脑股份有限公司
三星	指	三星集团，根据上下文也可指三星集团及其子公司
LG	指	LG集团，根据上下文也可指LG集团及其子公司
小米	指	小米集团，根据上下文也可指小米集团及其子公司
华为	指	华为技术有限公司
荣耀	指	荣耀终端股份有限公司
OPPO	指	OPPO广东移动通信有限公司旗下品牌
VIVO	指	维沃移动通信有限公司旗下品牌
苹果	指	苹果公司（Apple Inc.）
微软	指	微软公司（Microsoft Corporation）
海尔	指	海尔集团公司
海信	指	海信集团有限公司

传音控股	指	深圳传音控股股份有限公司
索尼	指	索尼株式会社（Sony Corporation）
吉利	指	吉利汽车集团有限公司
蔚来	指	上海蔚来汽车有限公司
Acer	指	宏碁股份有限公司（Acer Incorporated）
和辉光电	指	上海和辉光电股份有限公司，根据上下文也可指上海和辉光电股份有限公司及其子公司
华星光电	指	武汉华星光电技术有限公司，根据上下文也可指武汉华星光电技术有限公司及其子公司
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司，根据上下文也可指维信诺科技股份有限公司及其子公司，以及其可施加重大影响的关联方
广州国显	指	广州国显科技有限公司
合肥维信诺	指	合肥维信诺科技有限公司
惠科股份	指	惠科股份有限公司
深天马	指	天马微电子股份有限公司
赛力斯	指	赛力斯集团股份有限公司，根据上下文也可指赛力斯集团股份有限公司及其子公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
翰博高新	指	翰博高新材料（合肥）股份有限公司，根据上下文也可指翰博高新材料（合肥）股份有限公司及其子公司
峻凌电子	指	峻凌有限公司，根据上下文也可指峻凌有限公司及其子公司
友达光电	指	友达光电股份有限公司
信利	指	信利光电股份有限公司
彩虹光电	指	彩虹显示器件股份有限公司
超视界	指	超视界显示技术有限公司
华佳彩	指	福建华佳彩有限公司
深圳思尼克	指	深圳市思尼克技术有限公司
大象株式会社	指	大象S.T株式会社及其下属公司，包括DAESANG S.T Co.,Ltd.和天津大象胶带有限公司
狄之娇	指	北京狄之娇贸易有限公司及其下属公司
SKC	指	SK microworks solutions Co., Ltd和迈克沃高科技材料（苏州）有限公司
广东弘擎	指	广东弘擎电子材料科技有限公司
珠海方正	指	珠海方正印刷电路板发展有限公司
奇普仕	指	奇普仕股份有限公司
苏州义铠轩	指	苏州义铠轩电子科技有限公司
博敏电子	指	博敏电子股份有限公司
盟讯科技	指	盟訊科技股份有限公司

奇景光电	指	奇景光电股份有限公司，Himax Technologies, Inc
3M	指	明尼苏达矿业及机器制造公司
金百泽	指	深圳市金百泽电子科技股份有限公司
深南电路	指	深南电路股份有限公司
光弘科技	指	惠州光弘科技股份有限公司
雅葆轩	指	芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
易德龙	指	苏州易德龙科技股份有限公司
一博科技	指	深圳市一博科技股份有限公司
鸿富瀚	指	深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
博硕科技	指	深圳市博硕科技股份有限公司
可川科技	指	苏州可川电子科技股份有限公司
达瑞电子	指	东莞市达瑞电子股份有限公司
重庆宇隆二期项目	指	本次募投项目中之“重庆宇隆光电生产基地二期扩产项目”
合肥宇隆生产基地项目	指	本次募投项目中之“OLED控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目”
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
商务部	指	中华人民共和国商务部
工信部	指	工业和信息化部
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市规则》	指	深圳证券交易所创业板股票上市规则
保荐人、主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
中伦律师、律师	指	北京市中伦律师事务所
天健会计师、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
众华评估师、评估师	指	上海众华资产评估有限公司
最近三年、报告期	指	2023年度、2024年度和2025年度
最近一年	指	2025年度
报告期末	指	2025年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业释义

PCBA	指	Printed Circuit Board Assembly 的缩写，即将各种电子元器件组装到印制电路板（PCB）上，并经过焊接和测试后形成的功能性电路组件
FPCA	指	Flexible Printed Circuit Assembly 的缩写，即将各种电子元器件组装到柔性电路板（FPC）上，并经过焊接和测试后形成的功能性电路组件
SMT	指	Surface Mounted Technology 的缩写，即表面组装技术（或表面贴装技术），是将SMC（贴片元件）粘贴到PCB（印制电路板）的制作过程，为混合集成电路技术发展而来的新一代主流电子装联技术；SMT技术利用工具在表面贴装印制板的焊盘上涂上粘贴剂或锡膏，然后再将SMC的引脚贴于焊盘上，最后采取回流焊等方式进行焊接，从而形成导通回路，实现电气连接
PCB	指	Printed Circuit Board的缩写，即印制电路板（或印制电路板、印刷线路板）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体
FPC	指	Flexible Printed Circuit的缩写，即柔性电路板，与PCB相比具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点
EMS	指	电子制造服务（Electronics Manufacturing Services），指电子产品品牌商将制造、采购、设计及物流等环节外包给专业厂商的商业模式
ODM	指	原始设计制造商（Original Design Manufacturing），指由采购方委托制造方承担从产品研发、设计、生产到后期维护的全流程服务
OEM	指	原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer），指品牌企业委托其他厂商生产商品并贴附自有商标的经营模式，又称代工生产、定牌制造
SMC	指	Surface Mount Component的缩写，即贴片元件（或表面组装元件），属于电子元器件
ERP	指	Enterprise Resource Planning的缩写，企业资源管理，是指建立在信息技术基础上整合企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统
PMC	指	Production Material Control的缩写，指对生产计划与生产进度的控制，以及对物料的计划、跟踪、收发、存储、使用等各方面的监督与管理和呆滞料的预防处理工作
DIP	指	Double In-Line Package的缩写，PCBA的一种，即双列直插式组装，SMT贴片一般贴装的是无引脚或短引线表面组装元器件，需要先在线路板上印刷锡膏，接着通过贴片机贴装，然后通过回流焊固定器件。而DIP焊接的是直插形式封装的器件，通过波峰焊或人工焊接固定器件
CRT、CRT显示器	指	Cathode Ray Tube的缩写，即阴极射线显像管（或阴极射线管），是一种被逐步被淘汰的显示技术，CRT显示器在主流市场已被轻薄、低功耗、低成本的液晶显示器（LCD）所取代
PDP	指	Plasma Display Panel的缩写，即等离子显示板，是一种利用气体放电的显示技术，已逐步被LCD取代退出主流市场
LCD、LCD屏/面板	指	Liquid Crystal Display的缩写，即液晶显示器，是利用电场改变液晶分子排列状态而调制外界背光源的一种非自发光型显示技术，是非自发光的主流显示技术，广泛运用于手机电视等电子产品；LCD屏/面板：即运用LCD技术的显示屏

TN、TN-LCD	指	Twisted Nematic的缩写，LCD的一种单色显示分支，TN-LCD即扭曲向列型液晶屏，主要特点为较为节能
STN-LCD	指	Super Twisted Nematic的缩写，LCD的一种单色显示分支，STN-LCD即超扭曲向列型液晶屏，是TN显示技术的进一步改进，加大了显示容量
CSTN-LCD	指	Color Super Twisted Nematic的缩写，LCD的一种彩色显示分支，CSTN-LCD即彩色超扭曲向列型液晶屏，是基于STN显示技术基础上研发出的彩色显示技术
TFT、TFT-LCD	指	Thin Film Transistor的缩写，LCD的一种彩色显示分支，TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器，相比CSTN-LCD具有对比度高、色彩丰富的优点，是目前市场上的主流LCD显示技术
DS、DS-LCD	指	动态散射型液晶显示器件，属于早期液晶显示技术的一种，是利用电导率各向异性产生的电流效应控制光的散射状态实现显示
a-Si	指	Amorphous Silicon，即非晶硅
Oxide	指	氧化物，在半导体显示产业有时作为金属氧化物半导体的简称
LTPS	指	Low Temperature Poly-Silicon，即低温多晶硅
LED、LED屏/面板	指	Light Emitting Diode的缩写，即发光二极管，是由多个发光二极管组成发光层，利用液晶层的分子偏转来显示出不同的图像的显示屏技术，广泛运用于室内外大尺寸屏幕；LED屏/面板：即运用LED技术的显示屏
OLED、OLED屏/面板	指	Organic Light-Emitting Diode的缩写，即有机发光二极管，OLED是在电场驱动下通过电子和空穴注入和复合而发光并实现显示的一种自发光型显示技术，是自发光的主流显示技术，广泛运用于手机等电子产品；OLED屏/面板：即运用OLED技术的显示屏
PMOLED	指	Passive Matrix Organic Light-Emitting Diode的缩写，OLED的一种分支，PMOLED即被动矩阵有机发光二极管技术，与AMOLED相比所需驱动电压更高
AMOLED	指	Active-matrix Organic Light-Emitting Diode的缩写，OLED的一种分支，AMOLED即主动矩阵有机发光二极管技术，与PMOLED相比所需驱动电压更低，为目前市场上的主流OLED显示技术
Mini LED	指	Mini Light Emitting Diode，即芯片尺寸介于50-200微米的发光二极管，其尺寸介于Micro LED和小间距LED之间。 Mini LED主要有LCD背光光源和RGB直接显示两种应用方向：Mini LED作为LCD的背光光源用途时，主要是从最初的普通LED背光改良为Mini LED背光，属于技术改良范畴。该技术路径目前主要在中高端显示领域对标OLED；Mini LED作为直接显示用途时，主要是进一步缩小LED屏的点间距和晶粒尺寸，常用于超大尺寸终端产品，属于技术革新范畴。
Micro LED	指	Micro Light Emitting Diode，即芯片尺寸小于50微米的微型发光二极管
AR/VR	指	Augmented Reality/Virtual Reality，增强现实指通过设备将计算机生成的虚拟信息实时叠加到真实环境中，虚拟现实指利用头显等设备完全隔绝现实，生成可交互的虚拟三维环境，提供沉浸式感官体验
AI	指	Artificial Intelligence，即研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学
PC	指	Personal Computer，即个人电脑，通常包括台式电脑、笔记本电脑等

5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信网络，是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术
IOT	指	Internet of Things的缩写，即物联网，是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能
EMS	指	Electronics Manufacturing Services的缩写，电子制造服务是为电子产品类客户提供包括产品设计、生产制造等系列服务，需要集合电子技术、供应链、工程工艺、生产管理和人力资源等，拥有较高的专业性。
IC	指	Integrated Circuit的缩写，即芯片，是现代电子设备的基本组成部分。通过特定工艺将晶体管、电阻、电容等元件集成于半导体晶片上，实现功能模块化
T-con IC	指	Timing Controller Integrated Circuit的缩写，时序控制器集成电路，用于控制显示屏的时序信号，将输入的视频信号转换为驱动液晶面板的行列驱动信号，确保图像按正确的时间和顺序显示
Power IC	指	Power Integrated Circuit的缩写，功率集成电路，主要负责电源管理和功率转换，如电压调节、电能分配、电机驱动等，常见于电源适配器、主板供电模块中
Gamma IC	指	Gamma Correction Integrated Circuit的缩写，伽马校正集成电路，用于调整显示屏的灰阶电压曲线，确保不同亮度等级的图像显示准确，避免色彩失真或亮度偏差
L/S IC	指	Line/Source Driver Integrated Circuit的缩写，行/源极驱动集成电路，作为显示屏的行（Line）或源极（Source）驱动芯片，控制像素单元的开关状态和信号传输
DDIC	指	Display Driver Integrated Circuit，显示驱动芯片，是控制液晶面板及AMOLED面板开关及显示方式的集成电路芯片
AOI	指	Automated Optical Inspection，自动光学检测，为运用机器视觉做为检测标准技术实现的高速高精度光学影像检测系统
IPC	指	即国际电工委员会（International Electrotechnical Commission）制定的一系列国际标准，旨在规范电子产品设计、制造和测试的各个方面
BGA	指	BGA(Ball Grid Array Package)是球栅阵列封装技术，通过底部锡球阵列替代传统引脚，应用于微处理器、通信芯片及消费电子产品的永久固定
SOP	指	SOP（Small Out-Line Package）是小外形封装技术，引脚分布在芯片的两侧，特点是结构紧凑、成本低廉、工艺成熟
QFP	指	QFP（Quad Flat Package）是方型扁平式封装技术，是一种四侧带海鸥翼型引脚的表贴集成电路封装形式
QFN	指	QFN（Quad Flat No-leads Package）是方形扁平无引脚封装技术，表面贴装型封装之一
CSP	指	CSP封装（Chip Scale Package），全称芯片级封装，是一种集成电路封装技术，其核心特点是封装后尺寸接近芯片裸片本身，通常不超过裸片面积的1.2倍
Hot Bar	指	脉冲加热回流焊接，是SMT工艺中的一种精密焊接技术，可以在精准的温度、压力与时间下实现牢固连接
Bonding	指	芯片封装工艺中的核心打线技术，通过金线或铝线将芯片内部电路与封装管脚、线路板连接，利用超声波振动使金属表面摩擦结合形成机械连接，后续采用黑胶或有机材料封装以增强保护

精密模切	指	根据客户产品设计要求，利用模切、贴合和分切设备，将一种或多种材料进行高精度组合、模切，形成预定规格零部件的工艺
光学膜材料	指	用于LCD显示模组、MiniLED显示模组中背光源的反射片、扩散片、复合棱镜、匀光膜等
导电屏蔽材料	指	一种确保电流在电子设备中只沿规定的导体路径传送的材料，防止发生静电积累及电路漏电、短路等问题，主要包括导电布、铝箔麦拉/胶带、铜箔麦拉/胶带、吸波材等
智能穿戴设备	指	应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称，如手表、手环、眼镜、服饰等
ITO	指	Indium Tin Oxide，氧化铟锡，通过真空磁控溅射镀膜工艺制备，可形成透明导电薄膜
SUS	指	是不锈钢的一种，用于金属封装材料，具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点，被广泛应用于各种领域
SCF	指	一种超薄、复原性强的垫片密封泡沫，可很好地贴合凹凸不平和弯曲的表面，消除间隙
DFM	指	Design for Manufacturability，可行性制造设计，指产品开发过程中整合设计需求与制造可行性的系统化方法，其核心目标是通过优化物理设计与制造系统的相互作用，降低开发周期与成本
BOM	指	Bill of Materials，物料清单，是描述企业产品组成的技术文件
PCB Layout	指	通过电磁仿真软件对PCB设计进行电磁特性分析和信号完整性验证的过程，主要用于评估高速信号传输、电源完整性、电磁兼容性等关键指标
VMI	指	Vendor Managed Inventory的缩写，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略
Buy and Sell模式	指	客户向原材料供应商购买部分主要物料后转卖给公司，公司向该客户下单采购并付款，公司通过自行购买其他主要物料及辅耗材料后组织生产活动，最终将包含上述自客户处购买物料价值的产成品定向销售给该客户。这一模式在电子产品制造行业较为普遍
光通信模块	指	由光电子器件、功能电路和光接口等组成，作用为光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号
Gamma	指	Gamma显示，是显示器或图像处理中用于调整亮度、对比度和色彩平衡的技术，核心参数为Gamma值，通常为2.2，用于校正人眼对亮度的非线性感知
三防漆	指	一种用于保护印刷电路板的特殊涂料，具备防潮、防盐雾功能，同时具有绝缘、耐高低温、抗震、耐化学品腐蚀等特性
HDR	指	High Dynamic Range的缩写，高动态范围，是用来实现比普通数字图像技术更大曝光动态范围（即更大的明暗差别）的一种技术
NTSC	指	即美国国家电视标准委员会（National Television Standards Committee，简称NTSC）制定的色域标准

注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、重大事项提示

（一）特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”全文，并特别提醒投资者注意下列风险：

1、半导体面板周期性波动导致公司未来业绩增速放缓或经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为69,760.95万元、109,535.20万元和113,715.36万元，较前一年变动比率分别为-6.81%、57.02%和3.82%，营业收入存在一定的波动。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78万元和13,329.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,401.12万元、11,584.29万元和12,927.80万元，较前一年变动比率分别为22.89%、80.97%和11.60%，公司经营业绩亦存在一定的波动。

半导体显示面板行业属于资本密集型产业，具有投资规模大、建设周期长、产能调整滞后等特征，行业整体呈现明显的周期性波动。该等周期性波动主要表现为面板价格的周期性涨跌、产能利用率的周期性变化及下游库存周期的交替运行。从历史周期看，面板行业经历了多轮显著的周期性波动。2020年至2021年，受居家需求激增及供应紧张影响，面板价格大幅上涨；2022年至2023年，前一轮显示面板行业景气周期主要受益于“宅经济”驱动下的远程办公、在线教育等需求，在此背景下，消费电子终端设备需求提前释放。2022 年起，消费电子需求出现阶段性透支；2023 年以来，韩国、日本及中国台湾面板厂商陆续推进面板减产或转型，行业经控产保价后逐步企稳；显示技术进步以及AI技术的发展持续拉动下游终端需求。

整体来看，面板行业产能投放具有滞后性，新增产能的集中投产可能在未来需求增长不及预期时加剧供需失衡，引发价格下行。目前，尽管我国半导体行业

的话语权增强、面板行业市场集中度提升、厂商动态规划“按需排产”成为新常态，显示面板行业周期性波动逐步减弱，但行业周期性特征依然存在。

若未来出现全球宏观经济衰退或区域性经济波动，进而导致终端消费需求收缩、国际贸易环境及关税政策发生重大不利变化、主要显示面板厂商产能策略调整或盲目扩张产能导致供需失衡、显示面板及相关零部件价格大幅下跌、原材料价格大幅上涨、显示面板行业景气度下降，或公司在市场竞争中未能保持在产品开发、产品交付、产品性能、核心技术、客户资源、供应链管理等优势，可能导致显示面板厂商对公司产品需求减少、公司产品销售收入不及预期、在客户体系中被竞争对手替代、市场份额下滑等不利情况，则公司存在业绩波动、放缓甚至下滑超过 50%的风险。

2、第一大客户京东方销售占比较高的风险

根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。报告期内，发行人来自京东方的主营业务收入占比分别为 79.10%、53.61%和 55.22%，**发行人对京东方构成重大依赖**。

目前，公司主要产品以新型半导体显示面板为核心应用领域且主要面对国内市场，而京东方系全球及国内出货量第一的半导体显示面板厂商。在京东方市场占有率较高的情况下，若公司无法维持与京东方的合作关系，同时又无法通过拓展其他客户来弥补京东方销售收入下降带来的影响，公司的经营业绩将受到较大影响。

京东方在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产交付能力、质量控制能力、产能规模等进行全面的考核和评估，其对显示用器件产品建立了严格的测试和验证程序。若未来公司无法在京东方同类供应商中持续保持优势，无法继续维持与其的合作关系，公司的经营业绩也将受到较大影响。

消费电子产品更新迭代周期较短，京东方等显示面板厂商需要及时推出新产品、新技术或使用新器件以匹配终端品牌厂商以及终端消费者的需求。基于此，在京东方等面板厂商的迭代升级中，会不断开展新技术、新工艺、新器件等测试

验证，并对其配套零部件产生持续迭代的客观需求。若公司不能及时跟进京东方的需求，或者短期内市场上出现了新技术、新器件而公司未能及时跟进，则公司与京东方之间的商业合作规模可能面临下降的风险，进而影响公司业绩。

3、主要产品价格下降的风险

半导体显示面板行业普遍存在“年降”情形。报告期内，公司与客户签订的协议中的部分存在相关条款，部分产品的销售价格也因此有所下降，进而导致公司主要产品整体价格存在一定波动；此外，下游消费电子行业需求变化以及自身产品结构变动，亦会对公司主要产品平均销售价格产生一定影响。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。报告期内，公司显示用智能控制卡业务平均销售价格为 2.86 元/片、5.08 元/片及 5.56 元/片，其中公司显示用智能控制卡产品平均销售价格为 47.49 元/片、68.63 元/片、50.49 元/片，显示用智能控制卡 PCBA 制造服务平均销售价格为 2.19 元/片、2.10 元/片、2.19 元/片；显示用精密功能器件产品平均销售价格为 0.58 元/片、0.61 元/片及 0.60 元/片，均存在一定波动。

若公司未来无法通过持续推出新产品平抑老产品价格下降的影响，或者未来出现下游半导体显示及终端消费电子行业需求受行业政策等因素影响而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化、主要产品竞争加剧等负面情形，公司主要产品价格可能面临下行风险，进而会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

4、原材料价格波动的风险

报告期内，直接材料占公司主营业务成本的比重分别为 53.04%、69.34%和 71.34%，是公司产品成本中的重要组成部分。公司显示用智能控制卡业务主要原材料包括 IC 芯片、电路板、无源器件，公司显示用精密功能器件产品主要原材料包括导电屏蔽材料、光学膜材料、保护膜材料、胶粘材料等，相关原料采购价格具有一定波动性。

因此，主要原材料的价格波动对公司主营业务成本和盈利水平具有一定影响。

若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

5、应收款项规模较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 29,100.45 万元、43,039.67 万元和 37,591.50 万元，占公司流动资产比例分别为 37.49%、47.81%和 41.16%，随着业务规模的扩大而呈现增长态势。公司目前应收款项回收情况良好，且主要客户均为国内知名的半导体显示面板厂商，其经营情况及商业信用良好。

若公司主要客户的经营情况及财务状况出现恶化，或商业信用发生重大不利变化，则可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

6、宏观经济波动的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司所处电子制造服务业属于电子信息产业，其景气程度与宏观经济发展状况息息相关。

目前，我国已成为全球半导体显示面板产业乃至整个电子信息制造业的主要生产基地之一，相关产业受全球经济环境变化的影响日趋明显，同时下游消费电子行业需求亦受宏观经济及行业周期的影响产生波动。若未来全球宏观经济出现滞胀甚至衰退，或者下游行业景气程度降低，则可能影响下游客户对公司产品的需求，或将导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

7、国际贸易摩擦的风险

近年来，我国电子制造业快速发展，目前已成为全球电子信息制造业的重要组成部分，我国主要半导体显示面板厂商、终端品牌厂商也随之积极融入并深刻影响电子信息产业的全球化竞争格局。

报告期内，公司境外销售均为深加工结转业务，不存在直接出口销售的情形，但公司主要产品最终应用为消费电子领域，终端用户为全球消费者，与全球贸易仍存在较为紧密的联系。因此，公司主要产品的需求在一定程度上也会受到各国

关税、进出口等贸易政策等因素的影响。若未来国际政治环境、贸易政策、关税壁垒等发生重大不利变化，或相关国家及地区与我国政治、外交、经济合作关系等发生重大不利变化，可能对公司产品需求、原材料采购等造成不利影响。

8、行业政策变化的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

2023 年以来，我国陆续出台了《关于恢复和扩大消费的措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《提振消费专项行动方案》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》等鼓励支持政策，促进了消费电子产业发展和半导体显示面板及配套零部件市场需求的增长。

2026 年 3 月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

若相关政策停止或相关政策的支持力度有所减弱，或将会影响发行人下游行业的景气程度，使得下游客户对公司的产品需求增长放缓甚至下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

9、市场竞争加剧的风险

近年来，我国半导体显示面板及消费电子行业稳步发展，并带动配套产业链得到长足的进步，逐步成为全球重要的电子信息产业生产制造基地。报告期内，随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术的升级进步，以及国内陆续出台“消费补贴”、“以旧换新”等鼓励支持政策，半导体显示面板及下游消费电子行业景气度逐步企稳回升，行业整体利润水平得到改善，而消费电子行业的良好发展也可能导致未来的行业竞争日益激烈。

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据

Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%。截至报告期末，公司主要产品产能利用率均已达到 85%以上，处于较高水平。

面对市场竞争不断加剧的局面，行业将可能呈现规模、技术、资金实力等方面的全方位竞争态势。若公司不能顺应市场与行业快速发展的趋势，并通过研发投入、产品创新等方式巩固或提高市场竞争力，或落后于同行业竞争对手，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，可能导致公司面临产品竞争力下降、产能利用率下降、新增产能无法得到消化风险，将会使得公司产品在市场竞争中处于不利地位，进而对公司市场份额、盈利能力造成不利影响。

10、近期存储芯片涨价可能导致公司产品终端需求下降的风险

发行人产品主要应用于显示器、笔记本电脑、电视、平板电脑等消费电子终端领域。消费电子终端产品的核心元器件之一为存储芯片，包括 DRAM、NAND Flash 等。2026 年以来，存储芯片市场价格呈现持续上涨态势。受上游晶圆代工产能紧张、AI 及高带宽存储（HBM）需求快速增长、原厂控产保价策略等因素影响，DRAM 及 NAND Flash 主流产品价格自 2025 年四季度起进入上行通道，至 2026 年上半年涨幅进一步扩大。存储芯片价格的上涨直接推高了电视、手机等终端产品的 BOM 成本，终端品牌厂商面临显著的成本压力。未来若存储芯片市场价格发生大幅波动，将通过供应链传导对终端产品的制造成本及终端消费需求产生影响，进而可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

与此同时，存储芯片涨价已逐步向终端零售价格传导，可能抑制消费电子终端需求释放。2026 年以来，部分主流消费电子品牌厂商已普遍上调新品终端售价以应对上游成本上涨。消费电子产品属于价格敏感型商品，终端价格的上涨将在一定程度上削弱消费者的换机及新增购买意愿，尤其在中低端产品及新兴市场领域，需求的价格弹性更为显著。若存储芯片价格持续高位运行或进一步上涨，终端消费需求可能受到抑制，下游终端产品出货量存在下滑风险。

11、募投项目新建产能无法得到充分消化的风险

公司本次募投项目合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目达产后，可年产智能控制卡产品近 15,000 万片、年产精密功能器件 30,360 万片，较目前公司

现有产能增加较多。

公司本次募投项目系基于公司生产经营实际业务的需要，且有较为广阔的下游市场空间，凭借公司深耕半导体显示行业多年积累的品牌基础、客户资源、技术储备，主要目的系进一步提升公司市场份额和客户产线的覆盖能力，以把握下游 AI 等新技术革命引领下的行业历史性机遇。若未来宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面发生不利变化，或公司未能有效开拓市场，则可能面临新增产能难以消化或募投项目规模化量产能力受限的风险，从而导致本次募投项目无法实现预计效益，并对公司的生产经营产生不利影响。

12、2026 年全年盈利预测无法实现的风险

公司编制了 2026 年度盈利预测报告，并经天健会计师审核，出具了 2026 年度盈利预测审核报告（天健审〔2026〕17399 号）。公司预测 2026 年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为 132,434.09 万元、14,014.65 万元和 14,126.57 万元，同比增长率分别为 16.46%、5.17%和 5.98%。

虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及国内外经济环境、市场变化等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2026 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。

（二）本次发行前滚存利润分配方案及利润分配政策

根据公司股东会决议，本次发行上市实施完成后，本次发行前滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东按各自的股权比例享有。

公司利润分配政策具体内容详见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“三、本次发行前后股利分配政策差异情况”。

（三）本次发行相关主体作出的重要承诺

1、关于业绩下滑情形相关承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆

号已承诺，若公司本次发行上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润出现下滑的情形，延长其届时所持股份锁定期限。

2、关于发行人在审期间不进行现金分红的承诺

公司已出具承诺，本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有；自公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之日至本次发行上市前，公司将不进行现金分红或提出新的现金分红方案。

除上述承诺外，公司及相关责任主体已按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，就股份锁定安排、持股意向及减持意向、稳定股价等事项及其他重要事项作出承诺并进行了信息披露。

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、高级管理人员及中介机构作出的重要承诺，详见本招股说明书“附件二 与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

（一）发行人基本情况			
发行人	重庆宇隆光电科技股份有限公司	成立日期	2014 年 3 月 6 日
注册资本	38,730.2537 万元	法定代表人	王亚龙
注册地址	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号	主要生产经营地址	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号
控股股东	王亚龙	实际控制人	王亚龙、李红燕
行业分类	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
（二）本次发行的有关中介机构			
保荐人	中信证券股份有限公司	主承销商	中信证券股份有限公司
发行人律师	北京市中伦律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构（如有）	上海众华资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		无	
（三）本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	收款银行	【●】

其他与本次发行有关的机构	无

三、本次发行概况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次拟公开发行人民币普通股不低于43,033,616股，且不超过129,100,845股；本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定	占发行后总股本比例	公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 10%且不高于 25%
其中：发行新股数量	发行新股数量不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845 股	占发行后总股本比例	发行新股数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%且不高于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不低于 430,336,153 股，不超过 516,403,382 股		
每股发行价格	【●】元		
发行市盈率	【●】倍（按每股发行价格除以每股收益计算，每股收益按照【●】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）		
发行前每股净资产	【●】元（按【●】年【●】月【●】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【●】元
发行后每股净资产	【●】元（按【●】年【●】月【●】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【●】元
发行市净率	【●】倍（按照每股发行价格除以发行后的每股净资产计算）		
预测净利润（如有）	无		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深交所认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深交所开立股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【●】万元		
募集资金净额	【●】万元		

募集资金投资项目	合肥宇隆生产基地项目
	重庆宇隆二期项目
	补充流动资金
发行费用概算	【●】万元
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）	【●】
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如有）	【●】
拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	不适用
（二）本次发行上市的重要日期	
刊登发行公告日期	【●】年【●】月【●】日
开始询价推介日期	【●】年【●】月【●】日
刊登定价公告日期	【●】年【●】月【●】日
申购日期和缴款日期	【●】年【●】月【●】日
股票上市日期	【●】年【●】月【●】日

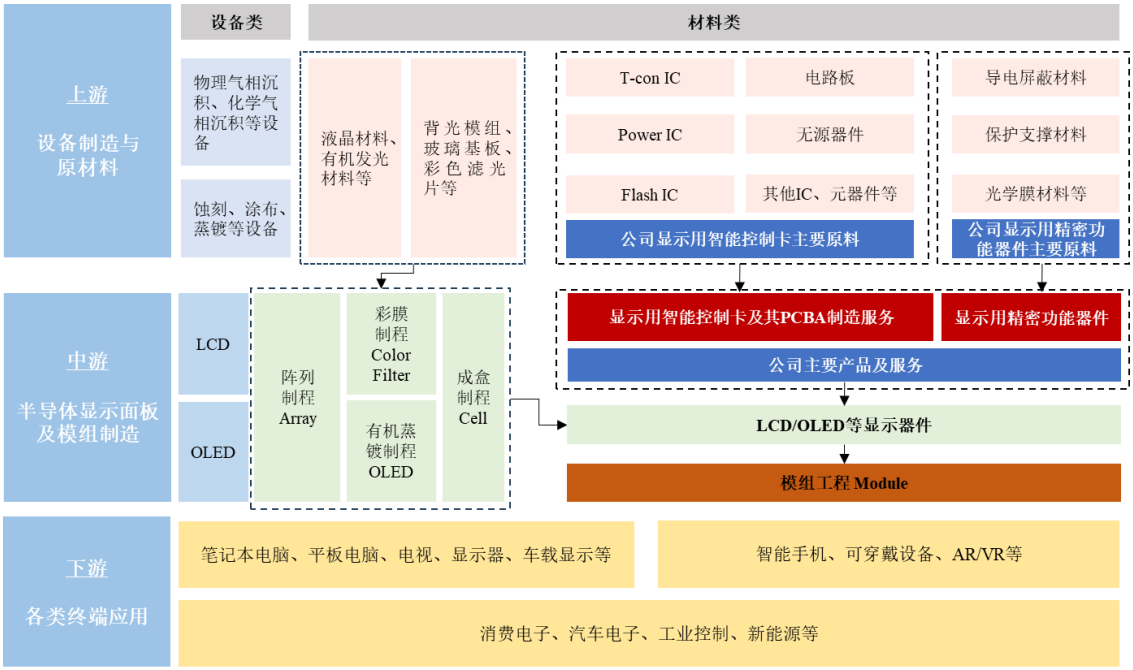
四、发行人主营业务经营情况

（一）主要业务、主要产品或服务及其用途

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

上述公司主要产品在半导体显示面板产业链中的应用及所处位置示意如下：



注：模组工程（Module）对于LCD或OLED显示面板存在一定差异。其中，LCD面板生产过程中，模组工程主要包括：切割、磨边、液晶盒进行偏贴、芯片（IC）绑定、涂胶、PCB板绑定、背光组装等工序，最终形成LCD显示模组；OLED面板生产过程中，模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定、盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	71,535.65	63.07	72,455.66	66.29	37,238.12	53.64
其中：1）显示用智能控制卡产品	45,310.20	39.95	43,828.49	40.10	9,205.19	13.26
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	26,225.45	23.12	28,627.16	26.19	28,032.93	40.38
显示用精密功能器件	39,364.99	34.71	34,618.54	31.67	30,790.97	44.36
其他	2,525.01	2.23	2,227.87	2.04	1,389.76	2.00
合计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

报告期内，公司显示用智能控制卡和显示用精密功能器件相关收入占主营业务收入的比例分别为 98.00%、97.96%和 97.77%，是公司主营业务收入的主要来源。

（二）主要原材料及重要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司显示用智能控制卡业务主要原材料为 IC 芯片、电路板和无源器件；公司显示用精密功能器件产品主要原材料包括导电屏蔽材料、光学膜材

料、保护膜材料、胶粘材料。

报告期内，公司主要原材料的采购金额及其占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IC 芯片	34,747.67	51.23	38,270.49	54.93	16,329.42	41.97
电路板	6,333.37	9.34	5,221.72	7.49	2,419.97	6.22
无源器件	4,514.23	6.66	4,047.24	5.81	2,429.35	6.24
导电屏蔽材料	10,233.12	15.09	9,525.69	13.67	7,283.19	18.72
光学膜材料	3,778.57	5.57	4,133.28	5.93	4,621.43	11.88
保护膜材料	3,347.00	4.93	3,790.95	5.44	2,978.95	7.66
胶粘材料	3,079.16	4.54	2,988.71	4.29	1,842.49	4.74
其他	1,796.60	2.65	1,697.07	2.44	1,005.26	2.58
总计	**67,829.73**	**100.00**	**69,675.15**	**100.00**	**38,910.06**	**100.00**

如上表所述，2023 年，半导体显示面板及消费电子行业景气度下行，公司主要原材料采购规模相对较低；2024 年以来，一方面，随着行业景气度逐步回暖，下游客户需求稳步提升；另一方面，公司自供料模式规模扩大，因此公司主要原材料采购规模显著增加。2025 年，公司主要原材料采购规模较 2024 年保持稳定。

2、报告期内公司前五名供应商情况

报告期内，公司对前五名供应商采购金额及其占公司总采购金额的比例如下：

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
2025 年度	深圳思尼克	16,063.02	22.24%	IC 芯片
	广州国显	5,617.87	7.78%	IC 芯片
	盟讯科技	4,356.64	6.03%	IC 芯片
	大象株式会社	3,762.85	5.21%	导电屏蔽材料
	博敏电子	3,319.26	4.59%	电路板
	合计	**33,119.64**	**45.85%**	-
2024 年度	深圳思尼克	15,787.44	21.33%	IC 芯片
	广州国显	5,569.27	7.52%	IC 芯片
	大象株式会社	3,410.15	4.61%	导电屏蔽材料

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
	奇景光电	3,407.57	4.60%	IC 芯片
	盟讯科技	3,095.25	4.18%	IC 芯片
	合计	**31,269.68**	**42.25%**	-
2023 年度	和辉光电	4,832.11	10.82%	IC 芯片
	华星光电	4,075.91	9.13%	IC 芯片、无源器件
	广州国显	3,386.34	7.59%	IC 芯片
	大象株式会社	2,028.54	4.54%	导电屏蔽材料
	狄之娇	1,611.82	3.61%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	合计	**15,934.72**	**35.70%**	-

注：大象株式会社包括：DAESANG S.T Co.,Ltd.和天津大象胶带有限公司。

报告期内，公司存在向和辉光电、华星光电、广州国显等客户采购 IC 芯片和无源器件等部分主要原材料的情形。上述向客户采购的原材料仅可用于生产交付该客户的产品，属于电子制造业行业常见的“Buy and Sell”[1]模式。

不考虑“Buy and Sell”模式下的相关采购，报告期内公司的前五名供应商采购金额及其占公司采购金额的比例如下：

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
2025 年度	深圳思尼克	16,063.02	24.46%	IC 芯片
	盟讯科技	4,356.64	6.63%	IC 芯片
	大象株式会社	3,762.85	5.73%	导电屏蔽材料
	博敏电子	3,319.26	5.05%	电路板
	狄之娇	2,736.16	4.17%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	合计	**30,237.93**	**46.05%**	-
2024 年度	深圳思尼克	15,787.44	24.52%	IC 芯片
	大象株式会社	3,410.15	5.30%	导电屏蔽材料
	奇景光电	3,407.57	5.29%	IC 芯片
	盟讯科技	3,095.25	4.81%	IC 芯片
	博敏电子	2,938.92	4.56%	电路板
	合计	**28,639.33**	**44.48%**	-

1、Buy and Sell 模式：即客户向原材料供应商购买部分主要物料后转卖给公司，公司向该客户下单采购并付款，公司通过自行购买其他主要物料及辅耗材料后组织生产活动，最终将包含上述自客户处购买物料价值的产成品定向销售给该客户。这一模式在电子产品制造行业较为普遍。

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
2023 年度	大象株式会社	2,028.54	6.30%	导电屏蔽材料
	狄之娇	1,611.82	5.01%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	SKC	1,379.68	4.29%	光学膜材料
	珠海方正	1,372.66	4.27%	电路板
	奇普仕	1,196.64	3.72%	IC 芯片
	合计	**7,589.34**	**23.59%**	-

注 1：大象株式会社包括：DAESANG S.T Co.,Ltd.和天津大象胶带有限公司；

注 2：SKC 包括：SK microworks solutions Co., Ltd 和迈克沃高科技材料（苏州）有限公司。

（三）主要生产模式

公司从事的生产环节主要为显示用智能控制卡以及显示用精密功能器件产品的生产制造。报告期内，公司遵循“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，结合客户提供的产品预测需求量以及自身的产能等情况安排生产。

报告期内，公司显示用智能控制卡及显示用精密功能器件存在客供料和自供料两种生产模式，具体如下：

（1）自供料模式：生产所需主要物料全部或部分由公司进行采购，包材等辅耗材亦由公司采购。生产完成后按自有产品对客户进行产品销售。该模式下，产品生产成本中除人工费用和制造费用外，还包含公司采购的主要原材料成本；

（2）客供料模式：生产所需主要物料均由客户提供，包材等辅耗材由公司采购。该等情形下，公司收取的客户提供的物料均明确用于客户的制造服务订单，公司单独设立客供仓保管客供料，并建立物料收发数量备查账，与公司自有的存货分开管理。该模式下，生产成本主要为人工费用和制造费用。

报告期内，公司主要产品按照客供料和自供料区分收入情况如下：

单位：万元、%

主要产品	业务模式	2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	自供料	45,310.20	63.34	43,828.49	60.49	9,205.19	24.72
	客供料	26,225.45	36.66	28,627.16	39.51	28,032.93	75.28
	总计	**71,535.65**	**100.00**	**72,455.66**	**100.00**	**37,238.12**	**100.00**
显示用	自供料	38,600.65	98.06	34,288.67	99.05	30,489.99	99.02

主要产品	业务模式	2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
精密功能器件	客供料	764.34	1.94	329.86	0.95	300.98	0.98
	总计	**39,364.99**	**100.00**	**34,618.54**	**100.00**	**30,790.97**	**100.00**

注：显示用智能控制卡业务可细分为显示用智能控制卡产品和显示用智能控制卡 PCBA 制造服务，与上表中的“自供料”和“客供料”业务模式相对应

如上表所述，报告期内，公司客供料模式主要为显示用智能控制卡 PCBA 制造服务，显示用精密功能器件仅存在少量客供料模式。

报告期内，公司主要采取自主生产的方式，但在订单交货时间较急且公司产能饱和的情况下，公司会将部分简单生产任务委托给外协供应商生产。报告期内，外协加工费用占营业成本的比例皆在 0.5%以下，占比较低。

（四）主要销售方式及重要客户

1、销售模式

公司的产品销售采取直销模式，即公司直接与最终客户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务。公司主要系通过主动市场开拓、现有客户介绍、参加行业论坛展会、行业资讯搜集等方式获取客户及业务资源，并通过商业谈判、招投标、询价等多元化方式获取订单。

报告期内，公司存在少量 VMI 销售模式。VMI 模式下，公司按客户要求将货物运送至客户指定的 VMI 仓库，客户根据实际需要领用公司产品。报告期内，公司 VMI 模式主要客户为半导体显示面板行业知名厂商深天马，符合行业惯例。

公司直销按照区域划分，具体可以分为内销、外销两种模式，内销是指公司直接向境内客户进行产品销售；公司外销业务均系深加工结转[2]（俗称“转厂出口”）业务。

2、重要客户情况

报告期内，公司前五大客户情况如下：

2、深加工结转：根据《海关对出口加工区监管的暂行办法》、《海关出口加工区货物出区深加工结转管理办法》等相关规定，深加工结转模式是一种间接出口的销售方式，指加工贸易企业将保税进口料件加工成成品或半成品后不直接出口，而是结转至另一加工贸易企业继续进行保税加工的经营活动。深加工结转货物受海关的监管，企业在办理货物的转厂手续时，需要货物转入和转出企业分别向各自主管海关办理货物转入申报和转出申报手续，而货物不需要离境，直接由国内的货物转出厂商发送到货物转入厂商

单位：万元

年度	客户名称	销售金额	占比	主要销售类别
2025 年度	京东方	62,628.32	55.22%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	30,025.15	26.47%	显示用智能控制卡
	深天马	10,552.21	9.30%	显示用智能控制卡
	广州国显	2,413.19	2.13%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,745.35	1.54%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	合计	**107,364.22**	**94.66%**	-
2024 年度	京东方	58,598.41	53.61%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	33,579.28	30.72%	显示用智能控制卡
	深天马	5,155.93	4.72%	显示用智能控制卡
	广州国显	3,125.58	2.86%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,686.11	1.54%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	合计	**102,145.31**	**93.45%**	-
2023 年度	京东方	54,910.59	79.10%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	6,210.44	8.95%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,673.83	2.41%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	广州国显	1,511.10	2.18%	显示用智能控制卡
	华星光电	1,143.79	1.65%	显示用智能控制卡
	合计	**65,449.76**	**94.28%**	-

注：以上受同一实际控制人控制的客户合并计算销售额，其中包括：

1、京东方合并口径包括京东方科技集团股份有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示照明有限公司等；

2、华星光电合并口径包括武汉华星光电技术有限公司、华显光电技术（惠州）有限公司；

3、惠科股份合并口径包括惠金（深圳）科技有限公司、绵阳惠科光电科技有限公司、重庆惠科金渝光电科技有限公司。

3、公司对京东方销售占比较高对公司持续经营能力不构成重大不利影响

根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。报告期内，发行人来自京东方的主营业务收入占比分别为 79.10%、53.61%和 55.22%，占比超过 50%，**发行人对京东方构成重大依赖**。

上述情形不会对公司未来持续经营能力构成重大不利影响，具体详见本招股

说明书之“第五节 业务和技术”之“三、公司销售情况及主要客户”之“（四）公司对京东方销售占比较高对公司持续经营能力不构成重大不利影响”相关内容。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局

公司所处行业为电子信息制造业，系现代化专业电子制造服务（EMS）的解决方案提供商。电子制造服务（EMS）包括为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试及售后服务等整体供应链解决方案，涉及通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域，下游市场应用广阔。

从竞争格局来看，EMS 行业呈现“市场规模庞大，龙头企业市场占有率高”的特点。根据 DIGITIMES 数据，2025 年排名全球前十的厂商营收占比超 70%，龙头企业具有良好的客户资源、丰富的行业经验、强大的供应链管理及竞价能力，为其构建了较高的竞争壁垒，如富士康、和硕、捷普、伟创力等。

近年来，随着新型显示技术、AI 人工智能、5G 通讯等领域的发展，以及地缘政治、国际贸易摩擦等因素使得消费电子和工业类产品的 EMS 业务存在向“专业化、区域化”发展的特点。与此同时，全球电子制造服务行业巨大的市场容量带来了显著的业务差异化需求，这也给国内优秀本土 EMS 厂商带来了业务发展机会。基于下游客户不同的定制化产品和业务需求，各 EMS 厂商逐渐拥有核心的下游客户群体和核心业务细分应用领域，并在直接客户、终端品牌等方面形成差异化的发展道路和竞争格局。

在过去二十年，全球半导体显示面板产业完成了由日韩转移至中国的产业链重构。随着全球消费电子产品整机制造厂在内地产能的快速扩张，国内企业逐渐凭借较低的成本、快速响应的优势、制造加工的业务模式从代工厂开始承接订单。随着行业发展，内资企业在生产技术、管理能力、产能规模等方面不断积累和提升，逐渐开始参与国际化的市场竞争，少数具有设计开发能力、大规模生产能力、高产品质量、差异化业务布局的企业逐步替代国外厂商成为下游主流终端品牌在上述环节的核心供应商，并与下游厂商建立了长期的合作关系。目前，全球范围

内的相关产能主要集中在我国大陆和我国台湾地区。

未来，随着全球电子信息制造业整体进一步向中国大陆地区转移及下游行业进入品牌发展时代，对于具有同步设计开发能力、产品性能高、具有大规模生产能力、良好的产品信誉、能够提供整体解决方案的国内企业，下游主流终端品牌对其的合作需求将会进一步提高，国产替代进口趋势仍将继续。

2、发行人主要产品的市场地位情况

公司主要产品广泛应用于国内龙头半导体显示面板厂商，最终在全球知名终端品牌商消费电子产品中广泛应用。

序号	主要产品名称	公司主要客户及其下游终端品牌	
		主要客户	主要客户下游终端品牌
1	显示用智能控制卡	京东方、和辉光电、深天马、广州国显、华星光电、惠科股份	苹果、华为、荣耀、联想、戴尔、惠普、华硕、小米等国内外知名品牌
2	显示用精密功能器件		

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。

五、发行人板块定位情况

（一）发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第二条、第三条相关要求

公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展，公司主营业务、核心技术、主要产品均属于现代化产业体系重要组成部分且具有创新性和可持续性，公司具有良好的成长性。发行人的创新、创造、创意性及其表征详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务及演变的情况”之“（十）公司关于符合创业板定位的具体说明”。

（二）发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条的相关要求

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条第二款的相关指标要求，具体情况如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于 5,000 万元	√是 □否 □不适用	2023-2025 年，公司研发费用合计 10,219.79 万元，高于 5,000 万元
最近三年营业收入复合增长率不低于 25%	□是 □否 √不适用	公司最近一年营业收入为 11.37 亿元，高于 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求

注：根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条规定，“最近一年营业收入金额达到 3 亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已在境外上市的红筹企业，不适用相关规定的营业收入复合增长率要求。”

（三）发行人符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条的相关要求

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条的规定：属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主要产品属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局颁布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司主营业务及主要产品属于“1.2 电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”之“显示器件制造”；根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属行业属于国家鼓励类产业中的“二十八、信息产业”之“8.显示屏元器件制造及生产专用设备”及“5.新型电子元器件制造”，符合国家产业政策。

公司产品与信息产业深度融合，符合国家产业政策，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原

则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业规定的行业。

六、发行人主要财务数据和财务指标

项目	2025 年度/2025.12.31	2024 年度/2024.12.31	2023 年度/2023.12.31
资产总额（万元）	151,342.95	148,913.58	126,002.57
归属于母公司所有者权益（万元）	115,458.72	101,590.09	89,208.40
资产负债率（合并）（%）	23.71	31.78	29.20
资产负债率（母公司）（%）	31.71	33.11	27.07
营业收入（万元）	113,715.36	109,535.20	69,760.95
净利润（万元）	13,325.36	12,059.78	7,572.08
归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,329.07	12,059.78	7,572.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,927.80	11,584.29	6,401.12
基本每股收益（元）	0.34	0.31	0.20
稀释每股收益（元）	0.34	0.31	0.20
加权平均净资产收益率（%）	12.28	12.64	8.89
经营活动产生的现金流量净额（万元）	25,378.94	8,724.06	14,873.65
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	3.29	3.19	4.29

七、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况

（一）财务报告审计截止日后经营情况

财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况稳定，主营业务、经营模式、持续盈利能力未发生重大不利变化。发行人的主要采购、技术研发、经营及销售等业务运转正常，主要客户、供应商未发生重大变化，不存在导致发行人业绩异常波动的重大不利因素，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2026 年 1-6 月经审阅财务数据及经营情况

公司招股说明书的财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日，天健会计师对公司 2026 年 1-6 月财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》（天健审〔2026〕17403 号），2026 年 1-6 月主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动率
资产总额	165,126.46	151,342.95	9.11%
负债总额	39,500.57	35,887.94	10.07%
归属于母公司所有者权益合计	123,585.56	115,458.72	7.04%
项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率
营业收入	65,556.59	59,743.74	9.73%
营业利润	8,799.59	8,036.08	9.50%
利润总额	8,804.52	8,025.91	9.70%
净利润	7,661.48	7,032.80	8.94%
归属于母公司所有者的净利润	7,717.44	7,032.80	9.73%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7,660.90	6,823.38	12.27%
经营活动现金流量净额	5,453.79	10,688.10	-48.97%

截至2026年6月末,公司资产总额为165,126.46万元,较上年末增长9.11%;负债总额为 39,500.57 万元，较上年末增长 10.07%；归属于母公司所有者权益合计为 123,585.56 万元，较上年末增长 7.04%，主要系公司主营业务经营情况良好，生产经营积累所致。总体而言，截至 2026 年 6 月末，公司资产负债结构稳定、资产状况良好，较 2025 年末未发生重大变化。

2026 年 1-6 月，公司营业收入为 65,556.59 万元，较上年同期增加 9.73%；归属于母公司所有者的净利润为 7,717.44 万元，较上年同期增加 9.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,660.90 万元，较上年同期增加 12.27%，主要原因系：一方面，公司充分发挥竞争优势，深化与主要客户的业务合作关系，持续开拓新增订单，带动主要产品销量稳步提升；另一方面，随着部分设备折旧年限到期，公司制造费用有所降低，产品毛利相应提升。

（三）2026 年 1-9 月经营业绩预计情况

基于目前的经营状况、市场环境及在手订单，公司对 2026 年 1-9 月经营业绩进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率
营业收入	93,500 至 99,600	88,958.76	5.10%至 11.96%

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率
归属于母公司所有者的净利润	11,100 至 12,000	10,891.86	1.91%至 10.17%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,800 至 11,600	10,591.86	1.97%至 9.52%

上述 2026 年 1-9 月预计经营业绩数据为初步测算结果，未经审计或审阅，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

（四）2026 年全年盈利预测情况

公司在 2025 年度经审计的财务报表及 2026 年 1-6 月未经审计的实际经营数据所反映的经营业绩基础上，以 2026 年 7-12 月经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，按照一贯采用的主要会计政策和会计估计，遵循谨慎性原则编制了 2026 年度盈利预测报告，天健会计师进行审核并出具了 2026 年度盈利预测审核报告（天健审〔2026〕17399 号）。

公司预测 2026 年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为 132,434.09 万元、14,014.65 万元和 14,126.57 万元，同比增长率分别为 16.46%、5.17%和 5.98%。具体信息参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、盈利预测”。

公司提示投资者注意：本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应关注已披露的盈利预测信息并谨慎使用。

八、发行人选择的具体上市标准

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条中所规定的具体上市标准包括：“发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：（一）最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元；（二）预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元；（三）预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元。”

根据天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕5466 号），公司 2024 年及 2025 年归属于母公司所有者的净利润分别为 12,059.78 万

元、13,329.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,584.29 万元、12,927.80 万元。因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款的上市标准，即“最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元”。

九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。

十、募集资金运用与未来发展规划

（一）募集资金运用

本次募集资金拟投资项目经第二届董事会第五次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过确定。本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资
1	合肥宇隆生产基地项目	96,850.28	45,000.00
2	重庆宇隆二期项目	53,571.44	25,000.00
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
总计		**180,421.72**	**100,000.00**

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金及自筹资金对上述项目进行前期投入，待募集资金到位，用募集资金置换预先已投入该项目的自有资金及自筹资金。如募集资金不能满足上述项目的需求，不足部分公司将以自有资金及自筹资金补充；如募集资金满足上述项目需求后尚有剩余，则剩余资金将用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。如募集资金超过上述项目的需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，履行法定程序后适当使用。

募集资金投资项目的详细情况请见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）公司发展战略规划

截至目前，公司通过在半导体显示领域的长期积累，沉淀了深厚的技术实力、丰富的行业经验和持续的创新能力。在此基础上，公司正将业务拓展至汽车电子、

光通信模块、协作机器人、低空经济等新兴产业，致力于打造多元化的产业生态，为客户提供全方位、跨领域的解决方案，推动公司持续高质量发展。

展望未来，公司将深刻贯彻执行国家对于战略新兴产业的发展纲要和政策指导，继续以“成为我国智能控制领域最有价值的企业”为目标，积极、深刻把握 AI 技术革命引领的行业历史性机遇。公司将秉承“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，坚持以人才、研发为基础和核心驱动力，以品质服务为根本，质量至上为原则，确保市场份额、产能和技术领先优势，不断吸引更多下游优质客户，继续保持高质量发展。

在新型半导体显示领域，公司将持续为客户提供设计研发、元器件选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、跟踪服务等一体化综合解决方案；同时，公司将积极开拓核心技术、产品在汽车电子、光通信模块、低空经济等多个领域的应用；此外，公司将组建协作机器人新业务体系，扩大丰富自身业务战略布局。

十一、其他对发行人有重大影响的事项

截至本招股说明书签署日，不存在其他对公司有重大影响的事项。

第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行及做出投资决定时，除本招股说明书已披露的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关的风险

（一）半导体面板周期性波动导致公司未来业绩增速放缓或经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为69,760.95万元、109,535.20万元和113,715.36万元，较前一年变动比率分别为-6.81%、57.02%和3.82%，营业收入存在一定的波动。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78万元和13,329.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,401.12万元、11,584.29万元和12,927.80万元，较前一年变动比率分别为22.89%、80.97%和11.60%，公司经营业绩亦存在一定的波动。

半导体显示面板行业属于资本密集型产业，具有投资规模大、建设周期长、产能调整滞后等特征，行业整体呈现明显的周期性波动。该等周期性波动主要表现为面板价格的周期性涨跌、产能利用率的周期性变化及下游库存周期的交替运行。从历史周期看，面板行业经历了多轮显著的周期性波动。2020年至2021年，受居家需求激增及供应紧张影响，面板价格大幅上涨；2022年至2023年，前一轮显示面板行业景气周期主要受益于“宅经济”驱动下的远程办公、在线教育等需求，在此背景下，消费电子终端设备需求提前释放。2022 年起，消费电子需求出现阶段性透支；2023 年以来，韩国、日本及中国台湾面板厂商陆续推进面板减产或转型，行业经控产保价后逐步企稳；显示技术进步以及 AI 技术的发展持续拉动下游终端需求。

整体来看，面板行业产能投放具有滞后性，新增产能的集中投产可能在未来需求增长不及预期时加剧供需失衡，引发价格下行。目前，尽管我国半导体行业的话语权增强、面板行业市场集中度提升、厂商动态规划“按需排产”成为新常态，显示面板行业周期性波动逐步减弱，但行业周期性特征依然存在。

若未来出现全球宏观经济衰退或区域性经济波动，进而导致终端消费需求收

缩、国际贸易环境及关税政策发生重大不利变化、主要显示面板厂商产能策略调整或盲目扩张产能导致供需失衡、显示面板及相关零部件价格大幅下跌、原材料价格大幅上涨、显示面板行业景气度下降，或公司在市场竞争中未能保持在产品开发、产品交付、产品性能、核心技术、客户资源、供应链管理等优势，可能导致显示面板厂商对公司产品需求减少、公司产品销售收入不及预期、在客户体系中被竞争对手替代、市场份额下滑等不利情况，则公司存在业绩波动、放缓甚至下滑超过 50%的风险。

（二）技术和产品创新迭代的风险

1、新产品开发滞后或无法匹配客户、市场需求的风险

产品和工艺技术升级是企业持续发展的重要支撑。公司所处行业下游为新型半导体显示面板及消费电子行业，终端应用更新换代周期较短，下游客户对关键零部件供应商的产品开发能力、工艺制造水平、量产交付能力、产品一致性等方面的要求不断提高。因此，公司需要根据消费电子行业前沿发展趋势和下游市场需求，不断对产品和技术工艺进行创新和改进，以保持对下游客户的持续、稳定供应。新产品开发完成后，最终可否量产还须经客户端的严格检测及认证。

为了在市场竞争中保持持续的竞争力，公司必须不断进行产品结构、工艺制程、性能表现、生产效率、服务内容等方面的创新和升级，持续加大在技术研发、人才培养等方面的投入，从而保持在市场竞争中的竞争优势。若公司存在对工艺技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对市场需求动态不能及时掌握，对技术路线和产品定位不能及时调整，或新技术、新产品不能得到客户认可等情况，公司或将无法持续获得客户订单，进而对公司经营业绩产生不利影响。

2、核心技术外泄和核心技术人才流失的风险

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的电子互联、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于知识产权保护不力、竞争对手采取不正当竞争手段、核心技术人员流失等原因导致公司的核心技术外泄，则会对公司的经营造成不利影响。

公司所处的半导体显示面板行业属于技术密集型行业。技术人才队伍是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发展动力的重要保障。公司深耕行业多年，在技术开发与生产经营的过程中已逐步建立了具备理论知识、实践经验的技术人才团队。虽然公司始终高度重视对核心技术及核心技术人才的保护，并形成了较为完善的人才培育计划和激励机制，但随着市场竞争加剧，如果公司未来无法保持或及时补充高水平技术人才，或者公司技术人员特别是核心技术人员出现重大流失，则可能对公司在研项目、技术工艺和产品创新等造成不利影响，同时也可能导致公司核心技术的外泄，从而对公司经营造成不利影响。

（三）第一大客户京东方销售占比较高的风险

根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。报告期内，发行人来自京东方的主营业务收入占比分别为 79.10%、53.61%和 55.22%，**发行人对京东方构成重大依赖**。

目前，公司主要产品以新型半导体显示面板为核心应用领域且主要面对国内市场，而京东方系全球及国内出货量第一的半导体显示面板厂商。在京东方市场占有率较高的情况下，若公司无法维持与京东方的合作关系，同时又无法通过拓展其他客户来弥补京东方销售收入下降带来的影响，公司的经营业绩将受到较大影响。

京东方在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产交付能力、质量控制能力、产能规模等进行全面的考核和评估，其对显示用器件产品建立了严格的测试和验证程序。若未来公司无法在京东方同类供应商中持续保持优势，无法继续维持与其的合作关系，公司的经营业绩也将受到较大影响。

消费电子产品更新迭代周期较短，京东方等显示面板厂商需要及时推出新产品、新技术或使用新器件以匹配终端品牌厂商以及终端消费者的需求。基于此，在京东方等面板厂商的迭代升级中，会不断开展新技术、新工艺、新器件等测试验证，并对其配套零部件产生持续迭代的客观需求。若公司不能及时跟进京东方的需求，或者短期内市场上出现了新技术、新器件而公司未能及时跟进，则公司

与京东方之间的商业合作规模可能面临下降的风险，进而影响公司业绩。

（四）主要产品价格下降的风险

半导体显示面板行业普遍存在“年降”情形。报告期内，公司与客户签订的协议中的部分存在相关条款，部分产品的销售价格也因此有所下降，进而导致公司主要产品整体价格存在一定波动；此外，下游消费电子行业需求变化以及自身产品结构变动，亦会对公司主要产品平均销售价格产生一定影响。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。报告期内，公司显示用智能控制卡业务平均销售价格为 2.86 元/片、5.08 元/片及 5.56 元/片，其中公司显示用智能控制卡产品平均销售价格为 47.49 元/片、68.63 元/片、50.49 元/片，显示用智能控制卡 PCBA 制造服务平均销售价格为 2.19 元/片、2.10 元/片、2.19 元/片；显示用精密功能器件产品平均销售价格为 0.58 元/片、0.61 元/片及 0.60 元/片，均存在一定波动。

若公司未来无法通过持续推出新产品平抑老产品价格下降的影响，或者未来出现下游半导体显示及终端消费电子行业需求受行业政策等因素影响而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化、主要产品竞争加剧等负面情形，公司主要产品价格可能面临下行风险，进而会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

（五）原材料价格波动的风险

报告期内，直接材料占公司主营业务成本的比重分别为 53.04%、69.34%和 71.34%，是公司产品成本中的重要组成部分。公司显示用智能控制卡业务主要原材料包括 IC 芯片、电路板、无源器件，公司显示用精密功能器件产品主要原材料包括导电屏蔽材料、光学膜材料、保护膜材料、胶粘材料等，相关原材料采购价格具有一定波动性。

因此，主要原材料的价格波动对公司主营业务成本和盈利水平具有一定影响。若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（六）财务风险

1、毛利率下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.01%、21.49%和 23.33%，其中显示用智能控制卡业务分别为 27.43%、19.10%、19.38%，2024 年以来保持稳定，而显示用精密功能器件业务分别为 17.59%、25.39%和 29.31%，呈现持续增长趋势。总体而言，公司主营业务毛利率受行业下游需求变化、产品价格变动、产品结构变动、原材料采购价格波动、生产规模效应等因素影响而出现了一定幅度的波动，进而对公司经营业绩产生了一定影响。

若未来出现下游半导体显示及消费电子行业需求受行业政策等因素影响而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形，则公司毛利率存在下降的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、应收款项规模较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 29,100.45 万元、43,039.67 万元和 37,591.50 万元，占公司流动资产比例分别为 37.49%、47.81%和 41.16%，随着业务规模的扩大而呈现增长态势。公司目前应收款项回收情况良好，且主要客户均为国内知名的半导体显示面板厂商，其经营情况及商业信用良好。

若公司主要客户的经营情况及财务状况出现恶化，或商业信用发生重大不利变化，则可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、存货减值的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,345.71 万元、7,149.16 万元和 7,790.86 万元，占流动资产的比例分别为 9.46%、7.94%和 8.53%。若未来公司主要原材料和产品的价格在短期内大幅下降，或因国家政策、市场供给、技术路线变化等因素的影响造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品无法正常销售，则可能造成相关存货的可变现净值低于账面价值，从而需要计提减值准备，并对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）关于与部分主要客户约定价格上限条款的风险

报告期内，发行人与部分客户签订的协议中约定了产品最优惠价格条款。鉴于公司主营产品属于“非标准、定制化”产品，不同客户对于同类型产品的功能、参数、规格型号等要求各不相同，公司因此不存在向不同客户销售相同产品的情形，公司销售予不同客户的产品本质上无法进行直接的价格比较。上述条款对公司现阶段客户开拓和经营业绩未造成重大不利影响。

若未来公司与相关客户签署的最优惠价格条款发生重大不利变化而导致公司主要产品价格出现大幅下降或因违反最优惠价格条款而进行赔偿，或将造成公司客户开拓受限等负面情形，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（八）产品质量风险

公司的下游客户主要系国内半导体显示面板龙头厂商，终端客户主要为消费电子品牌厂商，其均对合格供应商提供的产品有着严格的质量标准。报告期内，公司未发生重大产品质量事故或纠纷，若公司未来在产品质量控制方面出现问题，导致客户要求退货、索赔甚至终止合作，或将给公司带来经济和商业信誉等方面的损失，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（九）社保公积金补缴的风险

报告期内，公司存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情形，公司存在被追缴的风险。公司实际控制人针对该事项已作出承诺，具体内容参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、员工及社会保障情况”之“（二）员工社会保险及住房公积金缴纳情况”。

（十）内控风险

1、管理风险

报告期内，公司经营规模稳步增长，营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元及 113,715.36 万元；报告期内，公司资产总额分别为 126,002.57 万元、148,913.58 万元和 151,342.95 万元，整体亦呈稳步增长趋势。

报告期内，公司业务规模和资产规模的不断扩大对公司经营管理、人才建设、资源整合、产品研发、市场开拓以及内部控制等方面均提出了更高的要求。随着

业务的持续发展和募投项目的投建实施，公司业务和资产规模预计将进一步扩大。

若公司未能有效执行内部管理制度，管理水平无法匹配公司规模的持续扩张，组织架构和管理制度未能及时有效调整、升级，将可能引发相应的管理风险，可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

2、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王亚龙、李红燕夫妇。截至本招股说明书签署日，王亚龙、李红燕夫妇直接持有公司 59.31%股权，并通过宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号控制公司 14.86%股权，二人合计控制公司 74.16%股权。王亚龙目前担任公司的董事长，李红燕担任公司的副董事长。

王亚龙、李红燕夫妇作为公司的实际控制人，控制权较为集中。如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制，将对公司及公司中小股东的利益产生不利影响。

（十一）税收优惠及政府补助政策变化的风险

报告期内，公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠税率，适用 15%企业所得税税率等税收优惠，同时亦收到政府补助。若未来公司或上述子公司不能满足持续享受高新技术企业 15%所得税税率优惠的条件或者其他税收优惠政策，公司的综合税率将上升，进而可能给公司的利润水平带来不利影响。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,572.75 万元、785.71 万元和 658.45 万元，占当期利润总额的比例分别为 18.49%、5.72%和 4.35%。若国家相关补助政策发生变化或由于公司自身原因，致使公司不能持续获得政府补助，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

（十二）2026 年全年盈利预测无法实现的风险

公司编制了 2026 年度盈利预测报告，并经天健会计师审核，出具了 2026 年度盈利预测审核报告（天健审〔2026〕17399 号）。公司预测 2026 年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为 132,434.09 万元、14,014.65 万元和 14,126.57 万元，同比增长率分别为 16.46%、5.17%和 5.98%。

虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及国内外经济环境、市场变化等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2026 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。

二、与行业相关的风险

（一）宏观经济波动的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司所处电子制造服务业属于电子信息产业，其景气程度与宏观经济发展状况息息相关。

目前，我国已成为全球半导体显示面板产业乃至整个电子信息制造业的主要生产基地之一，相关产业受全球经济环境变化的影响日趋明显，同时下游消费电子行业需求亦受宏观经济及行业周期的影响产生波动。若未来全球宏观经济出现滞胀甚至衰退，或者下游行业景气程度降低，则可能影响下游客户对公司产品的需求，或将导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）国际贸易摩擦的风险

近年来，我国电子制造业快速发展，目前已成为全球电子信息制造业的重要组成部分，我国主要半导体显示面板厂商、终端品牌厂商也随之积极融入并深刻影响电子信息产业的全球化竞争格局。

报告期内，公司境外销售均为深加工结转业务，不存在直接出口销售的情形，但公司主要产品最终应用为消费电子领域，终端用户为全球消费者，与全球贸易仍存在较为紧密的联系。因此，公司主要产品的需求在一定程度上也会受到各国关税、进出口等贸易政策等因素的影响。若未来国际政治环境、贸易政策、关税壁垒等发生重大不利变化，或相关国家及地区与我国政治、外交、经济合作关系等发生重大不利变化，可能对公司产品需求、原材料采购等造成不利影响。

（三）行业政策变化的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

2023 年以来，我国陆续出台了《关于恢复和扩大消费的措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《提振消费专项行动方案》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》等鼓励支持政策，促进了消费电子产业发展和半导体显示面板及配套零部件市场需求的增长。

2026 年 3 月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

若相关政策停止或相关政策的支持力度有所减弱，或将会影响发行人下游行业的景气程度，使得下游客户对公司的产品需求增长放缓甚至下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（四）市场竞争加剧的风险

近年来，我国半导体显示面板及消费电子行业稳步发展，并带动配套产业链得到长足的进步，逐步成为全球重要的电子信息产业生产制造基地。报告期内，随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术的升级进步，以及国内陆续出台“消费补贴”、“以旧换新”等鼓励支持政策，半导体显示面板及下游消费电子行业景气度逐步企稳回升，行业整体利润水平得到改善，而消费电子行业的良好发展也可能导致未来的行业竞争日益激烈。

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%。截至报告期末，公司主要产品产能利用率均已达到 85%以上，处于较高水平。

面对市场竞争不断加剧的局面，行业将可能呈现规模、技术、资金实力等方面的全方位竞争态势。若公司不能顺应市场与行业快速发展的趋势，并通过研发投入、产品创新等方式巩固或提高市场竞争力，或落后于同行业竞争对手，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，可能导致公司面临产品竞争力下降、产能利用率下降、新增产能无法得到消化风险，将会使得公司产品在市场竞争中处于不利地位，进而对公司市场份额、盈利能力造成不利影响。

（五）近期存储芯片涨价可能导致公司产品终端需求下降的风险

发行人产品主要应用于显示器、笔记本电脑、电视、平板电脑等消费电子终端领域。消费电子终端产品的核心元器件之一为存储芯片，包括 DRAM、NAND Flash 等。2026 年以来，存储芯片市场价格呈现持续上涨态势。受上游晶圆代工产能紧张、AI 及高带宽存储（HBM）需求快速增长、原厂控产保价策略等因素影响，DRAM 及 NAND Flash 主流产品价格自 2025 年四季度起进入上行通道，至 2026 年上半年涨幅进一步扩大。存储芯片价格的上涨直接推高了电视、手机等终端产品的 BOM 成本，终端品牌厂商面临显著的成本压力。未来若存储芯片市场价格发生大幅波动，将通过供应链传导对终端产品的制造成本及终端消费需求产生影响，进而可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

与此同时，存储芯片涨价已逐步向终端零售价格传导，可能抑制消费电子终端需求释放。2026 年以来，部分主流消费电子品牌厂商已普遍上调新品终端售价以应对上游成本上涨。消费电子产品属于价格敏感型商品，终端价格的上涨将在一定程度上削弱消费者的换机及新增购买意愿，尤其在中低端产品及新兴市场领域，需求的价格弹性更为显著。若存储芯片价格持续高位运行或进一步上涨，终端消费需求可能受到抑制，下游终端产品出货量存在下滑风险。

三、其他风险

（一）募投项目实施后效益未能达到预期的风险

公司本次募集资金拟投向合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目以及补充流动资金项目。公司已结合客户需求、行业发展、市场环境等方面的因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究，并对募集资金投资项目的投资建设、经济效益、实施进度等方面进行了谨慎测算。

公司拟通过募集资金投资项目的实施，扩大经营规模、提升技术水平、增厚经营业绩，实现公司的长期发展规划。但募集资金投资项目的成功实施仍需市场环境、研发、运营管理等多方因素协同配合，前述因素的重大变化都可能导致募集资金投资项目不能如期完成或顺利实施，这将有可能导致项目成本增加、投产后无法实现预期收益等不利情况，进而对公司业绩带来不利影响。

（二）募投项目新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险

本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加。本次募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产、无形资产规模将有所增加，项目建成后预计公司将新增折旧摊销费用。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化，而同期新增的折旧摊销等成本大幅增加时，则公司存在短期内因新增资产折旧摊销对经营业绩增长产生不利影响的风险。

（三）募投项目新建产能无法得到充分消化的风险

公司本次募投项目合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目达产后，可年产智能控制卡产品近 15,000 万片、年产精密功能器件 30,360 万片，较目前公司现有产能增加较多。

公司本次募投项目系基于公司生产经营实际业务的需要，且有较为广阔的下游市场空间，凭借公司深耕半导体显示行业多年积累的品牌基础、客户资源、技术储备，主要目的系进一步提升公司市场份额和客户产线的覆盖能力，以把握下游 AI 等新技术革命引领下的行业历史性机遇。若未来宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面发生不利变化，或公司未能有效开拓市场，则可能面临新增产能难以消化或募投项目规模化量产能力受限的风险，从而导致本次募投项目无法实现预计效益，并对公司的生产经营产生不利影响。

（四）摊薄即期回报的风险

本次公开发行后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但募集资金投资项目产生效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的较短期间内，公司每股收益、每股净资产将会受股本增加而出现下降，公司也存在即期回报被摊薄的风险。

（五）发行失败的风险

本次发行的结果将受到市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对公司认可程度等多种内外部因素的影响。公司存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称：	重庆宇隆光电科技股份有限公司
英文名称：	Chongqing E-ong Optoelectronics Technology Co., Ltd.
注册资本：	38,730.2537 万元
法定代表人：	王亚龙
有限公司成立日期：	2014 年 3 月 6 日
整体变更为股份公司日期：	2021 年 1 月 29 日
住　　所：	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号
邮政编码：	400714
联系电话：	023-63170080
传　　真：	023-67285503
互联网址：	http://www.e-ong.com.cn
电子邮箱：	ir@e-ong.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门：	董事会办公室
信息披露和投资者关系负责人：	郭飞
信息披露和投资者关系相关联系方式	023-63170080

二、发行人设立情况及报告期内股本、股东变化情况

（一）发行人设立情况

公司的前身宇隆有限成立于 2014 年 3 月 6 日，后于 2021 年 1 月 29 日以整体变更的方式设立股份有限公司。

1、有限责任公司设立情况

发行人前身宇隆有限系由莱特光电、西安裕隆共同设立，注册资本为3,000.00万元。其中，莱特光电认缴出资 2,550.00 万元，西安裕隆认缴出资 450.00 万元。

2014 年 3 月 6 日，重庆市工商行政管理局两江新区分局向宇隆有限核发了注册号为“500905000464796”的《营业执照》。

宇隆有限设立时，股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	莱特光电	2,550.00	85.00%
2	西安裕隆	450.00	15.00%
合计		**3,000.00**	**100.00%**

注：莱特光电、西安裕隆未对宇隆有限实缴出资，后分别于 2014 年 4 月、2015 年 6 月无偿转让至自然人王亚龙、李红燕。根据上会会计师出具“上会师报字（2022）第 9670 号”《验资报告》，宇隆有限已收到王亚龙、李红燕缴纳的注册资本合计 3,000.00 万元，出资方式为货币出资。

2、股份有限公司设立情况

公司是由宇隆有限于 2021 年 1 月 29 日以整体变更方式设立。

2020 年 12 月 25 日，上会会计师出具《审计报告》（上会师报字（2020）第 9214 号），截至 2020 年 11 月 30 日，宇隆有限经审计的净资产值为 16,000.98 万元。

2020 年 12 月 27 日，众华评估师出具《重庆宇隆光电科技有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告》（沪众评报字（2020）第 0454 号），以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，宇隆有限的股东全部权益价值评估价值为 19,042.43 万元。

2021 年 1 月 4 日，宇隆有限召开股东会并作出决议，同意宇隆有限以经审计的截至 2020 年 11 月 30 日的净资产值 160,009,809.99 元折为股份有限公司的股本 45,879,641 股，每股面值为 1 元，余额计入股份有限公司资本公积。

2021 年 1 月 11 日，宇隆有限的全体股东作为发起人签署了《发起人协议》，约定将宇隆有限的组织形式由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

2021 年 1 月 19 日，宇隆科技召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于重庆宇隆光电科技股份有限公司设立情况的议案》等议案。同日，上会会计师出具了《验资报告》（上会师报字（2021）第 0047 号），公司的出资已经全部缴足。

2021 年 1 月 29 日，重庆市市场监督管理局向公司换发了《营业执照》。

本次整体变更完成后，宇隆科技的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	25,500,000	55.58%
2	李红燕	9,295,238	20.26%
3	宇隆企业管理	4,587,978	10.00%
4	殷鸿彬	2,338,758	5.10%
5	高军	1,594,591	3.48%
6	共青城瑞麟	1,500,000	3.27%
7	邓卫国	1,063,076	2.32%
合计		**45,879,641**	**100.00%**

（二）发行人自设立以来的注册资本、股本及股东变化概况

公司自设立以来，历次股权变动概况如下：


2014年3月
宇隆有限设立，注册资本3,000万元
莱特光电认缴出资2,550万元，西安裕隆认缴出资450万元
2021年1月
宇隆有限整体变更为股份有限公司，股本为4,587.96万元
宇隆有限整体变更为股份有限公司，以经审计的截至2020年11月30日的净资产值160,009,809.99元折为股份有限公司的股本45,879,641股，每股面值1元
2021年2月
宇隆光电第一次增资，增资至4,677.96万元
新增的90.00万元注册资本由共青城君成、共青城晓荷认缴
2021年3月
宇隆光电第二次增资，增资至5,208.13万元
新增的530.17万元注册资本由君联景诚、嘉兴华控、中金科元、两江战新服务基金、两江渝地股权基金、量子实益、泓鑫投资、陕西新材料基金、华昆创投、乾升秦瑞、郑锐认缴
2021年6月
宇隆光电第三次增资，增资至36,900.00万元
公司以5,208.13万股为基数，向公司在册全体股东每10股转增60.85股，总计转增31,691.87万股
2021年12月
宇隆光电第四次增资，增资至38,376.00万元
新增的1,476.00万注册资本由中金科元、燕赵保险、鑫享致联、青岛华控、鼎量永益认缴
2022年3月-6月
宇隆光电第一次股份转让
鼎祥投资、荣新基金、金通四号、西高投基石基金、西高投凤石基金、汇誉投资、盒中滋味、天祺投资、赢能鼎秀、鸿鹄恒通、张韵、李玲芳合计受让王亚龙持有的1,629.97万股股份
2022年6月
宇隆光电第五次增资，增资至38,730.25万元
新增的354.25万元注册资本由共青城高展认缴
2022年8月
宇隆光电第二次股权转让
张磊受让王亚龙持有的52.47万股股份
2023年12月
宇隆光电第三次股权转让
海南瑞麟肆号受让荣新基金、天祺投资、赢能鼎秀、金通四号和张韵合计持有的670.43万股
2024年11月
宇隆光电第四次股权转让
华祥智瑞受让海南瑞麟肆号持有的374.81万股股份
2025年1月
宇隆光电第五次股权转让
刘武受让海南瑞麟肆号持有的30.00万股股份
2025年2月
宇隆光电第六次股权转让
嵇亚明受让鼎祥投资持有的374.80万股股份
2025年3月
宇隆光电第七次股权转让
嵇文受让鑫享致联、燕赵保险、汇誉投资合计持有的445.12万股股份；鼎量弘益受让量子实益持有的157.33万股股份
2025年5月
宇隆光电第八次股权转让
潮江春涌受让海南瑞麟肆号持有的93.60万股股份；赟汇股权投资受让泓鑫投资持有的331.44万股股份；海南瑞麟肆号受让陕西新材料基金持有的276.20万股股份
2025年6月
宇隆光电第九次股权转让
鼎量广隆、榕数投资合计受让量子实益持有的174.11万股股份；两江承为股权基金受让中金科元持有的738.00万股股份

（三）发行人报告期内股本、股东变化情况

1、发行人报告期期初的股权结构

报告期期初，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	鼎祥投资	3,748,000	0.97%
11	青岛华控	3,690,000	0.95%
12	共青城高展	3,542,537	0.91%
13	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
14	量子实益	3,314,368	0.86%
15	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
16	共青城君成	3,188,283	0.82%
17	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
18	荣新基金	2,886,034	0.75%
19	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
20	金通四号	2,248,858	0.58%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
26	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
27	汇誉投资	1,499,239	0.39%
28	燕赵保险	1,476,000	0.38%
29	鑫享致联	1,476,000	0.38%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
30	郑锐	1,104,789	0.29%
31	盒中滋味	750,000	0.19%
32	天祺投资	749,619	0.19%
33	鼎量永益	738,000	0.19%
34	张磊	524,700	0.14%
35	赢能鼎秀	449,771	0.12%
36	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
37	张韵	370,000	0.10%
38	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

2、2023 年 12 月，宇隆科技报告期内第一次股份转让

2023 年 12 月，海南瑞麟肆号与荣新基金、天祺投资、赢能鼎秀、金通四号和张韵分别签署股份转让协议，荣新基金将其所持有的宇隆科技 288.60 万股股份作价4,238.27万元转让给海南瑞麟肆号；天祺投资将其所持有的宇隆科技74.96万股股份作价 1,104.20 万元转让给海南瑞麟肆号；赢能鼎秀将其所持有的宇隆科技 44.98 万股股份作价 653.80 万元转让给海南瑞麟肆号；金通四号将其所持有的宇隆科技 224.89 万股股份作价 3,319.31 万元转让给海南瑞麟肆号；张韵将其持有的宇隆科技 37.00 万股股份作价 546.15 万元转让给海南瑞麟肆号。2023 年 12 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
10	海南瑞麟肆号	6,704,282	1.73%
11	鼎祥投资	3,748,000	0.97%
12	青岛华控	3,690,000	0.95%
13	共青城高展	3,542,537	0.91%
14	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
15	量子实益	3,314,368	0.86%
16	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
17	共青城君成	3,188,283	0.82%
18	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
19	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
20	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
21	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
22	华昆创投	2,209,579	0.57%
23	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
24	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
25	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
26	汇誉投资	1,499,239	0.39%
27	燕赵保险	1,476,000	0.38%
28	鑫享致联	1,476,000	0.38%
29	郑锐	1,104,789	0.29%
30	盒中滋味	750,000	0.19%
31	鼎量永益	738,000	0.19%
32	张磊	524,700	0.14%
33	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
34	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

3、2024 年 11 月，宇隆科技报告期内第二次股份转让

2024 年 11 月，海南瑞麟肆号与华祥智瑞签署股份转让协议，海南瑞麟肆号将其所持有的宇隆科技 374.81 万股股份作价 5,000.00 万元转让给华祥智瑞。2024 年 11 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	华祥智瑞	3,748,097	0.97%
11	鼎祥投资	3,748,000	0.97%
12	青岛华控	3,690,000	0.95%
13	共青城高展	3,542,537	0.91%
14	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
15	量子实益	3,314,368	0.86%
16	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
17	共青城君成	3,188,283	0.82%
18	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
19	海南瑞麟肆号	2,956,185	0.76%
20	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
26	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
27	汇誉投资	1,499,239	0.39%
28	燕赵保险	1,476,000	0.38%
29	鑫享致联	1,476,000	0.38%
30	郑锐	1,104,789	0.29%
31	盒中滋味	750,000	0.19%
32	鼎量永益	738,000	0.19%
33	张磊	524,700	0.14%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
34	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
35	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

4、2025 年 1 月，宇隆科技报告期内第三次股份转让

2024 年 11 月，海南瑞麟肆号与刘武签署股份转让协议，海南瑞麟肆号将其所持有的宇隆科技 30.00 万股股份作价 400.20 万元转让给刘武。2025 年 1 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	华祥智瑞	3,748,097	0.97%
11	鼎祥投资	3,748,000	0.97%
12	青岛华控	3,690,000	0.95%
13	共青城高展	3,542,537	0.91%
14	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
15	量子实益	3,314,368	0.86%
16	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
17	共青城君成	3,188,283	0.82%
18	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
19	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
20	海南瑞麟肆号	2,656,185	0.69%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
26	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
27	汇誉投资	1,499,239	0.39%
28	燕赵保险	1,476,000	0.38%
29	鑫享致联	1,476,000	0.38%
30	郑锐	1,104,789	0.29%
31	盒中滋味	750,000	0.19%
32	鼎量永益	738,000	0.19%
33	张磊	524,700	0.14%
34	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
35	刘武	300,000	0.08%
36	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

5、2025 年 2 月，宇隆科技报告期内第四次股份转让

2025 年 1 月，鼎祥投资与嵇亚明签署了股份转让协议，鼎祥投资将其所持有的宇隆科技 374.80 万股股份作价 5,866.36 万元转让给嵇亚明。2025 年 2 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	华祥智瑞	3,748,097	0.97%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
11	嵇亚明	3,748,000	0.97%
12	青岛华控	3,690,000	0.95%
13	共青城高展	3,542,537	0.91%
14	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
15	量子实益	3,314,368	0.86%
16	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
17	共青城君成	3,188,283	0.82%
18	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
19	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
20	海南瑞麟肆号	2,656,185	0.69%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
26	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
27	汇誉投资	1,499,239	0.39%
28	燕赵保险	1,476,000	0.38%
29	鑫享致联	1,476,000	0.38%
30	郑锐	1,104,789	0.29%
31	盒中滋味	750,000	0.19%
32	鼎量永益	738,000	0.19%
33	张磊	524,700	0.14%
34	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
35	刘武	300,000	0.08%
36	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

6、2025 年 3 月，宇隆科技报告期内第五次股份转让

2025 年 2-3 月，鑫享致联、燕赵保险、汇誉投资与嵇文签署股份转让协议，鑫享致联、燕赵保险、汇誉投资将其各自持有的宇隆科技 147.60 万股、147.60 万股和 149.92 万股股份分别作价 2,354.34 万元、2,361.34 万元、2,350.00 万元转让给嵇文；量子实益与鼎量弘益签署股份转让协议，量子实益将其所持有的宇隆

科技 157.33 万股股份作价 1,727.90 万元转让给鼎量弘益。2025 年 3 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	嵇文	4,451,239	1.15%
11	华祥智瑞	3,748,097	0.97%
12	嵇亚明	3,748,000	0.97%
13	青岛华控	3,690,000	0.95%
14	共青城高展	3,542,537	0.91%
15	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
16	泓鑫投资	3,314,368	0.86%
17	共青城君成	3,188,283	0.82%
18	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
19	陕西新材料基金	2,761,974	0.71%
20	海南瑞麟肆号	2,656,185	0.69%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	量子实益	1,741,101	0.45%
25	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
26	鼎量弘益	1,573,267	0.41%
27	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
28	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
29	郑锐	1,104,789	0.29%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
30	盒中滋味	750,000	0.19%
31	鼎量永益	738,000	0.19%
32	张磊	524,700	0.14%
33	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
34	刘武	300,000	0.08%
35	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

7、2025 年 5 月，宇隆科技报告期内第六次股份转让

2025 年 4 月，海南瑞麟肆号与潮江春涌签署股份转让协议，将其所持有的宇隆科技 93.60 万股股份作价 1,390.00 万元转让给潮江春涌。

2025 年 5 月，泓鑫投资与赟汇股权投资签署股份转让协议，泓鑫投资将其所持有的宇隆科技 331.44 万股股份作价 3,694.40 万元转让给赟汇股权投资；陕西新材料基金与海南瑞麟肆号签署股份转让协议，陕西新材料基金将其所持有的宇隆科技 276.20 万股股份作价 3,835.12 万元转让给海南瑞麟肆号。

2025 年 5 月，上述股权转让完成。

本次转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	中金科元	11,799,165	3.05%
6	高军	11,297,792	2.92%
7	君联景诚	11,047,902	2.85%
8	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
9	邓卫国	7,531,970	1.94%
10	海南瑞麟肆号	4,482,132	1.16%
11	嵇文	4,451,239	1.15%
12	华祥智瑞	3,748,097	0.97%
13	嵇亚明	3,748,000	0.97%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
14	青岛华控	3,690,000	0.95%
15	共青城高展	3,542,537	0.91%
16	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
17	赟汇股权投资	3,314,368	0.86%
18	共青城君成	3,188,283	0.82%
19	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
20	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
21	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
22	华昆创投	2,209,579	0.57%
23	量子实益	1,741,101	0.45%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	鼎量弘益	1,573,267	0.41%
26	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
27	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
28	郑锐	1,104,789	0.29%
29	潮江春涌	936,027	0.24%
30	盒中滋味	750,000	0.19%
31	鼎量永益	738,000	0.19%
32	张磊	524,700	0.14%
33	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
34	刘武	300,000	0.08%
35	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

8、2025 年 6 月，宇隆科技报告期内第七次股份转让

2025 年 4 月、5 月，量子实益分别与榕数投资、鼎量广隆签署股份转让协议，量子实益将其所持有的宇隆科技 85.63 万股股份作价 950.00 万元转让给鼎量广隆，将 88.48 万股股份以 985.57 万元作价转让给榕数投资。

2025 年 6 月，中金科元与两江承为股权基金签署股份转让协议，将其所持有的宇隆科技 738.00 万股股份作价 12,106.67 万元转让给两江承为股权基金。

2025 年 6 月，上述股权转让完成。

本次股份转让完成后，宇隆科技的股权结构为：

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
1	王亚龙	163,844,945	42.30%
2	李红燕	65,857,433	17.00%
3	宇隆企业管理	32,506,156	8.39%
4	殷鸿彬	16,570,269	4.28%
5	高军	11,297,792	2.92%
6	君联景诚	11,047,902	2.85%
7	共青城瑞麟	10,627,608	2.74%
8	邓卫国	7,531,970	1.94%
9	两江承为股权基金	7,380,000	1.91%
10	海南瑞麟肆号	4,482,132	1.16%
11	嵇文	4,451,239	1.15%
12	中金科元	4,419,165	1.14%
13	华祥智瑞	3,748,097	0.97%
14	嵇亚明	3,748,000	0.97%
15	青岛华控	3,690,000	0.95%
16	共青城高展	3,542,537	0.91%
17	嘉兴华控	3,314,368	0.86%
18	赟汇股权投资	3,314,368	0.86%
19	共青城君成	3,188,283	0.82%
20	共青城晓荷	3,188,283	0.82%
21	两江战新服务基金	2,209,586	0.57%
22	两江渝地股权基金	2,209,579	0.57%
23	华昆创投	2,209,579	0.57%
24	乾升秦瑞	1,657,184	0.43%
25	鼎量弘益	1,573,267	0.41%
26	西高投凤石基金	1,499,239	0.39%
27	西高投基石基金	1,499,239	0.39%
28	郑锐	1,104,789	0.29%
29	潮江春涌	936,027	0.24%
30	榕数投资	884,801	0.23%
31	鼎量广隆	856,300	0.22%
32	盒中滋味	750,000	0.19%

序号	股东名称	股份数量（股）	持股比例
33	鼎量永益	738,000	0.19%
34	张磊	524,700	0.14%
35	鸿鹄恒通	374,800	0.10%
36	刘武	300,000	0.08%
37	李玲芳	224,900	0.06%
合计		**387,302,537**	**100.00%**

（四）发行人报告期内的重大资产重组情况

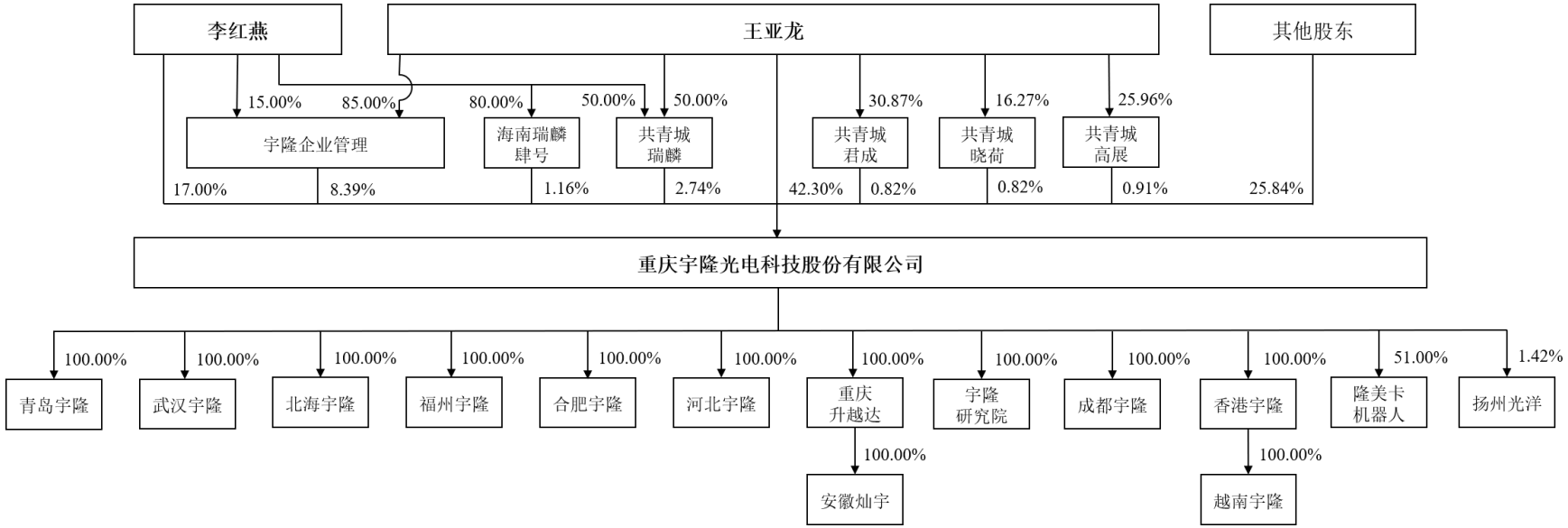
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

（五）发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况

截至本招股说明书签署日，公司未在其他证券市场上市或挂牌。

三、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下图所示：



四、发行人控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司控股子公司、参股公司情况如下：

序号	公司名称	注册地	主营业务	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	合肥宇隆	安徽省合肥市	显示用智能控制卡业务	12,000.00	12,000.00	100.00
2	福州宇隆	福建省福州市	显示用智能控制卡业务	5,000.00	5,000.00	100.00
3	武汉宇隆	湖北省武汉市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
4	青岛宇隆	山东省青岛市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
5	河北宇隆	河北省廊坊市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
6	成都宇隆	四川省成都市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
7	北海宇隆	广西壮族自治区北海市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
8	安徽灿宇	安徽省合肥市	显示用精密功能器件业务	3,000.00	3,000.00	100.00
9	重庆升越达	重庆市北碚区	显示用精密功能器件业务	3,000.00	3,000.00	100.00
10	宇隆研究院	重庆市北碚区	技术研发	500.00	500.00	100.00
11	隆美卡机器人	重庆市北碚区	拟开展机器人相关业务	4,285.71	4,285.71	51.00
12	香港宇隆	中国香港	海外业务持股平台	1.00 万美元	1.00 万美元	100.00
13	越南宇隆	越南北宁市	拟开展显示用智能控制卡等业务	521.46 亿越南盾[注]	-	100.00
14	扬州光洋	江苏省扬州市	柔性电路板、多层软硬结合电路板业务	70,300.00	70,300.00	1.42

注：越南宇隆注册资本 521.46 亿越南盾，折合等值 200 万美元。

（一）控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司合计拥有 13 家控股子公司，具体情况如下：

1、合肥宇隆光电科技有限公司

名称	合肥宇隆光电科技有限公司
成立时间	2016 年 12 月 16 日
注册资本	12,000.00 万元
实收资本	12,000.00 万元
注册地址	合肥市新站区玉皇山路与新蚌埠路交口 2 号合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
主要生产经营地	合肥市新站区玉皇山路与新蚌埠路交口 2 号合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙

主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	合肥及周边地区显示用智能控制卡业务

合肥宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	38,224.96
净资产	22,122.04
营业收入	13,453.44
净利润	2,728.52

2、福州宇隆光电科技有限公司

名称	福州宇隆光电科技有限公司
成立时间	2016 年 11 月 30 日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	5,000.00 万元
注册地址	福建省福州市福清融侨经济技术开发区斯泰克工业园 3#楼一二层
主要生产经营地	福建省福州市福清融侨经济技术开发区斯泰克工业园 3#楼一二层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	福州及周边地区显示用智能控制卡业务

福州宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	9,574.12
净资产	7,444.06
营业收入	3,091.12
净利润	413.78

3、武汉宇隆光电科技有限公司

名称	武汉宇隆光电科技有限公司
成立时间	2019 年 7 月 4 日
注册资本	3,000.00 万元

实收资本	3,000.00 万元
注册地址	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号
主要生产经营地	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	武汉及周边地区显示用智能控制卡业务

武汉宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,309.08
净资产	3,486.51
营业收入	3,040.38
净利润	125.72

4、青岛宇隆光电科技有限公司

名称	青岛宇隆光电科技有限公司
成立时间	2023 年 1 月 18 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	山东省青岛市黄岛区陡楼山路 777 号 1#车间户
主要生产经营地	山东省青岛市黄岛区陡楼山路 777 号 1#车间户
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	青岛及周边地区显示用智能控制卡业务

青岛宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,908.35
净资产	3,008.65
营业收入	1,998.73
净利润	86.39

5、河北宇隆光电科技有限公司

名称	河北宇隆光电科技有限公司
成立时间	2017 年 12 月 9 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号谊安工业园 A 栋 2 层
主要生产经营地	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号谊安工业园 A 栋 2 层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	河北及周边地区显示用智能控制卡业务

河北宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,591.82
净资产	4,390.10
营业收入	126.76
净利润	19.89

6、成都宇隆光电有限公司

名称	成都宇隆光电有限公司
成立时间	2023 年 11 月 6 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	成都高新区新创路 28 号 5 幢 2 楼 201 号
主要生产经营地	成都高新区新创路 28 号 5 幢 2 楼 201 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	成都及周边地区显示用智能控制卡业务

成都宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	6,562.20
净资产	2,938.51
营业收入	2,819.04
净利润	319.34

7、北海宇隆光电科技有限公司

名称	北海宇隆光电科技有限公司
成立时间	2022 年 3 月 9 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道 1 号广西惠科智能显示有限公司 A04 栋厂房西面一层
主要生产经营地	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道 1 号广西惠科智能显示有限公司 A04 栋厂房西面一层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	广西北海及周边地区显示用智能控制卡业务

北海宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	3,400.51
净资产	2,865.84
营业收入	1,367.85
净利润	-48.55

8、安徽灿宇光电科技有限公司

名称	安徽灿宇光电科技有限公司
成立时间	2012 年 12 月 7 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
主要生产经营地	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房

股东构成及控制情况	重庆升越达持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用精密功能器件业务
在发行人业务板块中定位	合肥及周边地区显示用精密功能器件业务

安徽灿宇最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	24,386.01
净资产	18,921.29
营业收入	24,272.78
净利润	6,412.33

9、重庆升越达光电科技有限公司

名称	重庆升越达光电科技有限公司
成立时间	2016 年 5 月 12 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72
主要生产经营地	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用精密功能器件业务
在发行人业务板块中定位	重庆及周边地区显示用精密功能器件业务

重庆升越达最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	21,818.01
净资产	9,113.73
营业收入	16,613.73
净利润	1,068.38

10、重庆宇隆电子技术研究院有限公司

名称	重庆宇隆电子技术研究院有限公司

成立时间	2020 年 4 月 28 日
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
注册地址	重庆市北碚区水善路 17 号
主要生产经营地	重庆市北碚区水善路 17 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	技术支持和研究开发
在发行人业务板块中定位	为主营业务、主要产品提供研发及技术支持

宇隆研究院最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	1,365.22
净资产	269.40
营业收入	964.00
净利润	344.02

11、重庆隆美卡智能机器人有限公司

名称	重庆隆美卡智能机器人有限公司
成立时间	2025 年 11 月 12 日
注册资本	4,285.7143 万元人民币
实收资本	4,285.7143 万元人民币
注册地址	重庆市北碚区水善路 17 号
主要生产经营地	重庆市北碚区水善路 17 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 51%，王亚龙持股 19%，纽禄美卡持股 30%
法定代表人	王亚龙
主营业务	截至 2026 年 6 月 30 日，仍处于前期筹建状态，尚未开展实际生产活动
在发行人业务板块中定位	拟开展机器人相关业务

隆美卡机器人最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	2,185.26
净资产	2,178.14

项目	2025 年末/2025 年度
营业收入	-
净利润	-7.57

12、香港宇隆科技有限公司

名称	香港宇隆科技有限公司
成立时间	2026 年 6 月 4 日
注册资本	1.00 万美元
实收资本	1.00 万美元
注册地址	RM 1602, 16/F Wing On CTR 111 Connaught RD, Central, Hong Kong
主要生产经营地	RM 1602, 16/F Wing On CTR 111 Connaught RD, Central, Hong Kong
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
主营业务	海外业务持股平台，截至 2026 年 6 月 30 日，仅持股越南宇隆
在发行人业务板块中定位	拓展海外业务的持股主体

香港宇隆于报告期后设立，作为发行人的海外业务持股平台，截至 2026 年 6 月 30 日，仅持股越南宇隆，最近一年无财务数据。

13、越南宇隆科技有限公司

名称（中文）	越南宇隆科技有限公司
名称（英文）	Vietnam E-ong Technology Company Limited
成立时间	2026 年 6 月 29 日
注册资本	521.46 亿越南盾
实收资本	-
注册地址	越南北宁省南山坊与方柳坊交界处的桂武工业园区（扩建区 O-1 地块）
主要生产经营地	越南北宁省南山坊与方柳坊交界处的桂武工业园区（扩建区 O-1 地块）
股东构成及控制情况	香港宇隆持股 100%
主营业务	截至 2026 年 6 月 30 日，仍处于前期筹建状态，尚未开展实际生产经营活动
在发行人业务板块中定位	越南及周边地区显示用智能控制卡等业务

越南宇隆于报告期后设立，尚未开展实际生产经营活动，最近一年无财务数据。

（二）参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家参股公司，简要情况如下：

名称	扬州光洋世一智能科技有限公司
成立时间	2021 年 1 月 25 日
注册资本	70,300.00 万元
股权结构	光洋股份持股比例为 86.77%；产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 7.11%；李树华持股比例为 1.64%；宇隆科技持股比例为 1.42%；常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 1.28%；张建钢持股比例为 0.50%；郑伟强持股比例为 0.50%；吴朝阳持股比例为 0.36%；陈大平持股比例为 0.28%；王军持股比例为 0.14%
控股方	光洋股份（002708.SZ）
公司出资金额	1,000.00 万元
公司持股比例	宇隆科技持股 1.42%
公司入股时间	2022 年 9 月
主营业务情况	主要从事柔性电路板、多层软硬结合电路板的研发、制造和销售

（三）报告期内注销或转让的子公司、参股公司

报告期内，发行人曾注销 1 家全资子公司西安宇隆，基本情况如下：

公司名称	西安宇隆光电科技有限公司
统一社会信用代码	91610131MA6UXF9P8G
法定代表人	王亚龙
成立时间	2018年6月1日
注册资本	3,000.00万元
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门D座1509室
主要生产经营地	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门D座1509室
注销时间	2023年3月8日
注销前股东构成	宇隆科技持股100%
经营范围	电子产品、半导体产品的研发、生产和销售;光学元器件、塑料制品、金属制品的加工及销售;货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

西安宇隆自设立至注销期间无实际经营业务，存续期间亦不存在违法违规行为，相关资产、债务、人员已经并入发行人，相关处置合法合规。

五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人的基本情况

1、控股股东、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，王亚龙直接持有公司 42.30%股权，为公司的控股股东；王亚龙、李红燕夫妇合计控制发行人 74.16%股权，为公司的实际控制人。报告期内，公司的控股股东、实际控制人均未发生变更。

王亚龙、李红燕夫妇直接持有公司 59.31%股权，并通过宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号控制公司 14.86%股权，二人合计控制公司 74.16%股权。

公司控股股东、实际控制人基本情况如下：

王亚龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证为 6103221971********。

李红燕，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证为 6102031974********。

2、控股股东、实际控制人所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。

（二）其他持有发行人 5%以上股份股东的情况

截至本招股说明书签署之日，其他持有发行人 5%以上股份的股东为宇隆企业管理，其基本情况如下：

企业名称	重庆宇隆企业管理有限公司
成立时间	2020 年 8 月 28 日
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
法定代表人	王亚龙
注册地址	重庆市北碚区水善路 17 号
主要生产经营地	重庆市北碚区水善路 17 号

股东构成	王亚龙持股 85%，李红燕持股 15%
主营业务及与发行人主营业务的关系	除股权投资并持有发行人股份外未从事其他生产经营活动，与发行人主营业务不相关

六、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本变化

本次发行前，公司总股本为 387,302,537 股，本次拟向社会公众发行不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845 股的新股；本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不低于本次发行后公司股份总数的 10%，且不超过本次发行后公司股份总数的 25%。

假设公开发行 129,100,845 股，本次发行前后，公司的股东持股情况如下：

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	比例	持股数（万股）	比例
1	王亚龙	16,384.49	42.30%	16,384.49	31.73%
2	李红燕	6,585.74	17.00%	6,585.74	12.75%
3	宇隆企业管理	3,250.62	8.39%	3,250.62	6.29%
4	殷鸿彬	1,657.03	4.28%	1,657.03	3.21%
5	高军	1,129.78	2.92%	1,129.78	2.19%
6	君联景诚	1,104.79	2.85%	1,104.79	2.14%
7	共青城瑞麟	1,062.76	2.74%	1,062.76	2.06%
8	邓卫国	753.20	1.94%	753.20	1.46%
9	两江承为股权基金	738.00	1.91%	738.00	1.43%
10	海南瑞麟肆号	448.21	1.16%	448.21	0.87%
11	嵇文	445.12	1.15%	445.12	0.86%
12	中金科元	441.92	1.14%	441.92	0.86%
13	华祥智瑞	374.81	0.97%	374.81	0.73%
14	嵇亚明	374.80	0.97%	374.80	0.73%
15	青岛华控	369.00	0.95%	369.00	0.71%
16	共青城高展	354.25	0.91%	354.25	0.69%
17	嘉兴华控	331.44	0.86%	331.44	0.64%
18	赟汇股权投资	331.44	0.86%	331.44	0.64%
19	共青城君成	318.83	0.82%	318.83	0.62%
20	共青城晓荷	318.83	0.82%	318.83	0.62%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数（万股）	比例	持股数（万股）	比例
21	两江战新服务基金	220.96	0.57%	220.96	0.43%
22	两江渝地股权基金	220.96	0.57%	220.96	0.43%
23	华昆创投	220.96	0.57%	220.96	0.43%
24	乾升秦瑞	165.72	0.43%	165.72	0.32%
25	鼎量弘益	157.33	0.41%	157.33	0.30%
26	西高投凤石基金	149.92	0.39%	149.92	0.29%
27	西高投基石基金	149.92	0.39%	149.92	0.29%
28	郑锐	110.48	0.29%	110.48	0.21%
29	潮江春涌	93.60	0.24%	93.60	0.18%
30	榕数投资	88.48	0.23%	88.48	0.17%
31	鼎量广隆	85.63	0.22%	85.63	0.17%
32	盒中滋味	75.00	0.19%	75.00	0.15%
33	鼎量永益	73.80	0.19%	73.80	0.14%
34	张磊	52.47	0.14%	52.47	0.10%
35	鸿鹄恒通	37.48	0.10%	37.48	0.07%
36	刘武	30.00	0.08%	30.00	0.06%
37	李玲芳	22.49	0.06%	22.49	0.04%
38	社会公众持股	-	-	12,910.08	25.00%
合计		**38,730.25**	**100.00%**	**51,640.33**	**100.00%**

（二）本次发行前的前十名股东

截至本招股说明书签署日，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	股份数（万股）	占发行前股本比例
1	王亚龙	16,384.49	42.30%
2	李红燕	6,585.74	17.00%
3	宇隆企业管理	3,250.62	8.39%
4	殷鸿彬	1,657.03	4.28%
5	高军	1,129.78	2.92%
6	君联景诚	1,104.79	2.85%
7	共青城瑞麟	1,062.76	2.74%
8	邓卫国	753.20	1.94%
9	两江承为股权基金	738.00	1.91%

序号	股东名称	股份数（万股）	占发行前股本比例
10	海南瑞麟肆号	448.21	1.16%
合计		**33,114.62**	**85.49%**

（三）前十名自然人股东及其担任发行人职务情况

截至本招股说明书签署日，公司直接持股的前十名自然人股东及其担任公司职务的情况如下：

序号	股东姓名	公司职务	持股数量（万股）	持股比例
1	王亚龙	董事长	16,384.49	42.30%
2	李红燕	副董事长	6,585.74	17.00%
3	殷鸿彬	董事、总经理	1,657.03	4.28%
4	高军	无任职	1,129.78	2.92%
5	邓卫国	重庆升越达副总经理	753.20	1.94%
6	嵇文	无任职	445.12	1.15%
7	嵇亚明	无任职	374.80	0.97%
8	郑锐	无任职	110.48	0.29%
9	张磊	无任职	52.47	0.14%
10	刘武	无任职	30.00	0.08%
合计			**27,523.11**	**71.06%**

（四）国有股份或外资股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在国有股东和外资股东。

（五）持有发行人股份的私募投资基金等金融产品及其纳入监管的情况

截至本招股说明书签署日，发行人共有 37 名股东，包括自然人股东 11 名，非自然人股东 26 名。其中，非自然人股东中有 13 名股东系《中华人民共和国证券投资基金法》（2015 年修正）、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，前述私募投资基金备案情况如下：

序号	股东名称	私募基金备案时间	私募基金备案编号	私募基金管理人名称	私募基金管理人登记编号
1	中金科元	2019.06.20	SGS684	中金资本运营有限公司	PT2600030375
2	君联景诚	2021.02.24	SNZ432	君联资本管理股份有限公司	P1000489

序号	股东名称	私募基金备案时间	私募基金备案编号	私募基金管理人名称	私募基金管理人登记编号
3	华祥智瑞	2024.11.12	SAED45	华岳（西安）私募基金管理有限公司	P1073471
4	青岛华控	2021.02.23	SNY470	霍尔果斯华控创业投资有限公司	P1025293
5	嘉兴华控	2016.02.17	S82832	霍尔果斯华控创业投资有限公司	P1025293
6	两江承为股权基金	2017.03.24	SS3453	重庆两江私募股权投资基金管理有限公司	P1009850
7	两江战新服务基金	2019.01.28	SES899	重庆两江私募股权投资基金管理有限公司	P1009850
8	两江渝地股权基金	2021.01.21	SNG957	重庆两江私募股权投资基金管理有限公司	P1009850
9	西高投基石基金	2019.06.04	SGP360	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	P1002877
10	西高投凤石基金	2021.10.18	SSS191	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	P1002877
11	鼎量弘益	2024.12.03	SARE53	成都鼎兴量子投资管理有限公司	P1005819
12	鼎量广隆	2025.04.23	SAXA16	成都鼎兴量子投资管理有限公司	P1005819
13	鼎量永益	2022.01.07	STL454	成都鼎兴量子投资管理有限公司	P1005819

除上述股东外，公司其他非自然人股东的情况具体如下：

序号	股东名称	是否属于私募基金	不属于私募投资基金的认定依据
1	宇隆企业管理	否	实际控制人控制的投资平台，仅持股宇隆科技
2	共青城瑞麟	否	实际控制人控制的投资平台，用于对外投资
3	海南瑞麟肆号	否	实际控制人控制的投资平台，仅持股宇隆科技
4	共青城高展	否	员工持股平台
5	共青城君成	否	员工持股平台
6	共青城晓荷	否	员工持股平台
7	赟汇股权投资	否	属于私募基金管理人，不属于私募投资基金，由陈鹏飞、鬲江慧持有 100%股权，非为专门投资发行人而设立的法人主体，以其自有资金投资，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形
8	乾升秦瑞	否	用于投资发行人的间接自然人股东持股平台，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形
9	潮江春涌	否	
10	榕数投资	否	
11	鸿鹄恒通	否	

序号	股东名称	是否属于私募基金	不属于私募投资基金的认定依据
12	华昆创投	否	由王敬良控制的公司，非为专门投资发行人而设立的主体，以其自有资金投资，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形
13	盒中滋味	否	由邱育敏控制的公司，非为专门投资发行人而设立的主体，以其自有资金投资，不涉及由私募投资基金管理人管理并进行有关投资活动，或者受托管理任何私募投资基金的情形，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形

如上表所述，上述股东均不存在募集行为，亦不存在委托其他私募基金管理人进行管理的行为，不属于需依据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》的规定履行备案程序的私募投资基金。

（六）申报前 12 个月内新增股东情况

申报前 12 个月，公司新增股东 9 名，分别为 6 名机构股东和 3 名自然人股东，上述股东取得股份的基本情况如下：

1、新增机构股东基本情况

（1）鼎量弘益

截至 2025 年 12 月 31 日，鼎量弘益基本情况如下：

企业名称	青岛鼎量弘益贰号创业投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	山东省青岛市市南区香港中路 12 号 B504-012
执行事务合伙人	成都鼎兴量子投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2023 年 5 月 15 日
经营期限	2023 年 5 月 15 日至 2043 年 5 月 14 日

截至 2025 年 12 月 31 日，鼎量弘益各合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	100.00	1.85%	普通合伙人
2	湖北宏泰创新投资有限公司	2,300.00	42.59%	有限合伙人

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
3	中金接续元亨（郑州）股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	18.52%	有限合伙人
4	深圳容安健康信息科技有限公司	1,000.00	18.52%	有限合伙人
5	四川振兴科创接力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	500.00	9.26%	有限合伙人
6	四川振兴产业技术研究院有限公司	500.00	9.26%	有限合伙人
合计		**5,400.00**	**100.00%**	——

（2）两江承为股权基金

截至 2025 年 12 月 31 日，两江承为股权基金基本情况如下：

企业名称	重庆两江新区承为私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址	重庆市江北区鱼嘴镇工农路 23 号
执行事务合伙人	重庆承运企业管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	许可项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
成立日期	2016 年 5 月 30 日
经营期限	2016 年 5 月 30 日至 2026 年 5 月 20 日

截至 2025 年 12 月 31 日，两江承为股权基金各合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
1	重庆承运企业管理有限公司	100.00	0.02%	普通合伙人
2	重庆两江新区产业发展集团有限公司	379,500.00	79.88%	有限合伙人
3	重庆两江新区开发投资集团有限公司	89,500.00	18.84%	有限合伙人
4	重庆两江金融发展有限公司	1,500.00	0.32%	有限合伙人
5	重庆悦来投资集团有限公司	1,500.00	0.32%	有限合伙人
6	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	1,500.00	0.32%	有限合伙人
7	重庆保税港区开发管理集团有限公司	1,500.00	0.32%	有限合伙人
合计		**475,100.00**	**100.00%**	——

（3）赟汇股权投资

截至 2025 年 12 月 31 日，赟汇股权投资基本情况如下：

企业名称	上海赟汇股权投资管理有限公司

注册地址	上海市黄浦区蒙自路 757 号 L5 层 505B 室
法定代表人	鬲江慧
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	5,000 万元
经营范围	股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期	2018 年 1 月 25 日
经营期限	2018 年 1 月 25 日至 2038 年 1 月 24 日

截至 2025 年 12 月 31 日，赟汇股权投资各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东姓名	认缴出资额	出资比例
1	陈鹏飞	2,750.00	55.00%
2	鬲江慧	2,250.00	45.00%
合计		**5,000.00**	**100.00%**

（4）潮江春涌

截至 2025 年 12 月 31 日，潮江春涌基本情况如下：

企业名称	杭州潮江春涌企业管理合伙企业（有限合伙）
注册地址	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路 426 号岩大房文苑大厦 20 楼 204585 室
执行事务合伙人	周锦航
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成立日期	2025 年 4 月 1 日
经营期限	2025 年 4 月 1 日至 9999 年 09 月 09 日

截至 2025 年 12 月 31 日，潮江春涌各合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
1	周锦航	1.00	0.07%	普通合伙人
2	黄继成	1,200.00	85.65%	有限合伙人

序号	合伙人姓名	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
3	刘君峰	100.00	7.14%	有限合伙人
4	陈红霞	100.00	7.14%	有限合伙人
合计		**1,401.00**	**100.00%**	-

（5）榕数投资

截至 2025 年 12 月 31 日，榕数投资基本情况如下：

企业名称	榕数投资（珠海）有限公司
注册地址	珠海市横琴上村 68 号第五层
法定代表人	刘振山
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	100 万元
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2024 年 11 月 08 日
经营期限	2024 年 11 月 08 日至无固定期限

截至 2025 年 12 月 31 日，榕数投资各股东出资情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
1	刘振山	99.00	99.00%
2	刘爱萍	1.00	1.00%
合计		**100.00**	**100.00%**

（6）鼎量广隆

截至 2025 年 12 月 31 日，鼎量广隆基本情况如下：

企业名称	苏州鼎量广隆创业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	苏州高新区马墩路 18 号 1 幢 1246 室
执行事务合伙人	成都鼎兴量子投资管理有限公司
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期	2025 年 2 月 7 日
经营期限	2025 年 2 月 7 日至 2045 年 2 月 6 日

截至 2025 年 12 月 31 日，鼎量广隆各合伙人出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资比例	合伙人类型
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	100.00	3.75%	普通合伙人
2	广安小平故里发展基金中心（有限合伙）	2,570.00	96.25%	有限合伙人
合计		**2,670.00**	**100.00%**	——

2、新增自然人股东

申报前十二个月，公司新增自然人股东的基本情况如下：

序号	姓名	性别	身份证号码	身份证住址
1	嵇文	男	32038119820215****	江苏省新沂市新安镇****
2	嵇亚明	男	32038119870627****	江苏省新沂市新安镇****
3	刘武	男	42900619871121****	北京市朝阳区****

3、入股原因、价格及定价依据

申报前十二个月，公司新增股东的入股原因、入股价格及定价依据如下：

序号	时间	股东名称	入股方式	入股原因	入股价格（元/股）	定价依据
1	2025.1	刘武	受让海南瑞麟肆号持有的 300,000 股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	13.34	转让双方参考临近期间市场化外部融资价格协商定价
2	2025.2	嵇亚明	受让鼎祥投资持有的 3,748,000 股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	15.65	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
3	2025.3	嵇文	受让鑫享致联持有的 1,476,000 股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	15.95	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
			受让汇誉投资持有的 1,499,239 股发行人股份		15.67	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
			受让燕赵保险持有的 1,476,000 股发行人股份		16.00	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
4	2025.3	鼎量弘益	受让量子实益持有的 1,573,267 股发行人股份	同一基金管理人的内部投资调整	10.98	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
5	2025.5	赟汇股权投资	受让泓鑫投资持有的 3,314,368 股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	11.15	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
6	2025.5	潮江春涌	受让海南瑞麟肆号持有的 936,027 股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	14.85	基于公司经营现状、发展前景等因素协商定价

序号	时间	股东名称	入股方式	入股原因	入股价格（元/股）	定价依据
7	2025.6	榕数投资	受让量子实益持有的884,801股发行人股份	外部投资者看好公司未来发展，决定投资公司	11.14	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
8	2025.6	鼎量广隆	受让量子实益持有的856,300股发行人股份	同一基金管理人的内部投资调整	11.09	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价
9	2025.6	两江承为股权基金	受让中金科元持有的7,380,000股发行人股份	基金内部投资调整，原股东转让至上层出资人直接持有	16.40	按转让方原投资成本考虑对应的投资收益等定价

注：表中第2、3、5、9项的新增股东，其入股价格系参考转让方投资成本并考虑对应的投资收益等确定。其中，投资成本由受让方承担，而投资成本对应的投资收益（投资收益=投资成本*投资年限*利息收益率）由实际控制人承担。

4、新增股东的关联关系、股份代持情况

（1）新增股东与发行人其他股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员关联关系情况

申报前十二个月，发行人新增股东与发行人其他股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员存在的主要关联关系如下：

1）嵇文与嵇亚明系兄弟关系，具有一致行动关系，二者合计持有发行人2.12%的股份；

2）鼎量弘益、鼎量广隆与鼎量永益的执行事务合伙人、私募基金管理人均为成都鼎兴量子投资管理有限公司，具有一致行动关系，三者合计持有发行人0.82%的股份；

3）两江承为股权基金与两江战新服务基金的执行事务合伙人均为重庆承运企业管理有限公司；两江承为股权基金、两江战新服务基金及两江渝地股权基金的私募基金管理人均为重庆两江私募股权投资基金管理有限公司，三者具有一致行动关系，合计持有发行人3.05%的股份。

除上述情形外，发行人申报前十二个月新增股东与发行人其他股东、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在关联关系。

（2）新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员关联关系情况

发行人申报前十二个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。

（3）新增股东股份代持情况

发行人申报前十二个月新增股东不存在股份代持情形。

（七）本次发行前各股东间关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例

本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例情况如下：

1、王亚龙与李红燕系夫妻关系；宇隆企业管理、共青城瑞麟系王亚龙、李红燕合计持股 100%的企业；海南瑞麟肆号系李红燕、王书豪（系王亚龙、李红燕之子）合计持股 100%的企业；共青城君成、共青城晓荷、共青城高展系王亚龙控制的企业；宇隆企业管理、共青城瑞麟、海南瑞麟肆号、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展均系王亚龙、李红燕的一致行动人，王亚龙、李红燕及其一致行动人合计持有发行人 74.16%的股份。

2、嵇文与嵇亚明系兄弟关系，具有一致行动关系，二者合计持有发行人 2.12%的股份。

3、青岛华控与嘉兴华控的执行事务合伙人、私募基金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司，具有一致行动关系，二者合计持有发行人 1.81%的股份。

4、两江承为股权基金与两江战新服务基金的执行事务合伙人均为重庆承运企业管理有限公司；两江承为股权基金、两江战新服务基金及两江渝地股权基金的私募基金管理人均为重庆两江私募股权投资基金管理有限公司，三者具有一致行动关系，合计持有发行人 3.05%的股份。

5、西高投基石基金与西高投凤石基金的执行事务合伙人、私募基金管理人均为西安高新技术产业风险投资有限责任公司，具有一致行动关系，二者合计持有发行人 0.77%的股份。

6、鼎量弘益、鼎量广隆与鼎量永益的执行事务合伙人、私募基金管理人均为成都鼎兴量子投资管理有限公司，具有一致行动关系，三者合计持有发行人 0.82%的股份。

（八）发行人股东公开发售股份的情况

本次发行不涉及发行人股东公开发售股份的情况。

七、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

八、发行人协议控制架构

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

九、控股股东、实际控制人合规情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况

（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况

1、董事

截至本招股说明书签署日，公司现任董事的基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	王亚龙	董事长	董事会	2024年1月-2027年1月
2	李红燕	副董事长	董事会	2024年1月-2027年1月
3	殷鸿彬	董事、总经理	董事会	2024年1月-2027年1月
4	徐建伟	董事、副总经理	董事会	2024年1月-2027年1月
5	王剑涛	董事、副总经理	董事会	2024年1月-2027年1月
6	郑翔龙	职工董事	职工代表大会	2025年8月-2027年1月
7	崔斌	独立董事	董事会	2024年1月-2027年1月
8	程茂勇	独立董事	董事会	2025年5月-2027年1月
9	张方晖	独立董事	董事会	2024年1月-2027年1月

公司现任董事简历如下：

王亚龙，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 7 月至 2001 年 6 月历任咸阳偏转集团公司国际贸易部客户经理、部

门经理；2001 年 7 月至 2004 年 7 月任陕西同辉国际贸易有限公司总经理；2004 年 8 月至 2005 年 3 月任西安鸿瑞光显部品有限公司总经理；2005 年 4 月至 2008 年 12 月任陕西虹瑞贸易有限公司总经理；2008 年 12 月至 2011 年 12 月任陕西捷盈电子科技有限公司总经理；2012 年 1 月至 2014 年 8 月任陕西莱特光电科技有限公司总经理；2014 年 8 月至今任莱特光电董事长、总经理。2014 年 3 月至 2015 年 6 月任宇隆科技董事长、总经理；2015 年 6 月至今，任宇隆科技董事长。

李红燕，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 7 月至 2000 年 12 月任咸阳偏转集团公司销售部客户经理；2001 年 1 月至 2005 年 12 月任咸阳偏转股份有限公司海外业务部大客户经理；2006 年 1 月至 2008 年 8 月任咸阳偏转集团公司人事部人事经理；2008 年 8 月至 2010 年 3 月任兴业银行股份有限公司咸阳支行大客户经理；2010 年 3 月至 2014 年 12 月任西安裕隆人事部人事经理；2015 年 3 月至 2023 年 11 月，历任莱特光电董事、人事经理、投资总监、总经理助理、副董事长；2023 年 11 月至今，任莱特光电副总经理、副董事长；2014 年 3 月至 2022 年 11 月，任宇隆科技董事；2022 年 11 月至今，任宇隆科技副董事长。

殷鸿彬，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 8 月至 1999 年 7 月任咸阳偏转集团公司科员；1999 年 7 月至 2005 年 5 月历任陕西同辉国际贸易有限公司科员、经理；2005 年 7 月至 2009 年 3 月历任陕西虹瑞贸易有限公司经理、副总经理；2009 年 3 月至 2015 年 5 月历任陕西捷盈电子科技有限公司副总经理、总经理；2015 年 6 月至今任宇隆科技董事、总经理。

徐建伟，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 7 月至 2006 年 5 月历任咸阳偏转集团公司科员、科长；2006 年 5 月至 2016 年 1 月历任陕西捷盈电子科技有限公司部长、副总经理；2016 年 1 月至今任宇隆科技副总经理；2021 年 1 月至今任宇隆科技董事。

王剑涛，男，1986 年 2 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 9 月至 2015 年 9 月历任陕西捷盈电子科技有限公司工程部技术员、工程师、工程经理、生产经理；2015 年 9 月至 2022 年 6 月任宇隆科技销售总监；2020 年 1 月至 2022 年 6 月任宇隆科技监事；2022 年 6 月至今任宇隆科技董事、

副总经理。

郑翔龙，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 2 月任中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司第四工程公司技术员；2017 年 3 月至 2017 年 5 月任河北宇隆业务员；2017 年 6 月至 2018 年 5 月任安徽灿宇业务员；2018 年 6 月至 2020 年 4 月任重庆升越达销售经理；2020 年 5 月至今历任宇隆科技销售经理、销售部长；2021 年 1 月至 2025 年 8 月任宇隆科技监事；2025 年 8 月至今任宇隆科技职工董事。

崔斌，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994 年 7 月至今，历任西北大学化学与材料科学学院助教、讲师、副教授、教授；2022 年 6 月至今任宇隆科技独立董事。

程茂勇，男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 5 月至今，历任西安交通大学经济与金融学院金融系讲师、副教授、教授；2025 年 12 月至今任思安新能源股份有限公司独立董事；2026 年 1 月至今任西安饮食股份有限公司独立董事；**2026 年 7 月至今任莱商银行股份有限公司独立董事；**2025 年 5 月至今任宇隆科技独立董事。

张方晖，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1987 年 7 月至 1995 年 9 月任西北轻工业学院基础部教师；1995 年 9 月至 1996 年 10 月西北轻工业学院在职研究生；1996 年 10 月至 1997 年 10 月单位公派日本名古屋工业大学留学；1997 年 10 月至 1998 年 7 月西北轻工业学院在职研究生；1998 年 7 月至 2004 年 9 月任陕西科技大学自控系教师、光电系系主任；2004 年 9 月至 2008 年 12 月任陕西科技大学电信学院教师、光电系系主任；2008 年 12 月至 2026 年 6 月任陕西科技大学电子信息与人工智能学院教授、光电系系主任；2026 年 6 月至今任陕西科技大学电子信息与人工智能学院教授；2022 年 6 月至今任宇隆科技独立董事。

2、取消监事会前在任监事

截至取消监事会前，公司监事会由 3 名监事黄小刚、郑翔龙、周文征组成。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规规定，

公司于 2025 年 8 月召开 2025 年第三次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会行使。

公司取消监事会前在任监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	提名人	本届任期
1	黄小刚	监事会主席	监事会	2024年1月-2025年8月
2	郑翔龙	职工代表监事	职工代表大会	2024年1月-2025年8月
3	周文征	监事	监事会	2024年1月-2025年8月

公司取消监事会前在任监事简历如下：

黄小刚，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 8 月至 2013 年 11 月任彩虹集团部门经理；2013 年 12 月至 2016 年 11 月任西安亚泰气体有限公司部门经理；2016 年 12 月至今任宇隆科技制造总监、基地运营总监；2022 年 6 月至 2025 年 8 月任宇隆科技监事会主席。

郑翔龙，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“1、董事”的相关内容。

周文征，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 6 月至 2001 年 6 月任中国出口商品基地建设陕西公司业务员；2001 年 6 月至 2006 年 7 月任咸阳偏转进出口有限公司业务经理；2006 年 7 月至 2010 年 7 月任苏州市智隆电子科技有限公司海外部长；2010 年 7 月至 2014 年 11 月任上海路捷电子科技有限公司副总经理；2014 年 11 月至今任宇隆科技基建项目总监；2021 年 1 月至 2022 年 6 月任宇隆科技董事；2022 年 6 月至 2025 年 8 月任宇隆科技监事。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，公司共有 7 名高级管理人员，基本情况如下：

序号	姓名	职务	本届任期
1	殷鸿彬	董事、总经理	2024年5月-2027年1月
2	徐建伟	董事、副总经理	2024年5月-2027年1月

序号	姓名	职务	本届任期
3	王剑涛	董事、副总经理	2024年5月-2027年1月
4	张珺	副总经理	2024年5月-2027年1月
5	万超	副总经理	2025年8月-2027年1月
6	郭飞	董事会秘书、副总经理	2025年1月-2027年1月
7	彭云强	财务总监	2025年1月-2027年1月

公司全体高级管理人员简历如下：

殷鸿彬，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“1、董事”的相关内容。

徐建伟，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“1、董事”的相关内容。

王剑涛，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“1、董事”的相关内容。

张珺，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 7 月至 2016 年 2 月任苏州腾达光学科技有限公司业务经理；2017 年 3 月至 2018 年 12 月任美辰照明业务经理；2019 年 1 月至 2020 年 7 月任重庆升越达销售总监；2020 年 8 月至 2021 年 1 月任宇隆科技销售总监；2021 年 1 月至今任宇隆科技副总经理。

万超，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2021 年 5 月历任富士康科技集团有限公司下属基地生产组长、生产课长、生产部长；2021 年 6 月至 2025 年 7 月历任宇隆科技制造部长、生产总监、基地运营总监；2025 年 8 月至今任宇隆科技副总经理。

郭飞，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

中级人力资源师。2004 年 7 月至 2006 年 9 月，任建设工业（集团）有限责任公司人力资源专员；2006 年 9 月至 2017 年 12 月，历任美的集团下属基地人力资源经理、管理部部长、分公司总经理助理等职务；2017 年 12 月至 2018 年 4 月，任重庆会通科技有限公司基地总经理助理兼管理部部长；2018 年 4 月至 2020 年 7 月任植恩生物技术股份有限公司人力资源总监；2021 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 31 日任莱特光电人力资源总监；2021 年 4 月至 2025 年 1 月任宇隆科技行政与人力资源总监；2025 年 1 月至今任宇隆科技副总经理、董事会秘书。

彭云强，男，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2013 年 7 月至 2014 年 6 月，任上海茂恒会计师事务所审计员；2014 年 7 月至 2015 年 9 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2015 年 10 月至 2023 年 7 月，任上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2023 年 8 月至 2025 年 1 月任宇隆科技财务部长；2025 年 1 月至今任宇隆科技财务总监。

4、其他核心人员

公司其他核心人员均为核心技术人员，基本情况如下：

序号	姓名	任职情况
1	徐建伟	副总经理
2	高文	研发总监
3	王耀辉	研发经理
4	张文志	研发经理

公司核心技术人员简历如下：

徐建伟，简历请参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“1、董事”的相关内容。

高文，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月至 2007 年 5 月任苏州诺斯达光电科技有限公司工程组长；2007 年 5 月至 2013 年 4 月任苏州三久光电科技有限公司工程科长；2013 年 5 月至今任安徽灿宇研发总监；2021 年 7 月至今任安徽灿宇监事。

王耀辉，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 11 月至 2012 年 3 月任松虹电子（福州）有限公司电子助理工程师；2012 年 4 月至 2015 年 5 月任河北捷盈工程部高级工程师；2015 年 9 月至 2016 年 10 月任宇隆科技工程部资深工程师；2016 年 10 月至 2021 年 5 月历任宇隆科技工程部副经理、经理；2021 年 6 月至今任宇隆研究院研发经理。

张文志，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 6 月任鑫茂科技（深圳）有限公司 SMT 助理工程师；2005 年 7 月至 2011 年 11 月历任富士康科技集团有限公司 SMT 设备组长、SMT 制程组长；2011 年 11 月至 2016 年 4 月任纬创资通（昆山）有限公司 SMT 制程高级工程师；2016 年 4 月至 2017 年 6 月任立讯电子科技（昆山）有限公司 DFM 高级工程师；2017 年 6 月至 2018 年 4 月任达研（上海）光电有限公司 NPI 高级工程师；2018 年 5 月至今任合肥宇隆研发副经理。

（二）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职企业	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
王亚龙	董事长	莱特光电	董事长、董事、总经理	实际控制人控制的其他企业
		莱特电子	执行董事兼总经理	
		蒲城莱特	执行董事	
		北京莱特	经理、执行董事	
		晓荷智能	执行董事	
		鲲鹏半导体	执行董事	
		鄂尔多斯鲲鹏	执行董事	
		共青城高展	执行事务合伙人	
		共青城君成	执行事务合伙人	
		共青城晓荷	执行事务合伙人	
		共青城麒麟	执行事务合伙人	
		共青城青荷	执行事务合伙人	
		西安麒麟	董事	

姓名	公司职务	兼职企业	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
		宇隆企业管理	执行董事	
		共青城瑞麟	执行事务合伙人	
		龙翔四海	执行事务合伙人	
		上海特莱晶	执行董事	
		陕西特莱晶	执行董事	
		莱特夸石	董事长、总经理	
李红燕	副董事长	莱特光电	董事、副董事长、副总经理	实际控制人控制的其他企业
		宇隆企业管理	监事	
		莱特迈思[注]	财务负责人	
		莱特电子	监事	
		鲲鹏半导体	监事	
		海南瑞麟贰号	执行事务合伙人	
		海南瑞麟壹号	执行事务合伙人	
		海南瑞麟叁号	执行事务合伙人	
		海南瑞麟肆号	执行事务合伙人	
		海南瑞麟伍号	执行事务合伙人	
		海南高展投资	执行事务合伙人	
		盘石精密	执行董事	
		陕西磐久	执行董事	
		海南磐久	执行事务合伙人	
		艾利特贸易	监事	
		SUNSHINE	总经理	
崔斌	独立董事	西北大学化学与材料科学学院	教授	无
程茂勇	独立董事	西安交通大学经济与金融学院	教授	无
		西安饮食股份有限公司	独立董事	无
		思安新能源股份有限公司	独立董事	无
		莱商银行股份有限公司	**独立董事**	**无**
张方晖	独立董事	陕西科技大学电子信息与人工智能学院	教授	无
		中国真空学会	理事	无

姓名	公司职务	兼职企业	兼职职务	兼职企业与发行人的关联关系
		陕西省真空学会	常务理事	无
		扬州市欧莱特光电科技有限公司	总经理	无
		西安拓创光芯科技有限公司	执行董事、财务负责人	无
		陕西新航佳成电子科技有限公司	执行董事	无
		陕西科诺新显器件技术有限公司	监事	无
		成都中嘉微视科技有限公司	顾问	无

注：莱特迈思已于 2025 年 7 月注销。

除上述情形外，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员不存在其他兼职情况。

（三）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，王亚龙与李红燕为夫妻关系，其余董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员相互间不存在亲属关系。

（四）最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员不存在行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况。

（五）董事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况

截至本招股说明书签署日，与公司建立劳动关系的董事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订了《劳动合同》，独立董事与公司签订了《聘任协议》。

截至本招股说明书签署日，上述协议均有效执行。

（六）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属持股情况

1、公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的近亲属直接或间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其近亲属直接及间接持股情况如下：

序号	姓名	公司职务/近亲属关系	直接持股比例	间接持股比例	合计持股比例
1	王亚龙	董事长	42.30%	9.13%	51.43%
2	李红燕	副董事长	17.00%	3.56%	20.56%
3	殷鸿彬	董事、总经理	4.28%	-	4.28%
4	徐建伟	董事、副总经理	-	0.28%	0.28%
5	王剑涛	董事、副总经理	-	0.23%	0.23%
6	郑翔龙	职工董事	-	0.01%	0.01%
7	张逸飞	前任董事	-	0.16%	0.16%
8	黄小刚	取消监事会前在任监事会主席	-	0.08%	0.08%
9	周文征	取消监事会前在任监事	-	0.07%	0.07%
10	张珺	副总经理	-	0.18%	0.18%
11	万超	副总经理	-	0.05%	0.05%
12	郭飞	董事会秘书、副总经理	-	0.04%	0.04%
13	彭云强	财务总监	-	0.05%	0.05%
14	高文	研发总监	-	0.04%	0.04%
15	王耀辉	研发经理	-	0.01%	0.01%
16	张文志	研发经理	-	0.01%	0.01%
17	王书豪	王亚龙之子	-	0.23%	0.23%

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况

截至本招股说明书签署日，公司的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其近亲属所持公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（七）董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员在近两年内变动情况

最近两年，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员变动情况如下：

1、董事变动情况

最近两年，公司董事变动情况如下：

变动时间	离任董事	新增董事	变动原因
2025 年 4 月	田冠军	程茂勇	田冠军因个人原因辞去独立董事职务；公司新聘任程茂勇担任独立董事
2025 年 8 月	张逸飞	郑翔龙	根据《公司法》的规定，发行人进一步优化法人治理结构，经职工代表大会民主选举职工董事郑翔龙；张逸飞辞去董事职务

2、取消监事会前在任监事变动情况

最近两年，除因取消监事会而导致监事离任外，发行人不存在其他变动情况，具体如下：

2025 年 8 月，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，公司不再设置监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使。因发行人取消监事会，原监事会成员黄小刚、郑翔龙、周文征离任。

3、高级管理人员变动情况

最近两年，公司高级管理人员变动情况如下：

变动时间	离任高级管理人员	新增高级管理人员	变动原因
2025 年 1 月	陈荣川	郭飞、彭云强	陈荣川因个人原因辞去董事会秘书、财务总监职位；公司根据经营管理需要调整管理团队，新增聘任郭飞担任副总经理及董事会秘书，新增聘任彭云强担任财务总监
2025 年 8 月	-	万超	公司根据经营管理需要，新增聘任万超担任副总经理

最近两年，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的调整主要系基于公司逐步调整完善法人治理结构、提高科学决策水平、满足公司实际经营发展需求，以及部分人员基于个人发展规划、工作职务调整等原因所致，公司上述变动均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不构成重大不利变化。

（八）董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有公司股权外，公司董事、取消监事会前在任监事、和高级管理人员的其他对外投资情况如下：

1、王亚龙与李红燕的对外投资情况

（1）王亚龙与李红燕直接或间接控制的其他法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，王亚龙与李红燕直接或间接控制的其他法人或其他组织情况如下：

序号	企业名称	注册资本	控制关系
1	莱特光电及其子公司	40,243.76 万元	王亚龙持股 49.52%（**截至 2026 年 3 月 31 日**）
2	晓荷智能及其子公司	5,000.00 万元	王亚龙持股 70.00%
3	上海特莱晶及其子公司	60,000.00 万元	王亚龙持股 53.00%
4	宇隆企业管理	500.00 万元	王亚龙持股 85.00%
5	西安麒麟	500.00 万元	王亚龙持股 85.00%
6	龙翔四海	100.00 万元	王亚龙持有 70.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
7	共青城瑞麟	255.00 万元	王亚龙持有 50.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
8	共青城麒麟	700.00 万元	王亚龙持有 51.71%的合伙份额且担任执行事务合伙人
9	共青城青荷	600.00 万元	王亚龙持有 34.83%的合伙份额且担任执行事务合伙人
10	共青城君成	900.00 万元	王亚龙持有 30.87%的合伙份额且担任执行事务合伙人
11	共青城晓荷	900.00 万元	王亚龙持有 16.27%的合伙份额且担任执行事务合伙人
12	共青城高展	1,000.00 万元	王亚龙持有 25.96%的合伙份额且担任执行事务合伙人
13	海南瑞麟壹号	100.00 万元	李红燕持有 80.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
14	海南瑞麟贰号	100.00 万元	李红燕持有 80.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
15	海南瑞麟叁号	100.00 万元	李红燕持有 80.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
16	海南瑞麟肆号	100.00 万元	李红燕持有 80.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
17	海南瑞麟伍号	300.00 万元	李红燕持有 80.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
18	海南高展投资	100.00 万元	李红燕持有 51.00%的合伙份额且担任执行事务合伙人
19	艾利特贸易及其子公司	100.00 万元	李红燕持股 95.00%
20	盘石精密	5,000.00 万元	李红燕持股 60.00%，并通过海南瑞麟叁号间接持股 32.00%
21	陕西磐久	1,000.00 万元	李红燕持股 60.00%，并通过海南瑞麟叁号间接持股 32.00%
22	SUNSHINE	5.00 万美元	李红燕持股 100.00%

序号	企业名称	注册资本	控制关系
23	海南磐久	300.00 万元	李红燕持股 66.67%

截至本招股说明书签署日，王亚龙与李红燕直接或间接控制的其他法人或其他组织与发行人业务相关情况等参见本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“六、发行人同业竞争情况”之“（一）与控股股东、实际控制人及其控制企业的同业竞争情况”之“2、公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业同业竞争情况”。王亚龙与李红燕直接或间接控制的其他法人或其他组织与发行人不存在利益冲突的情形。

（2）王亚龙与李红燕其他对外投资情况

截至 2026 年 6 月 30 日，除上述直接或间接控制的其他法人或其他组织，王亚龙与李红燕其他对外投资情况如下：

姓名	职位	对外投资企业名称	注册资本（万元）	投资额（万元）	持股比例/出资比例
李红燕	副董事长	苏州量子鼎腾投资合伙企业（有限合伙）	2,900.00	530.00	18.28%
		达广商务	1,000.00	500.00	50.00%

苏州量子鼎腾投资合伙企业（有限合伙）主要从事股权投资业务；达广商务主要从事商务服务与投资业务，该等企业与发行人业务均不存在相关性。

截至 2026 年 6 月 30 日，王亚龙与李红燕的其他对外投资的企业不存在与发行人业务相关的情况，亦不存在利益冲突的情形。

截至 2026 年 6 月 30 日，除上述情形外，王亚龙与李红燕不存在其他对外投资情况。

2、公司其他董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况如下其他对外投资情况：

姓名	职位	对外投资企业名称	注册资本（万元）	投资额（万元）	持股比例/出资比例
徐建伟	董事、副总经理	共青城晓荷	900.00	216.46	24.05%
		共青城高展	1,000.00	84.68	8.47%

姓名	职位	对外投资企业名称	注册资本（万元）	投资额（万元）	持股比例/出资比例
王剑涛	董事、副总经理	共青城君成	900.00	136.46	15.16%
		共青城高展	1,000.00	112.91	11.29%
黄小刚	取消监事会前在任监事会主席	共青城君成	900.00	68.23	7.58%
		共青城高展	1,000.00	20.00	2.00%
郑翔龙	取消监事会前在任职工代表监事	共青城君成	900.00	8.00	0.89%
周文征	取消监事会前在任监事	共青城君成	900.00	80.00	8.89%
张珺	副总经理	共青城晓荷	900.00	192.91	21.43%
万超	副总经理	共青城高展	1,000.00	59.76	5.98%
郭飞	董事会秘书、副总经理	共青城高展	1,000.00	42.34	4.23%
彭云强	财务总监	共青城高展	1,000.00	56.46	5.65%
高文	研发总监	共青城高展	1,000.00	10.00	1.00%
		共青城晓荷	900.00	30.00	3.33%
王耀辉	研发经理	共青城君成	900.00	12.00	1.33%
张文志	研发经理	共青城晓荷	900.00	8.00	0.89%
张方晖	独立董事	扬州市欧莱特光电科技有限公司	500.00	200.00	40.00%
		西安拓创光芯科技有限公司	500.00	255.00	51.00%
		西安时代拓创科技合伙企业（有限合伙）	50.00	20.00	40.00%
		西安黑钛科技合伙企业（有限合伙）	100.00	10.00	10.00%
		陕西新航佳成电子科技有限公司	300.00	90.00	30.00%
		陕西科诺新显器件技术有限公司	100.00	5.00	5.00%

共青城晓荷、共青城君成和共青城高展均为发行人的员工持股平台，除投资发行人外未从事其他生产经营活动。

截至 2026 年 6 月 30 日，除上述情形外，公司其他董事、取消监事会在任监事及高级管理人员不存在其他对外投资情况，上述人员的对外投资均未与公司业务产生利益冲突。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他董事、取消监事会在任监事及高级管理人员对外投资的企业不存在与发行人业务相关的情况，亦不存在利益冲突的情形。

（九）董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员薪酬情况

1、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序

公司已召开董事会、股东会会议审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，其中董事（非独立董事）和取消监事会前在任监事不享有津贴，在公司兼任其他职务的按照其职务领取薪酬；高级管理人员薪资主要包括基本薪资、福利和绩效奖金。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开董事会、2022 年 6 月 20 日召开股东大会会议审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》，确定公司独立董事薪酬标准为 10 万元/年（含税）。

2、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员报告期内薪酬总额占发行人利润总额的情况

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员薪酬总额占当期利润总额的比例情况如下：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
薪酬总额（万元）	700.13	613.10	600.15
利润总额（万元）	15,142.89	13,724.45	8,503.77
占比	**4.62%**	**4.47%**	**7.06%**

3、最近一年董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的薪酬情况

2025 年，公司董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员从公司领取薪酬的情况如下：

姓名	职务	2025年从公司领取薪酬或津贴（万元）	2025年在关联企业领薪（万元）
王亚龙	董事长	-	144.91
李红燕	副董事长	-	117.60
殷鸿彬	董事、总经理	91.78	否
徐建伟	董事、副总经理	73.36	否
王剑涛	董事、副总经理	79.47	否
崔斌	独立董事	10.00	否
程茂勇	独立董事	6.26	否

姓名	职务	2025年从公司领取薪酬或津贴（万元）	2025年在关联企业领薪（万元）
张方晖	独立董事	10.00	否
郑翔龙	职工董事	28.46	否
黄小刚	取消监事会前在任监事会主席	49.36	否
周文征	取消监事会前在任监事	45.59	否
张珺	副总经理	112.30	否
万超	副总经理	66.76	否
郭飞	董事会秘书、副总经理	69.72	否
彭云强	财务总监	82.99	否
张逸飞	原董事	57.24	否
陈荣川	原董事会秘书、财务总监	21.02	否
田冠军	原独立董事	3.74	否
合计		**808.04**	-

注：2025 年 4 月，发行人新聘任程茂勇担任独立董事；

除发行人董事王亚龙、李红燕在关联企业任职领薪外，公司其他董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员均不存在从公司的其他关联企业领取薪酬的情况，亦未在公司及公司的关联方享受其他待遇和退休金计划。

十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排

（一）员工持股平台的基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在已制定但尚未实施完毕的对董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。

2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于员工股权激励计划的议案》，通过设立持股平台共青城君成和共青城晓荷对员工进行股权激励。

2022 年 6 月 20 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于第二期员工股权激励计划的议案》，通过设立持股平台共青城高展对员工进行股权激励。两期股权激励的激励对象均为公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术和业务人员、公司认为对公司有特殊贡献的以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人员。

截至本招股说明书签署日，共青城君成、共青城晓荷和共青城高展三家员工持股平台的基本情况如下：

1、共青城君成

截至本招股说明书签署日，共青城君成基本情况如下：

企业名称	共青城君成投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	王亚龙
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2020 年 8 月 5 日
经营期限	2020 年 8 月 5 日至 2040 年 8 月 4 日

共青城君成各合伙人的出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	所属岗位
1	王亚龙	277.86	30.87%	普通合伙人	董事长
2	王剑涛	136.46	15.16%	有限合伙人	销售岗
3	张逸飞	116.46	12.94%	有限合伙人	管理行政岗
4	周文征	80.00	8.89%	有限合伙人	管理行政岗
5	黄小刚	68.23	7.58%	有限合伙人	管理行政岗
6	唐隽	60.00	6.67%	有限合伙人	管理行政岗
7	胡跃峰	20.00	2.22%	有限合伙人	销售岗
8	蒋利容	20.00	2.22%	有限合伙人	管理行政岗
9	王耀辉	12.00	1.33%	有限合伙人	研发技术岗
10	毛光林	12.00	1.33%	有限合伙人	生产制造岗
11	高庚	12.00	1.33%	有限合伙人	管理行政岗
12	陈晶兴	8.00	0.89%	有限合伙人	生产制造岗
13	梅灵懋	8.00	0.89%	有限合伙人	销售岗
14	郑翔龙	8.00	0.89%	有限合伙人	销售岗
15	魏昭飞	8.00	0.89%	有限合伙人	管理行政岗
16	叶江华	8.00	0.89%	有限合伙人	生产制造岗
17	朱奇辉	8.00	0.89%	有限合伙人	管理行政岗

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	所属岗位
18	邓敏	6.00	0.67%	有限合伙人	生产制造岗
19	陈玉芬	6.00	0.67%	有限合伙人	管理行政岗
20	吴文锋	6.00	0.67%	有限合伙人	研发技术岗
21	刘特奇	6.00	0.67%	有限合伙人	研发技术岗
22	董彤	6.00	0.67%	有限合伙人	管理行政岗
23	唐厚波	4.00	0.44%	有限合伙人	生产制造岗
24	陈德灼	3.00	0.33%	有限合伙人	研发技术岗
合计		**900.00**	**100.00%**	-	-

注：员工持股平台部分合伙人因岗位调整，其所属岗位类型相应发生变动。

2、共青城晓荷

截至本招股说明书签署日，共青城晓荷基本情况如下：

企业名称	共青城晓荷投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	王亚龙
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2020 年 8 月 5 日
经营期限	2020 年 8 月 5 日至 2040 年 8 月 4 日

共青城晓荷各合伙人的出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	职务
1	王亚龙	146.40	16.27%	普通合伙人	董事长
2	徐建伟	216.46	24.05%	有限合伙人	管理行政岗
3	张珺	192.91	21.43%	有限合伙人	销售岗
4	杜海宁	42.11	4.68%	有限合伙人	管理行政岗
5	杜海鹏	40.00	4.44%	有限合伙人	销售岗
6	陈伟	40.00	4.44%	有限合伙人	管理行政岗
7	李波	40.00	4.44%	有限合伙人	管理行政岗
8	高文	30.00	3.33%	有限合伙人	研发技术岗
9	吕义凯	20.00	2.22%	有限合伙人	生产制造岗
10	徐莹莹	20.00	2.22%	有限合伙人	管理行政岗

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	职务
11	林学峰	20.00	2.22%	有限合伙人	管理行政岗
12	贺永强	14.11	1.57%	有限合伙人	生产制造岗
13	杨立军	12.00	1.33%	有限合伙人	生产制造岗
14	孙成坤	12.00	1.33%	有限合伙人	生产制造岗
15	赵伟	12.00	1.33%	有限合伙人	销售岗
16	于维超	10.00	1.11%	有限合伙人	生产制造岗
17	张文志	8.00	0.89%	有限合伙人	研发技术岗
18	何林	8.00	0.89%	有限合伙人	生产制造岗
19	查全麟	6.00	0.67%	有限合伙人	管理行政岗
20	朱燕	3.00	0.33%	有限合伙人	研发技术岗
21	张凯凯	3.00	0.33%	有限合伙人	销售岗
22	贾丽	2.00	0.22%	有限合伙人	生产制造岗
23	杨家燕	2.00	0.22%	有限合伙人	管理行政岗
合计		**900.00**	**100.00%**	-	-

注：员工持股平台部分合伙人因岗位调整，其所属岗位类型相应发生变动。

3、共青城高展

截至本招股说明书签署日，共青城高展基本情况如下：

企业名称	共青城高展投资合伙企业（有限合伙）
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	王亚龙
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
成立日期	2021 年 12 月 14 日
经营期限	2021 年 12 月 14 日至 2041 年 12 月 13 日

共青城高展各合伙人的出资情况如下：

单位：万元

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	所属岗位
1	王亚龙	259.60	25.96%	普通合伙人	董事长
2	王剑涛	112.91	11.29%	有限合伙人	销售岗
3	徐建伟	84.68	8.47%	有限合伙人	管理行政岗
4	万超	59.76	5.98%	有限合伙人	管理行政岗

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	所属岗位
5	彭云强	56.46	5.65%	有限合伙人	管理行政岗
6	张逸飞	56.46	5.65%	有限合伙人	管理行政岗
7	郭飞	42.34	4.23%	有限合伙人	管理行政岗
8	李飞燕	28.23	2.82%	有限合伙人	管理行政岗
9	黄小刚	20.00	2.00%	有限合伙人	管理行政岗
10	陈乐乐	20.00	2.00%	有限合伙人	研发技术岗
11	林学峰	20.00	2.00%	有限合伙人	管理行政岗
12	贺军	19.76	1.98%	有限合伙人	管理行政岗
13	朱奇辉	12.00	1.20%	有限合伙人	管理行政岗
14	高文	10.00	1.00%	有限合伙人	研发技术岗
15	丁美仙	10.00	1.00%	有限合伙人	管理行政岗
16	张佳昇	8.47	0.85%	有限合伙人	销售岗
17	王川中	8.47	0.85%	有限合伙人	研发技术岗
18	杜海宁	8.00	0.80%	有限合伙人	管理行政岗
19	王成飞	8.00	0.80%	有限合伙人	生产制造岗
20	卢泉汉	8.00	0.80%	有限合伙人	管理行政岗
21	刘承华	8.00	0.80%	有限合伙人	管理行政岗
22	张发桃	8.00	0.80%	有限合伙人	管理行政岗
23	周训方	8.00	0.80%	有限合伙人	销售岗
24	杨瑞	8.00	0.80%	有限合伙人	管理行政岗
25	连朋飞	8.00	0.80%	有限合伙人	销售岗
26	雷朝阳	8.00	0.80%	有限合伙人	研发技术岗
27	赵强斌	7.06	0.71%	有限合伙人	生产制造岗
28	莫财江	6.00	0.60%	有限合伙人	生产制造岗
29	梁小波	6.00	0.60%	有限合伙人	管理行政岗
30	谭华伟	6.00	0.60%	有限合伙人	销售岗
31	李健	6.00	0.60%	有限合伙人	研发技术岗
32	卿明礼	6.00	0.60%	有限合伙人	研发技术岗
33	程胜钟	5.65	0.56%	有限合伙人	研发技术岗
34	梅双	5.65	0.56%	有限合伙人	管理行政岗
35	徐应桃	5.65	0.56%	有限合伙人	管理行政岗
36	文海锋	5.65	0.56%	有限合伙人	生产制造岗
37	刘平琴	5.65	0.56%	有限合伙人	管理行政岗

序号	合伙人姓名	出资额	出资比例	合伙人类型	所属岗位
38	王艳丽	5.65	0.56%	有限合伙人	销售岗
39	赵国成	5.65	0.56%	有限合伙人	生产制造岗
40	朱灿	5.65	0.56%	有限合伙人	生产制造岗
41	陶茜	5.65	0.56%	有限合伙人	管理行政岗
42	廖兴碧	5.65	0.56%	有限合伙人	管理行政岗
43	袁秀伟	5.36	0.54%	有限合伙人	研发技术岗
合计		**1,000.00**	**100.00%**	-	-

（二）员工持股计划的股份锁定期

发行人员工持股平台共青城君成、共青城晓荷和共青城高展持有发行人股票自发行人股票上市交易之日起锁定 36 个月。

（三）员工离职后的股份处理

根据员工持股平台的相关约定，激励对象所持股份的解锁安排与服务期限挂钩，具体为：自发行人股票上市之日起计算，激励对象持续服务满 3 年，可解锁其获授股份总数的 50%；自上市之日起持续服务满 4 年，可解锁剩余 50%的股份。

若员工于服务期未满阶段离职，则以其出资的成本价扣除其已累计收取的现金分红后作价转让给持股平台普通合伙人（即实际控制人王亚龙）或其指定的其他员工。因此，若员工于服务期未满阶段离职，则：

（1）转让至实际控制人王亚龙，则对应调减服务期内股份支付的分摊基数，并就该激励对象相关的累计已确认股份支付费用对应的金额予以转回，冲减离职当期的费用；

（2）或转让至实际控制人王亚龙指定的其他员工，则冲减原有股份支付形成的当期费用，并根据转让至新指定员工时点的股票公允价值重新计提股份支付费用。

（四）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响及上市后的行权安排

1、对公司经营状况的影响

通过设立共青城君成、共青城晓荷和共青城高展作为发行人员工持股平台，公司建立、健全了员工激励机制，充分调动了高级管理人员与骨干员工的工作积极性，增强了公司的凝聚力，提高了公司的经营效率。

2、对公司财务状况的影响

为公允反映股权激励对公司财务状况的影响，公司就上述股权激励事宜确认了股份支付。报告期内，发行人股份支付对当期损益的影响分别为 551.84 万元、321.91 万元及 539.56 万元，占当期利润总额的比例分别为 6.49%、2.35%及 3.56%。

发行人实施上述股权激励对公司财务状况的具体影响详见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”。

3、对公司控制权变化的影响

上述股权激励实施完毕前后，公司的控制权均未发生变化。

4、公司上市后的行权安排

截至本招股说明书签署日，发行人股权激励通过向员工持股平台定向增发股份的方式实施，由被激励对象直接持有持股平台份额，不涉及上市后的行权安排。

十二、员工及社会保障情况

（一）员工情况

1、员工人数及变化情况

报告期各期末，公司及子公司员工人数及变化情况如下表所示：

年份	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
员工人数（人）	1,401	1,282	1,301

2、员工专业结构情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司员工按专业划分的情况如下表所示：

专业类别	人数（人）	占比
管理及行政类人员	113	8.07%
生产制造类人员	1,125	80.30%
研发与技术人员	122	8.71%
销售人员	41	2.93%
合计	**1,401**	**100.00%**

（二）员工社会保险及住房公积金缴纳情况

公司按照国家法律法规和地方政府的有关规定，为员工办理了养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险，并执行住房公积金制度。报告期内，公司在职员工缴纳社会保险和住房公积金的具体情况如下：

1、公司社保缴纳情况

报告期内，公司在职员工缴纳社会保险的具体情况如下：

单位：人

项目	2025/12/31		2024/12/31		2023/12/31	
	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数	员工人数	缴纳人数
养老保险	1,401	1,387	1,282	1,256	1,301	1,260
医疗保险	1,401	1,386	1,282	1,225	1,301	1,252
生育保险	1,401	1,386	1,282	1,225	1,301	1,254
失业保险	1,401	1,387	1,282	1,256	1,301	1,260
工伤保险	1,401	1,387	1,282	1,257	1,301	1,260

截至 2025 年 12 月 31 日，公司部分员工未缴纳社会保险，主要原因为当月入职待缴纳、社保关系未转入等。

公司已按照中国有关社会保险的法律、行政法规、规章及规范性文件的规定为在职员工缴付了养老、医疗、工伤、失业及生育保险金。报告期内，公司不存在违反社会保险监管法律的重大违法违规行为，亦不存在因违反社会保险监管法律而受到行政处罚的情形，相关社保主管部门皆已出具了合规证明。

2、公司住房公积金缴纳情况

公司根据国家和地方政府的有关规定，执行相应的住房公积金制度，报告期内，公司在职员工缴纳住房公积金的具体情况如下：

项目	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31
员工总数（人）	1,401	1,282	1,301
住房公积金缴纳数（人）	1,389	1,266	1,266

截至 2025 年 12 月 31 日，公司部分员工未缴纳住房公积金，主要原因为当月入职待缴纳、公积金关系未转入等。

报告期内，公司不存在被住房公积金主管部门处罚的记录，相关住房公积金主管部门皆已出具了合规证明。

3、发行人控股股东、实际控制人关于社会保险和住房公积金的承诺

公司的实际控制人王亚龙、李红燕已出具如下承诺：

“若公司及其子公司因任何事项经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金和/或住房公积金，或公司及其子公司因任何事项而被社会保险行政部门和/或公积金管理部门处以罚款或其他任何处罚，本人将无条件向公司补偿该等全部补缴社会保险金和/或公积金金额以及全部处罚金额，以及公司及其子公司因此所支付的相关费用，以使公司及其子公司免受损失。”

（三）劳务派遣及劳务外包的情况

1、劳务派遣情况

报告期内，发行人不存在劳务派遣用工的情形。

2、劳务外包情况

报告期内，公司存在将临时性、辅助性或替代性的上料、投板、物料搬运等工作岗位发包给劳务外包单位的情形。发行人所聘请的劳务公司系独立经营的实体，发行人劳务外包仅涉及生产工序辅助岗位，操作简单重复、劳动密集性高、技术含量低，无需具备特定专业资质，业务实施及人员管理符合相关法律法规规定，发行人与劳务公司发生业务交易的背景合理，相关交易不存在重大风险。

报告期内，发行人与聘请的劳务公司不存在关联关系，劳务公司与发行人的劳务服务系参考市场价格协商确定，劳务外包费用定价合理、公允，不存在利益输送的情形。

第五节 业务和技术

一、公司主营业务、主要产品或服务及演变的情况

（一）公司主营业务概况

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕 LCD 显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro LED 等显示领域新技术的应用发展，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的技术研发、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，全面覆盖目前主流及未来新型显示技术路线。目前，公司已拥有样品、中小批量、大批量等各级产品综合制造能力，通过开展 DFM 可制造性分析及 BOM 优化、PCB Layout 模拟仿真、高精度电子装联、关键功能器件制造、终端级检测、售后服务等全套业务流程，长期服务于我国具有国际竞争力、先进制造工艺的半导体显示面板领先厂商。

凭借丰富的制造服务经验、优异的技术工艺及产品品质、完善的配套服务体系、高效的新产品响应速度以及业内一流的规模化量产交付能力，公司自成立以来助力我国半导体显示面板产业国产化率不断提升，持续开拓优质客户资源，获得了业内的广泛认可。作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

与此同时，公司以成为我国智能控制领域最有价值的企业为目标，积极拓宽业务边界、持续开拓产品应用领域，与国家关键战略新兴产业同频共振，不断

实现自身业务布局及产品结构的突破和发展。在新产品方面，公司已在Mini/Micro LED 等新型显示领域进入样品开发阶段；与此同时，公司已积极布局汽车电子等领域，并实现了对比亚迪、赛力斯等厂商的合格供应商认证和批量供货。2025 年下半年，公司与韩国上市公司纽禄美卡共同成立合资公司，以实现“AI 时代”的全新战略布局为目标，拟在现有业务基础上进一步拓展协作机器人领域。

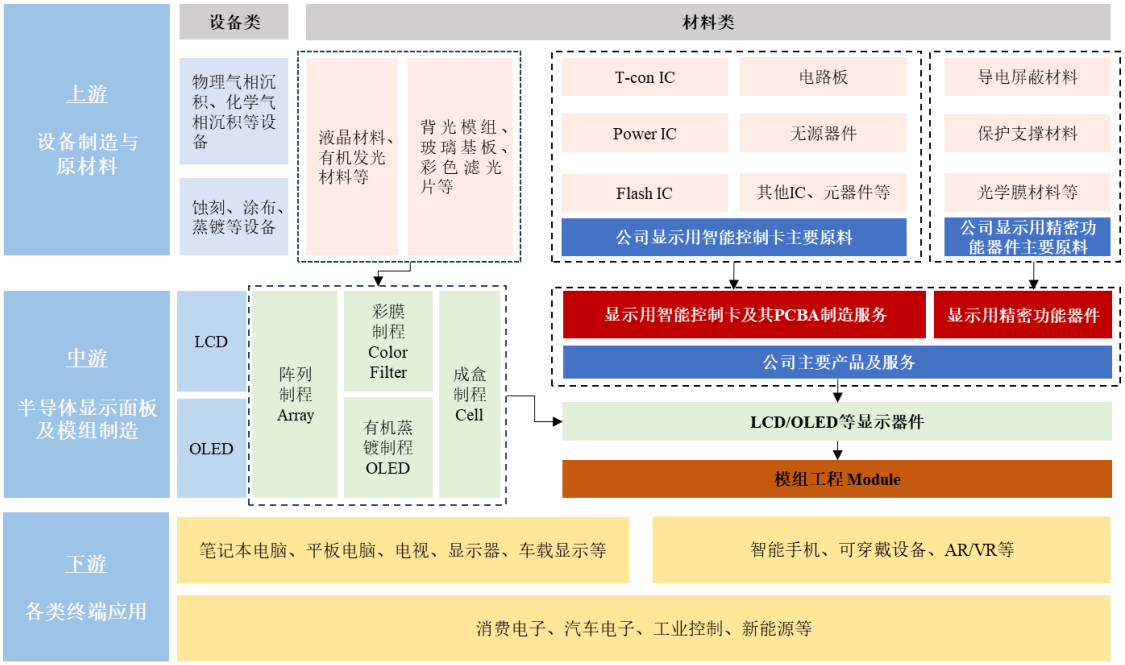
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有专利权 306 项，其中包括 12 项发明专利，另有 46 项发明专利正在申请中，参与了 3 项国家标准的起草制定。公司始终将研发投入和技术创新作为企业发展的核心驱动力，设立了显示研发实验中心和可靠性测试平台，并与多所知名高校共建联合实验室，汇聚光学、电子、软件等多学科人才。

经过多年发展创新及技术积淀，公司的生产经营规模、工艺装备水平、产品研发能力、质量控制以及产品交付能力等均处在行业领先水平，被评为国家重点支持专精特新“小巨人”企业、国家智能制造优秀场景、国家级高新技术企业、重庆市“高精度 PCBA 控制板制造数字化车间”、重庆市“高精密 OLED 控制板生产数字化车间”、重庆市知识产权优势企业、中国潜在独角兽企业等，并获得重庆市企业技术中心、重庆市制造业中试平台等资质认定。

（二）公司主要产品及服务

公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。

上述公司主要产品在半导体显示面板产业链中的应用及所处位置示意如下：



注：模组工程（Module）对于LCD或OLED显示面板存在一定差异。其中，LCD面板生产过程中，模组工程主要包括：切割、磨边、液晶盒进行偏贴、芯片（IC）绑定、涂胶、PCB板绑定、背光组装等工序，最终形成LCD显示模组；OLED面板生产过程中，模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定、盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。

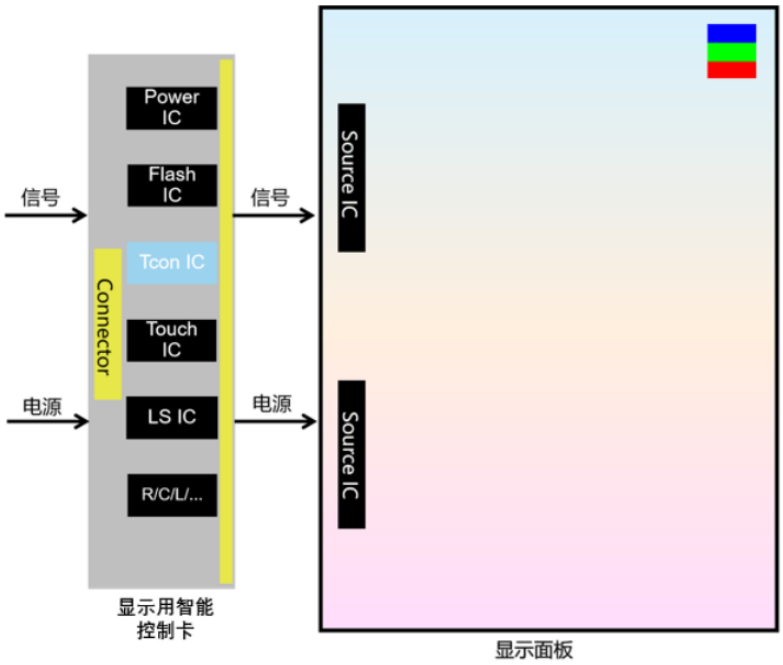
1、显示用智能控制卡

报告期内，公司通过自主采购原料生产显示用智能控制卡产品或向客户提供显示用智能控制卡 PCBA 制造服务。

（1）显示用智能控制卡产品

公司显示用智能控制卡产品主要应用于新型半导体显示领域，是显示面板系统中的关键核心部件。产品能够实现高带宽视频信号解码与格式转换、精密行列扫描时序规划，并对 Gamma、色域、均匀性、寿命等多维度显示驱动算法进行综合管理，从而确保显示画面稳定、准确呈现，有效提升面板整体性能与运行可靠性，也被称为半导体显示面板的“大脑”。

显示用智能控制卡的基础结构及工作原理



注：（1）T-con IC：时序控制芯片；（2）Power IC：电源管理芯片；（3）Flash IC：闪存芯片；（4）Touch IC：触控芯片；（5）LS IC：电平转换芯片；（6）R/C/L/...：电阻、电容、电感等电子元器件。

如上图所示，显示用智能控制卡以 PCB/FPC 基板为基础，集成了 T-con IC 芯片、Power IC 芯片、Flash 芯片等 IC 芯片模块，具备了时序控制、电压转换、图像算法优化、信号转换等功能，从而能够将图形图像数据信号转换成显示屏所需的行列驱动信号，实现对屏幕画面显示的控制和算法优化，最终呈现出最优的画面显示给终端用户。随着终端电子产品智能化、轻薄化趋势加剧，基板层数不断增加，元器件体积持续缩小，显示用智能控制卡亦朝着高精度、高密度、高集成度方向持续发展。

显示用智能控制卡通常用于需要独立控制电路的中大尺寸显示面板，终端应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视以及车载屏幕等领域。该等显示面板尺寸较大、分辨率较高，通常需要独立的控制卡以实现时序驱动、信号转换、图像处理等功能；而终端应用于手机、智能穿戴等领域的小尺寸显示面板，其尺寸较小、集成度要求高，因而显示控制功能大多直接集成于主处理器（SoC）或显示驱动芯片之中，不外置独立的“控制卡”。

报告期内，公司显示用智能控制卡产品及其终端主要应用情况如下：

产品名称	产品应用	产品图例	终端应用图例
显示用智能控制卡	平板电脑		
	笔记本电脑		
	显示器		
	中大尺寸电视		
	新能源汽车智能座舱显示屏		

（2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务

除自主采购物料用于生产制造向客户实现销售外，公司亦通过开展 PCBA 制造服务向客户提供显示用智能控制卡产品。

报告期内，公司 PCBA 电子制造服务流程包括产品设计评估、产品开发、样件试制、性能检测、售后服务等流程。具体过程如下：

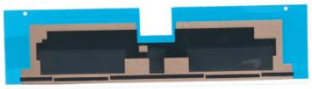
序号	流程名称	具体内容
1	产品设计评估	产品开发过程中整合设计需求与制造可行性的系统化方法，通过优化电路设计与制造系统的相互作用，降低开发周期
2	产品开发	对产品进行开发，开发活动包含设计开发、DFM 可制造性分析、测试环境开发、试制辅助治工具及各工序程式开发、物流包装设计等
3	样件试制	根据设定的 PCB Layout 组件布局图，将 PCB、IC、电阻电容、连接器等材料进行装联和电气连通的制造过程
4	性能检测	对经过装联后的产品进行多维度检测，具体包括可靠性测试、环境适应性测试、电性测试、功能测试、芯片读写与校验、画面检测等
5	售后服务	提供远程与现场技术支持，产品维修、更换和质保期内免费保障等

2、显示用精密功能器件

公司的显示用精密功能器件产品主要应用于消费电子领域，是平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子产品内部半导体显示面板结构中实现特定功能的器件，具体可以分为功能类器件和光学类器件。

其中，功能类器件具备单一或者多种功能，包括但不限于电磁屏蔽、散热导热、水氧阻隔、导电、绝缘、缓冲、填充等；光学类器件可实现对显示光源光线的反射、扩散、增强汇聚等功能。

报告期内，公司主要显示用精密功能器件产品及其终端主要应用情况如下：

序号	产品分类	产品类型	产品图例	终端应用图例
1	功能类器件	导电类功能器件		   
		绝缘屏蔽类功能器件		
		缓冲补强类功能器件		
		保护类功能器件		
		复合类功能器件		
2	光学类器件	反射类光学器件		
		扩散类光学器件		
		增光类光学器件		

（三）主营业务收入及构成情况

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	71,535.65	63.07	72,455.66	66.29	37,238.12	53.64
其中：1）显示用智能控制卡产品	45,310.20	39.95	43,828.49	40.10	9,205.19	13.26
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	26,225.45	23.12	28,627.16	26.19	28,032.93	40.38
显示用精密功能器件	39,364.99	34.71	34,618.54	31.67	30,790.97	44.36
其他	2,525.01	2.23	2,227.87	2.04	1,389.76	2.00
合计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

报告期内，公司显示用智能控制卡和显示用精密功能器件相关收入占主营业务收入的比例分别为 98.00%、97.96%和 97.77%，是主营业务收入的主要来源。

（四）主要经营模式

公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式和销售模式。报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

1、采购模式

公司已建立较为完整、系统的原材料供应体系并拥有独立的采购渠道。公司根据客户订单及中长期采购需求制定生产计划，并结合原材料安全库存、到货周期等情况进而进行动态调整。具体来看，公司采购部负责对公司生产所需原材料进行采购，采购的原材料由公司品质部进行检验合格后方能入库。公司采购部按照计划运营部的物料需求计划制定采购计划，主要通过询价、比价、议价及招标的模式进行采购。

报告期内，公司存在“Buy and Sell”模式，即客户向原材料供应商购买部分主要物料后转卖给公司，公司向该客户下单采购并付款，公司通过自行购买其他主要物料及辅耗材料后组织生产活动，最终将包含上述自客户处购买物料价值的产成品定向销售给该客户。这一模式在电子产品制造行业较为普遍。

公司已建立了严格的供应商管理制度，包括《采购管理办法》《供应商管理办法》等，由公司品质部协同采购部对供应商进行审核，并将审核合格的供应商纳入《合格供应商名录》进行管理，持续跟踪供应商产品质量，择优导入新供应商进行补充或替换。针对进入公司合格供应商名录的核心供应商，公司与其签署

“年度框架协议”及“短期采购订单”实施具体采购计划。

2、生产模式

公司从事的生产环节主要为显示用智能控制卡及显示用精密功能器件产品的生产制造。报告期内，公司遵循“以销定产”的生产模式，即以客户订单为基础，结合客户提供的产品预测需求量以及自身的产能等情况安排生产。

公司 PMC 部门主要对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。具体来看，公司销售部门收到客户订单或需求计划后通知 PMC 部门，PMC 部门结合客户需求、原材料储备情况和产能情况制定生产计划，并组织生产部门生产，生产完成检验合格入库。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均会进行品质检测，保障产品质量。

报告期内，公司显示用智能控制卡及显示用精密功能器件存在客供料和自供料两种生产模式，具体如下：

（1）自供料模式：生产所需主要物料全部或部分由公司进行采购，包材等辅耗材亦由公司采购。生产完成后按自有产品对客户进行产品销售。该模式下，产品生产成本中除人工费用和制造费用外，还包含公司采购的主要原材料成本；

（2）客供料模式：生产所需主要物料均由客户提供，包材等辅耗材由公司采购。该等情形下，公司收取的客户提供的物料均明确用于客户的制造服务订单，公司单独设立客供仓保管客供料，并建立物料收发数量备查账，与公司自有的存货分开管理。该模式下，生产成本主要为人工费用和制造费用。

报告期内，公司主要产品按照客供料和自供料区分收入情况如下：

单位：万元、%

主要产品	业务模式	2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	自供料	45,310.20	63.34	43,828.49	60.49	9,205.19	24.72
	客供料	26,225.45	36.66	28,627.16	39.51	28,032.93	75.28
	总计	**71,535.65**	**100.00**	**72,455.66**	**100.00**	**37,238.12**	**100.00**
显示用精密功	自供料	38,600.65	98.06	34,288.67	99.05	30,489.99	99.02
	客供料	764.34	1.94	329.86	0.95	300.98	0.98

主要产品	业务模式	2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
能器件	总计	**39,364.99**	**100.00**	**34,618.54**	**100.00**	**30,790.97**	**100.00**

注：显示用智能控制卡业务可细分为显示用智能控制卡产品和显示用智能控制卡 PCBA 制造服务，与上表中的自供料和客供料业务模式相对应

如上表所述，报告期内，公司客供料模式主要为显示用智能控制卡 PCBA 制造服务业务，显示用精密功能器件仅存在少量客供料模式。

报告期内，公司主要采取自主生产的方式，但在订单交货时间紧急且公司产能饱和的情况下，公司会将部分简单生产工序委托给外协供应商生产。

报告期内，公司外协加工金额占营业成本的比重如下：

单位：万元

项目	2025年	2024年	2023年
外协加工费	20.96	34.69	18.79
营业成本	87,218.78	86,049.03	53,771.57
占营业成本的比例	**0.02%**	**0.04%**	**0.03%**

报告期内，外协加工费占营业成本比例皆在 0.5%以下且整体降低。

3、销售模式

公司的产品销售主要采取直销模式，即公司直接与最终客户签署合同和结算货款，并向其提供技术支持和售后服务。公司主要系通过主动市场开拓、现有客户介绍、参加行业论坛展会、行业资讯搜集等方式获取客户及业务资源，并通过商业谈判、招投标、询价等多元化方式获取订单。

报告期内，公司存在少量 VMI 销售模式。VMI 模式下，公司按客户要求将货物运送至客户指定的 VMI 仓库，客户根据实际需要领用公司产品。报告期内，公司 VMI 模式主要客户为半导体显示面板行业知名厂商深天马，符合行业惯例。

公司直销按照区域划分，具体可以分为内销、外销两种模式，内销是指公司直接向境内客户进行产品销售；公司外销业务均系深加工结转[3]（俗称“转厂出

3、深加工结转：根据《海关对出口加工区监管的暂行办法》、《海关出口加工区货物出区深加工结转管理办法》等相关规定，深加工结转模式是一种间接出口的销售方式，指加工贸易企业将保税进口料件加工成成品或半成品后不直接出口，而是结转至另一加工贸易企业继续进行保税加工的经营活动。深加工结转货物受海关的监管，企业在办理货物的转厂手续时，需要货物转入和转出企业分别向各自主管海关办理货物转入申报和转出申报手续，而货物不需要离境，直接由国内的货物转出厂商发送到货物转入厂商

口”）业务。

4、盈利模式

公司主营业务收入主要来自于以半导体显示面板为核心应用领域的显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件业务的销售。公司主要系通过研发、生产并向下游半导体显示面板厂商客户销售显示用智能控制卡和显示用精密功能器件产品，并提供相关 PCBA 制造服务实现盈利。

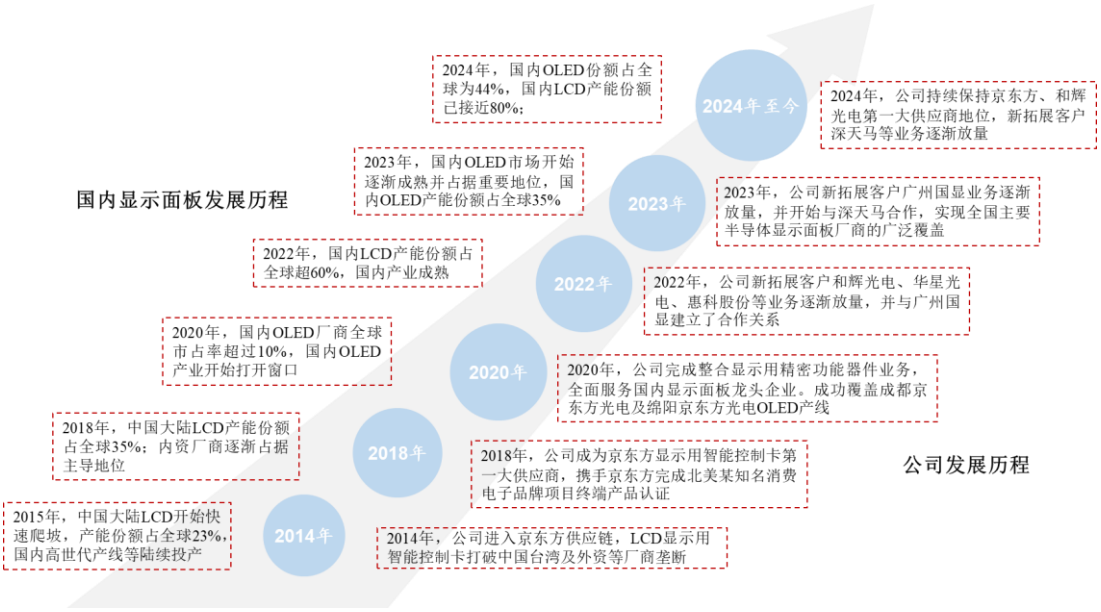
5、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司经营模式由半导体显示面板行业特性、公司所处产业链位置、上下游情况、客户需求特点等多重因素共同作用而形成，公司现有经营模式符合公司所属行业惯例并能够满足公司的业务发展需要。

报告期内，公司经营模式及相关影响因素未发生重大变化，在可预见的未来亦不会发生重大变化，公司经营模式成熟稳定。

（五）公司成立以来业务发展过程及主营业务演变情况

自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板产品为核心应用领域开展主营业务，至今未发生重大变化。公司成立以来业务发展过程及主营业务演变情况如下：



（六）发行人主要业务经营情况及核心技术产业化情况

报告期内，公司核心技术产品带来的营业收入主要为显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件产品，其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	110,900.63	107,074.19	68,029.10
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
占比	**97.52%**	**97.75%**	**97.52%**

由上表可知，报告期内发行人营业收入主要来自于核心技术产品的销售收入，由核心技术相关产品实现的营业收入比例较高，发行人核心技术已实现产业化。

（七）发行人主要产品工艺流程图及核心技术的具体使用情况和效果

公司自成立以来坚持自主研发、持续推进技术创新，已掌握多项核心技术并均已实现了产业化应用，公司主要产品工艺流程图及核心技术运用情况如下：

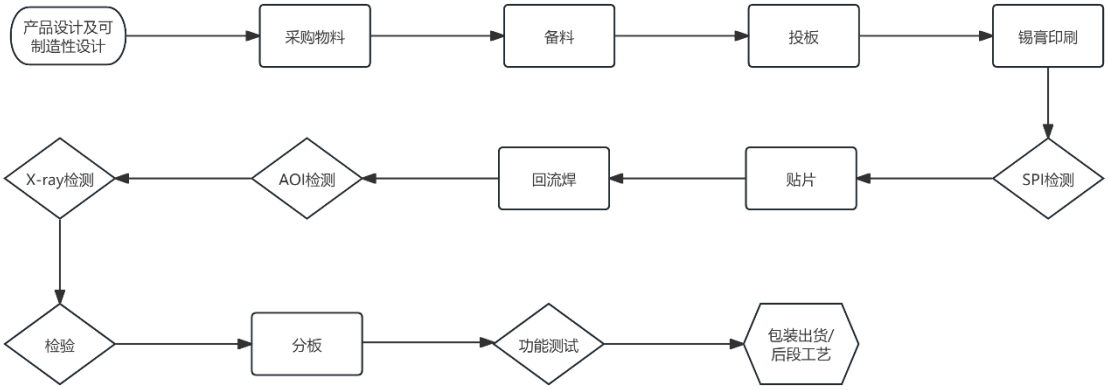
1、显示用智能控制卡

公司显示用智能控制卡产品主要应用于新型半导体显示领域，是半导体显示面板系统中的关键核心部件。报告期内，公司显示用智能控制卡业务的核心生产工艺主要为 PCBA 制造，PCBA 制造主要分为前段工艺及后段工艺。

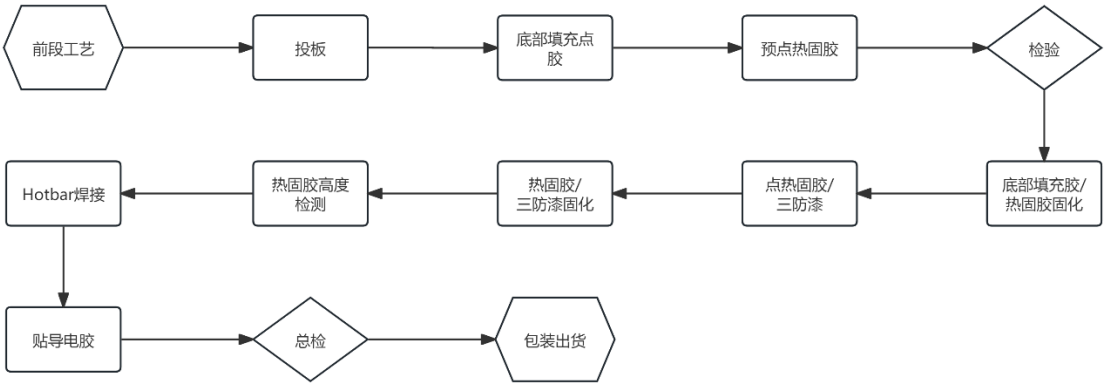
公司 PCBA 制造的前段工艺处理通过投板、锡膏印刷、贴片、回流焊等一系

列流程完成生产制作。前段工艺结束后，进行后段工艺处理，通过底部填充点胶、点热固胶/三防漆、Hot Bar 焊接等工艺过程完成生产制作，具体工艺流程如下：

（1）前段工艺



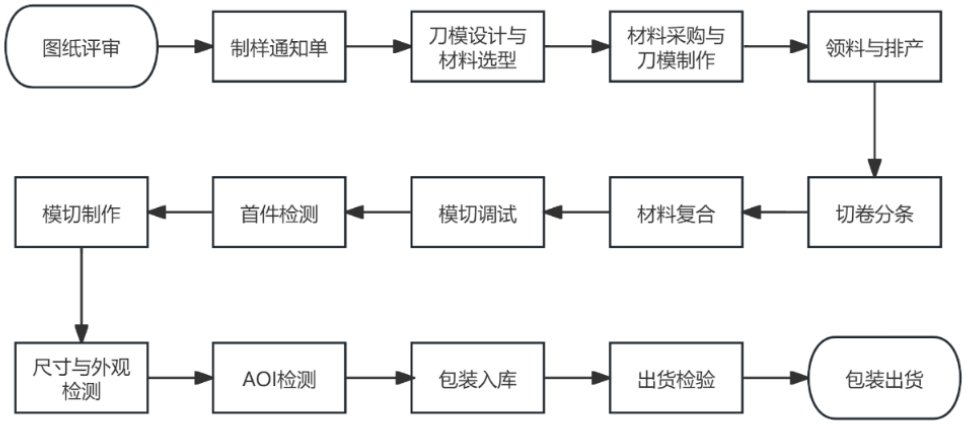
（2）后段工艺



2、显示用精密功能器件

显示用精密功能器件是利用精密加工、工艺开发、自动控制、AOI 检测等技术为电子产品提供特定功能确保其正常运行的部件和组件，功能件旨在实现电子产品功能模块或部件之间的绝缘屏蔽、抗干扰、导电散热、粘接、缓冲防护、防水防尘等功能，是半导体显示面板的重要组成部分。

公司显示用精密功能器件生产工艺流程主要分为图纸评审、刀模设计与材料选型、切卷分条、材料复合、模切成型、尺寸外观检测等：



公司生产相关核心技术在工艺中的运用情况参见本节之“六、公司技术与研发情况”之“（一）公司核心技术及其应用”相关内容。

（八）公司主要业务指标分析

报告期内，公司主要业务指标情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
归属于母公司股东净利润	13,329.07	12,059.78	7,572.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	12,927.80	11,584.29	6,401.12
主营业务收入	113,425.64	109,302.06	69,418.85
主营业务毛利	26,464.74	23,485.68	15,974.05
主营业务毛利率	23.33%	21.49%	23.01%

如上表所述，2024 年以来，随着新型显示技术、AI 人工智能以及 5G 等技术升级和进步，我国消费电子及半导体显示面板行业景气度逐步回升，公司主营业务收入、净利润等指标亦实现快速增长。

报告期内，公司显示用智能控制卡业务销量 13,012.07 万片、14,260.91 万片以及 12,866.10 万片，显示用精密功能器件销量 53,495.48 万片、56,862.06 万片以及 65,814.30 万片，实现主营业务毛利 15,974.05 万元、23,485.68 万元和 26,464.74 万元，经营情况良好。

（九）公司主营业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

报告期内，公司聚焦显示用智能控制卡和显示用精密功能器件产品，公司产

品与下游新型半导体显示面板行业、终端应用消费电子等领域深度融合，符合产业政策和国家经济发展战略，具体详见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“二、公司所属行业的基本情况”之“（二）行业主管部门、监管体制、法律法规及政策”相关内容之“3、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响”。

（十）公司关于符合创业板定位的具体说明

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

（1）半导体显示面板行业系我国现代化电子制造业的重要支柱产业之一，是我国现代化制造业体系和新质生产力的重要体现

半导体显示面板作为人机交互、虚拟现实交互的核心平台，承载着信息呈现与用户操作的关键功能。它不仅是用户与设备之间沟通的桥梁，更是实现数据可视化、指令输入和状态反馈的重要载体。从智能手机、平板电脑到工业控制界面、车载系统，再到智能家居和可穿戴设备，半导体显示面板的应用几乎覆盖所有现代电子设备领域。通过高分辨率、触控技术、柔性显示以及动态交互设计，半导体显示面板能够提供直观、高效且沉浸式的用户体验。同时，随着人工智能、5G、物联网 IOT 等技术的快速发展，半导体显示面板正逐渐集成更多智能感知与交互能力，例如手势识别、语音联动和环境自适应等，进一步拓展了人机交互、虚拟现实交互的深度与广度。因此，半导体显示面板不仅是硬件设备的重要组成部分，更是推动数字化、智能化社会发展的基础性技术平台。

半导体显示产业作为电子信息领域的核心产业，对我国电子信息制造业水平的提升发挥了关键作用，其不仅直接贡献了巨大的产业规模和经济价值，还通过技术突破、产业链协同和创新应用，全面推动了电子信息制造业的高质量发展。新型显示作为我国战略性新兴产业中新一代信息技术六大细分领域之一，始终发挥着不可替代的基础性作用。

我国新型显示行业经过多年跨越式发展已经成为全球产业中重要的成长极，“十四五”期间表现尤其突出，不仅为全球产业作出卓越贡献，而且也为我国经济平稳增长提供了有力支撑。目前，我国半导体显示面板产业已实现全球领先的产能和市场规模。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业

高质量发展指数（2025）》，我国新型半导体显示行业 2024 年产值规模的同比增速达到 12%，在全球市场中的占比超过 49%；2025 年，我国新型半导体显示行业的产值规模继续保持 5%左右的增长速度，在全球市场进一步提升至约 54%的占比。

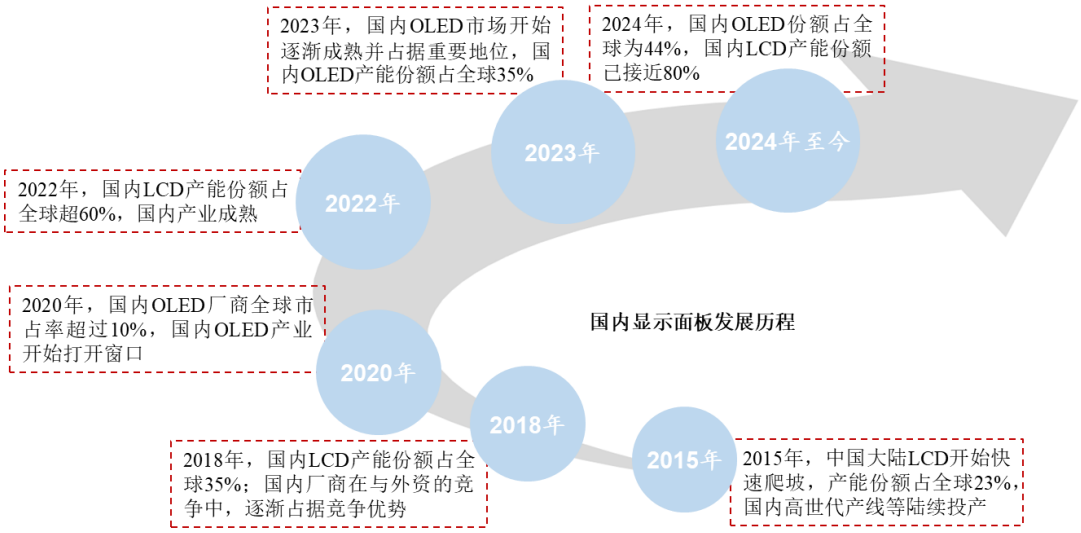
这一规模直接拉动了电子信息制造业的产值增长，并带动了上下游产业链的协同发展，包括装备制造和终端应用等领域。因此，我国半导体显示面板行业能够直接体现国家现代化电子信息制造业和新质生产力的发展水平。

（2）“国产替代”系我国半导体显示面板产业的核心战略发展逻辑

从半导体显示面板产业的发展历史来看，在第一代显像管技术（CRT 技术）时期，中国远远落后西方先进国家并且显示技术的自主程度低，生产线主要依靠进口，彼时显像管合资企业也主要由外国企业主导。

在第二代半导体显示技术（LCD）发展初期，随着 2003 年京东方首条依靠自主技术建设的生产线投建，我国真正逐步建立起来了强大的半导体显示面板产业链体系，并逐步涌现了一批如海思、集创北方等显示驱动芯片优秀企业，使得中国半导体显示面板产业“缺芯少屏”的问题得以解决。中国的 LCD 面板行业在短短二十多年的时间里，全球市场产能份额就从不足 5%增长到目前的 80%左右，成为全球最大的 LCD 面板生产国，中国半导体显示面板产业开始逐步实现国产替代并具备全球竞争力。

经历了 LCD 技术“引进、消化、吸收、自主创新”的过程后，在国产面板龙头厂商的引领下，包括公司在内的核心零部件厂商不断提升技术水平、增强资金实力、扩大产能规模，中国面板行业的世界话语权显著增强。目前，我国在 TFT-LCD、OLED 以及 Mini LED/Micro LED 等新型显示技术领域不再是曾经的“追赶者”，而已经进入行业的“第一梯队”。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型显示行业市场竞争力和技术创新能力均得到了显著提升。



回顾历史，半导体显示面板产业曾经一度是中国电子信息制造业的痛点，与发动机技术、芯片技术共同构成中国工业体系曾经“大而不强”的例证。但经历了数十年的发展和沉淀，我国面板产业在国家支持政策、资金、技术、产业链配套等全面支持下飞速发展，在全球半导体显示面板产业占比过半，成为全球第一大面板产业集中地，摆脱了半导体显示面板产业“卡脖子”的历史问题。

目前，全球半导体显示面板主流技术为 TFT-LCD 及 AMOLED 技术。在 TFT-LCD 技术领域，我国已经全面领先，全球市场占比接近 80%；在 AMOLED 技术领域，我国行业不仅取得了规模领先而且还积极探索了具有一定革新性或颠覆性的升级工艺并率先布局了量产项目。更为重要的是，我国半导体显示行业通过规模效应、技术自主化、产业链协同和全球化布局，全面提升了我国整体电子信息制造业的水平。它不仅奠定了中国在全球显示市场的领导地位，更通过创新应用驱动了电子信息制造业的转型升级，为数字经济时代新质生产力提供了核心支撑。

（3）我国半导体显示面板的崛起离不开配套产业链企业的持续投入和技术创新

中国半导体显示面板产业的崛起改变了全球市场格局。通过国家政策引导和企业投入，我国从过去的面板进口国转变为出口国，产业规模的扩大和技术成熟度提升，使中国成为全球电子信息制造供应链中不可或缺的重要一环。除了发展独立自主的关键技术能力，我国半导体显示面板产业的高质量发展离不开完善的产业链配套建设。

公司系我国龙头半导体显示面板厂商重要的合作伙伴，公司主要产品作为半导体显示面板的关键零部件，其性能、精密程度、产品良率和一致性对显示驱动芯片的控制精度和具体功能实现、面板产线生产良率以及终端消费电子产品的智能化、高端化、集成化等均有着直接影响，是我国包括京东方、和辉光电、深天马等厂商 TFT-LCD、AMOLED 等新型半导体显示技术得以实现、投资数千亿的高世代产线顺利投产并稳定运行的关键组成部分，也是我国半导体显示面板产业转型升级并具备与三星、LG 等全球顶级面板厂商同台竞争的重要影响因素。

自 2014 年成立以来，公司深耕新型半导体显示面板的智能控制卡及精密功能器件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置以及长期持续的研发投入和技术创新，不断实现自身关键产品、关键生产工艺和核心技术的迭代，推动了半导体显示面板产业的深度转型升级，助力我国半导体显示面板产业链逐步实现“卡脖子”技术的突破，促进我国半导体显示面板产业进一步向“高世代”产线、新型显示技术等方向不断前进。

作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，并助力半导体显示面板产业链实现高质量、现代化发展，进而带动公司成长为国内领先、国际一流的专注于半导体显示面板智能控制卡及精密功能器件细分领域的一体化解决方案提供商。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。

整体来看，公司通过创新、创造、创意促进了我国半导体显示面板产业科技成果的高水平应用，推动了我国半导体显示面板行业在全球的发展壮大，助力我国半导体显示面板产业链的升级，有力促进了我国新质生产力的发展，是我国电子信息制造业新质生产力的重要组成部分。未来，随着与人工智能、5G、物联网 IOT 等技术的深度融合，公司也将持续助力并进一步强化我国电子信息制造业的国际竞争力。

2、公司的技术创新性及其表征

自成立以来，公司持续进行研发投入，坚持以研发驱动发展，从而保持对核

心客户、核心技术以及行业趋势的把握和战略布局；同时，公司通过核心技术的应用与迭代不断拓宽产品边界和场景领域，保持持续的经营能力和核心竞争力。报告期内，公司研发费用共计投入约 1.02 亿元。截至报告期末，公司共有专利权 306 项，其中包括 12 项发明专利，另有 46 项发明专利正在申请中，参与了 3 项国家标准的起草制定。

公司被评为国家重点支持专精特新“小巨人”企业、国家智能制造优秀场景、国家级高新技术企业、重庆市“高精度 PCBA 控制板制造数字化车间”、重庆市“高精密 OLED 控制板生产数字化车间”、重庆市知识产权优势企业、中国潜在独角兽企业等，并获得重庆市企业技术中心、重庆市制造业中试平台等资质认定。

截至本招股说明书签署日，公司及子公司获得的资质及荣誉情况如下：

序号	公司名称	荣誉/资质名称	发证部门
1	宇隆科技	重点支持国家级专精特新“小巨人”企业	财政部、工业和信息化部
2	宇隆科技	国家专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
3	宇隆科技、重庆升越达、合肥宇隆、安徽灿宇、福州宇隆、武汉宇隆	高新技术企业	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局；安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局；福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局；湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局
4	宇隆科技	国家智能制造优秀场景	工业和信息化部、国家发改委、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局
5	宇隆科技	重庆市专精特新企业	重庆市经济和信息化委员会
6	重庆升越达、合肥宇隆、安徽灿宇、武汉宇隆	专精特新中小企业	重庆市经济和信息化委员会、安徽省经济和信息化厅
7	安徽灿宇	安徽省专精特新冠军企业	安徽省经济和信息化厅
8	宇隆科技	中国潜在独角兽企业	长城战略研究所
9	宇隆科技	国家绿色工厂	工业和信息化部
10	宇隆科技	重庆市企业技术中心	重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局、重庆海关
11	宇隆科技	重庆市知识产权优势企业	重庆市知识产权局
12	宇隆科技	重庆市中试平台	重庆市经济和信息化委员会
13	宇隆科技、合肥宇隆	数字化车间	重庆市经济和信息化委员会、安徽省经济和信息化厅

公司深耕新型半导体显示面板的智能控制卡及精密功能器件领域，作为起草

单位参与国家标准的起草，主要国家标准的制定体现了公司的行业地位和技术水平，公司参与起草的国家标准如下表所示：

序号	标准类别	标准名称
1	国家标准	印制板用铜箔测试方法（GB/T 29847-2025）
2	国家标准	柔性显示器件 第 6-1 部分：机械试验方法 形变试验（**GB/T 38001.61-2026**）
3	国家标准	电子纸显示器件 第 4-2 部分：环境试验方法（计划号：20241805-T-339）

公司的技术创新性及其表征主要体现如下：

（1）显示用智能控制卡及精密功能器件均随着半导体显示面板技术变革而不断升级迭代，公司已全面覆盖 LCD 及 OLED 主流新型显示技术路线，并实现了 Mini LED/Micro LED 技术路线的前瞻布局

回顾半导体显示技术的发展历程，自最初的 CRT 技术发展到 LCD 技术的出现，再到如今 OLED 技术已实现广泛的商业化应用，显示用智能控制卡作为半导体显示面板的“大脑”，不仅需要负责面板的信号处理和图像控制，还在确保显示效果和面板性能方面起到至关重要的作用。

随着半导体显示面板的分辨率、刷新率、对比度、色彩表现等指标要求的日益提升，其对显示用智能控制卡及精密功能器件的技术要求同步提升，显示用智能控制卡及精密功能器件的技术难度也在此过程中不断升级演变，具体情况如下：

比较指标	CRT 显示技术	LCD 显示技术	OLED 显示技术
代表性技术	单色 CRT、彩色 CRT	早期：DS-LCD 中期：TN-LCD、STN-LCD 目前：TFT-LCD（包括 a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD）	AMOLED（主流）、PMOLED
像素级别	CRT 的分辨率受限于荫罩孔距和荧光点密度，无物理分隔的像素单元，分辨率范围一般在 720P 以下	像素位置精确对应 TFT 阵列，形成规则的网格结构，支持高分辨率，分辨率范围一般在 720P 至 8K	每个像素是独立的有机发光二极管，无需背光；每个像素可单独开关，实现极高的分辨率、无限对比度和真黑色显示；分辨率范围一般在 1080P 以上
响应速度	通常为 1 毫秒	通常为 1-5 毫秒	最快可达 0.01 毫秒
显示控制原理	模拟信号扫描	电压控制液晶分子取向	电流驱动控制像素独立发光
显示控制所需的数据处理量	100Mbps	1.6–48Gbps	25–100Gbps+
显示用智能控制卡 DDIC 和 TCON IC 的数量	不涉及驱动 IC（DDIC）和时序控制 IC（TCON-IC）	通常只有几种优化算法	通常 10 种以上优化算法

比较指标	CRT 显示技术	LCD 显示技术	OLED 显示技术
显示用智能控制卡元器件规格	1-3 PCS/cm^2	4~7 PCS/cm^2	5~9 PCS/cm^2
显示用智能控制卡 PCB 规格	基础 PCB，通常为 4 层板以下	通常 6~8 层 1 阶通孔板 厚度到 0.7mm 左右	通常 8 层以上 HDI 板 厚度到 0.55mm 左右，更窄更薄
显示用智能控制卡作用	通过控制接收视频信号并转换为行/场扫描信号，实现图像传输	通过控制时序生成、数据转换等改变电压实现控制液晶分子取向，相比 CRT 更加复杂	在 LCD 基础上的升级。对每个自发光像素进行精密的“电流”控制，具备实时计算能力，运行复杂的补偿算法来解决 OLED 材料固有的均匀性和寿命问题，相比 LCD 更加复杂
显示用智能控制卡制程	传统的 SMT 贴片，部分器件采用手工插件工艺，器件尺寸大部分均为大型器件，精度和焊接要求低，满足 IPC 一级标准即可，对于产品的品质要求较低	新型自动化贴片生产线制造，对于贴片要求较高。高度自动化、标准化、精密化。从锡膏印刷到回流焊，全程由高精度设备完成，追求的是高效率、高良率、高一致性。焊接满足 IPC610 二级标准即可，部分 IC 类器件需要满足 3 级标准。	它在 LCD 的精密基础上，进一步追求极致。对每一个工艺参数的控制都达到顶峰，以确保最终产品电流控制的绝对精确和可靠，同时还增加了点胶制程，对于 BGA 等高度集成 IC 要求底部 100%填充，进一步加强了产品的可靠性，满足了产品的高精度，高品质和高信赖性的需求。焊接要求满足 IPC610 三级标准。
显示用智能控制卡对核心工艺 SMT 的精度要求	元件尺寸：多为 0805 及以上 芯片封装：SOP，QFP（间距≥0.65mm） 贴装精度：±50um	元件尺寸：0402， 0201 为主流 芯片封装：QFP，QFN，BGA（间距 0.5mm-0.8mm） 贴装精度：±40um～±25um	元件尺寸：0201， 01005 大量使用 芯片封装：精细间距 BGA/CSP（间距≤0.4mm） 贴装精度：±30um～±15um
显示用精密功能器件需要实现的功能、数量和精度	功能器件结构单一，规格较大的缓冲、绝缘、导电类的功能器件产品，产品精度偏低,尺寸公差一般±0.5 以内，且应用率较低,材料性能要求不高	需求更高精密的功能器件，偏向多层复合型,产品公差设计要求±0.15 以内偏多；多数固定、遮光、屏蔽、散热等重要功能使用功能器件替代，整套模组需求大量功能器件支撑其性能	高屏占比、高性能等行业要求，定义了此类功能器件整体支撑性能，高散热、导电、屏蔽等性能，多层复合类模切件（SCF、钢片），尺寸公差一般需要达到±0.08 以内，功能器件套件需求量大、一致性要求更高

资料来源：Frost & Sullivan、公开资料整理、中信证券研究

如上表所述，主流显示技术由 CRT 经 LCD 至 OLED 实现三代跃迁，而 LCD 技术更是历经多次技术升级，并持续迭代发展。基于半导体显示面板技术的革新，显示控制单元也从分立式模拟电路发展至集成化数字控制板卡，进而升级到如今的显示用智能控制卡，数据处理量从 100Mbps 升级至 100Gbps，功能亦由单纯的信号调制扩展至像素级电流控制、HDR 元数据处理及动态画质补偿，实现了控制架构的微型化、高速化与智能化迭代。

在显示技术不断迭代的过程中，公司持续把握技术发展趋势，核心产品已全面覆盖 LCD 及 OLED 技术路线。报告期内，公司应用于 OLED 技术产品占比自 2023 年的 18.97%提升至 2025 年的 36.50%，具体情况如下：

单位：万元、%

显示技术终端应用	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
OLED	40,479.81	36.50	45,953.89	42.92	12,903.95	18.97
LCD	69,055.50	62.27	59,126.99	55.22	52,723.94	77.50
其他	1,365.33	1.23	1,993.31	1.86	2,401.21	3.53
核心产品收入合计	**110,900.63**	**100.00**	**107,074.19**	**100.00**	**68,029.10**	**100.00**

注：核心产品收入包括显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件产品

与此同时，在新型 Mini/Micro LED 领域，公司已进行前瞻性的行业技术布局，目前 Mini LED 和 Micro LED 相关技术领域产品已进入试产阶段。随着 TFT-LCD、AMOLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术的不断发展，公司能持续紧跟显示技术发展的演变步伐，在新型显示技术领域占据优势地位。

综上，在如今显示技术迭代速度不断加快、新型技术不断涌现的浪潮中，公司凭借持续的研发创新、先进的工艺技术和稳定的产品品质，始终保持与行业领先技术的同步发展，是公司具备技术创新性的重要体现。

（2）公司主要客户系半导体显示面板行业领先厂商，是公司创新能力和技术水平的直接体现

1）半导体显示面板厂商集中度较高，公司已覆盖下游主流客户，该等客户代表了当今全球主流显示技术的先进水平

公司主要产品终端应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域，相关产品的更新周期较短，伴随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术的发展与推动，进一步加速了终端消费电子厂商以及半导体显示面板厂商的产品升级与技术迭代。下游客户在终端产品更新换代的过程中，不断开展新技术、新工艺、新器件等测试验证，并对其配套零部件产生持续迭代的客观需求。

因此，公司主要客户京东方、和辉光电、深天马等国内半导体显示面板厂商在产品结构、核心技术、应用领域等方面的先进性可以直接反映发行人的技术和工艺水平，也是发行人核心竞争力以及持续创新能力的具体体现。

截至报告期末，公司主要客户的产能份额情况如下：

主要客户	国内产能份额		显示器件或半导体显示面板领域下游主要客户	公司与其合作关系
	LCD	OLED		
京东方	34.47%	42.95%	苹果、华为、海信、小米、OPPO 等	显示用智能控制卡第一大供应商；显示用精密功能器件前五大供应商
和辉光电	-	11.20%	华为、传音控股、联想、Acer、吉利、小米、蔚来等	显示用智能控制卡第一大供应商
深天马	5.99%	15.97%	联想、OPPO、小米、VIVO、索尼等	显示用智能控制卡主要供应商；新建第 8.6 高世代产线显示用智能控制卡第一大供应商
维信诺	-	14.01%	荣耀、小米、OPPO、VIVO 等	中尺寸 OLED 显示用智能控制卡第一大供应商
华星光电	27.37%	10.27%	三星、TCL、索尼、华为、小米等	显示用智能控制卡前五大供应商
惠科股份	20.96%	-	三星、LG、小米、海信、TCL、海尔、联想等	显示用智能控制卡前五大供应商
合计	**88.79%**	**94.40%**	-	-

资料来源：长城证券《深天马 A（000050.SZ）：面板领先企业盈利修复，车载&柔性 OLED 开启成长新周期》，产能份额不包括签约及规划中产能；定期报告、公开资料整理、中信证券研究

注：如无特别说明，本招股说明书中，维信诺包括维信诺及其参股公司合肥维信诺、广州国显等。

如上表所述，公司主要客户产能已占据国内 LCD 领域 88.79%、国内 OLED 领域 94.40%的份额，该等客户代表了当今全球主流显示技术的先进水平。

作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，进入半导体显示面板龙头厂商京东方的供应链体系并逐步成为其显示用智能控制卡业务的第一大供应商；此后，公司相继进入和辉光电、华星光电、惠科股份、维信诺、深天马等面板厂商的供应链体系，实现了对半导体显示面板行业主要龙头企业的广泛覆盖。

从终端客户来看，国内主要半导体显示面板覆盖的终端品牌包括了苹果、华为、联想、荣耀、华硕、戴尔、惠普等全球知名厂商，该等终端客户代表了当今全球主流消费电子产品的顶尖水平，亦对搭载的半导体显示面板及其配套显示用智能控制卡、显示用精密功能器件提出了最高的产品标准和技术要求，覆盖了包括平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等各个领域。

2）公司已覆盖国内市场份额超过 80%的主要半导体显示面板厂商，并对该等面板厂商的高世代 LCD 及主流 OLED 产线实现了广泛覆盖

在半导体显示面板行业中，“高世代线”是指按照生产线所应用的玻璃基板尺寸划分的大尺寸产线，通常将 LCD 第 8 代以上适宜切割中大尺寸面板的产线称为高世代线。半导体显示面板高世代线的技术突破有效提升了中大尺寸显示面板的生产效率、降低生产成本。因此，高世代线是半导体显示面板行业的重要发展方向，通过技术革新和降本增效，为中大尺寸显示面板的大规模普及和新型显示技术的产业化应用提供了坚实的基础。

OLED 产线（目前主流为第六代及以上）由于革新的产品结构、工艺制程、机器设备等原因，投资金额远高于同代际的 LCD 产线，OLED 显示面板厂商对于上游配套供应商的研发技术水平、制造交付能力、品质可靠性等亦有着极高的要求。

公司的主要产品广泛应用于国内半导体显示面板厂商高世代 LCD 和 OLED 主流产线，亦是公司技术水平和创新能力的直接体现。截至本招股说明书签署日，公司在下游主要客户高世代 LCD 和主流 OLED 产线的产品覆盖情况如下：

序号	客户名称	高世代 LCD 产线或 主流 OLED 产线数量	公司覆盖数量
1	京东方	12	12
2	和辉光电	1	1
3	深天马	3	2
4	维信诺	2	2
5	惠科股份	4	3
6	华星光电	8	T4 产线已通过认证
合计		**30**	**20**

注：1、LCD 高世代产线指 LCD 第 8 代及以上适宜切割中大尺寸显示面板的产线，OLED 主流产线指 G6 代及以上的产线；2、公司主要为华星光电提供成熟的 LCD 第 6 代产线相关产品，尚未覆盖其高世代产线，其中 T4 高世代产线已通过认证。

综上所述，公司凭借扎实的技术实力、优异的产品性能和稳定的制造交付能力，已实现对国内市场份额超过 80%的主要面板厂商的全面覆盖，同时已完成对该等面板厂商高世代 LCD 及 OLED 主流产线的广泛覆盖。公司已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商、同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商，相关产品终端应用于国际知名公司的旗舰产品，体现了公司的持续竞争力和技术创新能力。

（3）公司通过持续的研发投入和长期深耕行业的经验积累，逐步搭建完善了智能化的工业算法应用数据库和现代化生产管理体系，是公司技术创新实力和持续经营能力的直接体现

由于消费电子及半导体显示面板行业技术迭代、产品升级周期较短且公司新客户、新业务不断拓展，只有能够快速完成新产品开发（包括设计优化、DFM可制造性评估、小批量试制等流程）才能够持续获取下游客户订单，进而保持行业竞争力。

公司基于多年来的产品研发、试产及制造经验，自主搭建并不断完善基于DFM Expert 软件的工业算法应用数据库，即基于公司多年来设计开发的实践积累，导入 3D 设计规则和 3D 器件模型等测试程序和电子元器件数据，至今已累计构建了 20 余万个 3D 器件模型和 1,500 余条设计规则。公司通过模拟仿真软件技术对新产品的设计、可制造性进行模拟评估，识别、优化和输出新产品的最优设计方案，大幅缩短了新产品从前端设计到量产交付期间的开发周期，彻底改变了传统实物试产模式带来的高成本、长耗时、低效率等问题。

与此同时，公司高度重视智能化制造在生产经营中的落实应用。截至报告期末，公司已搭建 MES（生产制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）等现代化生产制造管理系统，实现产品制造信息高度自动化及制造过程的全程可追溯性，并通过 ERP 企业资源计划等实现信息化系统管理，实现采购、生产、销售等关键过程一体化，形成了现代化的智能智造生产运营管理体系。

综上，公司凭借现代化工业算法应用和智能智造运营的技术和经验积累，逐步形成了智能化的工业算法应用数据库和现代化的生产管理体系，构建了自身智能设计、快速开发的能力，提升了产品开发和生产管理效率，大幅缩短新产品的开发周期、降低生产制造成本，助力下游客户大幅缩短面板产品的开发周期和迭代速度，从而快速响应终端消费电子的市场变化，实现了现代化先进信息技术与传统制造业的深度融合，是公司技术创新实力和持续经营能力的直接体现。

3、公司属于现代产业体系及其表征

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，不仅是新质生产力发展的核心引擎，更通过数字化与绿色化转型推动经济发展质效双升，对维

护工业稳定、实现制造强国目标具有不可替代的战略意义。电子信息制造业作为我国工业经济的重要支柱，在稳定经济增长、保障产业链供应链安全、维护国家政治经济安全等方面发挥着关键作用。该行业不仅整体收入规模连续多年位居工业门类首位，更是推动技术创新和产业升级的核心力量。

作为电子信息制造业中新质生产力相关行业的典型代表，新型显示产业的快速发展对保障国家信息安全、提升产业链自主可控能力至关重要，是我国电子信息制造业实现从“最大”到“最强”跨越的重要先锋行业。在关键显示技术领域，我国不仅主导了全球 LCD 产业的升级、迭代，还加速布局 OLED、Mini LED、Micro LED 等前沿技术。目前，中国新型显示产业已形成全球最大的产业集群，根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型半导体显示行业 2024 年产值规模的同比增速达到 12%，在全球市场中的占比超过 49%；2025 年，我国新型半导体显示行业的产值规模继续保持 5%左右的增长速度，在全球市场进一步提升至约 54%的占比。

凭借行业领先的技术创新能力，通过现代化生产要素的配置以及长期的研发投入，公司能够共同参与到下游半导体显示面板厂商的关键零部件开发中，不仅可以快速响应下游客户的需求，亦形成了自主创新和产品迭代能力。截至报告期末，公司已广泛覆盖目前主流半导体显示面板厂商的高世代 LCD 产线和主流 OLED 产线，终端产品直接应用于全球知名终端品牌厂商的消费电子产品，体现了公司的现代化技术水平和创新能力。

报告期内，公司核心技术产品带来的营业收入主要为显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件产品，其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	110,900.63	107,074.19	68,029.10
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
占比	**97.52%**	**97.75%**	**97.52%**

由上表可知，报告期内发行人营业收入主要来自于核心技术产品的销售收入，由核心技术相关产品实现的营业收入比例较高，发行人核心技术已实现产业化。截至本招股说明书签署日，公司已为京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内主流半导体显示面板厂商供应超过千款显示用智能控制

卡产品，覆盖了 TFT-LCD、AMOLED 等主流显示技术类型。公司现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

综上所述，公司主营业务、主要产品、核心技术均聚焦于我国现代化产业体系中的新型半导体显示面板领域，并具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，公司上述能力具备可持续性。

4、公司的成长性及其表征

（1）电子信息制造业是我国稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域，我国已出台相关政策促进行业整体稳定、健康发展

根据工业和信息化部、市场监督管理总局于 2025 年 8 月发布的《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》，“电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域。”该方案旨在通过扩大内需、激发市场潜力、促进传统消费升级，培育壮大包括新型显示在内的多个新兴增长点。

该方案着重要求“强化技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费”，并明确提出主要预期目标为“规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，……，到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4,000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进”。

根据我国 2026 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

公司始终专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，主要产品的核心应用领域主要为新型半导体显示面

板，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司主营业务、主要产品与我国发展电子信息制造业的战略布局高度契合，也将受益于我国电子信息制造业的快速发展，与下游半导体显示面板、消费电子行业终端产品的更新、升级形成同步创新和相互促进的发展道路。

（2）新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术领域的快速发展为半导体显示面板及下游消费电子行业注入新的动能

随着新型显示技术、AI 人工智能、5G 通讯等技术的快速升级进步，全球消费电子产品更新换代速度的加快，消费电子换机换新的市场需求将不断增加，为未来发展注入新的动能。

在新型显示技术领域，LCD 显示面板的市场规模稳定增长，OLED 等新型半导体显示面板的市场规模增量显著。根据群智咨询的统计数据，2024 年全球半导体显示面板产业产值达 1,092 亿美元，预计 2025 年将增长至 1,141 亿美元，增长率达 4.49%，其中 OLED 显示技术的快速发展尤为显著。根据 Frost & Sullivan 的统计，从 2020 年到 2024 年，全球 LCD 显示面板的出货面积整体保持稳定，从 2.5 亿平方米增长至 2.6 亿平方米；全球 OLED 显示面板呈现出快速增长的发展趋势，从 2020 年的 0.1 亿平方米快速增长至 2024 年的 0.2 亿平方米，年复合增长率高达 18.2%。根据 Frost & Sullivan 预测，从 2025 年到 2029 年，全球 LCD 显示面板的出货面积将达到 3.0 亿平方米，实现稳定增长，期间年复合增长率为 2.9%；同期，全球 OLED 显示面板的出货面积将增长至 0.4 亿平方米，保持高速发展态势，期间年复合增长率高达 20.8%。

在 AI 人工智能技术领域，相关技术的普及进一步推动行业变革，并促进形成对半导体显示面板产品的增量需求。根据 Frost & Sullivan 数据，伴随 AI 在端侧大模型能力等方面的系统性升级，预计智能手机出货量 2030 年将达到 1,447.4 百万台，2024 年到 2030 年的年复合增长率为 2.6%。随着生成式 AI 应用场景的不断拓展以及用户认知度的逐步提升，未来这一技术将加速向平板电脑、笔记本电脑等终端普及，Canalys 预测全球 AI PC 市场 2024-2028 年期间的复合年增长率将高达 44%，预计未来两到三年中国 AI PC 市场整体增速为 50%左右。

在 5G 通讯技术领域，5G 网络的规模化部署为高端显示的广泛应用提供坚实支撑。根据中国信通院统计，2024 年我国 5G 手机渗透率已超 86%，全年出货量达 2.72 亿部，直接拉动 OLED 等高端面板的搭载需求。群智咨询数据显示，2025 年，全球 OLED 智能手机面板出货量约 8.9 亿片，同比增长 5.2%。其中柔性 OLED 出货量约 6.9 亿片，同比增长约 9.6%。随着全球手机市场进入存量阶段，5G 通讯技术成为发展的新动能。此外，车载显示、智能座舱、AR/VR 等新兴场景持续扩张，多屏化、多场景、大尺寸化等趋势显著，均对半导体显示面板形成广泛需求。

此外，下一代 6G 通讯技术正处于从愿景研究向关键技术攻关和标准制定过渡的关键时期。2022—2025 年，我国已顺利完成第一阶段 6G 关键技术试验，形成超过 300 项关键技术储备。目前正在启动第二阶段技术方案试验。6G 通讯技术在“十五五”时期将重点开展标准研制与产业研发，预计在 2030 年左右启动商业应用。到 2035 年将实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的 6G 产业及应用市场。预计未来几年，技术方案试验和系统组网试验将逐步展开。按照当前规划，6G 有望在 2030 年左右实现商用，届时将开启万物智联的新时代，为沉浸式通信、智能工业、数字孪生等应用提供基础支撑，从“需求侧”拉动显示面板向更高性能、更多形态、更低功耗的方向升级。这一过程将加速显示技术的迭代，并促使面板企业提前布局相关产能与技术研发。

整体来看，新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术领域的深度融合不仅加速了半导体显示面板向高分辨率、柔性化、智能化的升级，也为包括公司在内的半导体显示面板和消费电子产业链创造了新的增长动能和发展机遇。

（3）我国半导体显示面板龙头企业国际竞争力不断增强，为我国电子信息制造服务业企业打开全球市场

经过多年发展，全球半导体显示行业已经达到千亿美元规模。根据群智咨询统计及预测，2022 年至 2024 年全球半导体显示面板产业产值分别为 1,003 亿美元、959 亿美元和 1,092 亿美元，预计 2025-2027 年将持续保持增长，分别将达到 1,141 亿美元、1,161 亿美元和 1,202 亿美元，市场前景广阔。

根据群智咨询数据，2024 年中国大陆半导体显示面板厂商在全球 LCD 显示

面板市场继续保持领先地位，全球市场份额占比为 65%，根据群智咨询数据，到 2025 年中国 LCD 半导体显示面板产量将占据全球 73%的市场份额，进一步巩固其全球供应中心地位；在 OLED 领域，中国厂商同样取得显著成绩，根据群智咨询数据，2025 年中国大陆 OLED 面板占全球的出货份额比例达到 49.3%。

中国企业依托本土半导体显示面板优势实现整体发展，细分领域的核心供应商可借助头部面板客户的全球扩张迎来业绩增长的新空间。作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。随着公司主要客户于全球市场份额的逐步扩大，我国电子信息制造服务业迈向全球市场也将成为公司业绩持续增长的关键影响因素。

二、公司所属行业的基本情况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主要产品属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局颁布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司主营业务属于“1.2 电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”领域中的“显示器件制造”；根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属行业属于国家鼓励类产业中的“二十八、信息产业”之“8.显示屏元器件制造及生产专用设备”及“5.新型电子元器件制造”，符合国家产业政策。

（二）行业主管部门、监管体制、法律法规及政策

1、行业主管部门及管理体制

发行人所属行业主管部门为工业和信息化部，行业自律性组织包括中国电子电路行业协会（CPCA）、中国电子企业协会等。

工业和信息化部主要负责拟订并组织实施行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织实施，监测工业行业日常运行，指导行业质量管理工作，提出优化产业

布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

中国电子电路行业协会（CPCA）成立于 1990 年 6 月，是世界电子电路理事会 WECC 的成员之一，由印制电路 PCB、覆铜箔板 CCL 等原辅材料、专用设备以及部分电子装联 SMT 和电子制造服务 EMS 的企业以及相关的科研院校组成。其职能包括：发动企业参与制订 CPCA 标准和 WECC 标准，并与 IPC 和 JPCA 制订联合标准；参与海关用语和单耗的制订；编辑出版印制电路信息报刊和专业书籍；主办每年 CPCA 展览会；每年国际 PCB 信息/技术论坛；开展职工技能培训和各类讲座等。

中国电子企业协会是由从事电子信息产品研究、开发、生产、经营销售、信息服务等企业单位或个人自愿结成的全国非营利性的社会组织，主要职责包括为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议；组织培训电子企业经营管理人员和技术人员；组织电子企业开展国际经济技术交流活动；编辑出版有关电子企业改革、发展与管理的刊物、书籍与资料等。

2、行业内重要法律法规、产业政策对发行人的影响

发行人所处行业为电子信息制造业，主要产品及服务主要应用于下游半导体显示面板行业，主要客户为半导体显示面板厂商，终端客户为消费电子终端品牌商，是电子信息产品智能化、集成化、多功能化、高品质用户体验的重要产业支撑，是国家鼓励发展的产业，享受多项政策支持。所涉及的主要法律法规及政策如下：

序号	单位	政策名称	发布时间	主要相关内容
1	工信部	《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》	2026 年 6 月	到 2028 年，人工智能与信息通信初步构建融合互促的创新发展格局。加强高端光电芯片和器件研发。大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系
2	十四届全国人大会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	2026 年 3 月	推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料。壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平
3	国家发展改革委、财政部	《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧	2025 年 12 月	支持家电以旧换新。个人消费者购买电视、电脑等 6 类家电中 1 级能效或水效标准的产品，按产品销售价格的 15%给予补贴；支持数码和智能产品购新。个人消

序号	单位	政策名称	发布时间	主要相关内容
		换新政策的通知》		费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等 4 类产品，按产品销售价格的 15%给予补贴
4	工信部、国家发展改革委等六部门	《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》	2025 年 11 月	到 2027 年，消费品供给结构明显优化，形成 3 个万亿级消费领域和 10 个千亿级消费热点。加快布局新领域新赛道，聚焦智能网联新能源汽车、智能家居、消费电子、现代纺织、食品、绿色建材等重点行业。强化人工智能融合赋能，推动人工智能在消费品全行业全领域全过程应用，推广生成式人工智能、3D 数字化设计等新工具
5	商务部、国家发展改革委等八部门	《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》	2025 年 9 月	扩大数字产品消费。鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级 3D 打印设备等新产品消费潜力。加快智能家电、智能安防、视频照护系统等研发及互联互通。培育建设新消费品牌，推动数字国潮等品牌创新发展
6	工信部、市场监督管理局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	2025 年 8 月	提出 2025 至 2026 年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费。加力推进电子信息制造业高端化、智能化、绿色化发展，有序推动先进计算、新型显示、服务器、通信设备、智能硬件等重点领域重大项目布局
7	中共中央办公厅、国务院办公厅	《提振消费专项行动方案》	2025 年 3 月	提出大力提振消费，全方位扩大国内需求，以增减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿，加力扩大实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级，实施手机、平板、智能手表（手环）3 类数码产品购新补贴
8	国家发展改革委、财政部	《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》	2025 年 1 月	提出 2025 年将加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策，包括加力支持家电产品以旧换新，继续支持冰箱、洗衣机、电视、电脑等 8 类家电产品以旧换新补贴，1 级能效的电视、电脑产品，补贴标准为产品销售价格的 20%；实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品，按产品销售价格的 15%给予补贴
9	国家发展改革委、工信部等十二部门	《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》	2024 年 11 月	在《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》的基础上，提出到 2027 年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现 5G 规模化应用，带动新型消费扩大升级
10	国务院	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	2024 年 3 月	提出 2025 年将加快实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策，包括加力支持家电、电视等以旧换新，继续支持冰箱、洗衣机、手机等数码产品更新；实施手机等数码产品购新补贴，对个人消费者购买指定数码产品按 15%给予补贴；提出推动消费新格局，其中重点包括“开展家电产品以旧换新”、“鼓励有条件的地区对消费者购买绿色智能家电给予补贴”等
11	工信部、教育部、科技部等七部门	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年 1 月	提出大力发展未来产业，是引领科技进步、带动产业升级、培育新质生产力的战略选择。打造人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G 网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、高端文旅装备、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备等十项创新标志性产品。新型显示作为创新标志性产品之一，要加快量子点显示、全息显示等研究，突破规模化应用。提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化”，将“薄膜光效应晶体管 LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管（OLED）、Mini/Micro LED 显示板等新型平板显示器”列入鼓励类

序号	单位	政策名称	发布时间	主要相关内容
12	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2024年本）》	2023年12月	提出推动制造业高端化、智能化、绿色化，将薄膜光效应晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管（OLED）、Mini/Micro LED显示板等新型平板显示器列入鼓励类
13	工信部、教育部、商务部等七部门	《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》	2023年12月	提出进一步推动视听电子产业高质量发展，培育数字经济发展新空间。面向智慧场景显示需求，推动智慧屏、交互屏、电子白板、电子标牌、商用平板、LED大屏、广告机、数字艺术显示屏及医用显示器等产品创新;提升电视机、音响、手机、平板电脑、LED大屏等优势产品国际竞争力
14	国家统计局	《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》	2023年12月	将“1.2电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”领域之“显示器件制造”的全部产品作为战略性新兴产业产品
15	工信部、财政部	《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》	2023年8月	提出2023年至2024年，我国计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右，手机市场5G手机出货量占比超过85%，75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%。加快信息技术领域关键核心技术创新和迭代应用，加强Micro LED、印刷显示等前瞻性产业布局。面向个人计算、新型显示、VR/AR、5G通讯、智能网联汽车等重点领域，推动电子材料、电子专用设备和电子测量仪器技术攻关，研究建立电子材料产业创新公共服务平台，发挥好集成电路材料生产应用示范平台、国家新材料测试评价平台电子材料行业中心等公共服务功能
16	工信部、科技部等四部门	《新产业标准化领航工程实施方案（2023－2035年）》	2023年8月	提出开展量子点显示、全息显示、视网膜显示等先进技术标准预研。研制Micro LED显示、激光显示、印刷显示等关键技术标准，新一代显示材料、专用设备、工艺器件等关键产品标准，以及面向智慧城市、智能家居、智能终端等场景的应用标准
17	国家发展改革委、工信部等七部门	《关于促进电子产品消费的若干措施》	2023年7月	提出加快推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境，促进电子产品消费有关工作，促进电子产品消费持续恢复
18	国家发展改革委	《关于恢复和扩大消费的措施》	2023年7月	提出利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代。支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景
19	中共中央、国务院	《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》	2022年12月	提出加快发展新产业新产品、壮大战略性新兴产业，强调全面提升信息技术产业核心竞争力以及建设国家新型工业化产业基地，培育世界级先进制造业集群，推动人工智能、新型显示、先进计算等技术创新和应用
20	国家发展改革委、商务部	《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》	2022年10月	提出大力发展先进制造、智能制造、绿色制造、服务型制造，提升现代产业体系竞争力，打造引领高质量发展的强大动力源
21	工信部、教育部等五部门	《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》	2022年10月	提出全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件，促进一体式、分体式等多样化终端产品发展，推进关键技术融合创新、加速多行业多场景应用落地
22	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	2022年1月	着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系
23	国家发展改革委、工信部等十部门	《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》	2021年7月	提出加快新型消费终端成熟。推进基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。推动嵌入式SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实/增强现

序号	单位	政策名称	发布时间	主要相关内容
				实等沉浸式设备工程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平
24	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年3月	提出实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。依托行业龙头企业，加大重要产品和关键核心技术攻关力度，加快工程化产业化突破
25	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划2021-2023年》	2021年1月	重点推广智能终端市场，瞄准智能手机、穿戴式设备、无人机、VR/AR设备、环境监测设备等智能终端市场，推动微型片式阻容元件、微型大电流电感器、微型射频滤波器、微型传感器、微特电机、高端锂电等片式化、微型化、轻型化、柔性化、高性能的电子元器件应用

3、行业政策对发行人经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面的具体影响

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，通过技术创新、规模效应和产业链协同，不仅成为新质生产力发展的核心引擎，更通过数字化与绿色化转型推动经济“质效双升”，对维护工业稳定、实现制造强国目标具有不可替代的战略意义。因此，国务院、各主管部门出台的一系列鼓励行业发展的规划、政策和指导意见，有力推动了我国电子信息制造业及新型显示产业的快速蓬勃发展，也为公司的发展带来了良好的生产经营环境和发展机遇，有助于公司进一步快速发展。

作为电子信息制造业中新质生产力的典型代表，新型半导体显示产业的快速发展对保障国家信息安全、提升产业链自主可控能力至关重要。其发展直接关系到新一代信息技术产业健康和数字信息“最后一米”的安全呈现，是我国电子信息制造业实现从“最大”到“最强”的跨越重要先锋行业。

根据工业和信息化部、市场监督管理总局于2025年8月发布的《电子信息制造业2025－2026年稳增长行动方案》，“电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域。”该方案旨在通过扩大内需、激发市场潜力、促进传统消费升级，并培育壮大包括新型显示在内的多个新兴增长点。特别地，该方案要求“强化技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费。”

根据我国2026年3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五

个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，主要产品的核心应用领域为新型半导体显示面板，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司主营业务、主要产品与我国发展电子信息制造业、促进国内外市场畅通经济循环的关键领域深度契合，公司也将受益于电子信息制造业的快速发展，与下游半导体显示面板、消费电子行业终端产品的更新、升级形成同步创新和相互促进的发展道路。

报告期内，新制定颁布的行业法律法规、政策未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、行业竞争格局等方面造成影响。

（三）所属行业特点、发展趋势及发行人自身情况

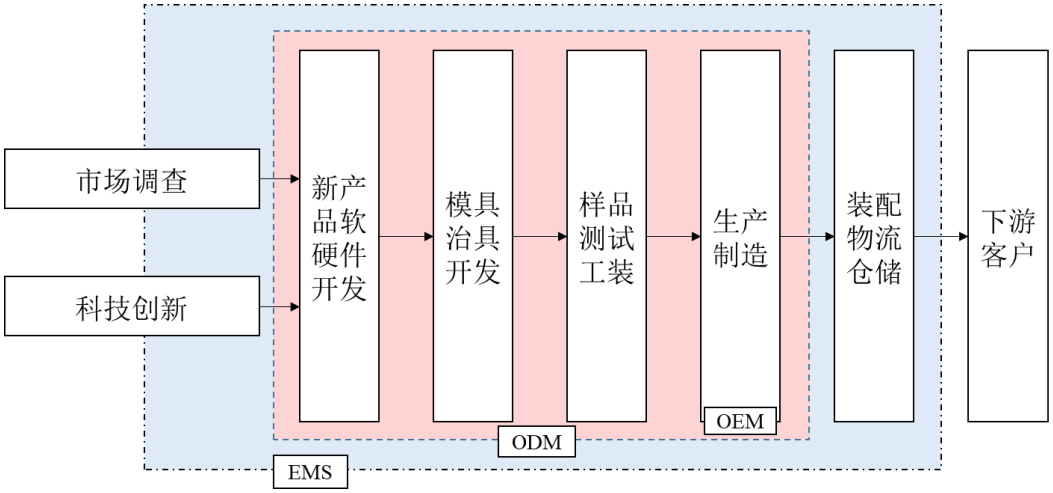
1、公司所属行业技术水平及特点、在产业链中的地位和作用，与上下游行业之间的关联性

公司系现代化专业电子制造服务（EMS）的解决方案提供商，所处行业为电子信息制造业。EMS 行业起源于快速兴起的电子制造行业，传统电子制造企业将设计、营销和品牌作为竞争的核心，进化为电子品牌商，同时将大量制造类业务专业外包，衍生出电子制造服务行业。随着产业链分工的进一步细化以及上下游合作模式的不断完善，现代化 EMS 厂商已具备为品牌客户提供涵盖产品设计、工程开发、物料采购与管理、生产制造、物流运输、测试及售后服务等各环节的综合服务能力，业务范围已全面覆盖整个产品生命周期，具备向下游客户提供整体解决方案的能力，行业市场规模逐渐增大。

随着各类电子产品的不断升级迭代，EMS 行业经过持续革新已逐渐成为全球电子产业垂直分工体系的重要一环。随着 AI 人工智能、5G 通讯等新技术应用场景多元化和应用深化，客户需求更加多样化、个性化，且新技术新产品迭代和

更新频率加快，对于 EMS 厂商的研发设计能力、柔性制造能力、服务响应速度、后端检测服务能力等提出了更高要求。

EMS 行业的产业链如下所示：

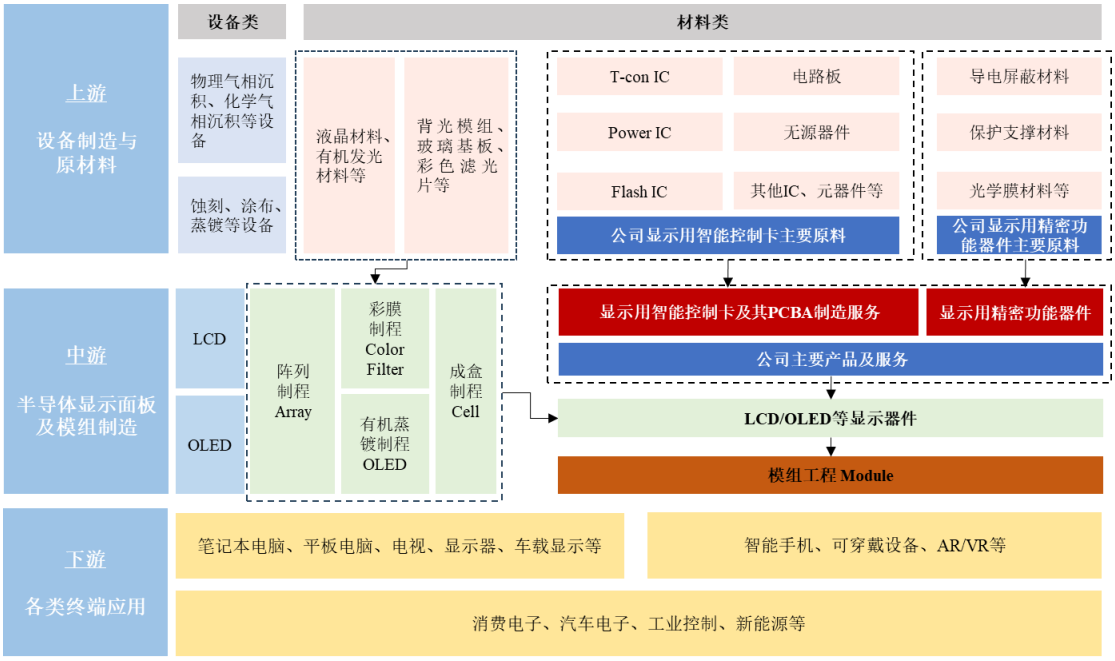


资料来源：金百泽《招股说明书》、中信证券研究

在终端消费电子产品需求快速增长的背景下，全球 EMS 业务规模也随之增长，产生了一批专业从事 EMS 服务的国际性企业，如富士康、立讯精密；而公司通过差异化战略布局，以半导体显示面板为核心应用领域，长期服务于我国具有国际竞争力、先进制造工艺的半导体显示面板领先厂商。自成立以来，公司业务规模稳步增长，现已发展成为该细分行业领域的领先企业之一。

就具体产品而言，公司主要产品为显示用智能控制卡和显示用精密功能器件，系半导体显示面板的关键零部件。其中，显示用智能控制卡系半导体显示面板的“大脑”和控制器；显示用精密功能器件是保证下游终端产品显示功能正常运作的重要辅助器件，其性能和品质的好坏直接影响着终端产品的质量、性能、可靠性、使用寿命等。因此，半导体显示面板厂商与半导体显示面板 EMS 厂商、终端品牌方一般会建立长期稳定的合作关系，以保证稳定的产品良率和产品一致性。

公司显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件产品在半导体显示面板产业中所处的位置如下：



注：模组工程（Module）对于LCD或OLED显示面板存在一定差异。其中，LCD面板生产过程中，模组工程主要包括：切割、磨边、液晶盒进行偏贴、芯片（IC）绑定、涂胶、PCB板绑定、背光组装等工序，最终形成LCD显示模组；OLED面板生产过程中，模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定、盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。

如上图所示，在半导体显示面板产业链中，公司为中游半导体显示面板厂商提供符合终端消费电子品牌商所需的显示用智能控制卡及精密功能器件产品，主要用于半导体显示产业链的“模组工程”环节。

2、公司所处行业的发展态势

（1）电子制造服务业发展趋势

电子制造服务业（Electronics Manufacturing Services，EMS）是全球电子信息制造体系中最核心的组成部分之一，承担着电子产品从设计、元器件采购、印制电路板组装到整机制造、测试及物流交付等关键环节。

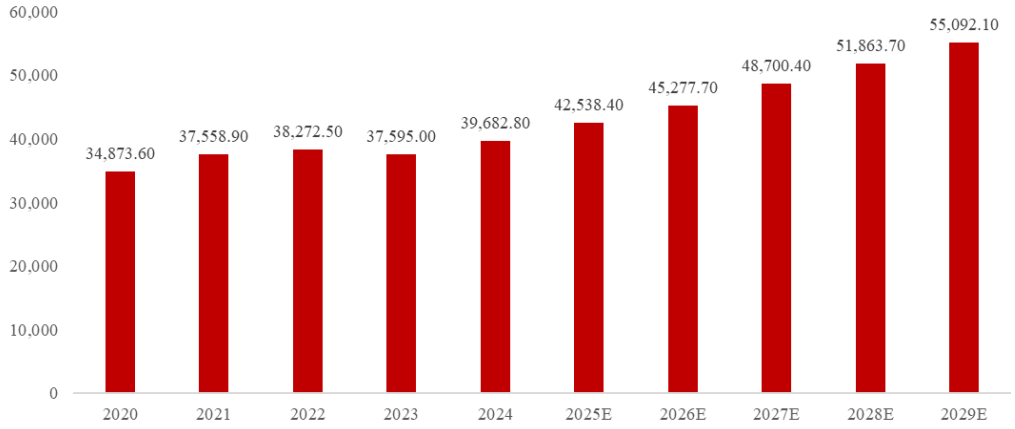
EMS 业务模式是全球电子制造业目前最主流的业务模式，也是全球电子产业链专业化分工的结果，其产生和发展得益于全球电子产品制造外包业务的推动。为了降低生产成本和争取更早的新产品上市时间，品牌商将产品生产和部分设计流程外包给其他企业，EMS 行业应运而生，并成为国际电子信息制造业产业链的重要一环。

凭借其在规模化生产、成本控制和供应链协同方面的显著优势，EMS 已成为全球电子制造体系高效运转的重要基础环节，目前 EMS 厂商主要为客户提供研发设计、原料采购、产品制造、物流配送以及售后服务等一系列服务。EMS

厂商现已成为支撑全球消费电子、通信设备、汽车电子及显示模组等终端产品量产化的关键平台。

从市场规模来看，全球电子制造服务业在近年持续保持稳健增长，市场规模从 2020 年的约为人民币 34,873.6 亿元增长至 2024 年的 39,682.8 亿元，预计到 2029 年将达到 55,092.1 亿元，2025 年至 2029 年期间的年复合增长率约为 6.7%。其中，中国是全球电子制造服务业的核心所在，其产业链完整度高、制造配套体系完善、生产能力强大，已成为全球电子制造产能最集中的国家。2024 年，中国 EMS 市场规模占全球总量超过一半，是全球最大的电子制造服务市场，对全球电子产品的稳定供应具有重要作用。

全球 EMS 市场规模 2020-2029E（亿元）



数据来源：Frost & Sullivan

（2）半导体显示面板行业发展趋势

1）行业概况

现代显示技术主要分为阴极射线管（CRT）和半导体显示技术，随着材料技术的发展，阴极射线管显示不断减少。20 世纪 80 年代末，现代显示行业迎来半导体显示技术的时代。随着半导体工艺的进步，半导体显示技术已经取代 CRT 成为全球主流的显示技术。半导体显示技术主要包括液晶显示（LCD）和有机发光二极管显示（OLED）。

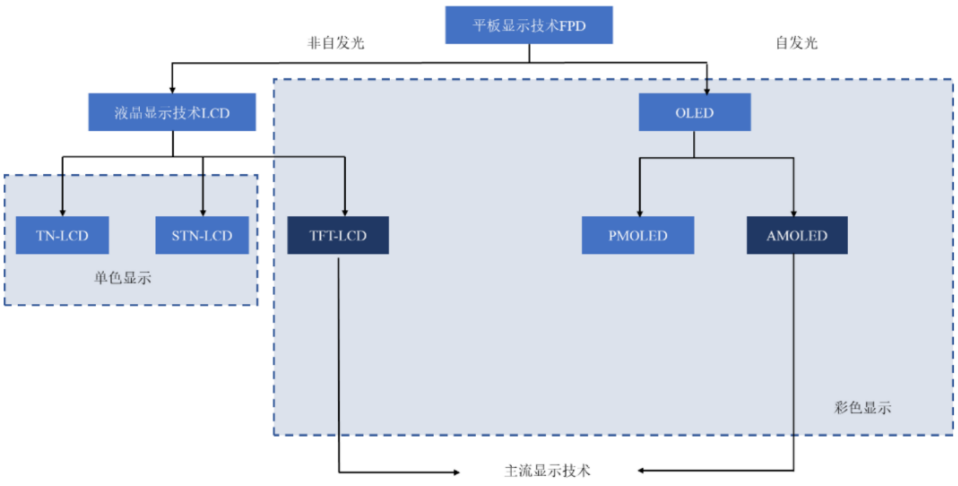


资料来源：《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》

LCD（Liquid Crystal Display），即液晶显示屏，采用液晶层控制光线的方向，本身并不发光，以 LED 的背光作为光源，并通过彩色滤光片来显像。LCD 显示面板成本较低，且具备了体积小、重量轻、耗能少等优势，整体技术较为成熟，其应用领域包括各种显示产品。目前市场上 LCD 主要指的是主动矩阵式的薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）。

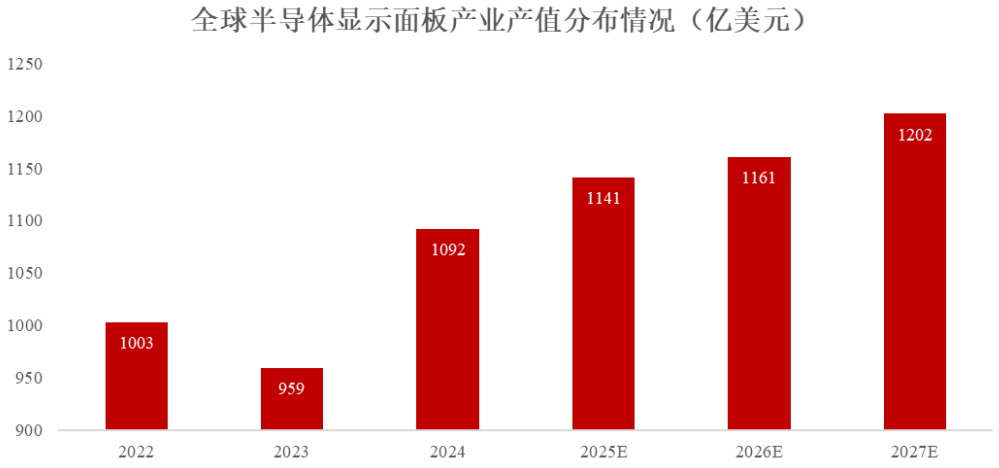
OLED（Organic Light-Emitting Diode），即有机发光二极管，不同于 LCD 显示面板通过背光光源来点亮像素，OLED 显示面板采用自发光技术，通过对逐个像素的控制实现像素点的独立发光，拥有超高对比度、宽广视角、轻薄外形、宽温操作、宽视角、快速响应等特点，主要应用在手机、可穿戴设备、平板电脑、车载显示等。OLED 按驱动技术分为被动式（PMOLED，又称无源驱动 OLED）与主动式（AMOLED，又称有源驱动 OLED）。目前 AMOLED 和 TFT-LCD 是半导体显示技术的主流技术。

半导体显示技术分类情况



资料来源：《京东方科技集团股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》

经过多年发展，全球半导体显示行业已经达到千亿美元规模。根据群智咨询统计及预测，2022 年至 2024 年全球半导体显示面板产业产值分别为 1,003 亿美元、959 亿美元和 1,092 亿美元，预计 2025-2027 年将持续保持增长，分别将达到 1,141 亿美元、1,161 亿美元和 1,202 亿美元，市场前景广阔。



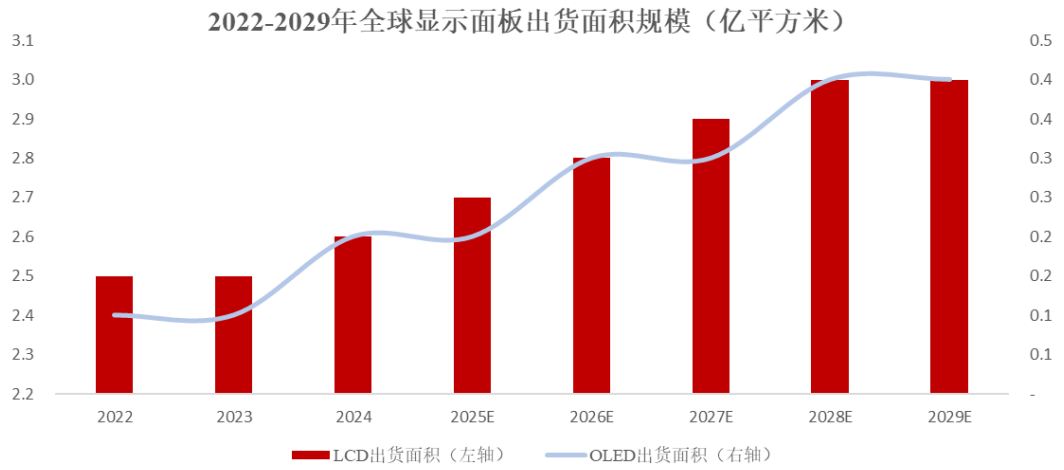
数据来源：群智咨询

目前，半导体显示面板行业呈现技术路线分化、产业分工明确、新型显示驱动增长的发展特征，即 LCD 与 OLED 在不同尺寸及市场领域各自主导，专业化分工推动配套供应链发展，同时半导体显示面板出货面积实现稳步增长。

2）行业发展态势

目前，全球半导体显示面板行业的发展态势在不同显示技术下存在一定差异。一方面，LCD 凭借成本和稳定性优势，持续巩固大尺寸领域；另一方面，OLED 主导智能手机、平板、笔记本电脑的高端市场，同时，也正在加速向车载、医疗等中尺寸领域拓展。

根据 Frost & Sullivan 的统计，从 2020 年到 2024 年，全球 LCD 显示面板的出货面积整体保持稳定，从 2.5 亿平方米增长至 2.6 亿平方米。OLED 显示面板的市场发展较为迅猛，呈现出快速增长的市场发展趋势。在出货面积方面，全球 OLED 显示面板从 2020 年的 0.1 亿平方米快速增长到 2024 年的 0.2 亿平方米，期间的年均复合增长率高达 18.2%。全球半导体显示面板市场正从以 LCD 为主的稳定增长阶段逐步过渡到以 OLED 为核心驱动力的快速增长阶段。



数据来源：Frost & Sullivan

①OLED 行业发展态势

OLED 技术自 2005 年起日趋成熟，逐步走向商业化应用。受益于高对比度、宽广视角等多项优点，OLED 显示面板凭借独特技术优势，近年来在消费电子中高端市场快速崛起，过去几年市场规模持续扩张，OLED 显示面板产业产值从 2017 年的 260 亿美元增长至 2024 年的 417 亿美元，在以智能手机为代表的小尺寸领域渗透率已超过 50%，成为显示行业的核心增长引擎。

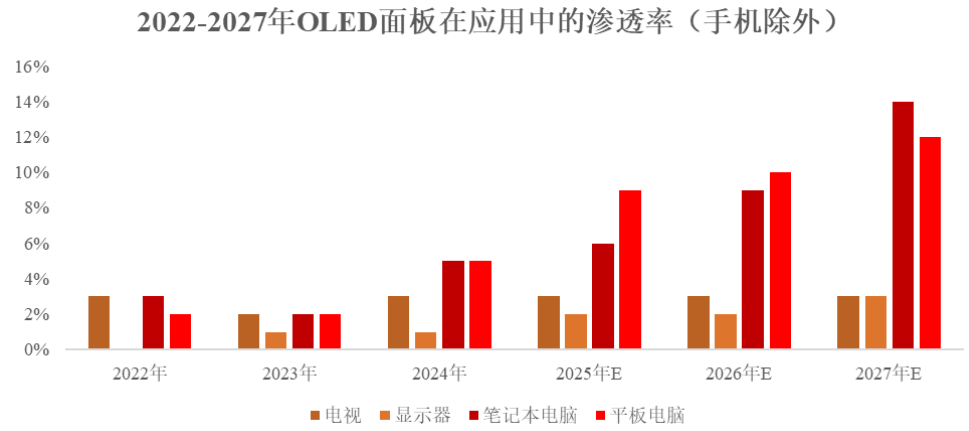
从发展趋势来看，OLED 凭借其技术优势，未来将继续加速向中尺寸渗透。同时，头部终端厂商在未来一段时间内持续推出新型 OLED 产品，对原有机型进行更新迭代，以及 OLED 在新兴显示领域的不断推广应用，该等因素共同拉动 OLED 行业持续发展。

A、小尺寸渗透率已超过 50%，中尺寸显示领域加速渗透

自 2023 年开始，三星显示与京东方开启了对 8.6 代 OLED 产线的投资，面板厂商对 8.6 代 OLED 产线的规划与布局加速。2024 年维信诺宣布在合肥投资 8.6 代 OLED 项目，2025 年华星光电紧随其后，在广州开启 T8 建设的项目。

从 OLED 面板的各尺寸渗透情况来看，根据 Omdia、群智咨询、AVC Revo、UBI Research 等研究机构的统计数据情况，目前 OLED 在以智能手机为代表的小尺寸领域渗透率已超过 50%；2025 年，在以笔记本、平板电脑为代表的中尺寸领域渗透率分别达到 5.9%和 4.4%，到了 2027 年之后渗透率有望超过 12%；显示器领域 2025 年市场渗透率首次突破 2%，在 2027 年有望超过 3%。整体来看，

未来市场空间的增量主要来自于中尺寸领域的突破，中尺寸领域 OLED 面板的使用将进入快速增长期。



数据来源：AVC Revo

B、头部消费电子厂商推动产品世代更替

随着终端品牌苹果的产品规划逐渐向 OLED 市场转移，上游布局 8.6 代 OLED 的面板厂商在争取其供应的权限与份额，IT 产品有望成为高世代 OLED 产能消耗的主力，这也将有望掀起 IT 市场新一轮的技术变革。

以苹果公司为例，苹果已于 2024 年 5 月推出首款搭载 OLED 屏幕的 iPad Pro，并将逐步在 iPad 和 Mac 系列使用 OLED 面板，该两类产品占据全球平板和电脑的市场份额分别达到 40%和 9%，其产品布局将有效带动 OLED 面板在中尺寸显示领域的快速渗透。

根据规划，苹果全面推动 OLED 应用的更迭计划如下：

产品	尺寸	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
iPad Mini	8.3 英寸	LCD				OLED	
iPad Air	10.8 英寸	LCD			OLED		
iPad Pro	11.0 英寸	LCD	OLED				
	13.0 英寸	Mini-LED	OLED				
	20.3 英寸	-				OLED（折叠）	
MacBook Air	13.6 英寸	LCD				OLED	
	15.3 英寸	LCD				OLED	
MacBook Pro	14.2 英寸	Mini-LED			OLED		
	16.2 英寸	Mini-LED			OLED		

资料来源：Omdia

注：上述更迭时间为产品上市时间，对应 OLED 面板需求时间或有所提前

伴随着苹果等头部终端厂商对行业起到的示范效应，各大终端厂商陆续开展对 OLED 产品的规划布局。除苹果外，华为已于 MatePad Pro 平板电脑、MateBook X Pro/ MateBook GT 14/ MateBook 14 笔记本电脑等多款旗舰产品中搭载 OLED 屏幕，并逐步在 Mate 各系列产品中推广应用；三星、戴尔、华硕、惠普、微软等终端厂商均已于其笔记本电脑的旗舰机型中搭载 OLED 屏幕，在中尺寸市场不断发力。

C、拓展新兴显示领域市场

OLED 具有可自发光、拥有高对比度、能够快速响应和柔性显示等特性，在智能座舱、智能穿戴、虚拟现实等新的应用领域具有极大的增长潜力。

具体来看，在智能座舱领域，根据头豹研究院数据，2024 年中国智能座舱市场规模达 941.4 亿元，同比增长 16.6%，预计 2024 年至 2030 年复合增长率为 9.5%。在可穿戴设备领域，根据 Omdia 的预测，2022 年至 2025 年应用在可穿戴设备上的 AMOLED 出货量将从 1.27 亿片增长至 1.46 亿片；在虚拟设备领域，OLED 的高响应度可以有效地减少拖影、残影等现象的发生，提供更加流畅、自然的虚拟环境。根据 IDC 数据，Meta 公司在 2023 年及 2024 年相继推出的新款 VR 头戴设备系列（Meta Quest 3 及 Meta Quest 3S），该系列设备在 2024 年出货量已超过 560 万台，并在 2025 年推出的 Quest Pro 2 中开始搭载了最新的硅基 OLED 显示技术；苹果在 2024 年推出的混合现实（MR）头盔—Vision Pro，销量超过 40 万台，这款设备亦系搭载硅基 OLED 显示技术。

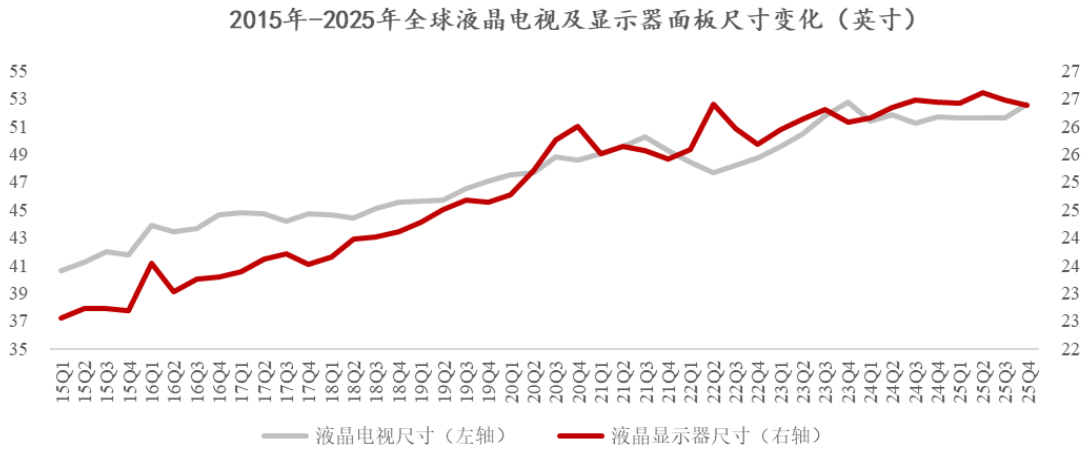
②LCD 行业发展态势

经过二十多年的高速发展后，LCD 显示面板已成为当前显示产业的主导力量。从发展趋势来看，未来 LCD 大尺寸化趋势显著，全球液晶面板平均尺寸增长，有效消化了高世代面板产能；另一方面，技术持续迭代推动应用场景拓展，向 Mini LED 等新型技术升级，LCD 在保持成本和寿命优势的同时，向大尺寸趋势发展并延伸技术曲线，为行业创造新需求与发展机遇。

A、大尺寸化趋势明显，有效消化 LCD 显示面板产能

近年来，受到消费升级及品牌商技术革新的推动，全球液晶面板大尺寸趋势

显著，50 英寸及以上电视需求保持强势增长。根据 WitsView 统计，全球液晶电视面板的平均尺寸由 2015 年的 41 英寸增长到 2025 年的 53 英寸，全球液晶显示器面板的平均尺寸由 2015 年 22.5 英寸增长到 2025 年的 26 英寸，预计 2026 年仍将维持同比增长的趋势，液晶面板平均尺寸的增长可以有效消化高世代 LCD 显示面板产能。



数据来源：WitsView

B、Mini LED 背光等技术推广应用

LCD 显示面板作为产业技术成熟、具有成本优势的技术，自上世纪中叶问世以来，始终以材料、背光与驱动的协同创新延续生命力并不断迭代。早期 LCD 的冷阴极管背光被白光 LED 取代，使模组厚度锐减、功耗显著下降；近年以来，Mini LED 阵列以数千级分区调光将对比度推至百万级，在超高对比度、广色域、高动态范围显示方面可以与 OLED 媲美。

对比项目		LCD	Mini-LED 背光	OLED
显示性能	亮度	>1000nit	>1000nit	<1000nit
	色域	96%NTSC	大于 110%NTSC	108%NTSC
	对比度	5000：1	10000：1	1000000：1
	响应速度	毫秒级	纳秒级	最快 0.01ms
工作性能	功耗	高	低	中，相比 LCD 大约低 30%-50%
	寿命（小时）	60,000	使用寿命较 OLED 长	40,000
量产工艺	适应尺寸	小中大	中大	小中，大尺寸渗透中
	柔性显示	难	可实现曲面显示	容易

对比项目		LCD	Mini-LED 背光	OLED
	厚度（毫米）	厚	厚	薄，1-1.5
	成本	低	中	中
	产业化进展	规模化量产	初步规模量产	规模化量产
应用领域		主导大尺寸市场（电视、显示器），中小尺寸市场应用成熟	中大尺寸市场（电视、显示器）逐步应用渗透	占据中小尺寸高端市场（手机、平板、折叠屏），向中大尺寸持续渗透

数据来源：Frost & Sullivan

同时，LCD 面板内部由 DS 经 TN、TFT 迭代，色彩与对比度等同步跃升；非晶硅薄膜晶体管（TFT）迭代至低温多晶硅（LTPS）材料，载流子迁移率提升一个数量级，为 4K/8K 高分辨率与 240Hz 高刷新提供驱动余量；在 5G 网络逐步规模化应用及 AI 技术创新发展的驱动下，配合 AI 画质芯片的帧级运动补偿与全域光控算法，LCD 在保持成本、寿命等优势的同时，持续刷新自身性能上限，不断迭代自身技术，演进曲线仍在持续延伸，进一步拉动 LCD 显示面板的规模化需求增长与产业革新。

③半导体显示面板行业专业化分工逐渐明确

半导体显示面板行业发展的驱动力之一在于专业化分工带来的生产效率的提升和生产成本的下降。许多半导体显示面板配套供应链企业在专业领域逐步发展壮大，形成了自己的核心竞争力。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，各大半导体显示面板厂商专注于半导体显示面板产品生产制造的核心环节，将显示用智能控制卡及精密功能器件生产等环节交给专业 EMS 企业，提高彼此的专业化分工程度和生产作业效率。从产业链结构看，半导体显示面板厂商与半导体显示面板配套供应链企业之间形成金字塔型的产业链结构，大致形成原材料零部件、半导体显示面板器件、半导体显示面板的供应链体系。

同时，半导体显示面板行业呈现出技术迭代速度快、产品更新速度快的特点，对产品质量、降本增效也具有较高的要求，从而要求产业链配套服务厂商的研发实力、成本管控、产品品质、交付周期等方面需具备较强的持续竞争力。该等行业特点也使得配套制造领域的专业化分工更为明确，产业链层级更加清晰，上游半导体显示面板厂商为发挥各自专业优势，进一步将供应链相关环节交付予更加专业的供应商，产业分工化趋势带来相关供应商在特定环节中获得更大份额、更

高壁垒与规模溢价，也将带来配套服务环节的市场空间的整体提升。

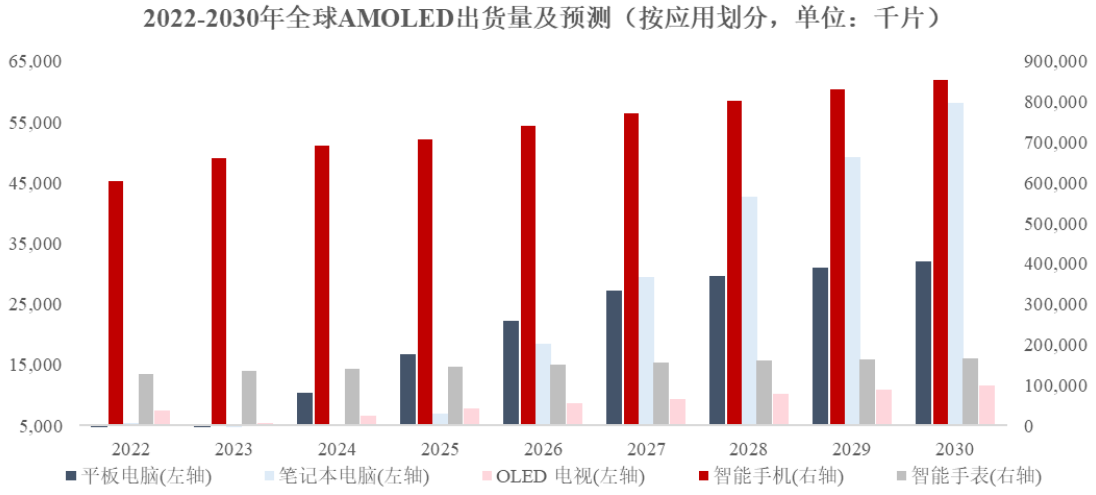
3）市场供需关系及竞争格局情况

①OLED 显示面板行业供需关系及竞争格局

A、供需关系

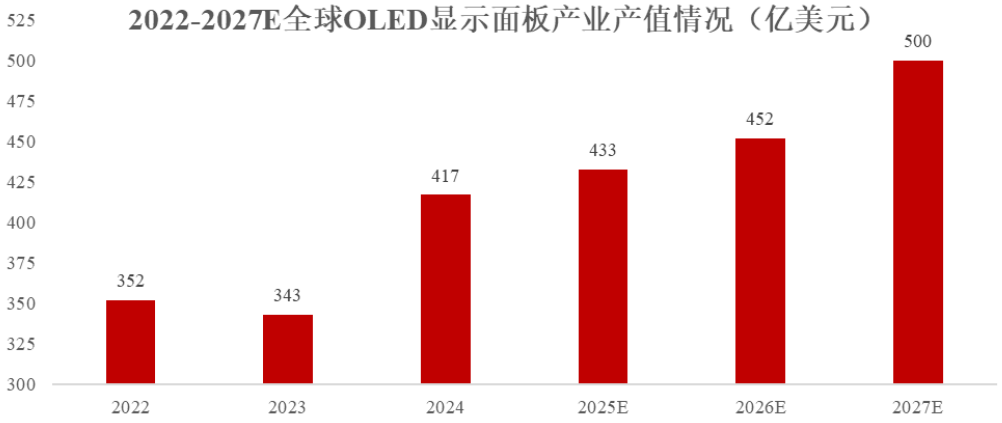
如前所述，OLED 行业正在向中大尺寸显示领域加速渗透、头部厂商持续推出新型 OLED 产品、同时拓展新兴显示领域市场。在该等趋势下，OLED 显示面板的市场需求持续提升。

在出货量方面，OLED 显示面板在平板、笔记本电脑等领域的出货量快速增长。根据 Omdia 数据统计，2024 年，应用于平板、笔记本电脑的 OLED 显示面板出货量为 1,032.5 万片和 510.6 万片，2025 年预计增长至 1,673.6 万片和 698.3 万片，增长率分别为 62%和 37%，远期亦将持续维持高增长态势。除平板、笔记本电脑领域的应用外，OLED 显示面板出货量及预测按应用情况划分如下：



数据来源：Omdia

在行业市场产值方面，全球 OLED 显示面板产值从 2017 年的 260 亿美元快速增长到 2024 年的 417 亿美元，2024 年的增长率达到 22%。未来，得益于 OLED 技术在柔性可塑性、高对比度、更广色域、更薄设计以及自发光特性等方面的显著优势，市场需求持续释放，预计全球 OLED 显示面板产值将在 2027 年达到 500 亿美元。整体来看，全球半导体显示面板市场正逐步过渡到以 OLED 为核心驱动力的快速增长阶段。



数据来源：群智咨询

为了打造更具成本优势和经济效益的 OLED 产线，从而响应中尺寸 OLED 消费电子等产品的高速增长需求，国内外半导体显示面板厂商快速推进最新第 8.6 代 OLED 产线建设。由于第 8.6 代 OLED 产线提高了基板尺寸，从而能够大幅提升中大尺寸面板的切割效率。

国内厂商京东方、维信诺，以及韩国厂商三星显示均已投建第 8.6 代 OLED 产线，致力于拓展以平板、笔记本电脑等为代表的中尺寸应用领域，推动 OLED 显示产业迈进中尺寸发展阶段。当前 OLED 显示面板行业新增产能较多，且主要集中在第 8.6 代产线与新兴应用领域。该等厂商新投建产线情况如下所示：

名称	产线类型	产品应用领域	投资额	建设进度
京东方	8.6 代 OLED 产线	平板、笔记本电脑等	约 630 亿元	2024 年 9 月全面封顶，2025 年 5 月首批设备已搬入，2025 年 12 月成功点亮一期产线
维信诺	8.6 代 OLED 产线	平板、笔记本电脑等	约 550 亿元	2024 年 9 月全面开工，2025 年 10 月封顶，部分设备采购已经开始招标，2026 年 3 月完成厂房建设交付
华星光电	8.6 代 OLED 产线	平板、笔记本电脑等	约 295 亿元	2025 年 10 月开工，建设中
三星显示	8.6 代 OLED 产线	平板、笔记本电脑等	约 215 亿元	2024 年 3 月设备导入，2026 年 1 月已实现量产
LG	6 代 OLED 产线扩建	下一代移动设备	约 37 亿元	2025 年 6 月宣布投资，预计 2027 年 6 月完成投资

资料来源：公开资料整理、中信证券研究

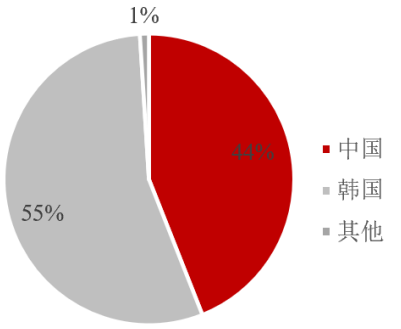
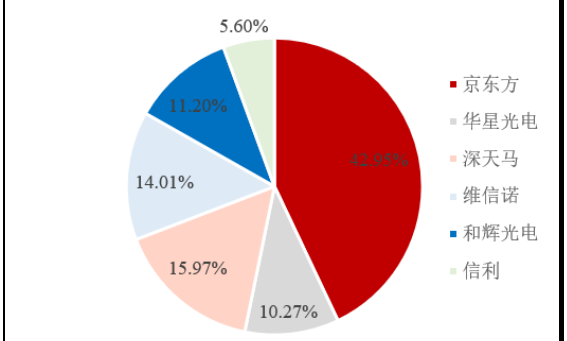
核心厂商战略布局、技术成熟度提升与产业链配套完善，共同推动了 OLED 产能持续扩张。一方面，头部面板厂商为抢占技术优势与市场份额，主动加大资本投入，规划 OLED 新建或扩建产线，以覆盖高端消费电子、车载显示等多元需求场景。另一方面，OLED 制造技术逐步成熟，关键工艺的技术进步降低了产能释放的技术门槛。随着 OLED 上游材料、控制卡等供应链日益完善，供应链

稳定性持续增强，为新增产能的落地与爬坡提供了充足支撑，进一步推动了行业新增产能的扩张。

B、竞争格局

从 OLED 显示面板细分市场来看，2024 年，全球 OLED 显示面板市场的竞争格局相较 LCD 更加集中，头部厂商在技术和市场份额上占据绝对优势。根据 CINNO Research 数据显示，韩国占据了 OLED 行业 55%的市场份额，中国紧随其后占据了 44%的市场份额，对韩国产业的市场地位构成了挑战。2025 年，根据群智咨询数据，中国大陆 OLED 面板占全球的出货份额比例达到 49.3%。

按产能统计，京东方、华星光电、深天马、维信诺及和辉光电占据了国内 OLED 市场产能的主要份额，京东方以 42.95%的产能份额位居第一。当前 OLED 显示面板市场在全球范围内正处于快速发展阶段，头部厂商通过持续的技术迭代和高端产品布局，进一步巩固了其在行业中的领导地位。

全球 OLED 面板市场各地区份额	中国 OLED 面板产能份额
	

数据来源：CINNO Research、长城证券

随着 OLED 在柔性显示、透明显示和新兴应用领域的加速推广，市场竞争将更加激烈，而规模化生产与技术创新将成为企业持续提升市场份额的关键因素。

②LCD 显示面板行业供需关系及竞争格局

A、供需关系

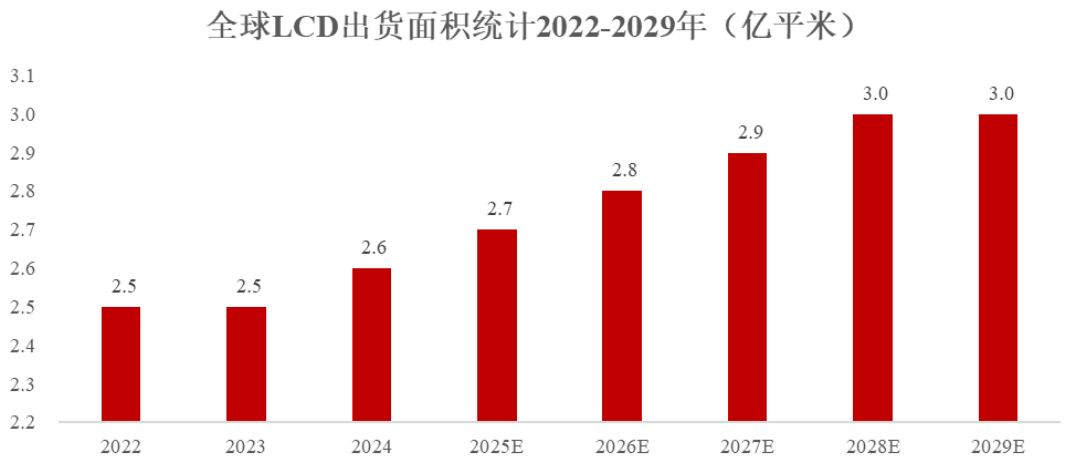
如前所述，LCD 行业正在向大尺寸化趋势升级，同时新型 Mini LED 背光等技术推广应用，进一步强化了 LCD 行业的未来发展动力。在该等趋势下，LCD 行业整体规模预计稳中有升。

一方面，随着 LCD 逐渐向大尺寸方面发展，全球大尺寸 LCD 面板出货面积

需求整体提升，半导体显示面板大尺寸化成了 LCD 面板发展的主要动力。根据 WitsView 统计数据显示，2024 年全球中大尺寸 LCD 面板（平板电脑、笔记本电脑、显示器及电视）出货面积达到 2.3 亿平方米，较 2023 年增长超过 5%。2025 年，全球中大尺寸 LCD 面板出货面积达到 2.4 亿平方米，较 2024 年增长 4.85%。

另一方面，在技术迭代的推动下，Mini LED 背光技术逐渐带来了 LCD 行业新的需求增量。近年来，随着 Mini LED 背光技术不断成熟以及消费者对高分辨率、高对比度显示需求逐渐增加，叠加中国电视品牌厂商积极推进 Mini LED 背光技术商业化进程，全球 Mini LED 背光产品产值快速增长。群智咨询数据显示，全球 Mini LED 背光产品产值由 2020 年 2 亿美元快速增长至 2024 年的 25 亿美元，预计 2027 年将达到 45 亿美元，2024 年至 2027 年复合年均增长率为 21.64%。

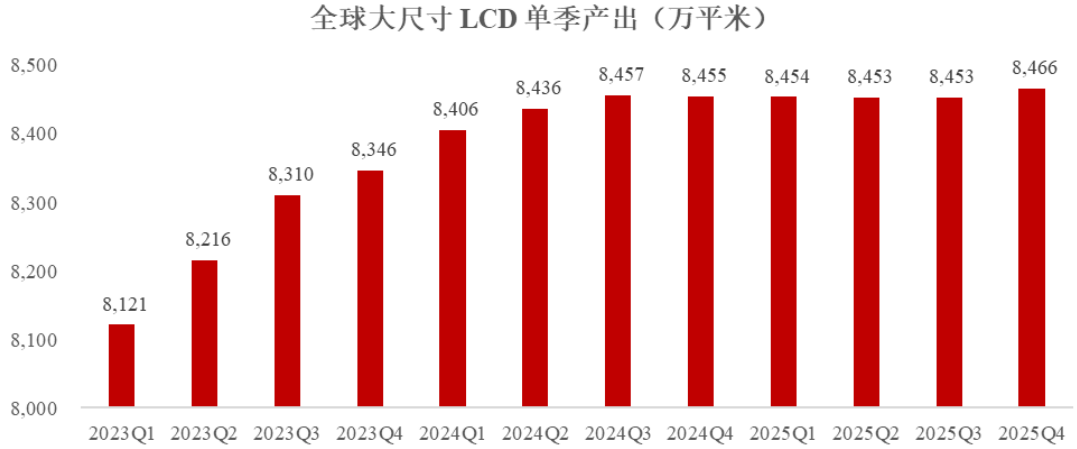
目前，LCD 作为市场主流显示技术类型，仍占据了绝大部分市场份额。从 2022 年到 2024 年，全球 LCD 显示面板的出货面积整体保持稳定，从 2.5 亿平方米增长至 2.6 亿平方米。得益于 LCD 技术的成熟性和稳定性，LCD 面板在电视、显示器、笔记本电脑等领域拥有广泛的需求。随着全球对高清显示和大尺寸屏幕需求的持续增长，LCD 显示面板市场尽管增速放缓，但仍保持稳健增长，预计到 2029 年全球 LCD 显示面板的出货面积将达到 3.0 亿平方米，2024 年到 2029 年期间年复合增长率将达到 2.9%。



数据来源：Frost & Sullivan

在需求端预计保持温和增长的同时，LCD 行业供给端的优化也将不断深化。在当前半导体显示面板市场中，LCD 面板的产能规模依然占据绝对主导地位，全球 LCD 产能未来几年的年均增长率将在 1%左右，也将保持较为平稳的态势。

尽管部分韩系厂商逐步退出中低端 LCD 领域，但国内头部企业通过产能优化，投建高世代 LCD 产线，同时进行技术升级填补了市场供给，使得行业在调整中保持供给稳定。根据国信证券研究报告，2023 年至 2025 年，全球大尺寸 LCD 的产能温和增长，2024 年大尺寸 LCD 产能同比增长 2.3%，2025 年全球大尺寸 LCD 产能面积较 2024 年增长 0.21%。



数据来源：国信证券研究所

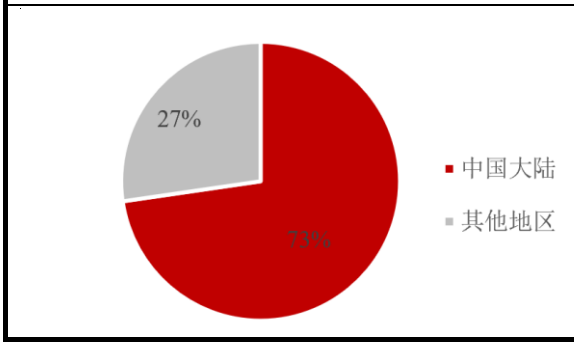
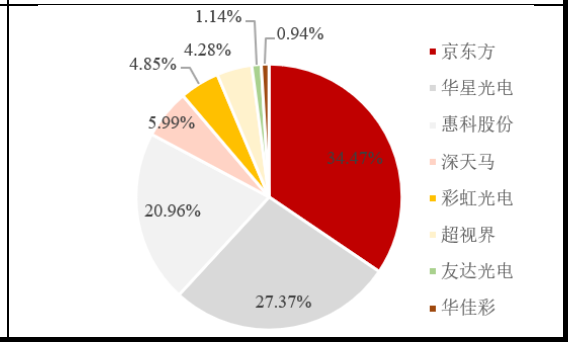
整体来看，此前 LCD 高世代产线建设形成的产能基础依然稳固，且 LCD 作为成熟显示技术，现有产线的设备折旧与生产工艺已进入稳定阶段，短期内全面退出或转型的成本较高，产能持续运行更为经济。LCD 凭借成熟的产业链、可控的生产成本以及在大尺寸显示领域的优势，以及技术持续迭代推动应用场景拓展，仍保持着可观的市场需求，进一步促使存量产能持续发挥作用。

综上所述，目前 LCD 显示面板存量产能仍较大，为产业链配套企业提供了广阔的需求空间。

B、竞争格局

随着全球 LCD 产能加速向中国大陆厂商转移，LCD 产业集中度将进一步提升，竞争格局也将持续改善。从 LCD 显示面板细分市场来看，2024 年，全球 LCD 显示面板市场竞争格局较为集中，国内占据了全球 LCD 接近 70%的市场份额。

按产能统计，京东方、华星光电、惠科股份及深天马占据了国内 LCD 市场产能的主要份额，京东方以 34.47%的产能份额位居第一。当前国内 LCD 显示面板厂商的制造能力、技术研发和全球供应链管理方面的深厚积累，使其在行业中占据了绝对优势。

全球 LCD 面板市场各地区份额	中国 LCD 面板产能份额
	

数据来源：群智咨询、长城证券

未来，随着大尺寸、高世代 LCD 产线全面释放产能，市场竞争的重点将逐步向效率提升和高端产品布局转移。

（3）公司所处细分领域行业发展趋势

1）显示用智能控制卡行业

显示用智能控制卡产品是半导体显示面板中用于输出信号、控制屏幕画面显示的核心部件，其通过信号传输驱动显示屏幕。显示用智能控制卡行业服务于下游半导体显示面板行业，其行业发展与下游半导体显示面板的需求密切相关，终端应用主要涵盖消费电子、汽车电子等领域。

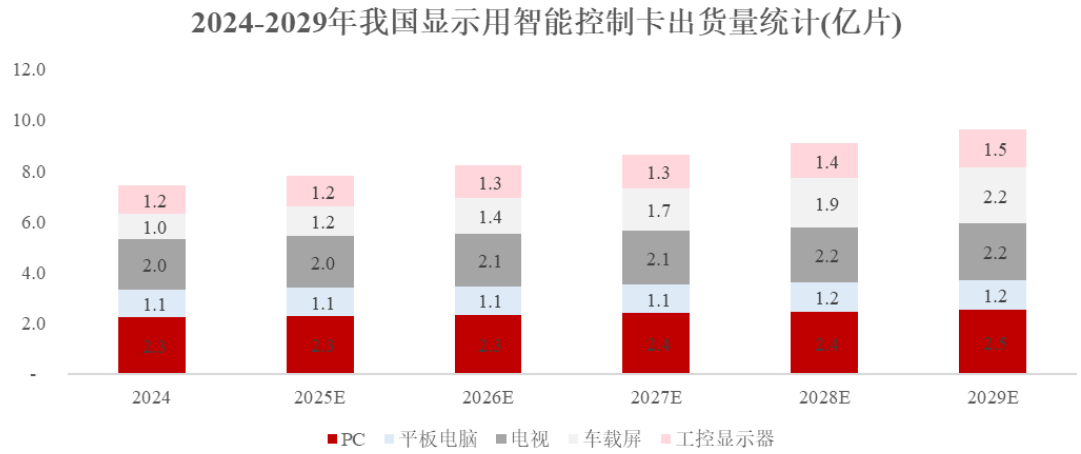
在消费电子领域，LCD 领域的大尺寸化发展、技术升级迭代是推动显示用智能控制卡需求增长的核心动力之一。随着大尺寸 LCD 面板在电视、显示器等应用场景的渗透率提升，TFT-LCD 在背板、显示等领域新技术的升级，显示系统控制复杂度进一步提升，显示用控制卡产品在驱动精度、功耗控制等方面持续升级，进一步释放了增量需求。整体来看，由于消费电子的软硬件升级更新频繁，且大多系通过“换机”予以实现，这为显示用智能控制卡创造了直接的增长空间。

同时，OLED 技术的快速渗透亦成为显示用智能控制卡需求增长的核心动力之一。OLED 屏幕具备柔性、高对比度、低功耗等优势，广泛应用于高端手机、折叠屏设备、智能穿戴等产品，其复杂的像素驱动逻辑和动态显示需求，对控制卡的信号处理能力、兼容性及稳定性提出了更高要求，直接带动了高性能显示用智能控制卡的配套需求。

此外，在汽车电子领域，多屏化、智能化与新能源换车浪潮持续深化，车载中控屏、仪表盘、抬头显示、后排娱乐屏等多屏联动成为中高端车型标配，车载

显示屏的渗透率与单车屏数量同步提升，成为支撑行业增长的重要动力。

中国作为全球显示用智能控制卡行业的最大市场，供应链本土化占比正持续提升。一方面，中国是全球最大的半导体显示面板生产基地，京东方、华星光电等龙头企业的面板出货量长期稳居全球前列，为本土显示用智能控制卡企业提供了天然的配套优势；另一方面，国内消费电子终端市场规模庞大，换机需求持续增长，直接拉动了本土化显示用智能控制卡的刚性需求。本土企业在技术迭代速度、成本控制能力与客户定制化服务上的优势日益凸显，国内显示用智能控制卡出货量逐年提升。根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年至 2024 年，中国显示用智能控制卡出货量由 6.8 亿片增长至 7.4 亿片，预计 2029 年将增长至 9.6 亿片，2025 年至 2029 年复合增长率达到 5.4%。



数据来源：Frost & Sullivan

2）显示用精密功能器件行业

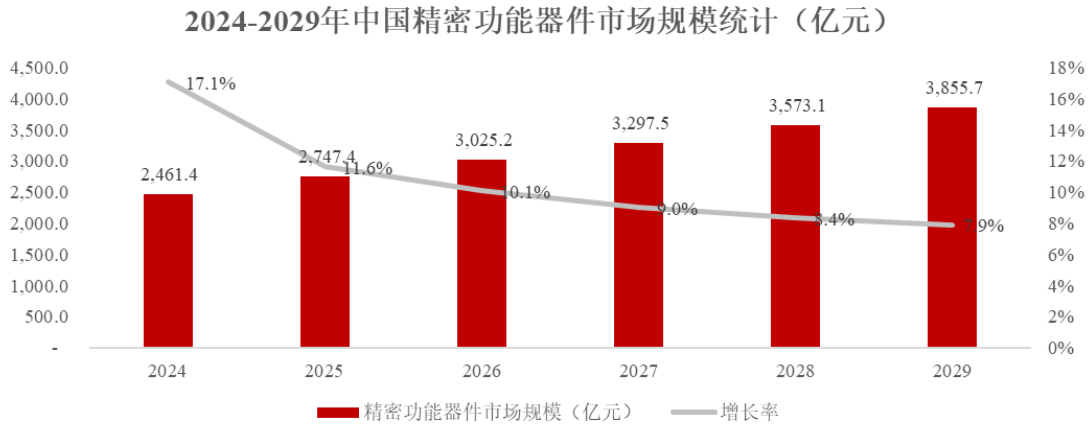
显示用精密功能器件是智能穿戴、手机、平板电脑、笔记本电脑、中大尺寸电视等消费电子产品内部半导体显示面板结构中实现特定功能的器件，具备单一或者多种功能，包括但不限于电磁屏蔽、散热导热、导电、绝缘、缓冲、填充等功能，或对显示光源光线的反射、扩散、增强汇聚等功能。显示用精密功能器件产业服务于下游半导体显示面板行业。

随着半导体显示面板技术的发展，OLED 折叠屏等显示技术的迭代对上游显示用精密功能器件提出了更高要求，例如电磁屏蔽、散热导热、导电、绝缘、缓冲、填充等功能类材料需兼顾柔韧性与粘接强度，产品须满足超精密尺寸公差，或需适配高集成度设计。同时，消费电子轻薄化、可穿戴设备小型化及汽车电子

化趋势，亦将持续增加显示用精密功能器件需求，推动行业向高精度、高性能方向升级。

同时，随着折叠屏手机、Mini LED 显示、AR/VR 设备等高端产品普及，显示用精密功能器件逐渐向超薄化、高可靠性发展，精密切割等先进工艺加速应用，国产供应链逐步突破进口替代。与此同时，消费电子内部结构复杂度攀升，组件精度要求持续增加，驱动厂商优化生产工艺，带来单个产品价值量提升，驱动显示用精密功能器件市场规模不断扩张。

根据 Frost & Sullivan 的统计，受益于全球产能向大陆地区转移以及下游蓬勃发展的电子终端产品制造，中国大陆地区精密功能器件市场整体呈现较快的发展形势。2020 年至 2024 年，中国精密功能器件市场规模从 1,428.5 亿元提升至 2,461.4 亿元，预计 2029 年中国精密功能器件市场规模将达到 3,855.7 亿元，2025 年至 2029 年复合增长率为 8.8%。



数据来源：Frost & Sullivan

整体来看，消费电子行业的蓬勃发展是显示用智能控制卡及显示用精密功能器件行业发展的核心动能。随着新型显示技术、AI、5G 通讯等新一代信息技术的不断进步与发展，公司主要产品显示用智能控制卡及显示用精密功能器件市场亦将迎来更为广阔的发展空间。

3、进入本行业的主要壁垒

（1）技术壁垒

从专业学科角度来看，消费电子产品及其关键零部件的各环节生产需综合机械工程、结构工程、自动化、信息化等跨学科知识，生产工艺复杂，涉及 SMT

贴装、精密模切、芯片封装与测试等多个工艺流程，技术壁垒较高，对企业的生产工艺和制造水平具有较高的要求，需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累。以公司主要下游客户的半导体显示面板厂商为例，其产线投资动辄数百亿元，因而对上游厂商的产品品质有着严苛的要求，厂商需要经过长时间的研发技术积累和生产工艺打磨才能具备配套生产并稳定供货的能力。

从下游客户需求角度来看，公司下游应用领域主要是消费电子行业，如平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等，而消费电子行业有着技术更新速度快、产品迭代周期短的特点；同时，由于消费电子行业竞争较为激烈且有着极强的定制化属性，不同终端品牌客户需求各异，终端产品具有品种繁多、工艺复杂、新器件应用层出不穷等特点。因此，新产品、新技术、新器件的应用和发展均对产业链上游企业的进入、发展和成长提出了较高的要求，新进厂商需要在新产品开发、新技术迭代、新器件应用等各环节与终端及半导体显示面板厂商相匹配。

整体来看，对于以消费电子及半导体显示面板行业为核心应用领域的厂商，研发能力、工艺技术、品控水平、交付能力等均离不开长时间的实践和积累，也离不开与行业下游领先厂商的合作经验积累，而市场新进入者较难在短期内拥有先进的技术水平并积累丰富的实践经验，进入行业的技术壁垒较高。

（2）认证壁垒

公司所处行业下游客户主要为京东方、和辉光电、深天马、惠科股份、华星光电、维信诺等全球领先的半导体显示面板厂商。上述厂商一般基于保障产品质量、维系产品稳定性和一致性等因素的考虑，下游客户对供应商具有严格的考察和全面认证体系，在供应商的设计研发、技术工艺、生产交付、质量管理、供应链管理和售后服务等方面均能达到认证要求后才会将其纳入合格供应商体系，上述认证周期一般在 1-2 年左右。

半导体显示面板行业主要下游应用领域为智能穿戴、手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等消费电子领域，以及新能源汽车智能座舱领域，终端品牌商包括苹果、华为、联想、华硕、戴尔、三星、比亚迪、赛力斯等。相关终端品牌商均有着严苛的供应链管理体系，其对半导体显示面板厂商及其上游关键零

部件厂商的产品设计、元器件选型、工艺技术、供应链管理、售后服务等方面均有着极为严苛的要求。因此，半导体显示面板行业的关键零部件企业不仅需要满足下游面板厂商的管理体系和技术标准，亦需要匹配终端品牌厂商的定制化、差异化要求，紧跟产品和技术迭代节奏。

此外，半导体显示面板及消费电子行业有着产品质量溯源的要求，叠加产品验证周期较长、供应商替代成本较高等影响，终端品牌商及半导体显示面板厂商与配套供应商一旦建立良好的合作关系后，配套供应商将被纳入下游终端客户的供应链管理体系并具备供货资质，为保证产品品质及维护供货的稳定性，下游客户通常不会轻易更换供应商。

整体来看，行业内严格的供应商资质认定以及基于长期合作而形成的稳定客户关系，对新进入者形成了较强的认证壁垒。

（3）资金壁垒

电子信息制造业是资金密集型行业，对固定资产投资规模要求较高，行业内企业在前期需投入较高规模的资金建设厂房、购置设备；同时，下游需求、行业技术工艺的不断迭代要求企业需要持续的研发投入，并建立稳定的核心技术团队，从而保障对新产品、新技术工艺、新器件的研究开发，以保持持续的行业竞争力。

相关产品稳定量产后，亦需要大量流动资金用以日常经营。一方面，基于下游市场情况，行业内企业需要通过围绕客户基地生产需求，通过多区域、多地域建厂来进一步缩短运输半径、提高快速响应能力；另一方面，现代化的 EMS 厂商还需要投入大规模资金开展原材料采购，搭建完整的供应链体系。上述经营活动均需要较高的前期资本投入。

随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的电子制造设备和检测设备也需要不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大，电子制造行业进入的资金壁垒愈发明显。

整体来看，对于新进入者来说，需要较大规模的资金先行投入，行业具有较高的资金壁垒。

（4）规模壁垒

公司主要产品的生产成本与生产规模具有直接关系，只有进行规模化生产，才能有效分摊固定成本和各项期间费用，进而产生经济效益；与此同时，现代化的企业只有具备独立的、有较强议价能力的供应链体系才能满足下游客户需求，因此要求相关企业有着较大的生产规模。

公司下游客户主要为半导体显示面板厂商，终端产品主要为消费电子产品。因此，公司下游客户订单具有规模较大、种类繁杂、定制化程度高等特征，对企业的规模化生产能力要求极高。为实现大规模生产、低成本、高品质和高效率的目标，企业必须建立完整、规范的生产管理体系和质量控制标准。同时，规模化企业才具有充裕的生产能力和先进的设备工艺组合，可以同时满足多个客户、多个产品的试制及新产品研发、生产需求，有利于产品技术储备和产品线的扩充。

整体来看，规模化生产能力对于新进入者亦是较为关键的因素，公司所处行业具有较高的规模壁垒。

4、行业面临的机遇与挑战

（1）行业面临的机遇

1）公司所处行业已受到国家政策大力支持

公司主要产品作为半导体显示面板产业链的重要组成部分，是消费电子产品智能化、轻薄化、集成化、多功能化、高品质用户体验的重要产业支撑，属于国家鼓励发展的产业。近年来，我国在半导体显示面板、电子制造业以及消费行业均出台了一系列鼓励支持政策：

《关于推动未来产业创新发展的实施意见》中明确提出支持打造新型显示作为创新标志性产品，将“薄膜光效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、有机发光二极管（OLED）、Mini-LED/Micro-LED 显示板等新型平板显示器”列入鼓励类。

《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》将公司所处的“C3974 显示器件制造”行业中的全部产品均列入战略性新兴产业产品；《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将“有机发光二极管（OLED）等新型平板显示器件等关键部件及关键材料”列入鼓励类项目范畴。

《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》指出要求扩大数字产品消费，“鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级 3D 打印设备等新产品消费潜力”。

《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》明确提出“2025 至 2026 年，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费。加力推进电子信息制造业高端化、智能化、绿色化发展，有序推动先进计算、新型显示、服务器、通信设备、智能硬件等重点领域重大项目布局”。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

2）随着 AI 技术的不断进步以及新型显示技术的不断进步，消费电子行业需求将迎来新的动能

近年来，TFT-LCD、AMOLED、Mini/Micro LED 等新兴显示技术逐步成熟，全球消费趋势和技术水平变化将继续推动消费电子终端产品加快升级换代。与此同时，AI 迎来了技术跃迁与产业渗透的双重爆发，AI 引领的新一轮技术革命几乎深入到各个行业，已成为驱动社会变革和产业创新的关键催化科技。

具体来看，AI 的“智能性”需要通过具象化的交互界面触达用户，而新型显示技术凭借其高清化、柔性化、场景化特性，恰恰能成为人工智能最关键的“表达窗口”。当人工智能的“认知能力”与新型显示的“呈现能力”深度融合，必将催生全新的应用场景与产业生态。目前，受益于 AI 技术的快速进步，全球半导体显示产业的发展模式正由“规模扩张”向“质量升级”转型。

基于此，未来半导体显示行业将进一步与场景融合加速，人机交互迈向“主

动智能”。从具备感知能力的手机屏幕，到融合多屏联动的智能座舱，半导体显示面板不再只是信息传输的窗口，更是融合感知与反馈能力的智能枢纽。其中，搭载 AI 的手机由旗舰下沉至中端，渗透率快速增长；AR/VR 等可穿戴形态设备逐渐起量；AI 终端笔记本电脑、平板电脑实现更新换代。整体来看，AI 创新与换机周期共同推动，重塑了消费电子产品的交互方式，消费电子行业迎来新的发展机遇。

以上变化趋势为显示用智能控制卡、显示用精密功能器件等配套制造厂商提供了发展动力。其中，显示用智能控制卡对消费电子等领域的产业升级和结构调整均起到不可或缺的支持作用；显示用精密功能器件行业亦直接推动终端电子产品轻薄化、便携化、多功能化、集成化等方向的发展，以不断拓展的新产品和新工艺、不断丰富的定制化功能，满足多个领域日益增长的市场需求。上述电子行业的发展趋势，有利于为新型半导体显示行业创造巨大的发展空间。

3）国内面板厂商已具备全球竞争优势，带动国内半导体显示面板产业链持续向好

国内面板厂商已具备显著的全球竞争优势，并正通过“出海”战略进一步带动整个半导体显示产业链持续向好。

以京东方、华星光电为代表的中国头部面板企业在全球 LCD 及 OLED 市场中已占据主导地位。2025 年，中国大陆已占据全球近 80%的 LCD 面板产能，全球 LCD 显示面板产业正在迎来国内厂商为主导的时代。国内面板厂商已拥有完整的垂直整合能力和规模化成本优势，并开始通过越南、印度等海外基地的建设，实现本地化生产、贴近下游客户，显著增强全球供应链韧性与响应速度。

根据中国机电产品进出口商会数据，2024 年中国液晶平板显示模组出口量达 18.93 亿套，同比增长 11.9%，出口额达 290.3 亿美元，同比增长 9%，实现贸易顺差 165.4 亿美元。2025 年，中国液晶平板显示模组出口量达 20.95 亿套，同比增长 10.7%；出口额 318.5 亿美元，同比增长 9.7%；实现贸易顺差 211.4 亿美元，较 2024 年保持增长态势。

随着国内产能结构性调整、制造体系以及供应链能力的提升，中国面板企业不仅能够巩固欧美高端市场份额，还可快速进入东南亚、拉美等新兴市场，持续

扩大全球版图，带动上游材料、设备、零组件等整个显示产业链出海，带动国内半导体显示面板产业链持续向好。

4）产业链专业化分工推动行业积极发展，本土品牌商崛起为本土领先 EMS 企业提供良好的发展机遇

近年来，随着 AI 等科技进步对消费电子行业的推动，消费者对电子产品需求增加，消费电子产品更新迭代不断加快，我国本土市场的巨大需求也推动了我国本土品牌商的迅速崛起。基于此，终端市场的需求增长直接为我国半导体显示面板厂商、专业 EMS 企业带来了巨大的发展空间。

半导体显示面板行业呈现出技术迭代速度快、产品更新速度快的特点，同时对产品质量、降本增效也具有极高的要求。该等行业特点也使得配套制造领域的专业化分工更为明确，产业链层级更加清晰。因此，行业专业化分工的发展趋势为产业链配套厂商提供了良好的发展机遇。

整体来看，我国电子制造服务行业正处于快速发展期。未来，在下游终端应用领域需求旺盛及专业化分工的背景下，国内 EMS 行业将持续发展。

5）AI 人工智能的快速发展推动现代化 EMS 企业持续提升生产效率

AI 人工智能的快速发展正为 EMS 企业注入全新的生产力。在产品开发设计环节，工业算法模型可实现对 SMT 工艺的模拟仿真，自动输出优化方案，有效解决了传统试产模式带来的高成本、长耗时、低效率的弊病；在生产制造环节，人工智能技术能够系统性提升产线应对不同型号产品生产的能力，通过实时数据分析、生产设备自适应控制等方式，可以推动产线智能化改造；在检测环节，与 AI 技术结合的高清视觉系统、精密运动系统、图形算法识别系统和深度学习的算法技术，能够实现对主要产品的缺陷进行精准检测。

整体来看，AI 人工智能的快速发展推动了现代化 EMS 行业从“规模红利”迈向“效率红利”，在全球供应链重构中持续扩大竞争优势。

（2）行业面临的风险

1）外部环境冲击带来不利影响

半导体显示面板及下游消费电子产业链具有较强的全球分工合作属性，其发

展在一定程度上受到全球地缘政治、贸易政策等因素影响。

近年来，在贸易摩擦、关税政策、地缘政治冲突等多重因素影响下，全球贸易合作受到一定冲击，终端应用产品销售的不确定性亦在增强，对半导体显示面板产业链及其上游供应商造成不利影响。

2）劳动力成本不断增长

人力成本是 EMS 行业乃至整个电子制造产业生产成本的重要构成因素。随着我国经济水平不断发展，整体人力成本可能会有所上升，国内 EMS 企业原有的人力成本优势可能将逐步减弱。整体来看，上升的人力成本对行业内企业的经营发展造成了一定的压力。

5、行业的周期性特征

电子制造服务的领域广泛，公司所处行业下游主要为半导体显示面板行业，终端应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域，公司下游和终端应用受宏观经济景气程度、产业结构调整政策、消费者偏好变化和居民消费意愿的影响，呈现出一定的波动性。

6、公司上述情况在报告期内的变化情况及未来可预见的变化趋势

报告期内，公司通过持续进行研发投入、加强新产品和新工艺开发，积极开拓、维护优质客户，市场竞争地位不断提升。

未来，公司将持续进行研发技术创新，通过提升自身产能规模，积极拓展客户资源，匹配下游半导体显示、消费电子等领域快速发展的趋势。预计随着未来募集资金投资项目的实施，公司产能规模将进一步得到提升，进而增强核心竞争力，提升市场份额，为未来可持续发展奠定良好基础。

（四）行业竞争情况

1、行业竞争格局

公司所处行业为电子信息制造业，系现代化专业电子制造服务（EMS）的解决方案提供商。电子制造服务（EMS）包括为各类电子产品和设备提供设计、工程开发、原材料采购、生产制造、物流、测试及售后服务等整体供应链解决方案，涉及通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域，下游市场应用广

阔。

从竞争格局来看，EMS 行业呈现“市场规模庞大，龙头企业市场占有率高”的特点。根据 DIGITIMES 数据，2025 年排名全球前十的厂商营收占比超 70%，龙头企业具有良好的客户资源、丰富的行业经验、强大的供应链管理及竞价能力，为其构建了较高的竞争壁垒，如富士康、和硕、捷普、伟创力等。

近年来，随着新型显示技术、AI 人工智能、5G 通讯等领域的发展，以及地缘政治、国际贸易摩擦等因素使得消费电子和工业类产品的 EMS 业务存在向“专业化、区域化”发展的特点。与此同时，全球电子制造服务行业巨大的市场容量带来了显著的业务差异化需求，这也给国内优秀本土 EMS 厂商带来了业务发展机会。基于下游客户不同的定制化产品和业务需求，各 EMS 厂商逐渐拥有核心的下游客户群体和核心业务细分应用领域，并在直接客户、终端品牌等方面形成差异化的发展道路和竞争格局。

在过去二十年，全球半导体显示面板产业完成了由日韩转移至中国的产业链重构。随着全球消费电子产品整机制造厂在内地产能的快速扩张，国内企业逐渐凭借较低的成本、快速响应的优势、制造加工的业务模式从代工厂开始承接订单。随着行业发展，内资企业在生产技术、管理能力、产能规模等方面不断积累和提升，逐渐开始参与国际化的市场竞争，少数具有设计开发能力、大规模生产能力、高产品质量、差异化业务布局的企业逐步替代国外厂商成为下游主流终端品牌在上述环节的核心供应商，并与下游厂商建立了长期的合作关系。目前全球范围内的相关产能主要集中在我国大陆和我国台湾地区。

未来，随着全球电子信息制造业整体进一步向中国大陆地区转移及下游行业进入品牌发展时代，对于具有同步设计开发能力、产品性能高、具有大规模生产能力、良好的产品信誉、能够提供整体解决方案的国内企业，下游主流终端品牌对其的合作需求将会进一步提高，国产替代进口趋势仍将继续。

2、发行人主要产品的市场地位情况

公司主要产品广泛应用于国内龙头半导体显示面板厂商，最终在全球知名终端品牌商消费电子产品中广泛应用。

序号	主要产品名称	公司主要客户及其下游终端品牌	
		主要客户	主要客户下游终端品牌
1	显示用智能控制卡	京东方、和辉光电、深天马、广州国显、华星光电、惠科股份	苹果、华为、荣耀、联想、戴尔、惠普、华硕、小米等国内外知名品牌
2	显示用精密功能器件		

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。

3、发行人与同行业可比公司比较情况

（1）同行业可比公司的选择依据、行业内主要企业及简要情况

公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。如前文所述，公司所处细分行业由于竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，不同企业专注的细分领域、主要服务客户均存在一定差异，行业内不存在业务领域、主要客户、技术能力等完全可比的同行业上市公司。

基于上述情形，发行人依据所属电子制造行业特征、业务相似性、数据资料可获取性等因素，按照不同业务选取了 10 家上市公司作为同行业可比公司，具体标准如下：1）业务中包含与发行人相同或相近的产品，主要从事电子元器件及电子制造服务相关业务（收入占比 5%以上）的上市公司且中上协行业代码为 CH39；2）数据的可获得性，可通过招股说明书、定期报告等公开披露资料获取到业务和财务数据；3）报告期内不存在财务数据相关的证监会、交易所处罚或监管措施。

根据上述标准，公司选取的同行业上市公司及其简要情况如下：

序号	公司名称	主营业务概述	主要产品及服务
1、选取的与显示用智能控制卡业务相同或类似的同行业上市公司			
1	金百泽 301041.SZ	专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，以电子产品技术研发、工程能力、集成设计与制造、供应链为核心能力开展业务。主要业务包括集成产品设计 IPD、集成产品制造 IPM、印制电路板 PCB 及科创服务、数字化转型服务等	印制电路板、电子制造服务、电子设计服务、科创平台服务
2	深南电路 002916.SZ	专注于电子互联领域，致力于“打造世界级电子电路技术与解决方案的集成商”，拥有印制电路板、封装基板、电子装联三项业务，形成了业界独特的“3-In-One”业务布局	印制电路板、电子装联、封装基板

序号	公司名称	主营业务概述	主要产品及服务
3	光弘科技 300735.SZ	专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS）。主要产品包括消费电子类（智能手机、平板电脑）、汽车电子类、网络通讯类、物联网、新能源等电子产品	EMS 制造（具体可分为消费电子类、汽车电子类、网络通讯类及其他）
4	雅葆轩 920357.BJ	专注于电子产品研发、生产和销售的企业，主要为客户提供专业的 PCBA 电子制造服务。具备高质量制造和快速交付能力，可提供灵活多样的电子制造服务，通过 BOM 优化、电子装联、检验测试及全流程技术支持服务等业务环节为客户提供优质的 PCBA 控制板产品。产品涵盖汽车电子、消费电子、工业控制三大系列多个品种，广泛应用于汽车、IT 显示、工控显示、仪器仪表、电子信息、低压电气、安防医疗等领域	PCBA 电子制造服务（具体可分为消费电子、工业控制和汽车电子及其他）
5	易德龙 603380.SH	全球布局的柔性 EMS 行业龙头企业，主要为通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域的客户提供电子制造服务	电子制造服务（具体可以分为通讯类产品、工业控制类产品、消费电子类产品、医疗电子类产品、汽车电子类产品及其他产品）
6	一博科技 301366.SZ	一家以印制电路板(PCB)设计服务为基础，同时提供印制电路板装配(PCBA)制造服务的一站式硬件创新服务商。长期以来专注于为客户提供高速高密 PCB 研发设计和 PCBA 研发打样、中小批量制造服务，致力于打造 PCB 设计、制板、元器件供应、PCBA 焊接组装、性能测试等一站式硬件创新平台，以满足多元化的客户需求。客户范围覆盖网络通信、工业控制、集成电路、人工智能、医疗电子、智慧交通、航空航天等行业领域	PCB 设计服务、PCBA 制造服务
2、选取的显示用精密功能器件业务相同或类似的同行业上市公司			
1	鸿富瀚 301086.SZ	主要从事精密功能性组件、自动化设备、散热解决方案及新材料的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、服务器、显卡及数据中心设备、通讯基站、光伏太阳能、新能源汽车等	消费电子产品功能性器件、自动化设备及相关产品、散热产品
2	博硕科技 300951.SZ	主要产品为精密功能件和智能自动化装备，广泛应用于智能手机、智能穿戴、智能家居等消费类领域，智能座舱、动力电池、储能电池等新能源/汽车类领域，以及智慧医疗领域	精密功能件、智能自动化装备
3	可川科技 603052.SH	主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售。功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业	电池类功能性器件、结构类功能性器件以及光学类功能性器件
4	达瑞电子 300976.SZ	在消费电子领域，主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实 VR/增强现实 AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居等终端产品。 在新能源领域，主要研发、生产和销售精密结构与功能性组件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器等终端产品	消费电子功能性器件、电子产品结构性器件、3C 智能装配自动化设备、新能源结构与功能性组件

资料来源：同行业上市公司定期报告、招股说明书等公开资料

综上所述，上述可比公司在主要产品及其应用领域、所处产业链环节、业务经营成熟度等方面与公司存在一定相似性。因此，发行人可比公司的选取依据充分、合理。

（2）发行人与可比公司指标对比

发行人与可比公司在相同或类似业务的经营情况及关键业务指标、下游应用领域、技术实力等方面的对比情况如下：

单位：亿元

序号	公司名称	相关业务经营情况	2025 年 相关业务收入	下游应用领域	技术实力
1、选取的与显示用智能控制卡业务相同或类似的同行业上市公司					
1	金百泽 301041.SZ	金百泽 IPM 中心提供产品集成解决方案、电子元器件选型及供应、PCBA 装联及组装一站式 EMS 服务。金百泽的 IPM 中心依靠电子产品研发和工程服务能力，为客户提供包括 PCBA 电子装联服务、BOM 齐套方案服务、元器件检测与可靠性服务，通过可制造性设计 DFM 和可装配性设计 PFM 约束规则、可采购性设计 DFP 工程数据，快速响应提供高可靠性产品保障，为客户提供精准的定制化服务。	2.10	工业控制、电力系统、新能源、信息技术等	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 212 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 266 人；2025 年度的研发投入金额为 0.48 亿元
2	深南电路 002916.SZ	深南电路电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。目前深南电路已具备为客户提供包括产品设计、开发、生产、装配、系统技术支持等全方位服务的能力。	30.75	数据中心、汽车电子、通信、工控、医疗等	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 933 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 2,981 人；2025 年度的研发投入金额为 15.91 亿元
3	光弘科技 300735.SZ	在 EMS 模式下，以客户需求为导向，为其提供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入（NPI）、半成品及成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。连续多年位列全球 EMS50 强之列，现排名第 14 位。 在智能手机、平板电脑和网络终端产品上，光弘科技成功进入华为、小米、荣耀、三星、OPPO 等全球知名品牌商及华勤、龙旗和闻泰等领先 ODM 企业的供应链。在汽车电子领域，光弘科技成功进入知名汽车零部件供应商法雷奥、大陆、电装的供应链，为包含宝马、奥迪、大众、日产等知名汽车品牌及华为系客户、小米提供汽车电子部件制造服务，同时光弘科技也为华为为代表的中国造车新势力提供全方位的汽车电子制造服务。2022 年，光弘科技亦步入新能源领域，开始为客户提供新能源电子产品的制造服务。	88.98	消费电子类（智能手机、平板电脑）、汽车电子类、网络通讯类、物联网、新能源	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 91 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 1,251 人；2025 年度的研发投入金额为 1.37 亿元
4	雅葆轩 920357.BJ	凭借多年来在电子制造服务领域的深厚积累，已形成了以中大批量 PCBA 电子制造服务为主的业务模式。相较于那些主要专注于小批量 PCBA 电子制造服务的企业，公司在生产规模、生产效率以及成本控制等方面具备显著优势。公司拥有先进的生产设备和成熟的生产工艺，能够快速响应客户的中大批量订单需求，并且保证产品质量的稳定性和一致性。	5.75	汽车电子、消费电子、工业控制	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 50 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 37 人；2025 年度的研发费用金额为 0.15 亿元
5	易德龙 603380.SH	公司是全球布局的柔性 EMS 龙头企业，目前，服务超过 300 家客户，覆盖工控、医疗、通信设备、汽车电子、高端消费电子等领域，产品超 6,000 种，其中外资客户营收占比超 65%，并与多个细分行业头部客户形成长期战略合作，已经形成全球性的高端化电子制造服务提供商的市场形象。专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域。	22.88	通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域	未披露截至 2025 年末专利数量；截至 2025 年末，研发人员数量为 292 人；2025 年度的研发投入金额为 1.45 亿元

序号	公司名称	相关业务经营情况	2025 年 相关业务收入	下游应用领域	技术实力
6	一博科技 301366.SZ	一博科技是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供印制电路板装配（PCBA）制造服务的一站式硬件创新服务商。公司深耕 PCB 设计业务近二十年，已建立行业领导地位，在高速、高密 PCB 设计领域具备突出的技术优势。一博科技 PCBA 制造服务定位于供应高品质快件，专注于研发打样和中小批量领域，具备柔性化制造及快速交付的能力。	8.98	网络通信、工业控制、集成电路、人工智能、医疗电子、智慧交通、航空航天等行业领域	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 396 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 963 人；2025 年度的研发投入金额为 1.30 亿元
发行人显示用智能控制卡业务			7.15	**消费电子领域为主**	截至报告期末，获得专利总数累计为 306 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 122 人；2025 年度的研发投入金额为 0.37 亿元
2、选取的显示用精密功能器件业务相同或类似的同行业上市公司					
1	鸿富瀚 301086.SZ	鸿富瀚消费电子功能性器件主要用于电子产品研发、生产过程中的粘贴、屏蔽、绝缘、防护、防尘、缓冲等功能。鸿富瀚消费电子功能性器件的产品主要包括以下几类：导热类、光学类、绝缘类、冲压屏蔽类、五金拉伸类、手机摄像头注塑类配件	6.92	消费电子领域	未披露截至 2025 年末专利数量；截至 2025 年末，研发人员数量为 207 人；2025 年度的研发投入金额为 0.55 亿元
2	博硕科技 300951.SZ	在电子产品的研发、生产过程中，博硕科技功能性器件主要用于防护、防尘、粘贴、固定、绝缘、缓冲等功能。其功能性器件主要有以下几种：防护类电子产品功能性器件、防尘类电子产品功能性器件、粘贴、固定类、绝缘类、缓冲类等其他电子产品功能性器件等	11.01	消费电子、汽车电子等领域	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 492 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 401 人；2025 年度的研发投入金额为 1.05 亿元
3	可川科技 603052.SH	电池类功能性器件业务方面，公司聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包；结构类功能性器件业务方面，公司专注于笔记本电脑结构件模组领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品，产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中；光学类功能性器件业务方面，公司产品主要为遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等，广泛应用于显示屏、芯片等产品。	2.35	消费电子和新能源领域	未披露截至 2025 年末专利数量；截至 2025 年末，研发人员数量为 102 人；2025 年度的研发投入金额为 0.55 亿元
4	达瑞电子 300976.SZ	消费电子功能性器件产品属于非标准产品，主要利用单双面胶带、保护膜、离型膜、海绵、泡棉、导电布、导电胶、铜箔、吸波材、石墨片、防尘网等金属或非金属材料，通过精密模切、冲压、贴合等工艺加工而成，产品具有定制化、品种多样、型号复杂、轻薄精密等特点。产品主要应用于手机、电脑、可穿戴电子产品等消费电子领域，根据功能不同，包括粘贴固定补强类、防震防尘防护类、绝缘屏蔽导电类等功能性器件	未披露	消费电子和新能源领域	截至 2025 年末，获得专利总数累计为 353 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 381 人；2025 年度的研发投入金额为 1.27 亿元

序号	公司名称	相关业务经营情况	2025 年 相关业务收入	下游应用领域	技术实力
发行人显示用精密功能器件产品			3.94	消费电子领域为主	截至报告期末，获得专利总数累计为 306 项；截至 2025 年末，研发人员数量为 122 人；2025 年度的研发投入金额为 0.37 亿元

数据来源：可比公司年度报告、招股说明书等公开资料。

注：上表中，“相关业务”系与发行人相同或类似的业务收入。其中，金百泽为“电子制造服务”业务收入，深南电路为“电子装联”业务收入，光弘科技为“EMS 制造”业务收入，雅葆轩、易德龙为其主营业务收入，一博科技为“PCBA 制造服务”业务收入，鸿富瀚为“消费电子产品功能性器件”业务收入，博硕科技为“精密功能件”业务收入，可川科技为其“结构类功能性器件”以及“光学类功能性器件”业务收入合计，达瑞电子为其“消费电子功能性器件”业务收入，达瑞电子 2024 年“消费电子功能性器件”业务收入为 8.19 亿元，达瑞电子 2025 年年度报告将“消费电子功能性器件”、“电子产品结构性器件”合并为了“消费电子结构与功能性组件”，未单独披露“消费电子功能性器件”收入。

4、公司的竞争优势与劣势

（1）竞争优势

1）技术优势

全球电子制造服务行业巨大的市场容量带来了显著的业务差异化需求，国内同行业公司发展战略也存在一定差异。公司长期服务于以新型半导体显示面板厂商为主的国内龙头优质客户，建立了具有市场竞争力的细分领域技术优势。

具体来看，自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板产品为核心应用领域，深耕 LCD 显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro LED 等显示领域新技术的应用发展，掌握了新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关的专利技术和先进生产工艺。通过开展产品设计评估、产品开发、样件试制、性能检测、售后服务等全套业务流程，公司目前已拥有样品、中小批量、大批量等各级综合制造能力。

A、产品设计及可制造性仿真方面，公司基于多年来的产品研发、试制及制造经验，自主搭建了一套基于 DFM Expert 软件的工业算法应用数据库，即以 3D 模型的形式导入基于实践积累的设计规则、3D 器件模型等测试程序和电子元器件数据，累计已构建了 20 余万个 3D 器件模型、1,500 余种设计规则，通过模拟仿真软件技术对新产品通过数据模型和规则应用，可快速开展产品设计及可制造性研究，并识别、优化和输出新产品的最优工艺路线，大幅缩短了新产品从设计到量产的周期，彻底改变了传统实物试产模式带来的高成本、长耗时、低效率问题。

B、显示用智能控制卡方面，公司在多年规模化生产中积累了丰富的生产经验，通过自动化控制系统结合自动植板机、自动贴胶机、AVI 自动检测机、自动化功能检测机等设备，形成了公司特有的自动化生产流程，有效的提高了生产效率和产品良品率，大幅节约人力成本，增强公司的盈利能力。公司目前 PCBA 制程能力已可实现±20um 片式电阻电容、0.25mm*0.125mm 贴片零件最小尺寸、0.25mm 最小元件脚间距、0.4mm*0.2mm—120mm*90mm 或 0.4mm*0.2mm—150mm*25mm 四方扁平封装尺寸，制造精密度已达到《IPC-A-610G》（CN 版）中的国际最高标准 Class 3（高性能电子产品）等级。

C、显示用精密功能器件方面，公司通过建立组合产线、增加高精度补偿装置、改造控制及视觉辅助系统、搭配系统 AI 识别算法等多种方式改进生产设备，持续改进工艺流程，提高生产效率。公司精密模切工艺对精密模具的雕刻精度可达±0.02mm，圆刀模切速度可达 55m/分钟，产品检验速度可达 30m/分钟，在产品精度、生产效率方面具备较强的竞争优势。

借助较强的技术和研发能力，公司能够共同参与到下游半导体显示面板厂商的关键零部件开发中，以快速响应下游客户的需求，稳固和强化了与客户的合作关系。截至报告期末，公司已广泛覆盖目前主流半导体显示面板厂商的高世代产线，如京东方第 10.5 代 LCD 产线、京东方第 8.6 代 OLED 产线、深天马第 8.6 代 LCD 产线等，终端产品直接用于全球主流终端品牌厂商的消费电子产品，体现了公司一流的技术水平和创新能力。截至本招股说明书签署日，公司已为京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内主流半导体显示面板厂商供应超过千款显示用智能控制卡产品，覆盖了 TFT-LCD、AMOLED 等目前主流显示技术类型。

公司始终将研发投入和技术创新作为企业发展的核心驱动力。未来，随着在研项目的推进，公司将持续进行项目储备与技术创新，不断拓展公司的产品种类和应用领域，实现可持续发展。

2）生产制造及产品质量优势

自成立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域。在消费电子及半导体显示面板行业技术不断升级、迭代的背景下，公司已形成了较强的工艺制造能力，在产品设计评估、产品开发、样件试制、性能检测、售后服务等方面处于行业领先水平，确保了优秀的良品率水平，可为下游客户持续供应性能优异、质量稳定的产品，在产品一致性和稳定性方面形成了较强的壁垒。

与此同时，公司在生产经营中已实现高度的自动化水平和智能制造布局，进而充分保障了公司生产制造水平和产品质量。截至报告期末，公司已经建立了精益化、数字化的管理体系，公司已搭建 MES（生产制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）等现代化生产制造管理系统，实现产品制造信息高度自动化及制造过程的全程可追溯性，并通过 ERP 企业资源计划等实现信息化系统管理，实现

采购、生产、销售等关键过程一体化，形成了现代化、自动化的智能智造生产运营管理体系。截至目前，公司已通过了 ISO9001（质量管理体系标准）、ISO14001（环境管理体系标准）、IATF16949（汽车行业质量管理体系标准）、UL（美国产品安全认证标准）等系列认证，报告期内公司显示用智能控制卡良品率已达到99%以上，产品质量得到了下游客户的一致认可。

3）器件检测优势

公司在产品生产之后，通过自建器件检测体系进一步验证器件产品的性能，该体系融合了 SPI 检测、3D AOI 自动光学检测、3D X-Ray 检测、ICT 在线测试、FCT 功能测试、AVI 自动视觉检测系统、飞针测试技术、矢量网络分析测试以及柔性测试自动化系统等先进检测手段，构建了覆盖全工艺流程的质量管控体系，对于公司持续开发新材料、提升产品品质、增强客户黏性等具有重要作用。

一方面，器件评测能够保证公司具备持续开发新产品、新技术的能力并及时调整研发方向。公司通过建立多维度测试系统，可根据下游面板厂商及终端品牌厂商的产品计划制定相应的器件持续开发计划，持续对器件结构中各组件的规格、参数及适配性进行测试，并可达到下游面板厂商及终端品牌厂商的同等检测覆盖率，从而根据测试结果进而及时调整研发方向，保证公司产品在客户产品体系更新换代中体现出优异性能。

另一方面，器件检测提高了公司产品在客户验证、器件匹配等环节的效率。公司在器件评测的过程中，半导体显示面板厂商会根据各层级组件间搭配情况对零部件需求参数进行不断调整，公司通过自建先进器件评测体系进行快速准确的筛选，有利于公司的产品快速与面板厂商的器件结构相匹配，从而进入面板厂商的新项目、新产品的供应体系。

4）客户优势

公司下游客户包括全球半导体显示面板龙头面板厂商京东方及华星光电、OLED 面板龙头和辉光电等全球知名的半导体显示面板企业。

新型半导体面板厂商对显示用智能控制卡及精密功能器件供应商的选取极为严格，供应商导入通常分为三个环节。资质审查环节，面板厂商对公司的各种资质、专利情况等进行审核，同时公司向面板厂商推荐各类材料，进行材料评测

筛选；工厂稽核环节，面板厂商对公司的研发实力、管理体系、品质管控、生产能力等进行严格审核；材料认证环节，面板厂商对公司从小批量、中批量、大批量等各个阶段材料的品质均一性、量产稳定性、模组信赖性等进行逐一验证，验证通过后开始批量供货。上述整体认证时间通常需要 1-2 年左右。

由于面板厂商对关键零部件供应商审查非常严格，需要经过多轮的测试通过后才能进入供应商体系，供应商一旦进入面板厂商供应体系，通常在较长时间内不易被替换，客户黏性较强。

发行人凭借与客户建立的长期合作关系，已经在产品同步开发、质量控制、生产规模、供应保障、售后服务响应等方面形成了较强的竞争力。由于公司下游客户对供应商的前期考核周期长、质量服务要求严格、评审认证体系复杂，因此其供应商更换成本较高，一旦建立合作关系不会轻易变更。公司长期积累的核心客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础，具有较高的客户壁垒。

5）规模优势

电子信息制造业的生产制造具有明显的规模效应。报告期内，公司主要产品产量稳步提升。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。大规模的生产能力确保公司能为客户提供及时稳定的交付，同时降低产品生产成本，增强公司的盈利能力和市场竞争地位。

6）管理团队优势及快速响应优势

公司管理团队多年来专注于显示用智能控制卡与显示用精密功能器件业务领域，积累了丰富的行业技术储备与企业经营经验，并对公司产品下游半导体显示面板行业有着深刻的理解和认知，对市场和技术发展趋势具有前瞻性的把握能力，能够保障公司长期、稳定的快速成长。

同时，半导体显示面板行业对上游供应商的响应速度要求较高，产品交付速度、交货稳定性等均为下游半导体显示面板厂商对供应商的重要考核指标。公司生产基地分布在重庆、合肥、福州、武汉、北海、青岛、成都等地，均系我国半导体显示面板产业重要的产业聚集地及半导体显示面板头部企业的主要生产基

地所在地。公司各生产基地与京东方等主要客户各生产基地的运输半径较小，送货时间较短，能够大幅降低运输成本，并能够保证在产品定制化过程中与客户保持持续沟通，具备较强的快速响应优势。

（2）竞争劣势

1）产能无法完全满足市场未来发展趋势和下游客户需求

受新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术发展驱动以及行业鼓励政策支持，我国及全球消费电子产业整体正在经历复苏阶段，各大厂商不断加大软硬件研发投入，公司直接下游半导体显示面板厂商在持续扩大高世代产线的投建，公司下游客户需求不断扩大，公司现有产能已不足以满足未来的市场需求。公司拟以本次募集资金扩充自身产能，扩大公司的产能规模，维护现有优质客户的份额以及满足新开拓客户的需求以促进公司业务的持续发展，持续提高市场占有率，进一步提升公司的综合竞争力。

2）融资渠道单一、资金保障能力较弱

消费电子周期主要由创新驱动，随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术的快速发展，公司下游半导体显示面板及消费电子行业正在加速创新、升级和迭代，半导体显示面板及终端品牌厂商的产能、研发投入均持续扩大，新产品、新技术、新器件层出不穷。因此，上述情形对于公司等现代化电子信息制造业 EMS 厂商的持续供应能力、研发投入等均提出了新的需求，故资金保障能力是公司通过项目建设、原材料采购、生产运营、技术研发等方式保持市场竞争力和市场份额的重要基础。

作为非上市公司，公司融资渠道较为单一，对公司未来的快速发展形成制约。为把握行业发展的机遇，加快公司发展，匹配下游客户需求，公司需要通过上市股权融资等途径拓宽自身的融资渠道，提升资本实力及财务风险抵御能力，为公司长期稳定发展提供资金保障。

三、公司销售情况及主要客户

（一）公司主要产品的产能、产量及销量情况

公司生产核心模式为“以销定产”，同时公司的产品定制化程度较高，不同

客户、不同产品的工艺流程均存在差异，公司的生产能力难以进行标准化衡量。因此，公司不同业务核心工艺关键设备的生产能力能够较好的衡量公司的产能和产出。具体说明如下：

1、显示用智能控制卡

公司显示用智能控制卡业务的核心生产环节主要为 PCBA 制造。

报告期内，虽然公司显示用智能控制卡产品均为定制化产品，不同客户产品的生产工艺、生产难度和生产时间均存在差异。考虑到公司显示用智能控制卡产品的生产核心工艺为 SMT 工艺，因此，可按照 SMT 工艺的生产能力核算产能。

报告期内，公司按照 SMT 工艺核算显示用智能控制卡产能、产量、产能利用率的情况如下：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
当期 SMT 产能（万点）	2,966,003.04	2,960,285.33	2,738,523.79
当期 SMT 点数（万点）	2,668,452.01	2,520,661.73	2,293,898.90
产能利用率	**89.97%**	**85.15%**	**83.76%**

报告期内，公司产能规模稳步扩张。从产能利用率来看，按照 SMT 工艺点数核算的产量整体呈现上升趋势，公司产能利用率整体保持较高水平。2024 年以来，随着行业景气度回升，公司显示用智能控制卡业务的产能利用率持续提升。

报告期内，公司显示用智能控制卡产量、销量及产销率情况如下：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
产量（万片）	12,977.92	14,169.50	12,947.79
销量（万片）	12,866.10	14,260.91	13,012.07
产销率	**99.14%**	**100.65%**	**100.50%**

报告期内，公司显示用智能控制卡业务产销率均保持在较高水平。

2、显示用精密功能器件

报告期内，公司显示用精密功能器件主要系通过精密模切工艺进行生产。因此，公司精密模切工艺的关键生产设备的实际工时投入和报告期各年度实际生产的产品应耗用的标准生产工时能够较好地衡量公司显示用精密功能器件产品的产能和产出。

报告期内，根据公司显示用精密功能器件产品应耗用的标准生产工时与报告期内公司实际投入使用的关键机器设备的实际工作时间计算的产能利用率情况如下：

单位：小时

项目	2025 年	2024 年	2023 年
标准生产机器工时耗用	293,635.80	278,720.40	245,123.20
实际生产机器工时投入	280,668.04	262,477.21	205,736.24
产能利用率	**95.58%**	**94.17%**	**83.93%**

报告期内，公司显示用精密功能器件业务的产销率情况如下：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
产量（万片）	70,655.68	61,088.81	52,707.64
销量（万片）	65,814.30	56,862.06	53,495.48
产销率	**93.15%**	**93.08%**	**101.49%**

报告期内，公司显示用精密功能器件的产能规模和产能利用率较为稳定，产销率保持较高水平。2024 年以来，随着下游行业需求回暖，公司显示用精密功能器件产能利用率持续提升，与显示用智能控制卡业务情况一致。

（二）公司主要产品情况及单价变动情况

1、公司主要产品销售收入情况

报告期内，公司显示用智能控制卡与显示用精密功能器件的客户主要为下游半导体显示面板厂商，包括京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等。公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

主营业务收入	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	71,535.65	63.07	72,455.66	66.29	37,238.12	53.64
显示用精密功能器件	39,364.99	34.71	34,618.54	31.67	30,790.97	44.36
其他	2,525.01	2.23	2,227.87	2.04	1,389.76	2.00
合计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

公司显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件业务收入占主营业务收入的比例分别为 98.00%、97.96%和 97.77%，该等产品以半导体显示面板为核心

应用领域，是公司主营业务收入的主要来源。2024 年以来，受益于半导体显示面板行业迅速发展带来的需求增长，公司收入规模呈现增长态势。

2、公司主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品销售单价的整体波动情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“八、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”相关内容。

（三）报告期内公司前五名客户情况

报告期内，公司前五大客户情况如下：

单位：万元

年度	客户名称	销售金额	占比	主要销售类别
2025 年度	京东方	62,628.32	55.22%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	30,025.15	26.47%	显示用智能控制卡
	深天马	10,552.21	9.30%	显示用智能控制卡
	广州国显	2,413.19	2.13%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,745.35	1.54%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	合计	**107,364.22**	**94.66%**	-
2024 年度	京东方	58,598.41	53.61%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	33,579.28	30.72%	显示用智能控制卡
	深天马	5,155.93	4.72%	显示用智能控制卡
	广州国显	3,125.58	2.86%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,686.11	1.54%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	合计	**102,145.31**	**93.45%**	-
2023 年度	京东方	54,910.59	79.10%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	和辉光电	6,210.44	8.95%	显示用智能控制卡
	惠科股份	1,673.83	2.41%	显示用智能控制卡、显示用精密功能器件
	广州国显	1,511.10	2.18%	显示用智能控制卡
	华星光电	1,143.79	1.65%	显示用智能控制卡
	合计	**65,449.76**	**94.28%**	-

注：以上受同一实际控制人控制的客户合并计算销售额，其中包括：

1、京东方合并口径包括京东方科技集团股份有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、

重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示照明有限公司等；

2、华星光电合并口径包括武汉华星光电技术有限公司、华显光电技术（惠州）有限公司；

3、惠科股份合并口径包括惠金（深圳）科技有限公司、绵阳惠科光电科技有限公司、重庆惠科金渝光电科技有限公司。

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、主要关联方和持有发行人 5%以上股份的股东未在前五大客户中拥有任何权益。

报告期内，公司前五大客户与公司及其股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（四）公司对京东方销售占比较高对公司持续经营能力不构成重大不利影响

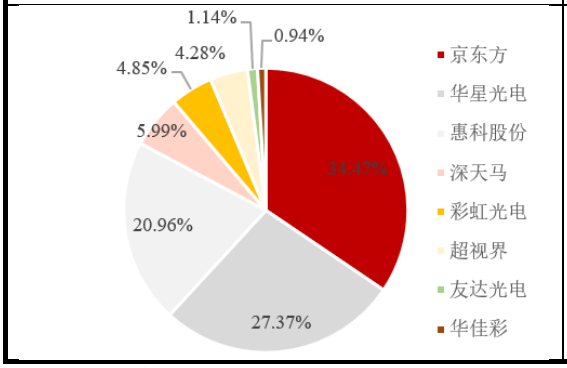
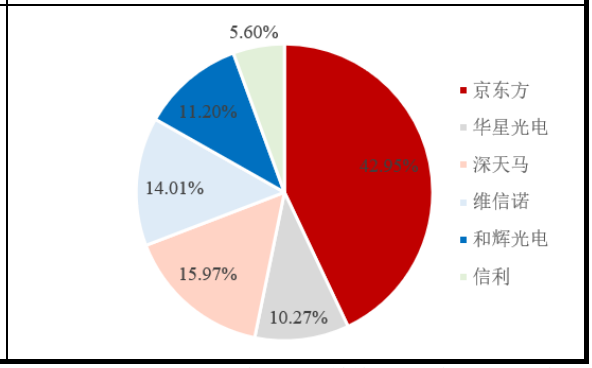
根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。报告期内，发行人来自京东方的主营业务收入占比分别为 79.10%、53.61%和 55.22%，占比超过 50%，**发行人对京东方构成重大依赖**。

上述情形不会对公司未来持续经营能力构成重大不利影响，具体原因如下：

1、公司客户集中度较高系因行业因素所致，与下游半导体显示面板行业集中度较高特征一致，不存在下游行业较为分散而发行人自身客户较为集中的情况

半导体显示面板行业为资本和技术密集型产业，行业进入门槛较高，导致半导体显示面板行业集中度相对较高。发行人主要产品显示用智能控制卡和显示用精密功能器件是半导体显示面板模组工程（Module）所需的关键组成部分。

目前，我国 LCD 显示面板市场竞争格局均较为集中，OLED 显示面板市场的竞争格局相较 LCD 更加集中，且头部厂商在市场份额上占据绝对优势。根据长城证券统计，从 LCD 显示面板细分市场来看，京东方以 34.47%的产能份额位居国内市场首位。从 OLED 显示面板细分市场来看，京东方以 42.95%的产能份额居国内第一。

国内 LCD 产能分布情况	国内 OLED 产能分布情况
	

资料来源：长城证券《深天马 A（000050.SZ）：面板领先企业盈利修复，车载&柔性 OLED 开启成长新周期》，产能份额不包括签约及规划中产能

整体来看，我国半导体显示面板行业具有较高的行业集中度，公司第一大客户京东方在 LCD 与 OLED 领域的产能规模均位居国内厂商首位，其在制造能力、技术研发和供应链管理方面的深厚积累使其在行业市场份额中占据领先地位。

2、京东方为我国半导体显示面板龙头企业且为 A 股上市公司，经营状况良好且具有良好的透明度，不存在重大不确定性风险

京东方成立于 1993 年 4 月，经过 30 多年的高速发展，于全球 20 多个国家和地区设立子公司，服务体系覆盖欧、美、亚、非等全球主要区域，已发展成为半导体显示领域全球领军企业，在半导体显示面板行业拥有雄厚的技术积累和领先的市场份额。

作为深交所上市公司，京东方具有良好的信息透明度，经营业绩向好。2024 年，京东方业绩呈快速增长趋势，营业收入达到 1,983.81 亿元，净利润为 41.45 亿元，同比增长 1,020.73%。2025 年，京东方继续保持高速增长的趋势，营业收入达到 2,045.90 亿元，同比增长 3.13%，净利润达到 50.27 亿元，同比增长 21.28%。

综上所述，京东方营业收入持续稳定上升，经营业绩整体向好，不存在重大不确定性风险。

3、公司与京东方合作关系具有历史基础，双方合作具有稳定性及可持续性

京东方作为上市公司及全球半导体显示面板领域领先的科技企业，在长期经营过程中建立了规范的公司治理、采购管理制度，在产品质量、产品规格、供应商生产能力等方面具有严格要求，在选择供应商时拥有一套严格的选择标准，从供应商资质、供货能力、产品质量、供货效率、响应速度、服务情况等方面进行

全方位考核且考核周期相对较长，对供应商的认证标准较高。一经认证合格，双方一般情况下会保持长期稳定的合作关系。

公司自 2014 年即与京东方建立了合作关系。自进入京东方供应商体系后，公司持续扩展与京东方的业务合作规模，深化业务合作范围，公司凭借优良的产品工艺、稳定的产品质量、先进的技术能力以及快速的响应能力，获得了京东方的长期认可，并与之建立了稳固、持续的合作关系。

报告期内，公司向京东方销售收入的金额分别为 54,910.59 万元、58,598.41 万元和 62,628.32 万元，销售收入整体呈现增长态势。

整体来看，作为京东方显示用智能控制卡的第一大供应商、显示用精密功能器件的主要供应商，公司与京东方已建立了长期、稳定的合作关系，与京东方未来合作具有稳定性及可持续性。

4、公司与京东方之间不存在关联关系，公司业务获取方式具有独立性，与京东方相关交易的定价具有公允性

截至本招股说明书签署日，公司与京东方不存在关联关系。京东方作为半导体显示面板行业的领军企业，具有完善的供应商管理体系。公司与京东方通过招投标等方式建立业务合作关系，公司业务获取方式具有独立性。报告期内，公司持续完成京东方对于供应商的考核管理，合作关系稳定。

公司主要产品属于非标、定制化产品，虽不存在公开的市场价格，但行业市场化竞争程度较高。京东方等下游客户通常会以招投标等市场化方式选择供应商并协商确定产品价格。报告期内，公司与京东方的合作模式及产品定价方式均未发生变化，交易价格为市场化竞争性磋商、询价报价或招投标结果，具有公允性。

5、公司已广泛开拓其他客户，能够独立面向市场获取业务

近年来，除京东方外，公司持续积极拓展新型半导体显示面板领域的国内厂商客户，现已成为和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

报告期内，公司向除京东方外其他客户的销售收入金额及占比情况如下：

单位：万元、%

类型	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
京东方	62,628.32	55.22	58,598.41	53.61	54,910.59	79.10
其他客户	50,797.33	44.78	50,703.65	46.39	14,508.26	20.90
主营业务收入	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

由上表可知，随着公司新客户的不断开拓，公司向除京东方外其他客户的销售规模迅速提升。整体来看，公司已广泛开拓除京东方外的其他客户，能够独立面向市场获取业务。

综上所述，公司来自京东方的营业收入占比较高不会对公司持续经营能力构成重大不利影响。

四、公司采购情况及主要供应商

（一）报告期内公司主要产品的原材料与能源的供应情况

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司显示用智能控制卡业务主要原材料为 IC 芯片、电路板和无源器件；公司显示用精密功能器件产品主要原材料包括导电屏蔽材料、光学膜材料、保护膜材料、胶粘材料。

报告期内，公司主要原材料的采购金额及其占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年		2024 年		2023 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
IC 芯片	34,747.67	51.23	38,270.49	54.93	16,329.42	41.97
电路板	6,333.37	9.34	5,221.72	7.49	2,419.97	6.22
无源器件	4,514.23	6.66	4,047.24	5.81	2,429.35	6.24
导电屏蔽材料	10,233.12	15.09	9,525.69	13.67	7,283.19	18.72
光学膜材料	3,778.57	5.57	4,133.28	5.93	4,621.43	11.88
保护膜材料	3,347.00	4.93	3,790.95	5.44	2,978.95	7.66
胶粘材料	3,079.16	4.54	2,988.71	4.29	1,842.49	4.74
其他	1,796.60	2.65	1,697.07	2.44	1,005.26	2.58
总计	**67,829.73**	**100.00**	**69,675.15**	**100.00**	**38,910.06**	**100.00**

如上表所述，2023 年，半导体显示面板及消费电子行业景气度下行，公司主要原材料采购规模相对较低；2024 年以来，一方面，随着行业景气度逐步回暖，下游客户需求稳步提升；另一方面，公司自供料模式规模扩大，因此公司主要原材料采购规模显著增加。2025 年，公司主要原材料采购规模较 2024 年保持稳定。

2、主要原材料采购价格变动情况及趋势分析

报告期内，公司主要产品均为定制化、非标准产品，细分类别、规格型号较多，不同型号的产品所需的原材料种类、规格各异，原材料采购价格亦存在差异。

报告期内，发行人主要原材料采购均价情况如下：

单位：元/颗、元/片、元/平方米

项目	2025 年		2024 年		2023 年
	单价	变动率	单价	变动率	单价
IC 芯片	11.90	-30.02%	17.00	-11.50%	19.21
电路板	6.47	1.34%	6.39	-41.30%	10.88
无源器件	0.04	-23.92%	0.05	-14.74%	0.05
导电屏蔽材料	95.26	0.50%	94.78	19.31%	79.44
光学膜材料	12.58	5.69%	11.90	-10.29%	13.26
保护膜材料	4.69	-11.15%	5.28	-7.04%	5.68
胶粘材料	22.88	-1.06%	23.13	22.11%	18.94

如上表所述，报告期各期，公司主要原材料价格存在一定波动。一方面，因下游客户结构及产品结构变化，公司主要原材料采购的具体内容和结构均有所差异，因而导致各期采购价格有所波动；另一方面，大宗商品（如铜、铝）价格波动也会对部分主要原材料（如导电屏蔽材料）价格产生一定影响。此外，部分主要原材料（如 IC 芯片）受宏观经济环境、市场供需关系影响较大。

3、主要能源消耗情况

报告期内，公司主要消耗的能源为电力，具体情况如下：

项目		2025 年	2024 年	2023 年
电力	采购数量（万度）	2,531.60	2,579.01	2,218.13
	采购金额（万元）	1,823.05	1,900.15	1,691.40
	采购单价（元/度）	0.72	0.74	0.76

报告期内，公司用电价格整体保持相对平稳。

（二）报告期内公司前五名供应商情况

报告期内，公司对前五名供应商采购金额及其占公司总采购金额的比例如下：

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
2025 年度	深圳思尼克	16,063.02	22.24%	IC 芯片
	广州国显	5,617.87	7.78%	IC 芯片
	盟讯科技	4,356.64	6.03%	IC 芯片
	大象株式会社	3,762.85	5.21%	导电屏蔽材料
	博敏电子	3,319.26	4.59%	电路板
	合计	**33,119.64**	**45.85%**	-
2024 年度	深圳思尼克	15,787.44	21.33%	IC 芯片
	广州国显	5,569.27	7.52%	IC 芯片
	大象株式会社	3,410.15	4.61%	导电屏蔽材料
	奇景光电	3,407.57	4.60%	IC 芯片
	盟讯科技	3,095.25	4.18%	IC 芯片
	合计	**31,269.68**	**42.25%**	-
2023 年度	和辉光电	4,832.11	10.82%	IC 芯片
	华星光电	4,075.91	9.13%	IC 芯片、无源器件
	广州国显	3,386.34	7.59%	IC 芯片
	大象株式会社	2,028.54	4.54%	导电屏蔽材料
	狄之娇	1,611.82	3.61%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	合计	**15,934.72**	**35.70%**	-

注：大象株式会社包括：DAESANG S.T Co.,Ltd.和天津大象胶带有限公司。

报告期内，公司存在向和辉光电、华星光电、广州国显等客户采购 IC 芯片和无源器件等部分主要原材料的情形。上述向客户采购的原材料仅可用于生产交付该客户的产品，属于电子制造业行业常见的“Buy and Sell”[4]模式。

不考虑“Buy and Sell”模式下的相关采购，报告期内，公司对前五名供应商采购金额及其占公司总采购金额的比例如下：

4、Buy and Sell 模式：即客户向原材料供应商购买部分主要物料后转卖给公司，公司向该客户下单采购并付款，公司通过自行购买其他主要物料及辅耗材料后组织生产活动，最终将包含上述自客户处购买物料价值的产成品定向销售给该客户。这一模式在电子产品制造行业较为普遍。

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占比	主要采购类别
2025 年度	深圳思尼克	16,063.02	24.46%	IC 芯片
	盟讯科技	4,356.64	6.63%	IC 芯片
	大象株式会社	3,762.85	5.73%	导电屏蔽材料
	博敏电子	3,319.26	5.05%	电路板
	狄之娇	2,736.16	4.17%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	合计	**30,237.93**	**46.05%**	-
2024 年度	深圳思尼克	15,787.44	24.52%	IC 芯片
	大象株式会社	3,410.15	5.30%	导电屏蔽材料
	奇景光电	3,407.57	5.29%	IC 芯片
	盟讯科技	3,095.25	4.81%	IC 芯片
	博敏电子	2,938.92	4.56%	电路板
	合计	**28,639.33**	**44.48%**	-
2023 年度	大象株式会社	2,028.54	6.30%	导电屏蔽材料
	狄之娇	1,611.82	5.01%	导电屏蔽材料、胶粘材料
	SKC	1,379.68	4.29%	光学膜材料
	珠海方正	1,372.66	4.27%	电路板
	奇普仕	1,196.64	3.72%	IC 芯片
	合计	**7,589.34**	**23.59%**	-

注 1：大象株式会社包括：DAESANG S.T Co.,Ltd.和天津大象胶带有限公司；

注 2：SKC 包括：SK microworks solutions Co., Ltd 和迈克沃高科技材料（苏州）有限公司。

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、主要关联方和持有发行人 5%以上股份的股东未在前五大供应商中拥有任何权益，公司前五大供应商与公司及其股东、实际控制人、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

五、公司的主要固定资产、无形资产情况

（一）固定资产

截至 2025 年末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

项目名称	资产原值	账面价值	成新率
房屋及建筑物	41,954.51	39,559.71	94.29%

项目名称	资产原值	账面价值	成新率
机器设备	36,467.07	8,028.72	22.02%
运输工具	95.27	23.00	24.14%
电子设备	1,232.26	268.98	21.83%
其他	3,833.48	1,195.42	31.18%
合计	**83,582.59**	**49,075.83**	**58.72%**

1、房屋及建筑物

（1）自有房产

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司共拥有 20 处房产的权属证书。具体情况如下：

序号	权利人	产权证号	坐落地点	面积（m^2）	用途	取得方式
1	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974959 号	重庆市北碚区水善路 17 号	10,304.64	工业	自建
2	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974983 号	重庆市北碚区水善路 17 号	30,359.66	工业	自建
3	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975023 号	重庆市北碚区水善路 17 号	7,619.52	工业	自建
4	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975236 号	重庆市北碚区水善路 17 号	47.84	工业	自建
5	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975243 号	重庆市北碚区水善路 17 号	25.80	工业	自建
6	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975377 号	重庆市北碚区水善路 17 号	261.64	工业	自建
7	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975262 号	重庆市北碚区水善路 17 号	8,216.07	工业	自建
8	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975334 号	重庆市北碚区水善路 17 号	13,534.38	工业	自建
9	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975147 号	重庆市北碚区水善路 17 号	160.15	工业	自建
10	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974998 号	重庆市北碚区水善路 17 号	770.59	工业	自建
11	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975165 号	重庆市北碚区水善路 17 号	4,934.44	工业	自建
12	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974852 号	重庆市北碚区水善路 17 号	60.01	工业	自建
13	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974831 号	重庆市北碚区水善路 17 号	24.19	工业	自建
14	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065381 号	合肥市新站区三十头路 210 号	282.82	工业	自建
15	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065382 号	合肥市新站区三十头路 210 号	14,330.25	工业	自建
16	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065383 号	合肥市新站区三十头路 210 号	39,364.01	工业	自建
17	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065384 号	合肥市新站区三十头路 210 号	17,509.21	工业	自建
18	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065385 号	合肥市新站区三十头路 210 号	17,515.22	工业	自建

序号	权利人	产权证号	坐落地点	面积（m²）	用途	取得方式
19	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065386 号	合肥市新站区三十头路 210 号	61.20	工业	自建
20	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065387 号	合肥市新站区三十头路 210 号	12,331.34	工业	自建

注：合肥宇隆已将上表中第 14-20 项不动产权抵押给中国建设银行股份有限公司合肥城东支行用于自身的贷款融资，主债权的授信金额为 4 亿元，担保的主债权确定期限为 2025 年 4 月 30 日至 2031 年 4 月 30 日。

根据发行人及其子公司的企业信用报告、发行人的说明，除已披露情形外，发行人及其子公司拥有的上述不动产权不存在抵押、查封等权利限制或权属纠纷情形。

（2）租赁房产

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司存在承租第三方房产的情况，公司房产承租情况如下：

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁期限	面积（m²）	用途	备案
1	合肥锦畅胶粘制品有限公司	合肥宇隆	合肥市新站区唐河路合肥锦畅胶粘制品有限公司北侧厂房 2 楼	2026.08.01-2026.12.31 注 2	2,640.00	生产	是
2	合肥锦畅胶粘制品有限公司	合肥宇隆	合肥市新站区唐河路合肥锦畅胶粘制品有限公司北侧厂房 3 楼	2026.07.01-2026.12.31	2,722.00	生产	是
3	合肥锦畅胶粘制品有限公司	安徽灿宇	合肥市新站区唐河路合肥锦畅胶粘制品有限公司北侧厂房 1、4、5 楼	2026.08.01-2026.09.30	6,843.00	生产/办公	是
4	巨神制泵武汉有限公司	武汉宇隆	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号的 1 号楼一层和六层标准厂房和办公楼	2022.06.01-2027.05.30	4,658.60	生产/办公	是
5	巨神制泵武汉有限公司	武汉宇隆	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号的 1 号楼二层标准厂房	2025.04.01-2028.03.31	2,291.30	生产/办公	是
6	福建斯泰克科技有限公司	福州宇隆	福清融侨经济技术开发区光电科技园斯泰克工业园里 3 号楼一层、二层	2025.05.01-2029.08.31	5,000.00	生产/办公	否注 1
7	广西惠科智能显示有限公司	北海宇隆	北海市经济技术开发区东北大道 1 号 3 幢 A04 栋厂房西面一层	2024.03.01-2029.02.28	5,727.13	生产/办公	是
8	青岛建国门窗幕墙工程有限公司	青岛宇隆	黄岛区陡楼山路 777 号	2023.01.01-2027.09.30	10,397.34	生产/办公	是
9	四川金网通电子科技有限公司	成都宇隆	成都市高新区西区新创路 28 号 5 栋 2 楼	2023.11.01-2028.10.31	6,660.00	生产/办公	是
10	四川金网通电子科技有限公司	成都宇隆	成都市高新区西区新创路 28 号 5 栋 2 楼	2026.05.15-2028.10.31	750.00	生产	是

序号	出租方	承租方	房屋坐落	租赁期限	面积（m^2）	用途	备案
11	SEAH VINA CO., LTD.	越南宇隆	Lot O-I, Que Vo Industrial Park (Expanded Area), Nam Son Ward and Phuong Lieu Ward,Bac Ninh Province.	2026.06.08-2031.06.08	6,032.00	生产/办公	-

注 1：根据《中华人民共和国城市房地产管理法》的相关规定，“房屋租赁，出租人和承租人应当签订书面租赁合同，约定租赁期限、租赁用途、租赁价格、修缮责任等条款，以及双方的其他权利和义务，并向房产管理部门登记备案。”根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。据此，福州宇隆承租前述房屋未办理备案登记手续情形的瑕疵不影响租赁合同的法律效力，租赁合同对合同各方具有法律约束力；

注 2：发行人合肥基地自有厂房装修已基本完成，子公司合肥宇隆及安徽灿宇计划从租赁厂房逐步搬迁至合肥基地的自有厂房。

发行人及其子公司上述租赁物业的出租方均已取得租赁房产的产权证书，系租赁房产的合法产权人；除福州宇隆租赁福建斯泰克科技有限公司房产未做租赁备案外，发行人及其子公司承租上述租赁物业均已签署合法有效的租赁合同且依法办理了租赁备案手续。

报告期内，福州宇隆亦未因该等情形受到主管部门的相关处罚。福州宇隆虽未就房产租赁合同办理登记备案手续，但该等情形并不影响房产租赁合同的生效，上述房屋租赁合同已经得到了实际履行。

2、主要生产经营设备

截至报告期末，发行人及其子公司的主要生产经营设备为机器设备、运输设备、电子设备等，均属于公司自有资产，目前由发行人及其子公司占有和使用，权属清晰，不存在权属纠纷情形。

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的主要生产经营设备不存在抵押情况，亦不存在查封等权利限制或权属纠纷情形。

（二）无形资产

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司共拥有 20 处土地使用权。具体情况如下：

序号	权利人	产权证号	坐落地点	宗地面积（m^2）	用途	取得方式
1	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974959 号	重庆市北碚区水善路 17 号	58,612.60	工业	自建

序号	权利人	产权证号	坐落地点	宗地面积（m^2）	用途	取得方式
2	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974983 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
3	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975023 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
4	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975236 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
5	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975243 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
6	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975377 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
7	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975262 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
8	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975334 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
9	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975147 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
10	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974998 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
11	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000975165 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
12	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974852 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
13	宇隆科技	渝（2025）两江新区不动产权第 000974831 号	重庆市北碚区水善路 17 号		工业	自建
14	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065383 号	合肥市新站区三十头路 210 号	50,950.74	工业	自建
15	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065385 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建
16	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065384 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建
17	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065382 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建
18	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065387 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建
19	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065381 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建
20	合肥宇隆	皖（2025）合肥市不动产权第 1065386 号	合肥市新站区三十头路 210 号		工业	自建

合肥宇隆已将上表所列序号 14-20 的 7 处不动产权抵押给中国建设银行股份有限公司合肥城东支行用于自身的贷款融资，主债权的授信金额为 4 亿元，担保的主债权确定期限为 2025 年 4 月 30 日至 2031 年 4 月 30 日。除已披露情形，发行人及其子公司拥有的上述土地使用权不存在查封等权利限制或权属纠纷情形。

2、专利

（1）专利基本情况

截至报告期末，发行人及其子公司已授权专利共有 306 项，具体情况如下：

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
1	宇隆科技	实用新型	2016205695158	PCB 板在线自动贴胶装置	2016/06/14	原始取得
2	宇隆科技	实用新型	2017205269297	一种电路板点胶设备	2017/05/12	原始取得
3	宇隆科技	实用新型	2017205272868	一种集成电路板的夹持设备	2017/05/12	原始取得
4	宇隆科技	实用新型	2017205272872	一种电路板装配设备	2017/05/12	原始取得
5	宇隆科技	实用新型	2017205272891	一种电路板工装架	2017/05/12	原始取得
6	宇隆科技	实用新型	201720527772X	一种电路板自动检测设备	2017/05/12	原始取得
7	宇隆科技	实用新型	2017205321008	液晶显示器用时序控制电路板性能自动测试装置	2017/05/15	原始取得
8	重庆升越达	实用新型	201720921641X	一种模切机的物料定位机构	2017/07/27	原始取得
9	重庆升越达	实用新型	2017209216439	一种模切机的模切装置	2017/07/27	原始取得
10	重庆升越达	实用新型	2017209216975	一种环保复合机	2017/07/27	原始取得
11	重庆升越达	实用新型	2017209223381	一种复合机烘道防尘结构	2017/07/27	原始取得
12	重庆升越达	实用新型	2017209223466	一种分条机	2017/07/27	原始取得
13	重庆升越达	实用新型	2017209230421	一种应用于模切机的套位拉料装置	2017/07/27	原始取得
14	重庆升越达	实用新型	2017209231301	一种分条机清扫机构	2017/07/27	原始取得
15	合肥宇隆	实用新型	2017216765125	一种按键板性能检测装置	2018/05/08	原始取得
16	安徽灿宇	实用新型	2018208712845	一种新型边废料剥离用产品防脱装置	2018/06/07	原始取得
17	安徽灿宇	实用新型	2018208713871	一种模切产品快速贴合装置	2018/06/07	原始取得
18	安徽灿宇	实用新型	2018208717213	一种便于移动的平面材料表面电阻检测装置	2018/06/07	原始取得
19	安徽灿宇	实用新型	2018208717251	一种组合式模切产品自动排废装置	2018/06/07	原始取得
20	宇隆科技	实用新型	2019209297948	一种背光 LED 灯条安装用辅助固定装置	2019/06/20	原始取得
21	宇隆科技	实用新型	2019209298014	一种电子元器件生产自动打码装置	2019/06/20	原始取得
22	宇隆科技	实用新型	2019209298048	一种线路板生产加工用多角度定位装置	2019/06/20	原始取得
23	宇隆科技	实用新型	2019209298211	一种柔性线路控制板生产用成品收纳装置	2019/06/20	原始取得
24	宇隆科技	实用新型	2019209299869	一种光电产品标签胶贴加工装置	2019/06/20	原始取得
25	重庆升越达	实用新型	2019210773593	一种模切异步裁切省料设备	2019/07/11	原始取得
26	重庆升越达	实用新型	2019210773606	一种模切喷码机联机裁切设备	2019/07/11	原始取得
27	重庆升越达	实用新型	2019210774346	一种模切机圆刀快速更换机构	2019/07/11	原始取得
28	重庆升越达	实用新型	2019210774350	一种光学膜生产加工用 CCD 定位装置	2019/07/11	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
29	重庆升越达	实用新型	2019210774948	一种背光材料加工用自动搬运运输设备	2019/07/11	原始取得
30	安徽灿宇	发明专利	2019113059487	一种胶带加工用模切设备	2019/12/18	原始取得
31	合肥宇隆	发明专利	2019113060696	一种控制板测试装置及测试系统	2019/12/18	原始取得
32	安徽灿宇	实用新型	2020201966388	一种保护膜的上胶装置	2020/02/24	原始取得
33	安徽灿宇	实用新型	2020201966424	一种模切产品用快速除静电装置	2020/02/24	原始取得
34	合肥宇隆	实用新型	2020201965258	一种电子电路控制板支架	2020/02/24	原始取得
35	合肥宇隆	实用新型	2020202044912	一种具有多种背景光的面板灯	2020/02/24	原始取得
36	福州宇隆	实用新型	2020204437850	一种电子产品贴片用线路板除尘装置	2020/03/31	原始取得
37	福州宇隆	实用新型	2020204438143	一种具有除尘功能的电路板安装箱	2020/03/31	原始取得
38	福州宇隆	实用新型	2020204438247	一种电路板安装箱	2020/03/31	原始取得
39	福州宇隆	实用新型	2020204438270	一种电路板的固定装置	2020/03/31	原始取得
40	福州宇隆	实用新型	2020204447778	一种电路板的防护装置	2020/03/31	原始取得
41	福州宇隆	实用新型	2020204448041	一种电子产品贴片用线路板清洗装置	2020/03/31	原始取得
42	重庆升越达	实用新型	2020231226132	一种光学膜片加工模切机用模切辊	2020/12/22	原始取得
43	重庆升越达	实用新型	2020231251399	一种光学膜片加工模切机的排废机构	2020/12/22	原始取得
44	重庆升越达	实用新型	2020231389360	一种用于背光模组光学膜片的切割结构	2020/12/23	原始取得
45	宇隆研究院	实用新型	202023138825X	一种光学膜片固定装置	2020/12/23	原始取得
46	宇隆研究院	实用新型	2020231388669	一种光学膜片加工装置	2020/12/23	原始取得
47	宇隆研究院	实用新型	202023166873X	一种光学膜片光学性能测试台	2020/12/24	原始取得
48	宇隆研究院	实用新型	2020231723050	光学膜片裁切刀具	2020/12/24	原始取得
49	宇隆研究院	实用新型	2020231820281	一种光学膜片粘片分离机构	2020/12/25	原始取得
50	宇隆研究院	实用新型	2020231840001	一种光学膜片烘烤治具	2020/12/25	原始取得
51	宇隆研究院	实用新型	2020231840069	一种光学膜片清洗机构	2020/12/25	原始取得
52	福州宇隆	实用新型	2021205491382	一种 FCT 插排线的测试装置	2021/03/17	原始取得
53	福州宇隆	实用新型	2021205491414	一种 SMT 表面贴装设备	2021/03/17	原始取得
54	福州宇隆	实用新型	2021205503680	一种新型钢网开孔装置	2021/03/17	原始取得
55	宇隆科技	实用新型	2021206411633	一种嵌入式控制板卡加工用开孔机构	2021/03/30	原始取得
56	宇隆科技	实用新型	2021206411864	一种控制板卡生产加工系统	2021/03/30	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
57	宇隆科技	实用新型	2021206411915	一种控制板卡生产加工用去毛刺装置	2021/03/30	原始取得
58	宇隆研究院	实用新型	2021206407534	一种嵌入式控制板卡加工用裁切结构	2021/03/30	原始取得
59	宇隆研究院	实用新型	2021206408039	一种光学膜片生产系统	2021/03/30	原始取得
60	宇隆研究院	实用新型	2021206411652	一种控制板卡生产用打磨机构	2021/03/30	原始取得
61	宇隆研究院	实用新型	2021206411760	一种控制主板检测用夹固工装	2021/03/30	原始取得
62	宇隆研究院	实用新型	2021206411879	一种控制板卡测试台	2021/03/30	原始取得
63	宇隆研究院	实用新型	202120641192X	一种控制板卡测试装置	2021/03/30	原始取得
64	宇隆研究院	实用新型	2021206411934	一种板卡对插连接稳定性检测治具	2021/03/30	原始取得
65	武汉宇隆	实用新型	2021213972609	一种具有高度调节功能的标签载料平台	2021/06/23	原始取得
66	武汉宇隆	实用新型	2021213972825	一种接驳台载具分流装置	2021/06/23	原始取得
67	武汉宇隆	实用新型	2021213974360	一种便于调节的 PCBA 生产用防主板堆板报警装置	2021/06/23	原始取得
68	武汉宇隆	实用新型	2021215099903	一种牢固使用方便的 PCBA 载具	2021/07/05	原始取得
69	武汉宇隆	实用新型	2021215105622	一种 PCBA 生产用载具车装载冷却装置	2021/07/05	原始取得
70	合肥宇隆	实用新型	2021215214189	一种平稳性好的 PCBA 板装载装置	2021/07/06	原始取得
71	合肥宇隆	实用新型	2021215225183	一种用于 PCBA 裂片的耐磨检测结构	2021/07/06	原始取得
72	合肥宇隆	实用新型	202121522522X	一种具有防呆结构的 PCBA 产品包装 Tray 盘	2021/07/06	原始取得
73	合肥宇隆	实用新型	2021215225535	一种基于 PCBA 的新型抗电磁干扰测试装置	2021/07/06	原始取得
74	合肥宇隆	发明专利	2021107605077	一种接触型 PCBA 开路短路测试装置及其测试方法	2021/07/06	原始取得
75	合肥宇隆	发明专利	2021107608126	一种用于电路板的具有辅助机构的连续性焊接装置及其使用方法	2021/07/06	原始取得
76	福州宇隆	实用新型	2021222081798	一种电路板锡膏印刷装置	2021/09/13	原始取得
77	福州宇隆	实用新型	2021222120538	一种 AOI 检测装置	2021/09/13	原始取得
78	福州宇隆	实用新型	2021222570794	全自动 AOI 检测仪器	2021/09/17	原始取得
79	福州宇隆	实用新型	2021222581943	一种全自动锡膏印刷机的清洁装置	2021/09/17	原始取得
80	武汉宇隆	实用新型	202122703885X	一种 PCBA 电路板元器件剥离强度测试装置	2021/11/07	原始取得
81	宇隆科技	发明专利	2021114638802	一种电路板加工用二极管针脚打磨装置	2021/12/2	继受取得
82	宇隆科技	发明专利	2021115039521	一种用于贴片元件焊接的装配系统	2021/12/10	继受取得
83	宇隆研究院	实用新型	2021231273941	一种 FPC 软板品质检测用便于组装的弯曲耐折试验机	2021/12/13	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
84	宇隆研究院	实用新型	2021231273956	一种集成电路制造用具有便携式定位结构的打孔装置	2021/12/13	原始取得
85	宇隆研究院	实用新型	2021231273960	一种显示器生产用具有防护结构的输送装置	2021/12/13	原始取得
86	宇隆研究院	实用新型	202123129525X	一种便于清理的光学薄膜恒温恒湿试验箱	2021/12/13	原始取得
87	宇隆研究院	实用新型	2021231295423	一种便于接料的 FPC 软板静电除尘机	2021/12/13	原始取得
88	宇隆研究院	实用新型	2021231295457	一种电子元器件生产用具有安全防护结构的恒温试验机	2021/12/13	原始取得
89	宇隆研究院	实用新型	2021231295531	一种光学膜片生产用具有导向功能的撕膜机	2021/12/13	原始取得
90	宇隆研究院	实用新型	202123129557X	一种集成电路芯片用具有折叠功能的电路板分板机	2021/12/13	原始取得
91	宇隆研究院	实用新型	2021231295673	一种集成电路与电子器件连接夹持机构	2021/12/13	原始取得
92	宇隆研究院	实用新型	2021231295688	一种显示器件制造用可调节倾角的操作台	2021/12/13	原始取得
93	宇隆研究院	实用新型	2021231295692	一种集成电路芯片制造用便于维护控制器的光刻机	2021/12/13	原始取得
94	宇隆研究院	实用新型	2021231357006	一种集成电路用具有稳定夹持结构的点焊装置	2021/12/13	原始取得
95	宇隆研究院	实用新型	2021231536650	一种具有导向功能的 FPC 软板测试装置	2021/12/13	原始取得
96	宇隆研究院	实用新型	2021231536881	一种防止偏移的柔性电路板超声波清洗机	2021/12/13	原始取得
97	宇隆研究院	实用新型	2021231538336	一种显示器件生产用具有工件定位结构的灌胶机	2021/12/13	原始取得
98	宇隆研究院	实用新型	2021231538919	一种具有夹持效果的集成电路板孔位检测装置	2021/12/13	原始取得
99	宇隆研究院	实用新型	2021231539292	一种集成电路制造用便于取放的清洗机	2021/12/13	原始取得
100	宇隆研究院	实用新型	2021231666067	一种电子元器件生产用具有防护结构的转运装置	2021/12/13	原始取得
101	宇隆研究院	实用新型	202123129541.9	一种用于电子元件生产防滴胶的点胶装置	2021/12/13	原始取得
102	宇隆科技	实用新型	2021232036248	一种显示器件制造用具有限位结构的传送装置	2021/12/20	原始取得
103	宇隆科技	实用新型	202123203652X	一种显示器件制造用便于固定工件的线路板焊锡机	2021/12/20	原始取得
104	宇隆科技	实用新型	2021232084542	一种显示器件制造用具有调平结构的点胶机	2021/12/20	原始取得
105	宇隆科技	实用新型	202123208467X	一种显示器件制造用便于居中的封箱机	2021/12/20	原始取得
106	宇隆科技	实用新型	202123214733X	一种显示器件制造用具有防掉落结构的运输装置	2021/12/20	原始取得
107	重庆升越达	实用新型	2021231999277	一种功能性胶带生产用具有间距调节功能的分切机	2021/12/20	原始取得
108	重庆升越达	实用新型	2021232007936	一种功能性胶带生产用便于维护的剥离强度试验机	2021/12/20	原始取得
109	重庆升越达	实用新型	2021232007989	一种光学膜制造用便于上下料的光学膜收卷装置	2021/12/20	原始取得
110	重庆升越达	实用新型	2021232023426	一种光学膜片用具有防尘功能的透光率检测仪	2021/12/20	原始取得
111	重庆升越达	实用新型	202123211884X	一种便于取料的光学膜厚测量仪	2021/12/20	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
112	宇隆科技	发明专利	2021115631410	一种 FPC 软板生产用具有自动夹持功能的拉力试验机	2021/12/20	原始取得
113	宇隆科技	发明专利	2022102416942	一种具有高精度定位连续加工效果的偏光片贴附机	2022/03/11	继受取得
114	宇隆科技	发明专利	2022106468221	基于图像处理的印制线路板缺陷检测方法	2022/06/08	继受取得
115	合肥宇隆	实用新型	2022214577315	一种用于 PCBA 粉尘的除尘机构	2022/06/13	原始取得
116	合肥宇隆	实用新型	2022214577207	一种用于 PCB 板高温贴胶的辅助装置	2022/06/13	原始取得
117	合肥宇隆	实用新型	2022215429077	一种治具周转箱	2022/06/20	原始取得
118	合肥宇隆	实用新型	2022215588069	一种高温胶带贴覆机构	2022/06/21	原始取得
119	重庆升越达	实用新型	2022215756948	一种模切机废料分离装置	2022/06/23	原始取得
120	重庆升越达	实用新型	202221575690X	一种显示屏幕的缓冲支架	2022/06/23	原始取得
121	武汉宇隆	实用新型	2022218076429	一种 PCB 板自动打包机构	2022/07/14	原始取得
122	合肥宇隆	实用新型	202221852933X	移动式检验平台	2022/07/19	原始取得
123	合肥宇隆	实用新型	2022218529344	一种固化治具固定装置	2022/07/19	原始取得
124	重庆升越达	实用新型	2022218955727	一种具有清理功能的圆刀切膜机	2022/07/21	原始取得
125	重庆升越达	实用新型	2022218955712	一种可形成凸包的冲切模具结构	2022/07/21	原始取得
126	重庆升越达	实用新型	2022218958265	一种光学膜印刷机用后端收料结构	2022/07/21	原始取得
127	安徽灿宇	实用新型	2022218958513	一种新型膜切贴合机	2022/07/21	原始取得
128	安徽灿宇	实用新型	2022218958462	一种可防止冲切移位的冲切模具结构	2022/07/21	原始取得
129	安徽灿宇	实用新型	2022218955657	一种针对蚀刻模具进行清废的清废机构	2022/07/21	原始取得
130	安徽灿宇	实用新型	2022218958481	一种切片机切片物料整理治具	2022/07/21	原始取得
131	安徽灿宇	实用新型	2022219171755	一种 PSA 胶条局部贴合治具	2022/07/25	原始取得
132	宇隆科技	实用新型	2022219645624	一种可防止 FPC 装载偏移的装板治具	2022/07/28	原始取得
133	宇隆科技	实用新型	2022219645535	一种改进型条码枪扫描式镭雕机	2022/07/28	原始取得
134	宇隆科技	实用新型	2022219645516	一种防偏移的 PCB 单板载具	2022/07/28	原始取得
135	宇隆研究院	实用新型	2022219883196	一种载具检验设备	2022/07/29	原始取得
136	宇隆研究院	实用新型	202221985705X	一种 PCB 固定载具	2022/07/29	原始取得
137	宇隆科技	实用新型	2022222394157	一种灯条测试夹具	2022/08/25	原始取得
138	宇隆科技	实用新型	2022222398548	一种 PCB 板自动盖板贴条装置	2022/08/25	原始取得
139	宇隆科技	实用新型	2022222528448	一种印刷钢网孔隙检测装置	2022/08/25	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
140	宇隆科技	实用新型	2022222528946	一种防呆高效率显示屏画面检测设备	2022/08/25	原始取得
141	安徽灿宇	实用新型	2022222794376	一种料带张力调节机构	2022/08/29	原始取得
142	安徽灿宇	实用新型	2022222785502	一种机贴产品包装盒	2022/08/29	原始取得
143	宇隆研究院	实用新型	2022222794747	一种 pcb 板连接器钢琴盖	2022/08/29	原始取得
144	重庆升越达	实用新型	2022222925851	具有喷码功能的模切设备	2022/08/30	原始取得
145	重庆升越达	实用新型	2022222919649	一种放料设备	2022/08/30	原始取得
146	宇隆研究院	实用新型	2022222919634	测试用线连接器	2022/08/30	原始取得
147	宇隆研究院	实用新型	202222291962X	一种模切加工用片状产品叠料装置	2022/08/30	原始取得
148	合肥宇隆	实用新型	2022223055174	控制板自动检测系统	2022/08/31	原始取得
149	宇隆研究院	实用新型	2022223182606	具有散热效果的治具转运车	2022/08/31	原始取得
150	宇隆研究院	实用新型	2022223182593	一种胶带贴附治具	2022/08/31	原始取得
151	宇隆研究院	实用新型	2022223182589	自动压合治具	2022/08/31	原始取得
152	武汉宇隆	实用新型	2022225761124	一种载具转运架	2022/09/28	原始取得
153	武汉宇隆	实用新型	2022225935573	一种可调节角度的排烟管	2022/09/29	原始取得
154	武汉宇隆	实用新型	2022225935821	印刷后扫描机构	2022/09/29	原始取得
155	福州宇隆	实用新型	2022225970365	一种印刷机酒精余量监测装置	2022/09/29	原始取得
156	福州宇隆	实用新型	2022225970384	一种滚动式载具传送导轨	2022/09/29	原始取得
157	宇隆研究院	实用新型	2022226081861	一种改进型高效 PCB 板载具	2022/09/30	原始取得
158	宇隆研究院	实用新型	2022226228705	一种卷膜材料架	2022/09/30	原始取得
159	福州宇隆	实用新型	2022226484383	一种能消除静电的门禁系统	2022/09/30	原始取得
160	福州宇隆	实用新型	2022226484612	一种金手指高温胶带压合机构	2022/09/30	原始取得
161	福州宇隆	实用新型	2022226077461	一种 PCB 防碰件静电料车	2022/09/30	原始取得
162	福州宇隆	实用新型	2022226467373	PCB 放置治具	2022/09/30	原始取得
163	福州宇隆	实用新型	2022226074919	一种模切自动上料机	2022/09/30	原始取得
164	福州宇隆	实用新型	2022226484487	倾斜角度可调节的 Tray 盘放置平台	2022/09/30	原始取得
165	安徽灿宇	实用新型	2022230215271	手工排废刮板	2022/11/14	原始取得
166	安徽灿宇	实用新型	2022230194434	圆刀机物料收齐盒	2022/11/14	原始取得
167	宇隆研究院	实用新型	2022230868278	一种载具箱	2022/11/21	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
168	宇隆研究院	实用新型	2022231073348	PCB 板生产加工用物料周转装置	2022/11/22	原始取得
169	宇隆研究院	实用新型	2022231721783	模切测试条手压刀	2022/11/29	原始取得
170	宇隆研究院	实用新型	2022231915789	一种脱模剂喷涂机构	2022/11/29	原始取得
171	宇隆研究院	实用新型	2022231919309	一种液晶显示设备的温度补偿电路	2022/11/30	原始取得
172	宇隆研究院	实用新型	2022234594949	一种带有降温机构的点胶设备	2022/12/22	原始取得
173	宇隆研究院	实用新型	2022234461612	一种有效降低气泡产生的活塞点胶筒	2022/12/22	原始取得
174	宇隆研究院	实用新型	2022234461631	一种高精度翻转机构	2022/12/22	原始取得
175	武汉宇隆	发明专利	2022116628528	一种用于电子元件的点胶方法	2022/12/23	原始取得
176	宇隆研究院	实用新型	2022235187348	一种 PCB 引脚裁剪机构	2022/12/28	原始取得
177	宇隆研究院	实用新型	2022235204019	一种高效率焊接装置	2022/12/28	原始取得
178	北海宇隆	实用新型	202223518681X	一种高精度点胶装置	2022/12/28	原始取得
179	宇隆研究院	实用新型	2022235187259	一种保护胶带切断装置	2022/12/28	原始取得
180	宇隆研究院	实用新型	2022235204038	一种防止吸嘴口粘附的贴片吸嘴结构	2022/12/28	原始取得
181	宇隆研究院	实用新型	2022235510781	一种改进型贴片吸嘴驱动机构	2022/12/28	原始取得
182	青岛宇隆	发明专利	2022117056329	一种贴片机吸嘴清洗装置	2022/12/29	原始取得
183	宇隆研究院	发明专利	2022117242356	一种显示效果的调整方法、装置、设备、介质及显示器	2022/12/30	原始取得
184	宇隆研究院	实用新型	2022231737442	一种 SMT 生产加工用炉后冷却装置	2023/02/22	原始取得
185	安徽灿宇	实用新型	2023206856890	模切自动接料机	2023/03/30	原始取得
186	安徽灿宇	实用新型	2023207027809	圆刀高精度分条半切治具	2023/03/31	原始取得
187	宇隆科技	实用新型	2023209943994	一种有效防呆的 PCB 治具	2023/04/27	原始取得
188	安徽灿宇	实用新型	2023209952391	一种膜材检测装置	2023/04/27	原始取得
189	武汉宇隆	实用新型	2023209954132	一种 PCB 板载具	2023/04/27	原始取得
190	宇隆科技	实用新型	2023210017272	一种分段设计式轨道挡板	2023/04/28	原始取得
191	宇隆科技	实用新型	2023210017215	一种位置可调式扫描器结构	2023/04/28	原始取得
192	武汉宇隆	实用新型	2023210064428	PCB 板贴标辅助工装	2023/04/28	原始取得
193	武汉宇隆	实用新型	2023210065280	料膜折边机构	2023/04/28	原始取得
194	宇隆科技	实用新型	202321344433X	一种使用稳定的固定支架	2023/05/30	原始取得
195	宇隆研究院	实用新型	2023213443816	一种自带割胶刀片的载具结构	2023/05/30	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
196	宇隆研究院	实用新型	2023213442940	一种加工用自感应离子吹风机构	2023/05/30	原始取得
197	宇隆研究院	实用新型	202321344296X	一种防止录错的可调式条码扫描器结构	2023/05/30	原始取得
198	安徽灿宇	实用新型	2023213593419	一种自动排废治具	2023/05/31	原始取得
199	安徽灿宇	实用新型	2023213592825	一种 CCD 料带检验装置	2023/05/31	原始取得
200	宇隆科技	实用新型	2023213593122	一种适用于异形物料的吸嘴	2023/05/31	原始取得
201	合肥宇隆	实用新型	2023213592469	一种 PFT 测试治具	2023/05/31	原始取得
202	安徽灿宇	实用新型	2023213631938	一种模切加工用胶带接头治具	2023/05/31	原始取得
203	安徽灿宇	实用新型	2023216751217	模切样品贴合排废治具	2023/06/29	原始取得
204	合肥宇隆	实用新型	2023216818753	一种阻抗测试治具	2023/06/29	原始取得
205	合肥宇隆	实用新型	202321681671X	一种便于换料的贴标机料枪	2023/06/29	原始取得
206	宇隆研究院	实用新型	202321699010X	一种模切快速调模卡位机构	2023/06/30	原始取得
207	北海宇隆	实用新型	2023216905361	一种用于 PCBA 的防呆 Tray 盘	2023/06/30	原始取得
208	合肥宇隆	实用新型	2023216879831	一种用于 PCBA 板的分板治具	2023/06/30	原始取得
209	重庆升越达	实用新型	2023216990025	一种可调节平台角度检验设备	2023/06/30	原始取得
210	北海宇隆	实用新型	2023216988398	一种可多向调节的扫码仪固定支架	2023/06/30	原始取得
211	重庆升越达	实用新型	2023216987643	一种便于排废的模切结构	2023/06/30	原始取得
212	福州宇隆	实用新型	2023220118138	SMT 回流炉智能冷却系统	2023/07/28	原始取得
213	北海宇隆	实用新型	2023220122345	一种快速取板的 pcb 板载具工装	2023/07/28	原始取得
214	重庆升越达	实用新型	2023220122415	一种模切加工用来料位置调节装置	2023/07/28	原始取得
215	宇隆研究院	实用新型	2023220121766	一种膜材剥离机构	2023/07/28	原始取得
216	合肥宇隆	实用新型	2023220123935	一种钢网远距离安全周转装置	2023/07/28	原始取得
217	福州宇隆	实用新型	2023220123422	一种 tray 盘限位防反向的装置	2023/07/28	原始取得
218	福州宇隆	实用新型	2023220286468	FCT 工装自动取放装置	2023/07/31	原始取得
219	武汉宇隆	实用新型	2023220284250	一种印刷机刮刀	2023/07/31	原始取得
220	宇隆研究院	实用新型	2023220287051	模切卷材检验治具	2023/07/31	原始取得
221	福州宇隆	实用新型	2023220349607	一种印刷机钢网堵孔检测擦拭装置	2023/07/31	原始取得
222	重庆升越达	实用新型	2023223461717	一种用于传送带表面废料的清理导料机构	2023/08/30	原始取得
223	宇隆研究院	实用新型	2023223461721	一种可调式检测灯源固定架	2023/08/30	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
224	重庆升越达	实用新型	2023223613512	一种柔性材料贴合装置	2023/08/31	原始取得
225	宇隆研究院	实用新型	2023223613279	一种可拆卸模具支撑座	2023/08/31	原始取得
226	重庆升越达	实用新型	2023223613387	一种光学膜原材侧边清洁机构	2023/08/31	原始取得
227	武汉宇隆	实用新型	2023223613264	一种便于探针检测的 PCBA 工装	2023/08/31	原始取得
228	宇隆科技	实用新型	2023223520128	一种吸嘴固定机构	2023/08/31	原始取得
229	重庆升越达	实用新型	2023223520147	一种模切产品收料机构	2023/08/31	原始取得
230	宇隆科技	实用新型	2023223520151	一种钢网防呆滑槽机构	2023/08/31	原始取得
231	宇隆研究院	实用新型	2023223613245	一种多工位抓取设备	2023/08/31	原始取得
232	合肥宇隆	实用新型	2023226176103	一种千分尺检测治具	2023/09/26	原始取得
233	合肥宇隆	实用新型	2023226175740	一种带温度检测预警机构的锡膏存储柜	2023/09/26	原始取得
234	宇隆研究院	实用新型	2023226177430	一种多工位显示器固定支架	2023/09/26	原始取得
235	武汉宇隆	实用新型	2023226577289	一种伸缩型吸嘴结构	2023/09/28	原始取得
236	宇隆研究院	实用新型	2023226434105	一种产品载具快速换型装置	2023/09/28	原始取得
237	宇隆研究院	实用新型	2023226434073	一种模切加工用变磁刀辊	2023/09/28	原始取得
238	宇隆研究院	实用新型	2023226458311	一种多向调节式吸嘴结构	2023/09/28	原始取得
239	宇隆研究院	实用新型	2023226577255	一种模切加工用高效接料装置	2023/09/28	原始取得
240	北海宇隆	实用新型	2023229339070	一种夹爪吸嘴联动式夹板机构	2023/10/31	原始取得
241	宇隆研究院	实用新型	2023229339117	一种点胶管固定支架	2023/10/31	原始取得
242	宇隆研究院	实用新型	2023229339206	一种 BGA 植球装置	2023/10/31	原始取得
243	福州宇隆	实用新型	202322933923X	一种 PCB 阶段冷却硬件装置	2023/10/31	原始取得
244	安徽灿宇	实用新型	2023229339259	一种用于废料筛选的翻转落料装置	2023/10/31	原始取得
245	武汉宇隆	实用新型	2023229339333	一种回流炉废气加速排出机构	2023/10/31	原始取得
246	宇隆研究院	实用新型	2023229339210	一种 USB 吸嘴	2023/10/31	原始取得
247	宇隆研究院	实用新型	2023229339032	一种吸盘位置可调式 PCB 板推料机构	2023/10/31	原始取得
248	宇隆研究院	实用新型	2023231854991	一种产品载具条码及 PCB 条码一体式扫描机构	2023/11/24	原始取得
249	宇隆研究院	实用新型	2023232199174	一种有效清除孔废的排废机构	2023/11/28	原始取得
250	宇隆研究院	实用新型	2023232225319	一种双重点胶方式的点胶机构	2023/11/29	原始取得
251	宇隆研究院	实用新型	2023232521596	一种防崩刀嵌入式尖刀模具	2023/11/30	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
252	福州宇隆	实用新型	2023232500072	一种大保护膜 AOI 检测设备	2023/11/30	原始取得
253	宇隆研究院	实用新型	2023232500034	一种 SMT 贴片加工用物料转移翻转机构	2023/11/30	原始取得
254	宇隆研究院	实用新型	2023235026552	一种 PCBA 板拉力检测固定辅助治具	2023/12/21	原始取得
255	宇隆研究院	实用新型	2023235026533	一种带防磨不锈钢条的载具送料凹槽结构	2023/12/21	原始取得
256	宇隆研究院	实用新型	2023235893603	一种底部条码扫描读取装置	2023/12/27	原始取得
257	宇隆研究院	实用新型	2023236149776	一种 PCBA 板测试工装	2023/12/28	原始取得
258	福州宇隆	实用新型	2023236037982	一种印刷机钢网锡膏高度测量机构	2023/12/28	原始取得
259	宇隆研究院	实用新型	2023236449893	一种 PCB 板维修卡具	2023/12/29	原始取得
260	宇隆研究院	实用新型	2023236449910	一种钢网检测台	2023/12/29	原始取得
261	宇隆研究院	实用新型	2023236609286	一种 SMT 加工用钢网安装工装	2023/12/29	原始取得
262	宇隆研究院	实用新型	2023236449944	一种气动抽取废料盘卷辊机构	2023/12/29	原始取得
263	安徽灿宇	实用新型	2024202206417	一种模切加工用镶块式雕刻模具	2024/01/16	原始取得
264	重庆升越达	实用新型	2024202296714	一种物料倒料轴	2024/01/23	原始取得
265	安徽灿宇	实用新型	2024203817117	一种分体快拆式五金模结构	2024/02/20	原始取得
266	宇隆科技	实用新型	2024203817155	一种双面旋转式点锡焊接装置	2024/02/22	原始取得
267	重庆升越达	实用新型	2024203817189	一种光学膜片自动上料调节装置	2024/02/22	原始取得
268	宇隆科技	实用新型	2024206238262	一种便于矫正模组位置的编带机	2024/03/11	原始取得
269	福州宇隆	实用新型	2024206396887	一种定位高温胶带的定位轮	2024/03/12	原始取得
270	安徽灿宇	实用新型	2024206238277	一种模切加工用废料操作机构	2024/03/20	原始取得
271	宇隆科技	实用新型	2024206238243	一种嵌入式警示灯	2024/03/22	原始取得
272	北海宇隆	实用新型	2024206238239	一种防起翘的 PCB 载具结构	2024/03/25	原始取得
273	福州宇隆	实用新型	2024206396872	一种贴片机三层 feeder 通电式放置车	2024/03/27	原始取得
274	合肥宇隆	实用新型	2024208760806	一种波峰焊锡渣筛取装置	2024/04/12	原始取得
275	合肥宇隆	实用新型	2024208760740	一种 PCBA 自动化功能测试装置	2024/04/12	原始取得
276	重庆升越达	实用新型	2024209152598	一种模切排废设备用调节式刮刀结构	2024/04/17	原始取得
277	武汉宇隆	实用新型	2024208730020	一种防偏式麦拉进料器结构	2024/04/18	原始取得
278	宇隆科技	实用新型	2024209388933	一种 SPI 上传和下载的控制和辅助电路	2024/04/22	原始取得
279	宇隆科技	实用新型	2024212294734	一种 I2C 烧录读写的电平转换的隔离保护电路	2024/04/22	原始取得

序号	申请人	专利类型	申请号/专利号	发明名称	申请日	取得方式
280	宇隆研究院	实用新型	2024209388878	一种 SMT 贴片加工用模组识别机构	2024/04/30	原始取得
281	武汉宇隆	实用新型	202421215369X	一种 PCB 板测试用多尺寸工装	2024/05/30	原始取得
282	武汉宇隆	实用新型	2024212153685	一种可调式 tray 盘结构	2024/05/30	原始取得
283	安徽灿宇	实用新型	2024212216190	模切胶条贴合治具	2024/05/31	原始取得
284	重庆升越达	实用新型	2024212216171	一种补强胶带类产品模切测选设备	2024/05/31	原始取得
285	安徽灿宇	实用新型	2024212216203	一种模切接料治具	2024/05/31	原始取得
286	合肥宇隆	实用新型	2024215074242	一种 PCBA 放置治具	2024/06/14	原始取得
287	合肥宇隆	实用新型	2024215008236	一种 PCB 金手指吹扫除尘清洁装置	2024/06/14	原始取得
288	福州宇隆	实用新型	2024214882995	一种双轨式 PCB 板金手指检测装置	2024/06/17	原始取得
289	宇隆科技	实用新型	2024215052351	一种 PCBA 金手指覆膜工装	2024/06/21	原始取得
290	宇隆科技	实用新型	2024215074280	一种 FPC to FPCA 假性压合测试工装	2024/06/24	原始取得
291	合肥宇隆	实用新型	2024218204712	一种自适应防浮高波峰焊插件治具	2024/07/30	原始取得
292	北海宇隆	实用新型	2024218367832	一种 PCB 载具钢片超声清洁装置	2024/07/31	原始取得
293	宇隆研究院	实用新型	2024218367762	一种利用光学相机的波峰焊插件零件产品检测装置	2024/07/31	原始取得
294	宇隆研究院	实用新型	2024221209177	一种可灵活固定刀模的刀模架	2024/08/30	原始取得
295	宇隆研究院	实用新型	2024218204638	一种显示屏电路板的接触式测试设备	2022/03/11	原始取得
296	武汉宇隆	实用新型	2024218204676	一种进料稳定的可调式料盘结构	2024/07/30	原始取得
297	合肥宇隆	实用新型	2024221132118	一种用于印刷机刮刀的平整度检查装置	2024/07/30	原始取得
298	宇隆研究院	实用新型	2024227147583	一种 SMT 加工用刮刀存放装置	2024/12/31	原始取得
299	宇隆研究院	实用新型	202422940364X	一种 PCBA 平整度校正辅助工装	2024/11/7	原始取得
300	宇隆研究院	实用新型	2024227147545	模切加工用泡棉胶贴合装置	2024/11/29	原始取得
301	宇隆研究院	实用新型	2024233162006	一种自动撕膜排废机	2024/11/7	原始取得
302	宇隆研究院	实用新型	2024233162044	一种堆叠放置装置	2024/12/31	原始取得
303	青岛宇隆	实用新型	2024232664024	一种锡膏印刷机	2024/12/31	原始取得
304	青岛宇隆	实用新型	2024232664058	一种具有精确裁剪功能的 SMT 接料装置	2024/12/30	原始取得
305	宇隆研究院	实用新型	2024232828927	一种非线性的底仓条码读码装置	2024/12/30	原始取得
306	宇隆研究院	实用新型	2024232828908	一种贴合机胶带排废治具	2024/12/30	原始取得

注：序号第 42、43、44、55、56、57、175、178、182、240 号的专利系公司子公司原始取得，并无偿转让予发行人或其他子公司主体

截至本招股说明书签署日，发行人已授权的专利不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

（2）继受取得及共有专利权情况

截至报告期末，发行人及其子公司取得的专利中有 4 项为继受取得，发行人不存在与他人共有专利情形。除发行人及其子公司之间转让专利的情况外，其他继受取得的专利具体情况如下：

序号	专利名称	类型	专利号	受让方	转让方	转让时间
1	一种具有高精度定位连续加工效果的偏光片贴附机	发明专利	2022102416942	宇隆科技	赤峰拓佳光电有限公司	2023/05/30
2	一种用于贴片元件焊接的装配系统	发明专利	2021115039521	宇隆科技	王晓娜	2023/05/30
3	基于图像处理的印制线路板缺陷检测方法	发明专利	2022106468221	宇隆科技	郑州卓润电子科技有限公司	2023/05/30
4	一种电路板加工用二极管针脚打磨装置	发明专利	2021114638802	宇隆科技	陈炎城	2023/05/30

发行人及子公司上述继受取得的专利均合法、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。

3、商标权

截至报告期末，发行人及其子公司共有 4 项注册商标权，具体情况如下：

序号	商标	注册号	类别	申请-	有效期限	取得方式
1	Eong	51852001	9	宇隆科技	2021/12/28-2031/12/27	原始取得
2	Eong	51831040A	9	宇隆科技	2021/11/21-2031/11/20	原始取得
3	宇隆光电	23051168	9	宇隆科技	2018/05/14-2028/05/13	原始取得
4	宇隆光电	23051121	11	宇隆科技	2018/05/14-2028/05/13	原始取得

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已注册的商标不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

4、软件著作权

截至报告期末，发行及其子公司拥有 31 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	取得方式
1	宇隆科技	2024SR1324129	重庆宇隆光电智能制造 MES(DIP)系统 V1.0	—	—	原始取得
2	宇隆科技	2024SR0321183	重庆宇隆光电生产看板系统 V1.0	2023/12/10	未发表	原始取得

序号	著作权人	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	取得方式
3	宇隆科技	2023SR0920669	重庆宇隆光电智能仓储 WMS 系统 V1.0	2023/05/31	未发表	原始取得
4	宇隆科技	2023SR0060623	重庆宇隆光电智能制造 MES 系统 V1.0	2022/08/31	未发表	原始取得
5	宇隆科技	2025SR0828694	重庆宇隆光电治工具管理系统 V1.0	—	未发表	原始取得
6	安徽灿宇	2018SR607975	灿宇胶带智能生产全自动控制系统 V1.0	2017/07/04	2017/07/14	原始取得
7	安徽灿宇	2018SR608050	灿宇胶带合成热处理监控软件 V1.0	2017/09/13	2017/09/23	原始取得
8	安徽灿宇	2018SR607979	灿宇抗菌性 PVC 保护膜性能测试系统 V1.0	2018/04/13	2018/04/23	原始取得
9	安徽灿宇	2018SR607970	灿宇环保型 PET 保护膜材料加工控制管理系统 V1.0	2018/05/18	2018/05/28	原始取得
10	安徽灿宇	2018SR606652	灿宇 PE 保护膜智能包装系统 V1.0	2017/02/02	2017/02/17	原始取得
11	合肥宇隆	2018SR542075	电源电路板蚀刻控制系统 V1.0	2018/03/15	未发表	原始取得
12	合肥宇隆	2018SR541144	高密度互连电路板电测系统 V1.0	2018/03/15	未发表	原始取得
13	福州宇隆	2018SR959825	锡膏印刷质量检验系统 V1.0	2018/02/09	2018/03/14	原始取得
14	福州宇隆	2018SR954861	锡膏印刷数据采集分析系统 V1.0	2018/06/15	2018/07/24	原始取得
15	福州宇隆	2018SR957326	贴片机贴片控制管理系统 V1.0	2017/09/16	2017/09/25	原始取得
16	福州宇隆	2018SR959901	贴片机抛料控制系统 V1.0	2017/02/11	2017/03/22	原始取得
17	福州宇隆	2018SR959866	贴片机生产线检测设备管理系统 V1.0	2017/07/06	2017/08/21	原始取得
18	福州宇隆	2018SR959865	静电报警系统 V1.0	2017/04/08	2017/05/20	原始取得
19	福州宇隆	2018SR958343	分布式回流焊温度监测控制系统 V1.0	2017/11/11	2017/12/12	原始取得
20	福州宇隆	2018SR959827	贴片自动检查系统 V1.0	2017/09/14	2017/10/31	原始取得
21	福州宇隆	2018SR959580	烧录机 IC 针脚视觉测量系统 V1.0	2018/03/09	2018/04/25	原始取得
22	福州宇隆	2018SR959824	炉温跟踪测试与数据分析系统 V1.0	2018/05/12	2018/05/28	原始取得
23	福州宇隆	2022SR0242450	线路板双面 AOI 自动光学检测系统 V1.0	2020/11/07	2020/11/09	原始取得
24	福州宇隆	2022SR0250928	PCBA 板检测设备智能控制系统 V1.0	2020/12/04	2020/12/05	原始取得
25	福州宇隆	2022SR0250929	PCBA 自动贴片加工控制系统 V1.0	2021/06/05	2021/06/08	原始取得
26	福州宇隆	2022SR0249353	电路板生产上料控制系统软件 V1.0	2021/07/12	2021/07/15	原始取得
27	福州宇隆	2022SR0249351	贴片机运行参数控制系统 V1.0	2021/08/20	2021/08/22	原始取得
28	福州宇隆	2022SR0250932	通用 AOI 智能检测软件 V1.0	2020/10/16	2020/10/18	原始取得
29	武汉宇隆	2021SR1688528	PCBA 贴片机贴片控制管理系统 V1.0	2021/03/24	2021/05/06	原始取得
30	武汉宇隆	2021SR1688859	PCBA 回流焊炉温监控控制系统 V1.0	2021/04/18	2021/06/13	原始取得

序号	著作权人	登记号	软件名称	开发完成日期	首次发表日期	取得方式
31	宇隆科技	2025SR1473762	重庆宇隆光电运营看板系统	2025/06/18	未发表	原始取得

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司的软件著作权不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况。

（三）许可经营资质和特许经营权

报告期内，公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售。截至本招股说明书签署日，公司及其控股子公司拥有的与其主营业务有关的资质、证书情况如下：

1、经营资质情况

（1）海关进出口货物收发货人备案回执

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已就进出口业务取得了对外贸易经营者备案登记表并办理了进出口货物收发货人备案手续，具体情况如下：

公司名称	资质名称	编号	许可范围	首次备案日期
发行人	对外贸易经营者备案登记表	05081463	-	2016/05/27
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：重庆两路寸滩保税港区水港功能区	2016/06/03
重庆升越达	对外贸易经营者备案登记表	05084188	-	2016/08/23
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：重庆两路寸滩保税港区水港功能区	2016/08/29
安徽灿宇	对外贸易经营者备案登记表	01446636	-	2013/04/25
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：庐州海关	2013/04/26
宇隆研究院	对外贸易经营者备案登记表	05084183	-	2022/01/14
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：重庆两路寸滩保税港区水港功能区	2022/01/21
合肥宇隆	对外贸易经营者备案登记表	02360850	-	2017/03/23
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：庐州海关	2017/03/28
武汉宇隆	对外贸易经营者备案登记表	04723976	-	2020/07/30
	报关单位备案	-	经营类别：进出口货物收发	2020/10/15

公司名称	资质名称	编号	许可范围	首次备案日期
			货人 所在地海关：汉阳海关	
隆美卡机器人	报关单位备案	5009240A0B	经营类别：进出口货物收发货人 所在地海关：两路寸滩海关	2025/11/25

（2）环保相关资质证书

截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司已依法办理排污登记手续，其排污许可证、固定污染源排污登记回执记载内容如下：

序号	单位名称	登记编号	生产经营场所地址	有效期至
1	发行人	91500000092411201U001Z	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号	2030/03/26
2	重庆升越达	91500000MA5U5YU55A001X	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号	2030/03/25
3	合肥宇隆	91340100MA2N9BKWXD001Q	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房内	2030/06/22
4	安徽灿宇	91340100058493047Q001U	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房	2030/06/18
5	福州宇隆	91350181MA2XTG336R001Y	福建省福州市福清融侨经济开发区斯泰克工业园 3#楼一、二层	2030/06/19
6	武汉宇隆	91420112MA4K4KDA3T001X	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号巨神产业园 1 幢 1 楼和 6 楼	2026/08/24
7	河北宇隆	91131082MA09G4M975001X	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号谊安工业园 A 栋	2025/04/22 注
8	北海宇隆	91450500MAA7HUOE05001X	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道 1 号广西惠科智能显示有限公司 A04 栋西面一层	2027/10/20
9	青岛宇隆	91370211MAC5XD121G001X	山东省青岛市黄岛区陡楼山路 777 号 1# 车间户	2028/08/01
10	成都宇隆	91510100MAD1KKMJ0T001W	成都高新区新创路 28 号 5#厂房 2F 西侧	2029/10/07

注：河北宇隆已停止生产，排污许可手续到期后不再续期。

2、特许经营权情况

截至本招股说明书签署日，公司未拥有特许经营权。

六、公司技术与研发情况

（一）公司核心技术及其应用

截至本招股说明书签署日，公司核心技术的具体情况如下：

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
显示用智能控制卡设计及性能优化	显示效果优化技术	显示用智能控制卡	针对不同温度环境液晶偏转角不一致导致的显示效果差异，通过在显示面板上的多组温度传感器实时反馈显示面板温度数据，搭配显示控制板上的自研补偿电路，能根据面板温度变化实时调整液晶分子的偏转电压，改善了液晶偏转角均一性不佳的问题，保证了显示模组在不同温度环境下显示效果的一致性	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	2022231919309 一种液晶显示设备的温度补偿电路 2022117242356 一种显示效果的调整方法、装置、设备、介质及显示器
	背光亮度均一性补偿技术	显示用智能控制卡	针对传统显示面板背光调光技术对显示效果均一性的负面影响，通过建立了背光控制信号系统和液晶分子偏转角控制系统的双系统实时耦合关系，建立了背光 PWM 信号与液晶分子偏转电路中 TFT 栅压的微秒级反馈链路，实现了背光控制和液晶分子偏转角的联动动态补偿控制，使得显示面板在背光亮度变化的情况下保持了画面显示效果一致	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	DFM 可制造性设计及模拟仿真应用技术	显示用智能控制卡	通过开发软件的建模算法对标准 Gerber 文件进行转换建模，形成 3D 虚拟产品的模型，实现了在设计阶段就对产品的 3D 整体模型进行观察和自动匹配规则库进行检查，达到了在资料设计阶段就提前检查出电子器件和 PCBLayout 设计缺陷问题，有效缩短新产品开发周期	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
显示用智能控制卡精密制造技术	软硬板高精密连接技术	显示用智能控制卡	一方面，通过对产品的焊点仿形设计钛合金压头，达到高导热和降低热效率损失的效果，实现了精准的焊接温度控制的效果。另一方面，通过在设备中整合视觉检测装置，在软板和硬板的对位时实现精准的视觉定位，实现了对位偏差±0.1mm 的精度，完成高密度小间距的刚性板与柔性板信号线路的垂直连接	自主研发	后段工艺-Hotbar	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度 SMT 定位装联技术	显示用智能控制卡	该技术通过自主设计的高精度合金治具对 PCB 进行精准定位，通过搭配纳米钢网，可以实现 0.2mm 小间距及 0.25*0.125mm 封装器件的贴装焊接，从而提升焊接良率，提高器件的贴装密度和集成度	自主研发	前段工艺-贴片	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	精密视觉与算法技术	显示用智能控制卡	该技术优化了 AOI 设备的多角度光学检测技术：通过增加彩色成像加侧视光源组合，识别元件偏移、立碑、焊球缺失等缺陷，尤其针对连接器等器件侧边隐藏焊点进行 3D 建模分析，增加设备的拦截率	自主研发	前段工艺-AOI 检测	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	Hotbar 高效自动组装技术	显示用智能控制卡	通过工艺设计和技术整合，达到了 Hotbar 流程从上料到下料的高效自动化生产技术需求：1、通过对 Hotbar 焊接工艺和生产流程的梳理，设计出完整的焊接线体。线	自主研发	后段工艺-Hotbar	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			体通过设计专用的多拼板焊接治具和整合自动点助焊剂的装置，实现自动定位点助焊剂，达到高效生产的目的，实现了 6 倍的点助焊剂效率提升；2、通过整合 Hotbar 焊接压头的设计，将 6 个压头进行设计合并，实现了多拼板同时生产的目的，实现了焊接效率提升 6 倍的效果；3、通过设计专用的下料装置，整合真空吸嘴和 Tray 盘上下料的自动定位和剥离机构，实现对生产后的自动吸附至 Tray 中，达到了自动化下料的目的				
	微米级 SMT 电子封装技术	显示用智能控制卡	一方面，通过 SMT 纳米钢网的优化及炉温的精准控制，使元器件焊点上的助焊剂充分挥发，减少助焊剂的阻隔，提升了胶水的毛细蔓延效果，实现了 UF 胶填充率由 90%提升至 100%的进步。另一方面，通过优化 UV 胶水的成分配比，同时配合调整点胶机的点胶路径，实现了将溢胶范围控制在 0.6mm 以内，使胶水的涂敷厚度＞25um。达到了防水等级 IPX8 级，实现 30 米生活防水	自主研发	后段工艺-底部填充点胶	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度组合涂覆技术	显示用智能控制卡	通过对点胶设备改造雾化阀和电磁阀的合并，可以进行双阀同时作业，对于点胶精度要求高的区域使用电磁阀点胶，要求不高的全区域使用雾化阀点胶，实现了高精度的三防胶水点胶工艺的同时还保存着高效的点胶效率。达到了三防点胶 1.5mm 溢胶的高标准需求	自主研发	后段工艺-点三防漆	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
显示用智能控制卡检测技术	线路测试保护技术	显示用智能控制卡	通过研发用于芯片读写与测试过程的控制、隔离、保护电路及测试程序，大幅降低芯片的数据传输丢失率、信号的抗干扰性能及外源对芯片造成的浪涌损坏	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024209388933 一种 SPI 上传和下载的控制和辅助电路 2024212294734 一种 I2C 烧录读写的电平转换的隔离保护电路
	微米级、多维度采样检测技术	显示用智能控制卡	通过研发动静态结合测试技术、自容互容模拟检测技术、智压检测装置并结合高精度视觉技术和运控系统，替代行业传统的探针测试技术并实现自动化。从而将测试采样点的最小尺寸由毫米级降低至微米级，将传统的单一测试能力提升至多维度测试，同时大幅提升缺陷侦测率、测试直通率及测试稳定性	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024215074280 一种 FPCtoFPCA 假性压合测试工装 2021231536650 一种具有导向功能的 FPC 软板测试装置
	高自由度测试设备技术	显示用智能控制卡	采用自主研发融合飞针的静态测试系统、动态测试系统、并行测试技术，通过软件编程的高效测试路径，取代传统的固定针模的人工测试治具。实现无治具的通用型与自动化测试，并且该技术采用编程及算法，程序化	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024106987650 一种电路板的智能型无载测试装置、系统及其方法；

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			并行测试待测品的性能参数，通过 SPEC 管控采样数据的准确性，筛选出瑕疵品，从而大幅提升测试效率、测试覆盖率				2020115301100 一种控制板卡专用检测台；2024206238243 一种嵌入式警示灯
	OLED 控制卡智能检测技术	显示用智能控制卡	通过研发集成多轴机械手臂控制系统、多功能视觉辅助系统和开发新型的产品载具快速换型装置，实现对各种显示用智能控制卡自动化测试及自动分拣。该技术下的全自动化测试实现“无人化”作业，数倍提升检测效率、提升 40%以上的测试覆盖率	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2023226434105 一种产品载具快速换型装置 2024218204638 一种显示屏电路板的接触式测试设备 2020115496611 一种用于测试产品性能的自动化测试设备及系统
	自动化外观检测技术	显示用智能控制卡	通过研发优化 AOI 程序及开发金面检测算法与装置，用于高效、精密的检测控制卡的金面缺陷。该技术结合自动化装置，替代传统的裸眼检查，提升自动化水平、提高产品可靠性及良率，并保障产品出货质量稳定提升至国际标准最高等级 CLASS3，处于行业领先水平	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	201720527772X 一种电路板自动检测设备 2021222120538 一种 AOI 检测装置
精密功能器件开发、优化与治具设计技术	背光模组支撑体系优化技术	显示用精密功能器件	通过新材料组合 PSA（压敏胶）、PET 材质以及 Foam（泡棉）替代传统注塑支架，在保障性能基础上，简化生产步骤，有效降低生产物料与加工成本；相比传统注塑支架生产，更利于批量、标准化制造，提升生产效率与产品一致性	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	磁性辊轴裁切技术	显示用精密功能器件	通过定制一种带有强磁性辊轴，配合厚度仅 0.5mm 柔性复合钢板，在柔性钢板上雕刻出刀锋高度约 0.3mm 刀锋，磁性辊轴上设计专用定位装置，把设计好的柔性钢板按照定位贴合在强磁辊轴上，可临时替代实体圆刀进行器件裁切，该技术应用在结构复杂，精度高产品上，相对于实体圆刀，模具成本节约 60%以上	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度圆角刀锋角度设计与仿真技术	显示用精密功能器件	经 CAD/CAM 协同及逆向工程优化，刀模设计精度重塑，曲面与刃口轮廓更精准，提升加工及模切质量；同时通过五轴联动（CNC）与慢走丝技术，实现 0.2mm 圆角区域达±5um 高精度，满足精密模切对刀模尺寸严苛要求	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	金属模切件边缘平整度技术	显示用精密功能器件	通过逆向工程与参数化建模结合，让圆弧圆角刀模曲面重构误差大幅降低，刃口轮廓更贴合精密模切需求，设计精度从传统模式的“经验依赖型”升级为“数据驱动型”，为后续加工奠定精准基础。弹性缓冲压料机构	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			（压面）可自动适应材料厚度与张力，浮动式裁切组件补偿加工与装配公差，两者配合让裁切时材料定位偏差＜0.05mm，毛刺率降至 0.5%以下，挤压变形问题减少 90%以上，实现金属模切件边缘过渡区域平整度，满足消费电子、医疗设备等领域精密模切件的表面质量标准				
精密功能器件精密制造技术	多层次复合材料贴合处理技术	显示用精密功能器件	通过自主研发的贴合设备，完成对多层次复合材料进行预剥离，并同时完成二次贴合，并配套设计张力控制系统及 AOI 检测系统和自动纠偏系统，实现了贴合精度≤0.1mm,贴合过程中横张力控制，提升了材料在裁切前端的稳定性，解决了复合材料由于贴合张力差异性导致的翘曲现象	自主研发	材料复合	应用阶段，应用于主营业务产品	2024107019939 一种模切材料贴合处理方法及贴合装置
	废料剥离角度精密控制技术	显示用精密功能器件	通过自主设计可移动平台，在平台上设计有特殊角度导轨及卡槽，通过卡槽及导轨配合可实现剥离刮刀呈现-45°至 135°范围内进行调整，可结合产品不同结构设置角度达到最优剥离效果，具有操作方便，适配性高，大大降低遗漏风险	自主研发	材料复合	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	零间距智能协控技术	显示用精密功能器件	实现产品间工艺间距的零距离，最大化利用材料，降低人力成本；同时，实现了机械化“零排废”替代人工操作，避免因人工排废导致的产品移位、尺寸不良问题，产品良品率显著提升，生产稳定性增强；此外，通过自动化排废工艺减少人工干预与调试时间，提升生产效率，缩短生产周期，适配大批量连续生产需求	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	多层材料异步协同技术	显示用精密功能器件	通过异步裁切技术优化主材排版间距，材料利用率显著提升，单位产出量显著提升，减少换卷停机损耗；解决厚主材胶体回粘问题，良品率大幅提升，避免因废料粘连（回粘）导致的产品撕裂、尺寸不良等问题	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	Y 向上异步协同送料技术	显示用精密功能器件	通过与线体 X 向出料垂直方向的上异步送料技术，优化主材分布集中性，材料利用率显著提升，单位产出量大幅提升；较于普通型异步技术，解决的同向长间距产品异步无法送料问题，解决了 X 向长尺寸局部材料的异步送料褶皱、气泡等问题；Y 向可以使用宽幅较大，异步位置为 X 向排布的产品类型；同时该技术也解决了 X 同向异步的易产生的问题点，改善了 X 向出料窄宽幅分切痛点，通过更换走料方向提升设备可操作性，解决了分切、模切中的窄料问题瓶颈	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
	全自动折叠对贴技术	显示用精密功能器件	该方案省去人工贴合步骤，以及单片冲压的低效率问题，实现了半成品不停机联机贴合冲压。通过结构贴合改良，解决了两种或多种材料重叠无法裁切的问题，利用贴合设备机构自动翻折对贴后滚轮复压，进而完成贴合，再次套位联机冲切外形的步骤；相比传统多层重叠材料通过单片手工贴合后，单片再次冲压，完成直接跳过人工贴合过程和单片冲压低效率，贴合设备可自动完成折叠对贴，以卷材的形态进入下一道冲切步骤，制作重叠材料产品效率提升	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
精密功能器件检测技术	AOI在线检测技术	显示用精密功能器件	通过自主设计检测软件，建立产品资料库，配合红外感应系统以及在线打码技术，可实现对高精度产品尺寸、外观监控，并且可在线进行打码标识，大大降低人员漏失，提升产品质量稳定性	自主研发	AOI 检测	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

公司的主要产品及核心技术较为成熟，核心技术均系自主研发形成。公司通过建立研发管理制度等文件对研发活动和人员进行规范。公司对核心技术采取严格的保密措施，通过与核心技术人员签订保密协议、对部分核心技术申请专利保护、规范研发流程并实行严格的保密制度等方式，对公司的核心技术进行保护，能够有效防止核心技术流失。

（二）公司获得的资质及重要荣誉

公司收到主管机构以及行业协会的多项资质及荣誉认定，具体详见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务及演变的情况”之“（十）公司关于符合创业板定位的具体说明”之“2、公司的技术创新性及其表征”相关内容。

（三）公司正在从事的研发项目情况

截至本招股说明书签署日，公司主要的在研项目情况如下：

序号	项目名称	项目阶段	拟达到的目标水平	应用领域
1	移动设备OLED显示控制板	研发阶段	1.低功耗设计与电源管理：通过增加感光芯片，控制根据环境光强度和显示内容，动态调节屏幕亮度和刷新率。增加局部调光技术，将显示区域划分为多个独立控制区块，对暗区像素降低驱动电流，进一步提升能效 2、电磁兼容性设计：通过将数字电路、模拟电路物理隔离，并采用 PCB 分割接地层技术，避免不同信号间的相互干扰。针对高速信号传输，实施精确的阻抗控制	显示用智能控制卡
2	中小尺寸LCD显示控制板	研发阶段	1、触控控制：通过集成高性能触摸屏控制 IC 芯片，支持自电容和互电容检测，实现 10 点触控和 3mm 悬停识别。针对工业环境，增加了抗干扰设计，确保在电机、变频器等强干扰环境下仍能稳定工作。开发智能手势识别和手掌抑制算法，准确区分有意触控和无意接触，避免误操作 2、可靠性提升：通过优化元器件布局，缩短关键信号路径、分散发热元件并加强散热。通过 PCBA 板表面涂覆三防漆、外露接口配备 TVS 管和稳压二极管、BGA 封装元件 UF 胶加固，提升元件保护能力	显示用智能控制卡
3	LCD显示精密结构件研究	研发阶段	1、石墨烯铜箔包边抗碎裂：采用 PET 外扩屏蔽强化工艺，在石墨烯贴合阶段预覆外扩 0.05mmPET，通过压合使铜箔边缘和 PET 将石墨烯包裹，形成机械防护层，实现裁切面毛刺屏蔽 2、无基材导热胶深冷控流：解决无基材导热胶常温流淌引发的溢胶问题，开发低温贴合-裁切定型工艺：利用-30℃深冷冻结+0.5MPa 贴合把无基材导热胶溢胶宽度控制在＜0.05mm、节省 30min/班清理时间 3、多层复合材料裁切：运用复合导电屏蔽材料，验证不同材料裁切的最佳模具角度，过程中转移保护膜的顺畅剥离，边缘毛刺处理等，达到快速散热，高导通，屏蔽效能好的要求	显示用精密功能器件
4	消费品显示背光模切研究	研发阶段	1、集成化加工系统：采用复合冲裁模实现喷码/裁切/传送工序同步完成，工艺参数：运行速度≤30 次/分钟，模具间隙<1mm，材料利用率预计提升 30%；配备高精度伺服电	显示用精密功能器件

序号	项目名称	项目阶段	拟达到的目标水平	应用领域
			机同步传送系统（时序误差±0.1s） 2、防错机制：集成激光喷码模组，采用高精度数字化循环控制系统 3、自动化工艺流程：实现自动化的材料上料、精确定位、喷码质量校验、自动裁切、成品传送等	
5	OLED 柔性显示模切研究	研发阶段	1、组合技术：实现多种功能材料的高精度、洁净化组合。解决复合过程中的兼容性问题，确保整个制程环境洁净度达标，特别针对局部微小结构实现无损、完整的精密贴合，避免材料在复合过程中产生压痕、褶皱或污染，同时整合多种工艺设备于一体化的生产流程。实现开发各工艺间的无缝衔接与精准协同控制，实现加工精度的显著提升 2、模具设计：针对特定产品结构，创新性地采用反向设计思维进行模具排版。深度分析材料特性（如延展性、应力分布）与产品几何形状，设计出最大化利用材料幅宽的排刀方案，确保模具结构能精确实现设计意图，预计达成材料利用率从 40%至 90%以上的跨越式提升 3、自动化智能贴装：开发高精度、高柔性的自动化贴装系统，集成视觉定位、精密运动控制、压力传感等关键技术。解决微小、异形或多层部件的精准拾取、对位和可靠贴合问题，实现高效、稳定的自动化生产，提升产品良率与产能	显示用精密功能器件
6	大尺寸 LCD 显示控制板	研发阶段	1、高分辨率与刷新率支持：实现控制板稳定支持 4K 分辨率、120Hz 高刷新率，以满足消费者对于高清、流畅画面的需求 2、接口兼容性与高速数据传输：实现控制板支持每通道 6Gbps 以上的数据速率，满足大尺寸 LCD 常采用 V-by-One 或 eDP 接口。确保控制板在高速信号传输中的稳定性与抗干扰能力，优化 PCB 布局与电源设计，降低信号衰减与延迟。同时支持 HDR10+、局部调光等先进显示技术，提升画面动态范围与对比度表现，为用户提供更优质的视觉体验 3、精准背光控制：对于 MiniLED 背光的大尺寸 LCD，控制板需要具备多区精确的分区控光能力	显示用智能控制卡
7	新能源汽车及储能控制单元	研发阶段	1、高效能量管理模块，设计多通道能量分配电路，实现对电池组的高效充放电管理，支持动态负载均衡，延长电池寿命 2、智能热管理系统，集成温度传感器和散热控制算法，实时监测电池温度，自动调节散热策略，防止过热或过冷 3、高速数据通信接口，采用 CAN 总线与车载网络无缝连接，支持高带宽数据传输，确保控制板与整车系统的高效协同 4、故障诊断与保护机制：内置自诊断功能，可实时检测电池状态、电路异常等，并触发保护措施，确保系统安全运行	其他
8	可穿戴设备控制板	研发阶段	1.微型化与高密度集成技术：采用刚柔结合板设计，在设备需要弯曲或折叠的部分使用柔性电路与主板刚性部分无缝连接，节省空间并提高可靠性；在组件集成方面采用 SiP 封装和 CSP 封装等先进器件封装技术，将主处理器、存储器、电源管理芯片等核心元件以三维堆叠方式集成，大幅减少占板面积 2.热管理与可靠性设计技术：在关键热源位置部署温度传感器件，实现动态温控调节，当检测到局部温度过高时，自动降低相关模块的性能或关闭非必要功能，确保表面温度始终低于 40℃的人体舒适阈值	显示用智能控制卡
9	高端笔记本电脑精密结构件	研发阶段	1、微米级复合模切工艺：融合激光模切与伺服驱动圆刀模切技术，开发“平刀预切+圆刀精修”复合工艺，实现模切尺寸公差稳定性及高精度，满足先进显示技术要求	显示用精密功能器件

序号	项目名称	项目阶段	拟达到的目标水平	应用领域
	模切产品研究项目		2、智能边缘质量优化：采用定制钨钢刀模并增设防粘涂层，配合压力闭环控制系统，解决模切胶带边缘溢胶、卷边问题，搭载 AI 视觉检测系统，实现边缘缺陷实时识别与工艺参数动态调整，控制边缘平整度误差 3、全尺寸 CPK 精准管控：通过整合 CCD 视觉定位等技术构建全流程尺寸监测体系，实现模切产品全尺寸参数实时采集分析，满足自动化机贴对尺寸一致性的严格要求	

（四）合作研发情况

报告期内，公司不存在合作研发的情形。

（五）研发费用

报告期内，公司研发费用及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

年度	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入	3,737.89	3,490.52	2,991.38
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
占营业收入比例	**3.29%**	**3.19%**	**4.29%**

（六）核心技术人员与研发人员情况

1、研发人员情况

基于在显示用智能控制卡和显示用精密功能器件领域的技术创新与实践，公司构建了以产品开发和工艺技术开发为核心的协同创新体系，通过技术研发与产业化的深度耦合，形成覆盖产品全生命周期的技术闭环。公司设立研发部专门开展日常研发工作。公司研发项目主要围绕开发、改良或优化显示用智能控制卡、显示用精密功能器件等相关产品、器件、生产工艺，以持续提高产品性能、优化生产工艺、提升生产效率，并进行相应的样品试制及测试工作，与主营业务密切相关。

报告期内，公司研发人员包括主要从事产品开发、工艺技术改进等直接从事研发活动的人员，以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员。报告期内，公司不存在将既从事研发活动又从事非研发活动，且当期研发工时占比低于50%的人员认定为研发人员的情况，也不存在将从事后勤服务的文秘、前台、餐饮、安保等人员认定为研发人员的情形。

报告期各期末，公司研发人员数量、占比、学历分布情况具体如下：

单位：人

项目	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比
本科及以上	42	34.43%	38	32.48%	34	30.63%
专科	68	55.74%	68	58.12%	67	60.36%
高中及以下	12	9.84%	11	9.40%	10	9.01%
研发人员合计	**122**	**100.00%**	**117**	**100.00%**	**111**	**100.00%**

报告期各期末，公司研发人员数量分别为 111 人、117 人及 122 人；研发人员数量占公司员工总数比例分别为 8.53%、9.13%及 8.71%。

报告期各期末，公司研发人员中拥有本科及以上学历的人数分别为 34 人、38 人及 42 人，占研发人员总人数的比例分别为 30.63%、32.48%和 34.43%，呈上升趋势；高中及以下学历人员主要为试产相关的技术工人。

2、核心技术人员及主要研发人员情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：

序号	名称	职位
1	徐建伟	副总经理
2	高文	研发总监
3	张文志	研发经理
4	王耀辉	研发经理

公司核心技术人员的学历背景、取得的专业资质以及简历情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（一）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

核心技术人员的重要科研成果以及对公司研发的具体贡献如下：

序号	姓名	学历背景	重要科研成果和奖项	对公司研发的具体贡献
1	徐建伟	本科	主导 I2C 烧录读写时电平转换隔离保护电路项目的开发，通过动态隔离与降压电路协同设计，降低过压损坏率，开发 SPI 上传下载控制与辅助电路，实现高低压域信号无损传输，数据传输稳定性提升显著，支撑公司通信模组；开发底部填充胶防溢胶工艺及设备，攻克小间距 BGA 封装溢胶难题，不良率下降显著；系公司 39 项授权专利的发明人之一	主持及参与了公司多项重大研发项目，为公司在液晶，OLED 显示模组控制卡的印刷，贴片，点胶，AOI 及测试等研发领域获得重大突破作出了突出贡献
2	高文	大专	主导开发胶带加工用模切设备与工艺，有效解决	主持及参与了公司在自动化

序号	姓名	学历背景	重要科研成果和奖项	对公司研发的具体贡献
			了模切过程中胶带易被拉断、切边起毛的问题，并显著提升了废料分离效率和产品良率。攻克料带张力自动调节技术难题，实现了对料带张力的动态自适应调节，有效解决了料带张力不均的问题，提升了加工稳定性。 开发了基于光透过原理的膜材检测装置，避免了传统手动撕扯检测对产品造成的损伤和浪费，提高了检测效率和准确性。优化模切胶条精密贴合工艺，确保产品与胶条在贴合过程中即使发生偏移也能同步移动，极大提升了胶条贴合的精准度和稳定性，有效降低了因错位偏移导致的 NG 品。系公司 25 项授权专利的发明人之一	设备开发、精密制造工艺优化、质量控制与检测技术等领域的多个关键研发项目。在胶膜材料加工、自动化排废、张力控制、机器视觉检测以及精密贴合组装等方面取得了一系列创新性成果，成功解决了生产过程中的多个技术瓶颈，显著提升了相关工序的自动化水平、生产效率、产品良率和质量稳定性。提升公司在精密模切领域的核心竞争力
3	张文志	本科	主导开发 BGA 植球装置，植球钢网结构通过组装单元锁定，确保锡球精准植入并排出多余物料。该成果避免了 BGA 物料因锡球变形而报废，使植球后的物料可与正常物料一同使用，显著节省了生产成本。主导开发基于 PCBA 的新型抗电磁干扰测试装置，实现测试器的便携性；携带测试器对多个 PCBA 板进行抗电磁干扰测试，大幅提高了工作效率，开发了固化治具固定装置，针对光学元件 UV 固化工艺设计，提高稳定性，以及工艺效率；系公司 14 项授权专利的发明人之一	主持并参与了多项关键技术项目，其创新成果显著推动了公司在 SMT 表面贴装技术领域的技术进步与市场竞争力提升
4	王耀辉	本科	主导开发创新的静态检测装置，通过芯片自锁模块、微针模组与静态综合测量仪器的组合设计，实现了对芯片 pin 脚内部网络的全面静态检测，摒弃传统检测中的复杂外围电路和上电操作，显著降低了检测成本并提升了检测效率；开发根据环境温度实时调整 VCOM 电压的温度补偿电路，通过温度感应模块、控制模块、偏移检测模块和缓冲模块的协同工作，实现对初始 VCOM 电压的精确补偿，确保液晶显示屏在不同温度条件下画面显示效果稳定，研发了一种智能型无载测试装置，采用视觉引导的机器臂和相机定位测试点，结合自动数据记录和 MES 系统追溯功能，实现对不同 PCBA 和 FPCBA 产品的通用自动化测试，解决了人工测试效率低、易出错的弊端，提高了测试准确性和生产效率；系公司 53 项授权专利的发明人之一	主持并参与了公司多项关键研发项目，其创新成果在显示技术、芯片检测和电路板测试领域为公司带来了显著的技术突破。这些技术不仅优化了产品性能和生产流程，还降低了制造成本、提升了市场竞争力，为公司在相关行业的持续发展和行业领先地位奠定了坚实基础

3、核心技术人员的约束激励措施

公司与核心技术人员签署了保密及竞业限制相关协议，对其任职期间和离职后的保密义务、竞业禁止义务进行了约定。同时，公司对核心技术人员和研发人员建立了奖励和激励机制，通过对员工进行绩效评定等方式，对于业绩考核成绩突出、在研发工作中做出重要贡献的员工给予奖励，激励研发人员充分发挥主观能动性、积极推进研发进度、提升研发质量。

核心技术人员还通过员工持股平台间接持有公司股份，分享公司不断成长发展带来的收益，增强了核心技术人员的稳定性及其与公司发展目标的一致性。

截至本招股说明书签署日，核心技术人员持股情况如下：

序号	姓名	公司任职	持股方式	持股比例
1	徐建伟	副总经理	通过共青城晓荷、共青城高展间接持股	0.28%
2	高文	研发总监	通过共青城晓荷、共青城高展间接持股	0.04%
3	张文志	研发经理	通过共青城晓荷间接持股	0.01%
4	王耀辉	研发经理	通过共青城君成间接持股	0.01%

4、报告期内核心技术人员的主要变动情况

公司核心技术人员自报告期初均已在公司任职。报告期内，公司的核心技术人员未发生重大不利变动。

（七）技术创新情况

公司自成立以来，高度重视研发和技术创新，建立了一系列技术创新机制，具体情况如下：

1、研发体系与研发项目管理机制

公司基于行业特征及自身经营特点，建立了完备的研发体系。公司已制定《研发项目管理制度》《研究开发活动管理办法》等制度。

公司自成立以来，始终坚持自主研发的发展道路，密切跟踪行业前沿技术发展和市场需求，进行技术研发与工艺升级，提前布局推进前沿技术的研发工作，进行技术储备。公司设立电子电路实验室、光学实验室、可靠性实验室、产品研发室、工程设计室和失效分析实验室，通过理论与实践的结合，不断深化技术研发与产品开发的广度与深度，同时不定期聘请行业资深专家组成技术委员会，就公司研发项目和产品设计进行咨询交流。

2、技术储备及创新安排

公司丰富技术储备、保持技术创新能力的主要安排包括：

（1）持续开展与重点客户的技术交流：通过调研与技术交流，挖掘重点客户的现实与潜在需求，基于行业技术发展方向及市场需求确立研发方向、开展研发活动进行相应技术储备。

（2）持续增强研发工作的科学性、规范性和有效性：通过执行严格的项目管理制度明确研发目标和各研发岗位职责，结合健全的研发考核体系，有力保障

研发项目的高效进行。

（3）持续加大公司研发体系的各类资源投入：通过增添性能先进的研发设备及仪器，充分满足技术研发的各项需求；通过追踪国内外技术发展动态，针对性加强工艺改进和技术研发力度，贴合行业前沿技术理论，进行创新研发。

综上，公司紧密结合市场发展方向，以系统性的研发战略、持续性的研发投入及前瞻性的创新研发扩展了公司技术储备，有力提升了公司的产品创新能力和市场竞争力。

3、研发激励机制

公司制定了切实可行的人员激励机制，通过多种奖励措施，增强企业对人才的吸引力和凝聚力。公司将创新能力及研发成果作为研发人员的绩效考核指标的同时，以公平合理的激励制度和畅通的晋升渠道，充分调动研发人员的工作积极性，释放研发人员的研发潜力，提高创新能力。

七、环境保护情况

（一）公司生产经营过程中的主要污染物及治理措施

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150号），公司主营业务不属于重污染行业。

公司生产经营过程中的主要污染物包括废水、废气、固体废弃物和噪声。公司重视污染物治理及环境保护工作，并在日常生产经营中严格遵守国家相关环保法律法规，认真执行建设项目环境影响评价制度和环境保护制度。

公司建立了包括《环境因素识别与评价程序》《废弃物管理程序》《固体废弃物管理控制程序》《大气污染防治管理程序》《噪声控制管理程序》《能源、资源管理程序》《应急准备与响应程序》等环境保护制度，针对不同类型的污染物制定了切实有效的处理措施。

报告期内，公司从事生产经营的主体为宇隆科技、重庆升越达、武汉宇隆、合肥宇隆、安徽灿宇、福州宇隆、河北宇隆、成都宇隆、青岛宇隆和北海宇隆。

公司生产经营中涉及主要污染物具体名称、主要处理设施及处理能力情况如

下：

1、宇隆科技

宇隆科技采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	锡及其化合物、非甲烷总烃等	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废活性炭、废焊锡膏等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	选用低噪声设备，合理布局，墙体隔音，基础减振等措施来进行降噪

2、重庆升越达

重庆升越达采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	非甲烷总烃	经活性炭装置吸附处理后由高排气筒排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废边角料等、废活性炭等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	选用低噪声设备，合理布局，墙体隔音，基础减振等措施来进行降噪

3、武汉宇隆

武汉宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	锡及其化合物、非甲烷总烃	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废锡膏瓶、废活性炭等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	选用低噪音设备、采取建筑隔声、减震消声等措施进行降噪

4、合肥宇隆

合肥宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	锡及其化合物、非甲烷总烃等	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废活性炭等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

5、安徽灿宇

安徽灿宇采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物	产生量较少，在生产车间内呈无组织形式排放，对环境影响较小
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废边角料等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

6、福州宇隆

福州宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度等	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	办公室、车间	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、酒精空瓶、锡膏空罐等	由固废暂存间暂存后，通过有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

7、河北宇隆

河北宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物、锡及其化合物	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	车间、办公室	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废清洗剂等	通过固废暂存间暂存后，交予有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

8、北海宇隆

北海宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物、锡及其化合物	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	车间、办公室	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废活性炭、废锡膏瓶等	通过固废暂存间暂存后，交予有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

9、成都宇隆

成都宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物、锡及其化合物	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	车间、办公室	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废活性炭等	通过固废暂存间暂存后，交予有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

10、青岛宇隆

青岛宇隆采取的环境保护措施如下：

类别	排放源	主要污染物名称	主要环境保护措施
废气	车间	颗粒物、锡及其化合物	经活性炭二级净化箱装置吸附处理后由高排气筒高空排放
废水	生活污水	pH、CODcr、NH_3-N 等	由化粪池处理后，经市政污水管网排入污水处理厂进行处理
固废	车间、办公室	生活垃圾	通过生活垃圾存放点，分类收集后由环卫部门统一处置
	车间	废包装材料、废活性炭、废锡膏瓶等	通过固废暂存间暂存后，交予有资质单位回收等方式处置
噪声	车间	运行噪声	采取减振、隔声、降噪措施控制噪声污染

（二）公司环保投入情况

报告期内，公司环保投入情况如下：

单位：万元

年份	2025 年	2024 年	2023 年
环保设施投入	0.57	798.77	43.91
环保费用投入	53.77	38.37	39.68

报告期内，公司严格遵守国家和地方的环保法律法规要求，重视环保及安全风险防范，对环保设施的运行和建设进行持续投入；公司主要环保投入包括环保设施运行、环保监控设施等环保费用，以及环保设备和工程投入。

（三）环保处罚及整改情况

自报告期初至本招股说明书签署日，公司及其子公司不存在受到环境保护行政处罚的情况，不存在与环境保护相关的重大违法违规行为。

八、公司境外经营情况

公司境外经营主体为香港宇隆和越南宇隆。

2026 年 6 月 4 日，发行人设立全资子公司香港宇隆，将其作为公司海外业务的持股平台；香港宇隆后于 2026 年 6 月 29 日设立全资子公司越南宇隆，拟与公司主要客户形成同步配合，进而拓展越南及周边地区的显示用智能控制卡等业务。截至 2026 年 6 月 30 日，越南宇隆仍处于前期筹建状态，尚未开展实际生产经营活动。具体情况详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况” 之“四、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”。

第六节 财务会计信息与管理层分析

如不特殊注明，本节中数据均引自经天健会计师审计后出具的《审计报告》（天健审〔2026〕5466 号）。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司提醒投资者，若欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，应当认真阅读财务报告及审计报告全文。

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动资产：			
货币资金	44,116.61	38,421.79	40,140.57
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	17.88	161.61	37.34
应收账款	37,591.50	43,039.67	29,100.45
应收款项融资	610.13	353.48	8.00
预付款项	384.59	434.76	297.83
其他应收款	242.72	271.88	337.19
存货	7,790.86	7,149.16	7,345.71
其他流动资产	581.19	194.78	352.38
流动资产合计	**91,335.48**	**90,027.13**	**77,619.48**
非流动资产：			
其他权益工具投资	1,000.00	1,000.00	1,000.00
固定资产	49,075.83	49,902.66	18,271.63
在建工程	3,570.66	445.38	21,114.73
使用权资产	1,451.02	1,867.92	2,590.87
无形资产	3,275.40	3,381.12	3,512.61
长期待摊费用	858.48	1,257.06	1,351.41
递延所得税资产	490.15	422.59	453.46

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
其他非流动资产	285.93	609.72	88.38
非流动资产合计	**60,007.47**	**58,886.45**	**48,383.09**
资产总计	**151,342.95**	**148,913.58**	**126,002.57**
流动负债：			
短期借款	-	3,993.42	2,846.75
应付票据	3,105.67	1,540.10	-
应付账款	19,112.48	23,273.74	17,423.37
合同负债	10.73	-	-
应付职工薪酬	1,874.79	1,820.24	1,809.54
应交税费	725.45	1,062.34	487.51
其他应付款	326.17	240.45	369.00
一年内到期的非流动负债	5,531.14	4,793.60	1,004.75
其他流动负债	17.88	119.65	37.34
流动负债合计	**30,704.30**	**36,843.55**	**23,978.25**
非流动负债：			
长期借款	3,509.64	8,851.78	10,416.09
租赁负债	708.31	1,111.02	1,506.28
预计负债	-	-	37.89
递延收益	943.01	269.58	451.87
递延所得税负债	22.68	247.56	403.79
非流动负债合计	**5,183.64**	**10,479.94**	**12,815.92**
负债合计	**35,887.94**	**47,323.48**	**36,794.17**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	38,730.25	38,730.25	38,730.25
资本公积	27,161.52	26,621.97	26,300.06
盈余公积	2,419.64	2,233.18	1,885.36
未分配利润	47,147.31	34,004.69	22,292.73
归属于母公司所有者权益合计	**115,458.72**	**101,590.09**	**89,208.40**
少数股东权益	-3.71	-	-
所有者权益合计	**115,455.01**	**101,590.09**	**89,208.40**
负债和所有者权益总计	**151,342.95**	**148,913.58**	**126,002.57**

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
一、营业总收入	**113,715.36**	**109,535.20**	**69,760.95**
其中：营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
二、营业总成本	**99,080.86**	**96,323.69**	**62,314.48**
其中：营业成本	87,218.78	86,049.03	53,771.57
税金及附加	868.88	563.44	416.00
销售费用	2,062.94	1,918.79	1,458.14
管理费用	5,735.31	5,026.70	4,368.82
研发费用	3,737.89	3,490.52	2,991.38
财务费用	-542.95	-724.80	-691.44
其中：利息费用	376.64	355.89	153.82
利息收入	999.73	1,144.30	902.40
加：其他收益	1,143.39	1,473.61	1,312.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	168.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-7.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	112.19	-299.70	18.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-711.59	-656.22	-861.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	38.23	6.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**15,178.48**	**13,767.44**	**8,083.03**
加：营业外收入	11.37	2.31	463.86
减：营业外支出	46.96	45.30	43.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**15,142.89**	**13,724.45**	**8,503.77**
减：所得税费用	1,817.53	1,664.67	931.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**13,325.36**	**12,059.78**	**7,572.08**
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,325.36	12,059.78	7,572.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,329.07	12,059.78	7,572.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3.71	-	-

项目	2025 年	2024 年	2023 年
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	**13,325.36**	**12,059.78**	**7,572.08**
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,329.07	12,059.78	7,572.08
归属于少数股东的综合收益总额	-3.71	-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.34	0.31	0.20
（二）稀释每股收益	0.34	0.31	0.20

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	122,793.05	103,708.08	79,988.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,340.26	1,651.57	2,315.21
经营活动现金流入小计	**125,133.31**	**105,359.66**	**82,303.48**
购买商品、接受劳务支付的现金	72,994.14	73,153.80	43,300.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,485.11	16,246.75	16,563.43
支付的各项税费	6,944.09	4,642.68	5,423.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,331.04	2,592.37	2,143.32
经营活动现金流出小计	**99,754.37**	**96,635.60**	**67,429.83**
经营活动产生的现金流量净额	**25,378.94**	**8,724.06**	**14,873.65**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	77,100.00
取得投资收益收到的现金	-	-	168.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.12	0.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	14,000.00	14,000.00	37,000.00
投资活动现金流入小计	**14,001.12**	**14,000.30**	**114,268.75**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,035.19	12,895.10	20,243.62
投资支付的现金	-	-	64,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,000.00	16,000.00	33,000.00
投资活动现金流出小计	**24,035.19**	**28,895.10**	**117,743.62**
投资活动产生的现金流量净额	**-10,034.07**	**-14,894.80**	**-3,474.87**

项目	2025 年	2024 年	2023 年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	512.44	17,575.56	15,263.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	17.40	13.45
筹资活动现金流入小计	**512.44**	**17,592.96**	**15,277.00**
偿还债务支付的现金	9,090.00	13,896.52	4,672.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320.75	582.82	338.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,203.97	904.12	1,011.34
筹资活动现金流出小计	**10,614.72**	**15,383.46**	**6,023.03**
筹资活动产生的现金流量净额	**-10,102.28**	**2,209.49**	**9,253.97**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-21.45**	**-32.52**	**-29.90**
五、现金及现金等价物净增加额	**5,221.14**	**-3,993.76**	**20,622.85**
加：期初现金及现金等价物余额	24,095.86	28,089.62	7,466.77
六、期末现金及现金等价物余额	**29,317.00**	**24,095.86**	**28,089.62**

二、财务会计信息

（一）财务报表审计意见

天健会计师审计了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

天健会计师认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度、2024 年度和 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）关键审计事项

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	
公司收入主要来自于显示用智能控制卡和显示用精密功能器件的销售。2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司营业收入	针对收入确认关键审计事项，实施的审计程序主要包括： （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。 （2）检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元。 由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此将收入确认确定为关键审计事项。	法是否适当。 （3）按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因。 （4）对于境内非 VMI 模式的销售收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于境内 VMI 模式的销售收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户领用记录及客户对账单等；对于深加工结转模式下出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、报关单及客户签收单等。 （5）结合应收账款函证，选取项目函证销售金额，并对主要客户进行实地走访。 （6）实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认。 （7）获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况。 （8）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
2、应收账款减值	
报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 29,695.23 万元、43,935.21 万元和 38,371.33 万元，坏账准备分别为 594.78 万元、895.54 万元和 779.82 万元，账面价值分别为 29,100.45 万元、43,039.67 万元和 37,591.50 万元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，将应收账款减值确定为关键审计事项。	针对应收账款减值，实施的审计程序主要包括： （1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性。 （2）针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计。 （3）复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征。 （4）对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对。 （5）对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确。 （6）结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性。 （7）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（三）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本招股说明书中与财务会计信息相关的披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的预计负债	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 10%
重要的非全资子公司	资产总额、销售收入或利润总额超过发行人合并口径资产总额、销售收入或利润总额的 15%

（四）财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制财务报表。

公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

2、合并财务报表的范围及变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下：

子公司名称	取得方式	持股比例	是否纳入合并财务报表范围		
			2025 年	2024 年	2023 年
福州宇隆	同一控制下企业合并	100%	是	是	是
合肥宇隆	同一控制下企业合并	100%	是	是	是
河北宇隆	同一控制下企业合并	100%	是	是	是
西安宇隆（注 1）	新设	100%	否	否	否
武汉宇隆	新设	100%	是	是	是
宇隆研究院	新设	100%	是	是	是
北海宇隆	新设	100%	是	是	是
重庆升越达	同一控制下企业合并	100%	是	是	是
安徽灿宇	同一控制下企业合并	100%	是	是	是
青岛宇隆（注 2）	新设	100%	是	是	是

子公司名称	取得方式	持股比例	是否纳入合并财务报表范围		
			2025 年	2024 年	2023 年
成都宇隆（注 3）	新设	100%	是	是	是
隆美卡机器人（注 4）	新设	51%	是	否	否

注 1：西安宇隆于 2023 年 3 月 8 日完成工商及税务注销的办理；
注 2：青岛宇隆于 2023 年 1 月 18 日出资设立；
注 3：成都宇隆于 2023 年 11 月 6 日出资设立；
注 4：隆美卡机器人于 2025 年 11 月 12 日出资设立。

（五）分部信息

公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部。

三、主要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（四）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（五）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（六）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被

转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3）不属于上述 1）或 2）的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4）以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

1）当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2）当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可

观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6、金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（七）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

1、按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
		表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——应收合并范围内关联方往来组合（注）	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收合并范围内关联方往来组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

注：合并范围内关联方系指纳入公司合并财务报表范围内的各关联方公司，下同。

2、账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票预期信用损失率（%）	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	2.00	2.00	2.00
1-2 年	20.00	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

注：应收商业承兑汇票、应收账款、其他应收款的账龄自初始确认日起算。

3、按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

（八）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（九）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3	5	31.67

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
其他	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

（十）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产
待安装设备及其他	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十二）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利及专利使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50 年，根据法律及合同规定有效年限确定	直线法
专利及专利使用权	3 年，根据预计使用年限确定	直线法
软件	3-5 年，根据预计使用年限确定	直线法

3、研发支出的归集范围

（1）人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

直接从事研发活动的人员、外聘研发人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

（2）直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1）直接消耗的材料、燃料和动力费用；2）用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3）用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

（3）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

（4）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

（5）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十三）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十四）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受

益计划义务的现值和当期服务成本；

2）设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3）期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十六）预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十七）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照

有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十八）收入

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）

客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3、收入确认的具体方法

公司为客户提供的产品/服务主要有：显示用智能控制卡及其 PCBA 制造服务、显示用精密功能器件等，属于在某一时点履行的履约义务。收入确认具体方法如下：

（1）对于境内非 VMI 模式的销售，收入确认需满足以下条件：公司已将产品或提供制造服务所涉及的产品运送至合同约定的交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单，客户已取得相关产品的控制权，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；

（2）对于境内 VMI 模式的销售，收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户实际领用并经客户对账确认后，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；

（3）对于深加工结转模式下的出口销售，收入确认需满足以下条件：公司

已根据合同约定将产品或提供制造服务所涉及的产品交付给客户并报关，已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入，具体为取得报关单及客户签收单时点确认销售收入。

（十九）合同取得成本、合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3、该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十）合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作

为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

（二十一）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十二）递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5、同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十三）租赁

1、公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1）租赁负债的初始计量金额；2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3）承租人发生的初始直接费用；4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发

生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2、公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产 。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（二十四）重要会计政策和会计估计的变更、会计差错更正说明

1、会计政策的变更

（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行该规定；

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定。执行上述规定对本公司合并财务报表未产生重要影响。

（2）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中，“关于售后租回交易的会计处理”本公司于 2023 年起提前执行；“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。执行上述规定对本公司合并财务报表未产生重要影响。

（3）保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

2、会计估计的变更

公司报告期内无重要会计估计变更事项。

3、前期会计差错更正

公司报告期内无重大会计差错更正事项。

四、非经常性损益

根据天健会计师出具的《关于重庆宇隆光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕5467 号），公司最近三年非经常性损益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12.82	35.17	6.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	474.86	562.68	1,223.63

项目	2025 年	2024 年	2023 年
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	160.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22.77	-39.92	-29.04
小计	**439.26**	**557.92**	**1,361.60**
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	37.99	82.42	190.64
少数股东损益	-	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	**401.28**	**475.49**	**1,170.96**
扣除非经常性损益前归属于公司普通股股东的净利润	13,329.07	12,059.78	7,572.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	**12,927.80**	**11,584.29**	**6,401.12**

报告期内，公司归属于公司普通股股东的非经常性损益净额分别为 1,170.96 万元、475.49 万元和 401.28 万元，主要系计入当期损益的政府补助。公司扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润金额分别为 6,401.12 万元、11,584.29 万元和 12,927.80 万元，占当期归属于公司普通股股东的净利润比例分别为 84.54%、96.06%和 96.99%，公司净利润主要来源于经常性损益。

五、税项

（一）主要税种及税率

公司主要税种及税率的情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

报告期内，公司合并范围内各纳税主体适用的所得税税率明细如下：

纳税主体名称	2025 年度	2024 年度	2023 年度
宇隆科技	15%	15%	15%
合肥宇隆	15%	15%	15%
福州宇隆	15%	15%	15%
武汉宇隆	15%	15%	15%
重庆升越达	15%	15%	15%
安徽灿宇	15%	15%	15%
北海宇隆	15%	15%	15%
成都宇隆	15%	15%	15%
隆美卡机器人	15%	尚未设立	尚未设立
除上述以外的其他纳税主体	25%	25%	25%

注：隆美卡机器人于 2025 年 11 月 12 日设立。

（二）税收优惠及相关文件

1、关于先进制造业企业增值税加计抵减政策

根据财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）、工业和信息化部办公厅《工业和信息化部办公厅关于 2023 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅财函〔2023〕267 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。宇隆科技、合肥宇隆、福州宇隆、武汉宇隆、重庆升越达和安徽灿宇属于先进制造业企业，可享受增值税加计抵减政策。

2、西部大开发企业所得税优惠政策

根据财政部、税务总局、国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。宇隆科技、重庆升越达、北海宇隆、成都宇隆和隆美卡机器人于报告期内享受该政策优惠，减按 15%税率计缴企业所得税。

3、高新技术企业所得税优惠政策

报告期内，公司及子公司取得国家高新技术企业证书情况如下：

纳税主体名称	有效期覆盖报告期的国家高新技术企业证书取得年度
宇隆科技	2022 年 10 月 12 日、2025 年 11 月 18 日
合肥宇隆	2022 年 10 月 18 日、2025 年 10 月 28 日
福州宇隆	2022 年 12 月 14 日、2025 年 12 月 8 日
武汉宇隆	2022 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 19 日
重庆升越达	2022 年 10 月 12 日、2025 年 11 月 18 日
安徽灿宇	2022 年 11 月 18 日、2025 年 10 月 28 日

注：（1）根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》《关于<国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告>的解读》，通过认定的高新技术企业，其资格自颁发证书之日起有效期为 3 年。企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书颁发之日所在年度起享受税收优惠；

（2）报告期内，宇隆科技和重庆升越达实际享受西部大开发企业所得税优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，除宇隆科技和重庆升越达外，上述企业于 2023-2025 年度享受高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税减按 15%计缴。

六、本公司主要财务指标

（一）报告期主要财务指标情况

财务指标	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	2.97	2.44	3.24
速动比率（倍）	2.72	2.25	2.93
资产负债率（合并）（%）	23.71	31.78	29.20
资产负债率（母公司）（%）	31.71	33.11	27.07
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.98	2.62	2.30
项目	**2025 年度**	**2024 年度**	**2023 年度**
应收账款周转率（次）	2.82	3.04	2.36
存货周转率（次）	11.68	11.87	7.09
总资产周转率（次）	0.76	0.80	0.59
息税折旧摊销前利润（万元）	22,313.36	20,659.24	15,344.69
利息保障倍数（倍）	41.21	21.89	19.68
每股经营活动现金流量（元/股）	0.66	0.23	0.38
每股净现金流量（元/股）	0.13	-0.10	0.53
归属于发行人股东的净利润（万元）	13,329.07	12,059.78	7,572.08

扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润金额（万元）	12,927.80	11,584.29	6,401.12
研发投入占营业收入的比例（%）	3.29	3.19	4.29

注：上述主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债；

2、速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债；

3、资产负债率＝期末总负债／期末总资产；

4、归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于母公司所有者权益／期末总股本；

5、应收账款周转率＝营业收入／应收账款期初期末平均账面价值；

6、存货周转率＝营业成本／存货期初期末平均账面价值；

7、总资产周转率＝营业收入／总资产期初期末平均余额；

8、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

9、利息保障倍数＝（利润总额+费用化利息支出）／（费用化利息支出+资本化利息支出）；

10、每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；

11、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本；

12、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司报告期内的净资产收益率、每股收益如下：

项目明细	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	12.28%	0.34	0.34
	2024 年度	12.64%	0.31	0.31
	2023 年度	8.89%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年度	11.91%	0.33	0.33
	2024 年度	12.14%	0.30	0.30
	2023 年度	7.52%	0.17	0.17

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方

的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；

Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

七、影响公司经营成果和财务状况的主要因素

（一）影响因素

1、服务特点的影响因素

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。

报告期内，公司显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件的相关收入占主营业务收入的比例分别为 98.00%、97.96%和 97.77%，是主营业务收入的主要来源。随着消费电子行业景气度逐步回暖，下游半导体显示面板厂商客户需求显著提升，公司营业收入、毛利、净利润均呈现增长态势，经营情况向好。

2、业务模式的影响因素

公司经营模式主要由行业的特性、客户需求特点、公司发展经验的总结、公司的宗旨与目标、公司所处产业链位置、上下游情况等多重因素共同作用所形成。具体请见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“一、公司主营业务、主要产品或服务及演变的情况”之“（四）主要经营模式”。

3、行业竞争程度的影响因素

公司所处行业下游为新型半导体显示面板及消费电子行业，终端应用更新换代周期较短，下游客户对关键零部件供应商的产品开发能力、工艺制造水平、量产交付能力、产品一致性等方面的要求在不断提高。此外，随着半导体显示面板及下游消费电子行业景气度逐步企稳回升，行业整体利润水平得到改善，而消费

电子行业的良好发展也可能导致未来的行业竞争日益激烈。

因此，公司需要根据消费电子行业发展趋势和下游市场需求，不断进行产品结构、工艺制程、性能表现等方面的研究和创新，持续加大在技术研发、人才培养等方面的投入，从而保持在市场竞争中的技术优势。若公司不能顺应市场与行业快速发展的趋势，并通过研发投入、产品创新等方式巩固或提高市场竞争力，公司将可能在日益加剧的市场竞争中处于劣势，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、外部市场环境的影响因素

在 2023 年以来我国逐步出台一系列扩大居民消费鼓励措施的背景下，随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术的升级和进步，我国消费电子及半导体显示面板行业景气度逐步回升。根据国家出台的一系列行业支持政策、消费电子及半导体显示面板行业市场的发展趋势，预计未来半导体显示面板市场将保持快速增长，相应带动上游行业的持续增长。

公司始终专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，主要产品的核心应用领域主要为新型半导体显示面板，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域，公司产品与新型半导体显示面板产业深度融合。随着我国大力发展新型半导体显示面板产业，公司将受益于下游产业的快速发展，并与其形成同步创新和相互促进的发展道路。

（二）对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

1、财务指标

根据公司所处的行业状况及自身业务特点，公司营业收入增长率、主营业务毛利率等财务指标对公司具有核心意义，其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

（1）营业收入增长率可用来判断公司主营业务的发展状况。报告期内，公司营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，公司业务发展呈现增长态势。

（2）主营业务毛利率是衡量公司盈利能力的重要经营指标，对公司业绩变动具有较强的预示作用。报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 23.01%、21.49%和 23.33%，公司具有稳定持续的盈利能力。

2、非财务指标

凭借丰富的制造服务经验、优异的技术工艺及产品品质、完善的配套服务体系、高效的新产品响应速度以及业内一流的规模化量产交付能力，公司自成立以来逐步突破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，在助力半导体显示面板产业国产化率不断提升的同时，公司也收获了广泛的行业认可，持续开拓优质的客户资源。

作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商显示用智能控制卡的主要供应商。

根据公司所处的行业状况及自身业务特点，公司显示用智能控制卡业务、显示用精密功能器件业务的产能规模等非财务指标对公司具有核心意义，是公司可持续经营能力的保障。

八、经营成果分析

报告期内，公司主要经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
营业总成本	99,080.86	96,323.69	62,314.48
营业利润	15,178.48	13,767.44	8,083.03
利润总额	15,142.89	13,724.45	8,503.77
净利润	13,325.36	12,059.78	7,572.08
归属于母公司股东的净利润	13,329.07	12,059.78	7,572.08
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	12,927.80	11,584.29	6,401.12

报告期内，发行人营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，归属于母公司股东净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78 万元

和 13,329.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 6,401.12 万元、11,584.29 万元和 12,927.80 万元。

报告期内，公司营业收入及净利润水平均呈上升趋势，整体经营情况良好。

（一）营业收入分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	113,425.64	99.75	109,302.06	99.79	69,418.85	99.51
其他业务收入	289.72	0.25	233.14	0.21	342.09	0.49
合计	**113,715.36**	**100.00**	**109,535.20**	**100.00**	**69,760.95**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入分别为 69,418.85 万元、109,302.06 万元和 113,425.64 万元，占营业收入的比重均超过 99.50%，公司经营所得主要来源于主营业务，其他业务收入规模、占比均较低。

1、主营业务收入分产品构成

报告期内，公司按产品划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	71,535.65	63.07	72,455.66	66.29	37,238.12	53.64
其中：1）显示用智能控制卡产品	45,310.20	39.95	43,828.49	40.10	9,205.19	13.26
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	26,225.45	23.12	28,627.16	26.19	28,032.93	40.38
显示用精密功能器件	39,364.99	34.71	34,618.54	31.67	30,790.97	44.36
其他	2,525.01	2.23	2,227.87	2.04	1,389.76	2.00
合计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

报告期内，公司显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件收入规模整体呈增长趋势，占主营业务收入的比例分别为 98.00%、97.96%和 97.77%，是公司主营业务收入的主要来源；公司主营业务中的其他收入金额及占比均较小，主要为视频监控电子终端、电池管理系统控制卡程序烧录服务等。

报告期内，公司显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件的核心应用领域均为半导体显示面板，主要客户均为国内半导体显示面板厂商。

2024 年，在消费电子行业景气度逐步回暖的背景下，下游半导体显示面板厂商客户需求显著提升，公司显示用智能控制卡业务收入同比增长 94.57%，主要系在与京东方合作规模稳步提升的同时，公司与和辉光电、深天马等客户合作规模迅速扩大所致。2025 年，公司显示用智能控制卡业务收入较 2024 年保持稳定。

报告期内，公司显示用精密功能器件业务收入分别为 30,790.97 万元、34,618.54 万元和 39,364.99 万元，整体呈稳步发展态势。

2、主营业务收入分地区构成

报告期内，公司主营业务收入分地区情况如下：

单位：万元、%

地区	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	**111,649.64**	**98.43**	**106,704.33**	**97.62**	**64,541.24**	**92.97**
其中：华东	67,459.95	59.48	65,655.69	60.07	31,103.73	44.81
西南	30,238.29	26.66	23,110.97	21.14	21,405.12	30.83
华南	8,099.64	7.14	10,140.73	9.28	3,861.38	5.56
华中	2,583.75	2.28	4,256.66	3.89	3,836.77	5.53
华北	2,985.42	2.63	3,540.28	3.24	4,334.24	6.24
其他	282.59	0.25	-	-	-	-
境外销售（“深加工结转”）	**1,776.00**	**1.57**	**2,597.74**	**2.38**	**4,877.61**	**7.03**
总计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

报告期内，公司境内销售收入主要集中在华东、西南、华南、华中和华北地区，该等地区是我国重要的半导体显示面板产业集群地，聚集了京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内半导体显示面板的龙头厂商。公司在上述地区销售收入合计分别为 64,541.24 万元、106,704.33 万元和 112,255.47 万元，占当期主营业务收入的比重分别为 92.97%、97.62%和 98.19%。公司销售收入区域分布与下游产业区域分布相匹配。

报告期内，发行人不存在直接出口境外销售情形，境外销售收入系公司通过

深加工结转模式进行生产和销售产生的收入。公司深加工结转模式业务整体规模呈下降趋势，占主营业务收入比重相对较低。

3、主营业务收入季节性变动分析

报告期内，公司主营业务收入季节性变动情况具体如下：

单位：万元、%

季度	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
一季度	29,419.53	25.94	22,072.72	20.19	17,446.18	25.13
二季度	30,260.50	26.68	29,350.39	26.85	16,003.64	23.05
三季度	29,278.73	25.81	26,786.45	24.51	16,499.31	23.77
四季度	24,466.88	21.57	31,092.50	28.45	19,469.72	28.05
合计	**113,425.64**	**100.00**	**109,302.06**	**100.00**	**69,418.85**	**100.00**

报告期内，公司主营业务收入季节分布较为均匀，收入波动与季节关联度较低。报告期内，公司主营业务收入波动主要系公司客户开拓情况及市场供需关系变动所致，公司主营业务收入不存在明显的季节性特征。

4、主营业务收入按业务模式变动分析

报告期内，公司主要产品按照业务模式划分的收入情况如下：

单位：万元、%

主要产品	业务模式	2025 年		2024 年		2023 年	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	自供料	45,310.20	63.34	43,828.49	60.49	9,205.19	24.72
	客供料	26,225.45	36.66	28,627.16	39.51	28,032.93	75.28
	总计	**71,535.65**	**100.00**	**72,455.66**	**100.00**	**37,238.12**	**100.00**
显示用精密功能器件	自供料	38,600.65	98.06	34,288.67	99.05	30,489.99	99.02
	客供料	764.34	1.94	329.86	0.95	300.98	0.98
	总计	**39,364.99**	**100.00**	**34,618.54**	**100.00**	**30,790.97**	**100.00**

注：显示用智能控制卡业务可细分为显示用智能控制卡产品和显示用智能控制卡 PCBA 制造服务，与上表中的自供料和客供料业务模式相对应，下同。

2023 年，公司显示用智能控制卡以客供料模式为主，即以提供显示用智能控制卡 PCBA 制造服务为主。2024 年，随着公司与以自供料模式为主的和辉光电、深天马等客户合作进一步深入，自供料模式的销售规模快速提升，因自供料

模式的产品平均单价较高，进而自供料模式的销售收入占比明显提升。2025 年，公司各业务模式收入占比相较于 2024 年基本保持稳定，显示用控制卡自供料业务保持增长态势。

报告期内，公司显示用精密功能器件的收入规模整体呈稳步增长趋势。从业务模式来看，公司显示用精密功能器件以自供料模式为主，该模式收入占比分别为 99.02%、99.05%和 98.06%，整体较为稳定。

5、主要产品收入变动趋势及原因分析

报告期内，公司主营业务收入变动情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	金额	同比	金额	同比	金额
显示用智能控制卡	71,535.65	-1.27	72,455.66	94.57	37,238.12
其中：1）显示用智能控制卡产品	45,310.20	3.38	43,828.49	376.13	9,205.19
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	26,225.45	-8.39	28,627.16	2.12	28,032.93
显示用精密功能器件	39,364.99	13.71	34,618.54	12.43	30,790.97
其他	2,525.01	13.34	2,227.87	60.31	1,389.76
合计	**113,425.64**	**3.77**	**109,302.06**	**57.45**	**69,418.85**

如上表所述，2024 年度、2025 年度，公司主营业务收入同比增长率分别为 57.45%、3.77%，主要系显示用智能控制卡业务收入、显示用精密功能器件业务收入在报告期内变动所致，具体分析如下：

（1）显示用智能控制卡

报告期内，公司显示用智能控制卡的收入、销量及单价情况如下：

单位：万元、万片、元/片

业务	项目	2025 年		2024 年		2023 年
		金额/数量	同比	金额/数量	同比	金额/数量
显示用智能控制卡	收入	71,535.65	-1.27%	72,455.66	94.57%	37,238.12
	数量	12,866.10	-9.78%	14,260.91	9.60%	13,012.07
	单价	5.56	9.43%	5.08	77.53%	2.86

2024 年，下游半导体显示面板及消费电子行业需求逐步回暖，公司积极开拓新客户、新业务，与和辉光电、深天马等客户的显示用智能控制卡产品业务合

作规模快速扩大。鉴于该业务产品单价相对较高，公司当期销售单价增长 77.53%，进而导致显示用控制卡业务收入规模较 2023 年提升 94.57%。具体情况如下：

单位：万片、元/片

产品/服务名称	销售单价			销售数量		
	2024 年	同比	2023 年	2024 年	同比	2023 年
显示用智能控制卡	**5.08**	**77.53%**	**2.86**	**14,260.91**	**9.60%**	**13,012.07**
其中：1）显示用智能控制卡产品	68.63	44.51%	47.49	638.66	229.48%	193.84
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	2.10	-3.91%	2.19	13,622.25	6.27%	12,818.24

2025 年，公司下游半导体显示面板及消费电子行业需求情况良好，显示用智能控制卡业务销售单价为 5.56 元/片，较 2024 年增长 9.43%；公司显示用智能控制卡业务收入为 71,535.65 万元，较 2024 年基本保持稳定。

单位：万片、元/片

产品/服务名称	销售单价			销售数量		
	2025 年	同比	2024 年	2025 年	同比	2024 年
显示用智能控制卡	5.56	9.43%	5.08	12,866.10	-9.78%	14,260.91
其中：1）显示用智能控制卡产品	50.49	-26.43%	68.63	897.49	40.53%	638.66
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	2.19	4.27%	2.10	11,968.61	-12.14%	13,622.25

（2）显示用精密功能器件

报告期内，公司显示用精密功能器件产品的销量及单价情况如下：

单位：万元、万片、元/片

业务	项目	2025 年度		2024 年		2023 年
		金额	同比	金额	同比	金额
显示用精密功能器件产品	收入	39,364.99	13.71%	34,618.54	12.43%	30,790.97
	数量	65,814.30	15.74%	56,862.06	6.29%	53,495.48
	单价	0.60	-1.76%	0.61	5.77%	0.58

如上表所述，2024 年，公司显示用精密功能器件产品收入稳步增长，产品销量及价格整体均呈上升趋势，主要系：一方面，随着产品迭代更新，高单价新产品的销量增加带动整体单价提升；另一方面，应用于某终端客户模组组件的产品需求及销量持续增加，鉴于该终端客户对产品品质、一致性等要求较高，且需要经过终端资格认证方可进入其供应体系，故该部分产品单价相对较高，进而导致显示用精密功能器件产品单价在此期间持续提升。

2025 年，公司显示用精密功能器件产品单价保持稳定，产品销量随下游客户需求增加而增长，带动公司当期显示用精密功能器件产品收入有所提升。

（二）营业成本分析

1、营业成本总体情况分析

报告期内，公司营业成本总体构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	86,960.90	99.70	85,816.38	99.73	53,444.80	99.39
其他业务成本	257.88	0.30	232.65	0.27	326.77	0.61
合计	**87,218.78**	**100.00**	**86,049.03**	**100.00**	**53,771.57**	**100.00**

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重分别为 99.39%、99.73%和 99.70%，与主营业务收入占比相匹配。

2、主营业务成本按产品种类构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品种类的构成情况如下：

单位：万元、%

业务板块	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	57,672.81	66.32	58,620.20	68.31	27,024.30	50.56
其中：1）显示用智能控制卡产品	41,034.10	47.19	39,275.95	45.77	7,655.30	14.32
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	16,638.71	19.13	19,344.25	22.54	19,369.00	36.24
显示用精密功能器件	27,827.82	32.00	25,827.76	30.10	25,374.87	47.48
其他	1,460.27	1.68	1,368.42	1.59	1,045.63	1.96
合计	**86,960.90**	**100.00**	**85,816.38**	**100.00**	**53,444.80**	**100.00**

报告期内，显示用智能控制卡和显示用精密功能器件系主营业务成本的主要构成，两者占主营业务成本比例分别为 98.04%、98.41%和 98.32%，与主营业务收入的结构一致。

3、主营业务成本按要素构成分析

报告期内，公司主营业务成本按要素的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	62,038.47	71.34	59,507.19	69.34	28,349.73	53.04
直接人工	5,354.60	6.16	5,244.23	6.11	6,449.57	12.07
制造费用	19,567.83	22.50	21,064.96	24.55	18,645.50	34.89
合计	**86,960.90**	**100.00**	**85,816.38**	**100.00**	**53,444.80**	**100.00**

报告期内，公司直接材料和制造费用系主营业务成本的主要构成，占主营业务成本比重分别为 87.93%、93.89%和 93.84%。其中，直接材料占比在 2024 年及 2025 年较往年显著提升，主要系公司显示用智能控制卡业务中的自供料模式销售收入快速提升，考虑到该模式下公司需要自行采购主要物料，进而导致直接材料占比有所增加。整体来看，公司主营业务成本直接材料占比变动与公司收入结构相匹配。

报告期内，公司直接人工整体有所下降主要系产能利用率水平提升、自动化水平提升以及公司相应缩减用工数量所致；公司制造费用整体较为稳定。在此情况下，由于直接材料占比提升，直接人工及制造费用占比相应有所下降。

报告期内，公司主要产品成本要素构成如下：

（1）显示用智能控制卡

报告期内，公司显示用智能控制卡业务产品成本按要素的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	38,870.12	67.40	37,763.55	64.42	7,133.72	26.40
直接人工	3,659.65	6.35	3,507.85	5.98	4,519.30	16.72
制造费用	15,143.04	26.26	17,348.80	29.60	15,371.28	56.88
合计	**57,672.81**	**100.00**	**58,620.20**	**100.00**	**27,024.30**	**100.00**

如上表所示，报告期内，公司显示用智能控制卡业务直接材料占其主营业务成本比重分别为 26.40%、64.42%和 67.40%。其中，2024 年及 2025 年占比显著增长，主要系公司 2024 年以来显示用智能控制卡业务自供料模式销售收入快速提升，因自供料模式下直接材料占比较高，从而导致直接人工及制造费用占比有

所下降。

（2）显示用精密功能器件

报告期内，公司显示用精密功能器件产品成本按要素的构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	22,675.52	81.49	20,925.64	81.02	20,299.14	80.00
直接人工	1,553.29	5.58	1,645.06	6.37	1,883.03	7.42
制造费用	3,599.00	12.93	3,257.05	12.61	3,192.70	12.58
合计	**27,827.82**	**100.00**	**25,827.76**	**100.00**	**25,374.87**	**100.00**

报告期内，公司显示用精密功能器件成本主要由直接材料构成，直接材料占比分别为 80.00%、81.02%和 81.49%，成本结构整体保持稳定。

（三）毛利分析

1、毛利的构成

报告期内，公司毛利构成及占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	26,464.74	99.88	23,485.68	100.00	15,974.05	99.90
其他业务毛利	31.83	0.12	0.48	0.00	15.33	0.10
合计	**26,496.57**	**100.00**	**23,486.16**	**100.00**	**15,989.37**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利占比分别为 99.90%、100.00%和 99.88%，是公司毛利的主要来源，与公司收入结构、变动趋势基本一致。

2、主营业务毛利构成分析

报告期内，公司主营业务毛利按产品分类情况如下：

单位：万元、%

产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示用智能控制卡	13,862.83	52.38	13,835.46	58.91	10,213.82	63.94
其中：1）显示用智能控制卡产品	4,276.09	16.16	4,552.54	19.38	1,549.89	9.70

产品	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	9,586.74	36.22	9,282.92	39.53	8,663.93	54.24
显示用精密功能器件	11,537.17	43.59	8,790.78	37.43	5,416.10	33.91
其他	1,064.74	4.02	859.45	3.66	344.13	2.15
合计	**26,464.74**	**100.00**	**23,485.68**	**100.00**	**15,974.05**	**100.00**

报告期内，公司主营业务毛利分别为 15,974.05 万元、23,485.68 万元和 26,464.74 万元，主营业务毛利结构保持稳定且实现稳步增长。其中，显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件销售毛利占各期主营业务毛利比例分别为 97.85%、96.34%和 95.98%，是公司主营业务毛利的主要来源。

整体来看，报告期内，随着下游消费电子需求增长以及半导体显示面板行业景气度逐步恢复，公司主要产品需求稳步提升，公司主营业务毛利整体有所增加。

（四）毛利率分析

报告期内，公司主营业务按产品分类的毛利率情况如下：

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
显示用智能控制卡	19.38%	0.28%	19.10%	-8.33%	27.43%
其中：1）显示用智能控制卡产品	9.44%	-0.95%	10.39%	-6.45%	16.84%
2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务	36.56%	4.13%	32.43%	1.52%	30.91%
显示用精密功能器件	29.31%	3.91%	25.39%	7.80%	17.59%
其他	42.17%	3.59%	38.58%	13.82%	24.76%
合计	**23.33%**	**1.85%**	**21.49%**	**-1.52%**	**23.01%**

1、主要产品毛利率变动分析

（1）显示用智能控制卡

报告期内，公司显示用智能控制卡业务的销售单价、单位成本、毛利率变动情况如下：

单位：元/片

年份	单位售价、成本及毛利率变化				
	销售单价	销售单价较上期增减额	单位成本	单位成本较上期增减额	毛利率
2025 年	5.56	0.48	4.48	0.37	19.38%
2024 年	5.08	2.22	4.11	2.03	19.10%
2023 年	2.86	-	2.08	-	27.43%

报告期内，公司显示用智能控制卡业务均为定制化产品或服务，不同客户业务所需的材料、工艺制程、生产难度、生产规模均存在差异，因此不同客户、不同型号的显示用智能控制卡成本、单价均有所差异。

2024 年，公司显示用智能控制卡业务销售均价较 2023 年提高 77.53%，主要系自供料模式收入占比提升所致，由于该模式下产品单价、单位成本均相对较高，进而导致公司显示用智能控制卡产品整体销售均价、单位成本较 2023 年有所提升。由于单位成本增长幅度高于销售价格增长幅度，因此公司显示用智能控制卡业务毛利率较 2023 年有所下降，但整体仍保持较高水平。

2025 年，随着自供料模式收入占比进一步提升，公司显示用智能控制卡业务销售均价、单位成本均有所上升。由于销售均价、单位成本上升幅度较为接近，公司 2025 年毛利率较 2024 年基本保持稳定。

报告期内，公司显示用智能控制卡业务按业务模式划分的单价、单位成本情况具体如下：

单位：元/片、万片

显示用智能控制卡	2025 年			2024 年			2023 年		
	单价	单位成本	销量	单价	单位成本	销量	单价	单位成本	销量
显示用智能控制卡产品（自供料）	50.49	45.72	897.49	68.63	61.50	638.66	47.49	39.49	193.84
显示用智能控制卡 PCBA 制造服务（客供料）	2.19	1.39	11,968.61	2.10	1.42	13,622.25	2.19	1.51	12,818.24
合计	**5.56**	**4.48**	**12,866.10**	**5.08**	**4.11**	**14,260.91**	**2.86**	**2.08**	**13,012.07**

如上表所示，报告期内，显示用智能控制卡客供料模式下（即 PCBA 制造服务）的主料由客户提供，公司仅提供辅料并收取生产加工费，因此公司客供料整体单价、单位成本均较为稳定；自供料模式下，由于公司通常负责主辅料的采购和相应的产品生产，因此自供料产品价格、单位成本均明显高于客供料，且产品

结构差异亦会导致价格、成本存在一定波动。

（2）显示用精密功能器件

报告期内，公司显示用精密功能器件的销售单价、单位成本和毛利率变动情况如下：

单位：元/片

报告期	单位价格、单位成本及毛利率变化				
	销售单价	销售单价较上期增减额	单位成本	单位成本较上期增减额	毛利率
2025 年	0.60	-0.01	0.42	-0.03	29.31%
2024 年	0.61	0.03	0.45	-0.02	25.39%
2023 年	0.58	-	0.47	-	17.59%

2024 年，公司显示用精密功能器件产品结构随着下游客户需求变动有所波动，且新产品持续推出，导致平均价格小幅上涨；同时，2024 年以来，随着下游行业需求逐步回暖，公司产能利用率快速提升，受规模效应影响，公司显示用精密功能器件单位成本随着业务规模的提升而有所降低；2025 年，公司显示用精密功能器件产品平均价格较 2024 年基本保持稳定。此外，为了平抑行业波动影响，公司持续进行工艺改进，提升自动化水平，亦使显示用精密功能器件产品单位成本有所下降。

整体来看，由于价格变动幅度略高于单位成本变动幅度，进而导致公司显示用精密功能器件产品毛利率持续提升。

2、毛利率与同行业上市公司比较

公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。如前文所述，公司所处细分行业由于竞争较为充分，综合实力突出的大型企业相对较少，不同企业专注的细分领域、主要服务客户均存在一定差异，行业内不存在业务领域、主要客户、技术能力等完全可比的同行业上市公司。

报告期内，公司与同行业可比公司毛利率比较情况如下：

项目	公司名称	证券代码	2025 年	2024 年	2023 年
显示用智能控制卡	金百泽	301041.SZ	24.11%	22.28%	22.22%
	深南电路	002916.SZ	15.00%	14.40%	14.66%

项目	公司名称	证券代码	2025 年	2024 年	2023 年
	光弘科技	300735.SZ	11.62%	12.70%	17.51%
	雅葆轩	920357.BJ	18.82%	20.87%	16.68%
	易德龙	603380.SH	25.40%	25.05%	21.98%
	一博科技	301366.SZ	24.44%	30.52%	34.09%
	平均值		**19.90%**	**20.97%**	**21.19%**
	宇隆科技		**19.38%**	**19.10%**	**27.43%**
显示用精密功能器件	鸿富瀚	301086.SZ	36.71%	40.09%	40.15%
	博硕科技	300951.SZ	30.41%	32.75%	40.71%
	可川科技	603052.SH	22.51%	21.72%	19.53%
	达瑞电子	300976.SZ	未披露	24.95%	32.44%
	平均值		**29.88%**	**29.88%**	**33.21%**
	宇隆科技		**29.31%**	**25.39%**	**17.59%**

数据来源：WIND 资讯

注：同行业上市公司毛利率为该公司可比业务的毛利率。具体如下：金百泽取“电子制造服务”业务毛利率；深南电路取“电子装联”业务毛利率；光弘科技、雅葆轩、易德龙取其主营业务毛利率；一博科技取“PCBA 制造服务”业务毛利率；鸿富瀚取“消费电子产品功能性器件”业务毛利率，博硕科技取“精密功能件”业务毛利率；可川科技取“结构类功能性器件”以及“光学类功能性器件”的合计业务收入、成本计算得出；达瑞电子取“消费电子功能性器件”业务毛利率。其中，达瑞电子 2025 年年度报告将“消费电子功能性器件”、“电子产品结构性器件”合并为了“消费电子结构与功能性组件”，未单独披露“消费电子功能性器件”毛利率

（1）显示用智能控制卡业务

2023 年，公司毛利率高于同行业上市公司平均值，主要系同行业公司雅葆轩产品销售单价受市场影响下降、原材料成本及人工成本增加，其毛利率较 2022 年明显下降，拉低了同行业上市公司毛利率均值；2024 年及 2025 年，公司与同行业上市公司毛利率平均值基本一致。

整体来看，显示用智能控制卡业务方面，同行业上市公司毛利率平均水平与公司不存在显著差异。

（2）显示用精密功能器件业务

报告期内，同行业公司中可川科技应用于笔记本电脑产品的收入占比较高，故报告期内其毛利率水平与公司整体较为接近；鸿富瀚、博硕科技、达瑞电子的消费电子产品功能性器件产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等，且应用于苹果、微软、亚马逊、三星视界等优质客户的产品收入占比较高，产品定

位偏中高端。由于智能手机、平板电脑等迭代速度较快，对工艺技术同步更新要求较高，需持续投入较多研发资源以维持产品竞争力；叠加终端消费者对头部消费电子终端品牌价格敏感度较低，故其毛利率水平相对较高。

报告期内，公司显示用精密功能器件业务主要客户为京东方，下游主要应用于笔记本电脑、平板电脑等中尺寸领域。其中，该类终端产品迭代节奏相对平缓、生命周期相对较长，考虑到下游终端品牌厂商、半导体显示面板厂商供应链成本管理机制，该产品毛利率水平在 2023 年整体相对偏低。2024 年以来，公司应用于终端客户为北美消费电子知名品牌商模组组件的产品收入占比增加，以及产品更新迭代的共同作用，公司该类产品逐渐向中高端领域拓展，毛利率持续增长。此外，2023 年以来，为了平抑行业波动影响，公司持续进行工艺改良，毛利率相应增长。

整体来看，2023 年，如前文所述，因产品定位差异等原因，公司毛利率相对较低。2024 年以来，随着公司应用于终端客户为北美消费电子知名品牌商产品模组组件的产品收入占比增加，以及产品更新迭代，公司产品逐渐向中高端领域拓展，毛利率持续增长，与同行业公司毛利率水平趋于一致。

（五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	2,062.94	1.81	1,918.79	1.75	1,458.14	2.09
管理费用	5,735.31	5.04	5,026.70	4.59	4,368.82	6.26
研发费用	3,737.89	3.29	3,490.52	3.19	2,991.38	4.29
财务费用	-542.95	-0.48	-724.80	-0.66	-691.44	-0.99
合计	**10,993.19**	**9.67**	**9,711.22**	**8.87**	**8,126.90**	**11.65**

报告期内，公司期间费用分别为 8,126.90 万元、9,711.22 万元和 10,993.19 万元，占营业收入的比重分别为 11.65%、8.87%和 9.67%，占比整体保持稳定。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	885.74	42.94	716.68	37.35	564.99	38.75
业务招待费	891.76	43.23	958.56	49.96	662.18	45.41
差旅及交通费	99.78	4.84	105.88	5.52	94.27	6.46
股份支付	153.23	7.43	73.71	3.84	98.58	6.76
其他	32.42	1.57	63.97	3.33	38.13	2.61
合计	**2,062.94**	**100.00**	**1,918.79**	**100.00**	**1,458.14**	**100.00**

报告期内，公司销售费用分别为 1,458.14 万元、1,918.79 万元和 2,062.94 万元，占当期营业收入的比重分别为 2.09%、1.75%和 1.81%，占比较低。

报告期内，公司销售费用主要由职工薪酬及业务招待费构成，具体情况如下：

（1）职工薪酬

报告期内，公司销售人员职工薪酬分别为 564.99 万元、716.68 万元和 885.74 万元，整体呈上升趋势，主要原因系：报告期内，公司持续推动客户多元化的发展战略，扩充销售团队，公司报告期内销售人员数量呈增长趋势，职工薪酬随着销售人员的增长而有所增加。

（2）业务招待费

报告期内，公司业务招待费分别为 662.18 万元、958.56 万元和 891.76 万元。其中，2024 年，公司业务招待费金额增长较快，主要系半导体显示面板行业整体景气度逐步回暖，公司积极布局优势领域的新客户开拓以及终端品牌厂商的客户合作开发，采取主动销售策略，从而加大了市场拓展力度所致。

（3）销售费用和同行业上市公司比较

报告期各期，公司与同行业可比上市公司销售费用率对比情况如下：

单位：%

公司简称	股票代码	2025 年度	2024 年度	2023 年度
金百泽	301041.SZ	5.93	6.05	6.11
深南电路	002916.SZ	1.61	1.70	1.99
光弘科技	300735.SZ	0.55	0.38	0.41
雅葆轩	920357.BJ	1.11	1.90	2.20

公司简称	股票代码	2025 年度	2024 年度	2023 年度
易德龙	603380.SH	1.54	1.44	1.60
一博科技	301366.SZ	4.64	5.30	6.18
鸿富瀚	301086.SZ	4.64	4.36	4.50
博硕科技	300951.SZ	4.07	4.87	3.65
可川科技	603052.SH	1.44	1.91	1.89
达瑞电子	300976.SZ	2.41	3.20	5.48
平均值		**2.79**	**3.11**	**3.40**
发行人		**1.81**	**1.75**	**2.09**

公司销售费用率低于行业平均水平，但与深南电路、雅葆轩、易德龙、可川科技处于同一水平。整体来看，同行业可比上市公司及发行人整体销售费用率不存在重大差异。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,997.69	52.27	3,135.43	62.38	2,751.74	62.99
折旧及摊销	895.62	15.62	512.01	10.19	401.64	9.19
股份支付	308.42	5.38	237.03	4.72	333.36	7.63
中介机构服务费	525.77	9.17	327.58	6.52	247.10	5.66
办公费	294.33	5.13	209.09	4.16	139.74	3.20
差旅交通费	126.53	2.21	163.48	3.25	148.86	3.41
租赁费	77.25	1.35	118.06	2.35	97.86	2.24
业务招待费	89.91	1.57	79.27	1.58	45.15	1.03
残疾人就业保障金	59.71	1.04	49.93	0.99	31.28	0.72
其他	360.09	6.28	194.83	3.88	172.09	3.94
合计	**5,735.31**	**100.00**	**5,026.70**	**100.00**	**4,368.82**	**100.00**

报告期内，公司管理费用分别为 4,368.82 万元、5,026.70 万元和 5,735.31 万元，占当期营业收入比例分别为 6.26%、4.59%和 5.04%。

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、折旧及摊销、股份支付、办公及

差旅费用、中介机构服务费等，其中职工薪酬占比较高。具体说明如下：

（1）职工薪酬

报告期内，公司管理人员职工薪酬分别为 2,751.74 万元、3,135.43 万元和 2,997.69 万元，整体保持相对稳定，相关变动主要系管理人员数量变化所致。

（2）折旧摊销

报告期内，公司管理费用的折旧摊销费分别为 401.64 万元、512.01 万元和 895.62 万元。其中，2024 年，公司管理费用中的折旧摊销费用有所增长，主要系新设立的子公司成都宇隆 2023 年末开始投入运营所致；2025 年，公司管理费用中的折旧摊销费用同比增长较大，主要原因系重庆宇隆二期项目、合肥宇隆生产基地项目房屋建筑物于 2024 年底转固，2025 年起计提折旧所致。

（3）股份支付

公司股权激励对象通过员工持股平台共青城君成、共青城晓荷和共青城高展持有公司股份，该事项构成股份支付，相应确认每期的股份支付费用。公司股权激励具体情况详见“第四节 发行人基本情况”之“十一、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排”相关内容。

（4）管理费用和同行业上市公司比较

报告期各期，公司与同行业可比上市公司管理费用率对比情况如下：

单位：%

公司简称	股票代码	2025 年度	2024 年度	2023 年度
金百泽	301041.SZ	8.91	8.57	9.57
深南电路	002916.SZ	4.50	4.05	4.44
光弘科技	300735.SZ	5.73	5.04	5.23
雅葆轩	920357.BJ	2.28	2.79	2.35
易德龙	603380.SH	6.11	5.86	5.82
一博科技	301366.SZ	8.35	7.64	6.86
鸿富瀚	301086.SZ	10.30	8.54	8.77
博硕科技	300951.SZ	8.61	8.63	6.06
可川科技	603052.SH	5.64	3.96	4.08
达瑞电子	300976.SZ	5.44	5.33	10.87

公司简称	股票代码	2025 年度	2024 年度	2023 年度
平均值		6.59	6.04	6.40
发行人		5.04	4.59	6.26

报告期内，公司管理费用率与同行业可比上市公司平均水平不存在显著差异。

3、研发费用

公司研发项目主要围绕开发、改良或优化显示用智能控制卡、显示用精密功能器件等相关产品、器件、生产工艺，以持续提高产品性能、优化生产工艺、提升生产效率，并进行相应的样品试制及测试工作。

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》《监管规则适用指引——发行类第 9 号：研发人员及研发投入》等相关规定，通过“研发费用”科目核算上述研发活动以及相关人员实际发生的费用，核算内容主要包括职工薪酬、物料消耗、折旧及摊销费用等。

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下表所示：

单位：万元、%

项目	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,962.12	52.49	1,796.64	51.47	1,725.78	57.69
物料消耗	1,540.35	41.21	1,473.89	42.23	1,010.55	33.78
折旧及摊销	152.94	4.09	166.02	4.76	143.34	4.79
股份支付	57.07	1.53	15.27	0.44	82.90	2.77
其他	25.42	0.68	38.71	1.11	28.82	0.96
合计	**3,737.89**	**100.00**	**3,490.52**	**100.00**	**2,991.38**	**100.00**

报告期内，公司研发费用分别为 2,991.38 万元、3,490.52 万元和 3,737.89 万元，占营业收入比例分别为 4.29%、3.19%和 3.29%；最近三年，公司累计研发费用金额为 10,219.79 万元，占最近三年累计营业收入的比例为 3.49%。

报告期内，公司主要研发项目（报告期内合计投入超过 200 万元的项目）情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目预算金额	研发费用发生额			报告期合计	截至报告期末进展
			2025 年	2024 年	2023 年		
1	中小尺寸 LCD 显示控制板	2,240.33	697.64	693.20	615.65	2,006.50	在研
2	移动设备 OLED 显示控制板	1,008.10	440.26	266.81	226.22	933.29	在研
3	新能源汽车及储能控制单元	895.00	326.59	327.56	178.13	832.28	在研
4	大尺寸 LCD 显示控制板	829.12	357.27	198.71	171.45	727.43	在研
5	LCD 中小模组结构件研究	494.00	-	204.94	184.95	389.89	已结项
6	OLED 手机显示模组结构件研究	374.00	-	255.12	126.51	381.63	已结项
7	可穿戴设备控制板	345.00	132.52	108.89	68.02	309.43	在研
8	高端笔记本电脑显示结构件研究项目	292.00	254.24	-	-	254.24	已结项
9	0LED 柔性显示模切研究	238.50	232.15	-	-	232.15	在研
10	F1 NB 精密模切研究项目	240.00	-	131.52	96.11	227.63	已结项
11	LCD 显示精密结构件研究项目	272.00	205.07	-	-	205.07	在研

报告期各期，公司与同行业可比上市公司研发费用率对比情况如下：

单位：%

公司简称	股票代码	2025 年度	2024 年度	2023 年度
金百泽	301041.SZ	6.83	6.71	7.35
深南电路	002916.SZ	6.73	7.10	7.93
光弘科技	300735.SZ	1.52	2.00	2.38
雅葆轩	920357.BJ	2.48	3.27	3.45
易德龙	603380.SH	6.31	5.41	6.04
一博科技	301366.SZ	11.50	12.38	12.84
鸿富瀚	301086.SZ	6.09	5.30	7.93
博硕科技	300951.SZ	7.47	7.05	6.19
可川科技	603052.SH	5.93	6.15	4.22
达瑞电子	300976.SZ	4.00	4.25	5.98
平均值		**5.89**	**5.96**	**6.43**
发行人		**3.29**	**3.19**	**4.29**

2023 年，公司研发费用率与同行业上市公司平均水平较为接近。

2024 年以来，伴随消费电子及新型显示行业快速发展，公司经营规模稳步

扩大，营业收入实现快速增长；与此同时，公司持续加大研发投入、客户新项目开发力度。鉴于公司营业收入增速高于研发费用增速，公司研发费用率整体略有下降，但与同行业可比公司雅葆轩、光弘科技研发费用率水平相近。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用的具体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	376.64	355.89	153.82
利息收入	-999.73	-1,144.30	-902.40
汇兑损益	21.45	32.52	29.90
其他	58.69	31.09	27.24
合计	**-542.95**	**-724.80**	**-691.44**

报告期内，公司财务费用分别为-691.44 万元、-724.80 万元和-542.95 万元，占营业收入的比例分别为-0.99%、-0.66%和-0.48%，主要由借款产生的利息支出及银行存款产生的利息收入构成。

（六）发行人净利润的主要来源及净利润增减变化情况

报告期内，公司主要利润来源于经常性损益。公司营业利润、利润总额、归母净利润、扣除非经常性损益后的归母净利润的情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
营业成本	87,218.78	86,049.03	53,771.57
营业利润	15,178.48	13,767.44	8,083.03
利润总额	15,142.89	13,724.45	8,503.77
归属于母公司股东净利润	**13,329.07**	**12,059.78**	**7,572.08**
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	**12,927.80**	**11,584.29**	**6,401.12**

报告期内，发行人营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为 6,401.12 万元、11,584.29 万元和 12,927.80 万元，整体均呈现增长态势。

（七）其他影响经营成果的因素分析

1、其他收益

报告期各期，公司其他收益金额分别为 1,312.81 万元、1,473.61 万元和 1,143.39 万元。公司其他收益明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	226.57	317.37	487.44
与收益相关的政府补助	431.87	436.59	635.31
代扣个人所得税手续费返还	4.46	3.92	44.58
增值税加计抵减	480.48	715.73	145.49
合计	**1,143.39**	**1,473.61**	**1,312.81**

报告期内，公司计入其他收益的与日常经营活动相关的政府补助明细如下：

（1）与资产相关的政府补助

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
2019 年设备投入补助	-	31.42	75.40
2020 上半年固定资产投资补贴	4.70	27.26	84.67
2020 年重庆市工业和信息化专项资金项目计划补助	4.03	24.20	24.20
2022 年第三批工业和信息化专项资金	84.62	92.31	92.31
2022 年技术改造财政增量贡献奖励资金（市级）	26.96	20.22	-
2023 年工业技改政策支持项目	22.43	15.78	0.58
北碚区 2017 年中小企业扶持资金	-	-	0.38
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	22.40	62.92	62.92
合肥新站区经贸发展局-18 年度工业发展补助	-	3.82	13.09
合肥新站区经贸发展局-19 年度工业发展补助	6.25	13.08	13.65
借转补项目政府补助	-	6.18	84.02
设备贴息补助	10.35	14.32	23.41
新站区经贸发展局 2020 年进口贴息	-	0.63	7.58
新站区经贸发展局 2021 年进口贴息	5.24	5.24	5.24
厂房封顶项目扶持	12.61	-	-
2023 年企业技术改造补贴项目奖补市级资金	19.00	-	-
生产基地固投补贴	7.98	-	-

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合计	226.57	317.37	487.44

（2）与收益相关的政府补助

1）2025 年度

单位：万元

项目	2025 年度
产业扶持资金	200.00
重点群体、退役士兵税收补贴	70.73
小巨人补助	50.00
其他零星补助	46.52
社会保险补贴	35.86
稳岗、扩岗补贴	28.76
合计	431.87

2）2024 年度

单位：万元

项目	2024 年度
小巨人补助	256.50
其他零星补助	65.65
重点群体、退役士兵税收补贴	36.54
稳岗、扩岗补贴	33.90
潜在独角兽及独角兽补助	24.00
高企奖励	20.00
合计	436.59

3）2023 年度

单位：万元

项目	2023 年度
产业扶持资金	277.00
其他零星补助	65.04
厂房租金补贴	63.60
高企奖励	60.00
稳岗、扩岗补贴	45.42
专精特新中小企业奖励	40.00
先进制造业奖励	35.00

项目	2023 年度
重点群体、退役士兵税收补贴	29.25
首次进入规模以上工业企业奖励	20.00
合计	**635.31**

2、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为 168.75 万元、0.00 万元和 0.00 万元，为公司购买的结构性存款和理财产品在持有期间的投资收益。

3、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失构成明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款坏账损失	112.40	-300.76	17.57
其他应收款坏账损失	-0.21	1.06	0.62
合计	**112.19**	**-299.70**	**18.19**

报告期内，公司信用减值损失金额分别为 18.19 万元、-299.70 万元和 112.19 万元，均为坏账损失，主要系应收账款坏账损失。其中，2023 年，信用减值损失为负数，主要系公司 2023 年末应收账款余额较 2022 年末有所下降所致；随着销售规模的增加，公司 2024 年末应收账款余额增加，按组合计提坏账准备金额有所增长，信用减值损失相应有所增加。

报告期内，公司应收账款的坏账损失及其他应收款的坏账损失情况详见“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“九、资产质量分析”之“（二）流动资产构成及变动分析”之“4、应收账款”和“7、其他应收款”相关内容。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失构成明细如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失	-711.59	-656.22	-861.68
合计	**-711.59**	**-656.22**	**-861.68**

报告期各期，公司资产减值损失分别为-861.68 万元、-656.22 万元以及-711.59

万元。报告期内，公司资产减值损失均为存货跌价损失。

报告期内，公司存货跌价损失主要系报告期初因客户项目关闭或订单量未达预期等原因，对预期无法实现销售的少量库存商品及相关原材料计提减值损失所产生。报告期内，公司已按照存货账面价值与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备，存货跌价计提充分。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
使用权资产处置收益	-	38.23	6.44
合计	**-**	**38.23**	**6.44**

报告期各期，公司资产处置收益分别为 6.44 万元、38.23 万元和 0.00 万元，均系公司正常经营过程中终止租赁合同形成。

6、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	-	-	450.00
无法支付款项	-	0.15	5.82
违约金收入	10.00	-	3.30
其他	1.37	2.17	4.74
合计	**11.37**	**2.31**	**463.86**

2023 年，公司营业外收入金额较大，主要为政府补助款；2024 年及 2025 年，公司营业外收入金额较小。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动资产毁损报废损失	12.82	3.07	0.23
赔款支出	10.15	35.54	41.06
税收滞纳金	18.88	6.70	0.87
对外捐赠	5.00	-	-
其他	0.11	0.00	0.96
合计	**46.96**	**45.30**	**43.12**

报告期内，公司营业外支出主要包括赔偿款支出、滞纳金、非流动资产处置损失等，金额较小。

7、企业所得税费用

报告期内，公司企业所得税费用情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
当期所得税费用	2,109.97	1,790.03	800.48
递延所得税费用	-292.44	-125.36	131.21
合计	**1,817.53**	**1,664.67**	**931.69**

（八）纳税情况

报告期内，公司享受的税收政策未发生重大变化，亦不存在即将实施的重大税收政策调整的情形。报告期内，公司主要税种的缴纳情况如下：

1、企业所得税及增值税计缴情况

报告期内，公司纳税情况如下：

单位：万元

期间	项目	企业所得税	增值税
2025 年度	期初未交数	644.55	142.09
	本期应交数	2,109.97	3,659.18
	本期已交数	2,286.12	3,752.86
	期末未交数	468.40	48.41
2024 年度	期初未交数	137.95	-82.46
	本期应交数	1,790.03	2,968.87
	本期已交数	1,283.43	2,744.32

期间	项目	企业所得税	增值税
	期末未交数	644.55	142.09
2023 年度	期初未交数	533.64	945.52
	本期应交数	800.48	2,564.72
	本期已交数	1,196.17	3,592.70
	期末未交数	137.95	-82.46

报告期各期，公司应交企业所得税和增值税与公司的经营规模和盈利水平相匹配，变动具备合理性。

2、税金及附加

报告期内，公司税金及附加如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
城市维护建设税	236.33	194.08	138.08
教育费附加	101.25	83.17	59.18
地方教育附加	67.50	55.45	39.45
土地使用税	84.09	84.09	84.09
房产税	289.92	51.23	43.43
印花税	64.61	74.65	37.95
其他税金及附加	25.17	20.77	13.84
合计	**868.88**	**563.44**	**416.00**

报告期内，公司税金及附加分别为 416.00 万元、563.44 万元和 868.88 万元，主要由城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、土地使用税、房产税和印花税构成。

3、税收优惠对经营成果的影响

报告期内，公司享受的税收优惠政策，参见本节之“五、税项”之“（二）税收优惠及相关文件”。

报告期各期，公司享受税收优惠具体金额情况具体如下：

单位：万元

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
企业所得税优惠税率的影响	1,377.28	1,196.27	492.84

财务指标	2025 年度	2024 年度	2023 年度
先进制造业企业增值税加计抵减的影响	480.48	715.73	145.49
税收优惠金额合计	**1,857.76**	**1,912.01**	**638.33**
利润总额	**15,142.89**	**13,724.45**	**8,503.77**
税收优惠占利润总额的比例	**12.27%**	**13.93%**	**7.51%**

报告期内，对发行人财务数据影响较大的税收优惠主要包括高新技术企业所得税税收优惠及先进制造业企业增值税加计抵减政策。发行人始终重视研发投入，预计未来可继续被认定为高新技术企业；先进制造业企业增值税加计抵减政策执行期间为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，发行人在上述期间内主营业务预计不会发生重大变化，未来仍可继续适用上述优惠政策。

整体来看，发行人对税收优惠不存在重大依赖。

九、资产质量分析

（一）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	91,335.48	60.35	90,027.13	60.46	77,619.48	61.60
非流动资产	60,007.47	39.65	58,886.45	39.54	48,383.09	38.40
资产总计	**151,342.95**	**100.00**	**148,913.58**	**100.00**	**126,002.57**	**100.00**

报告期内，公司资产总额分别为 126,002.57 万元、148,913.58 万元和 151,342.95 万元，随着公司经营规模的稳步扩张，流动资产及非流动资产均有所增长，进而总资产规模实现稳步增长。其中，公司流动资产占总资产的比例相对较高，分别为 61.60%、60.46%和 60.35%。

（二）流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司流动资产构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	44,116.61	48.30	38,421.79	42.68	40,140.57	51.71
应收票据	17.88	0.02	161.61	0.18	37.34	0.05
应收账款	37,591.50	41.16	43,039.67	47.81	29,100.45	37.49
应收款项融资	610.13	0.67	353.48	0.39	8.00	0.01
预付款项	384.59	0.42	434.76	0.48	297.83	0.38
其他应收款	242.72	0.27	271.88	0.30	337.19	0.43
存货	7,790.86	8.53	7,149.16	7.94	7,345.71	9.46
其他流动资产	581.19	0.64	194.78	0.22	352.38	0.45
流动资产合计	**91,335.48**	**100.00**	**90,027.13**	**100.00**	**77,619.48**	**100.00**

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
库存现金	-	-	-	-	1.16	0.00
银行存款	29,317.00	66.45	24,095.86	62.71	28,088.46	69.98
其他货币资金	14,799.62	33.55	14,325.93	37.29	12,050.95	30.02
合计	**44,116.61**	**100.00**	**38,421.79**	**100.00**	**40,140.57**	**100.00**

报告期各期末，公司货币资金分别为 40,140.57 万元、38,421.79 万元和 44,116.61 万元，占流动资产的比例分别为 51.71%、42.68%和 48.30%。公司货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金，其他货币资金主要为银行大额存单及利息。截至报告期末，公司其他货币资金中无受限资金。

报告期内，公司业务规模整体有所增长、客户回款情况良好，经营活动现金流持续流入，期末货币资金相应整体有所增加。

2、应收票据

报告期各期末，公司应收票据分别为 37.34 万元、161.61 万元和 17.88 万元，占流动资产的比例分别为 0.05%、0.18%和 0.02%。公司应收票据均为银行承兑汇票。

3、应收账款

（1）应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目名称	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
应收账款账面余额	38,371.33	43,935.21	29,695.23
减：坏账准备	779.82	895.54	594.78
应收账款账面价值	**37,591.50**	**43,039.67**	**29,100.45**
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
应收账款账面余额占营业收入的比例	**33.74%**	**40.11%**	**42.57%**

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 29,695.23 万元、43,935.21 万元和 38,371.33 万元，占各期营业收入的比例为 42.57%、40.11%和 33.74%。报告期内，公司各期末应收账款余额占当期营业收入的比例整体稳中有降，应收账款回款情况良好。其中，2024 年及 2025 年，在消费电子行业景气度逐步回暖的背景下，下游半导体显示面板厂商客户需求显著提升，公司与和辉光电、深天马等行业知名厂商的合作规模迅速扩大，公司当期营业收入有所提升，应收账款余额整体有所增加。

（2）主要客户信用政策

报告期内，公司显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件产品为公司主要收入来源，主要客户包括京东方、和辉光电、广州国显、惠科股份、深天马等半导体显示面板下游客户。公司根据客户的合作时长、销售规模、历史回款情况等综合评定，一般给予 60-120 天左右不等的账期。

报告期内，公司主要客户的信用政策未发生重大变化。

（3）主要客户应收账款情况

报告期各期末，公司应收账款前五名余额及占比情况如下：

单位：万元

单位名称	余额	账龄	占比
2025.12.31			
京东方	21,290.06	1 年以内为主	55.48%

单位名称	余额	账龄	占比
和辉光电	7,509.48	1 年以内	19.57%
广州国显	3,970.05	1 年以内	10.35%
深天马	1,655.33	1 年以内	4.31%
杭州叙简	699.20	1 年以内为主	1.83%
合计	**35,124.12**	-	**91.54%**
2024.12.31			
京东方	20,096.64	1 年以内为主	45.74%
和辉光电	12,870.29	1 年以内	29.29%
广州国显	2,850.44	1 年以内	6.49%
深天马	1,493.55	1 年以内	3.40%
杭州叙简	1,326.96	1 年以内	3.02%
合计	**38,637.89**	-	**87.94%**
2023.12.31			
京东方	16,467.62	1 年以内	55.46%
广州国显	4,438.25	1 年以内	14.95%
和辉光电	2,789.83	1 年以内	9.39%
华星光电	2,587.96	1 年以内	8.72%
杭州叙简	984.64	1 年以内	3.31%
合计	**27,268.30**	-	**91.83%**

注 1：2024 年末，京东方含 8.23 万元账龄为 1 年以上的应收账款余额；2025 年末，京东方含 17.51 万元账龄为 1 年以上的应收账款余额，杭州叙简含 11.84 万元账龄为 1 年以上的应收账款余额；

注 2：京东方合并口径包括京东方科技集团股份有限公司、合肥鑫晟光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、重庆京东方显示照明有限公司等；

注 3：华星光电合并口径包括武汉华星光电技术有限公司、华显光电技术（惠州）有限公司。

报告期各期末，公司应收账款前五大客户主要为京东方、和辉光电、广州国显、深天马等国内知名半导体面板公司，该等客户资信等级较高，应收账款坏账风险较小；公司应收账款中不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4）应收账款坏账准备计提及账龄情况

报告期内，公司应收账款坏账准备计提具体情况如下表所示：

单位：万元

类别	2025.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	38,371.33	100.00%	779.82	2.03%	37,591.50
合计	**38,371.33**	**100.00%**	**779.82**	**2.03%**	**37,591.50**
类别	**2024.12.31**				
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**比例**	**金额**	**计提比例**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	43,935.21	100.00%	895.54	2.04%	43,039.67
合计	**43,935.21**	**100.00%**	**895.54**	**2.04%**	**43,039.67**
类别	**2023.12.31**				
	账面余额		**坏账准备**		**账面价值**
	金额	**比例**	**金额**	**计提比例**	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	29,695.23	100.00%	594.78	2.00%	29,100.45
合计	**29,695.23**	**100.00%**	**594.78**	**2.00%**	**29,100.45**

1）按单项计提坏账准备的应收账款

报告期各期末，公司不存在预计无法收回而单项计提坏账准备的应收账款。

2）按组合计提坏账准备的应收账款

报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款如下：

单位：万元

账龄结构	2025.12.31			
	账面余额	坏账准备	坏账准备占比（%）	计提比例（%）
1 年以内	38,302.45	766.05	98.23	2.00
1 至 2 年	68.87	13.77	1.77	20.00
2 至 3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	-	-	-	100.00
合计	**38,371.33**	**779.82**	**100.00**	**2.03**
账龄结构	**2024.12.31**			

	账面余额	坏账准备	坏账准备占比（%）	计提比例（%）
1 年以内	43,842.21	876.84	97.91	2.00
1 至 2 年	92.69	18.54	2.07	20.00
2 至 3 年	0.31	0.16	0.02	50.00
3 年以上	-	-	-	100.00
合计	**43,935.21**	**895.54**	**100.00**	**2.04**
账龄结构	**2023.12.31**			
	账面余额	**坏账准备**	**坏账准备占比（%）**	**计提比例（%）**
1 年以内	29,690.38	593.81	99.84	2.00
1 至 2 年	4.85	0.97	0.16	20.00
2 至 3 年	-	-	-	50.00
3 年以上	-	-	-	100.00
合计	**29,695.23**	**594.78**	**100.00**	**2.00**

报告期各期末，公司账龄结构主要分布在 1 年以内，且公司主要客户均为规模较大、信誉良好的半导体显示面板公司，如京东方、和辉光电、广州国显、深天马等，应收账款回款风险较小。

公司与同行业可比上市公司的应收账款坏账准备计提比例对比情况如下：

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
金百泽	5%	20%	50%	100%
雅葆轩	5%	10%	20%	50%/80%/100%
易德龙	5%/10%	20%	50%	100%
一博科技	5%	20%	50%	100%
鸿富瀚	5%	20%	50%	100%
博硕科技	5%	20%	50%	100%
可川科技	5%	20%	50%	100%
达瑞电子	5%	10%	30%	50%/80%/100%
发行人	**2%**	**20%**	**50%**	**100%**

数据来源：同行业可比上市公司公开披露文件

注：1、深南电路和光弘科技按照不同客户类别分别计提应收账款坏账准备，故上表中未列示；2、雅葆轩和达瑞电子 3-4 年应收账款坏账准备计提比例为 50%，4-5 年应收账款坏账准备计提比例为 80%，5 年以上应收账款坏账准备计提比例为 100%；3、易德龙 6 个月以内应收账款坏账准备计提比例为 5%，6 个月-1 年应收账款坏账准备计提比例为 10%

公司 1 年以内应收账款坏账准备计提比例略低于同行业上市公司平均水平，主要原因系公司客户为京东方、和辉光电等行业知名半导体显示面板上市公司，

资信及历史回款情况良好，根据《企业会计准则》计量的预期信用损失率较低；公司 1 年以上应收账款坏账计提比例与同行业上市公司不存在显著差异。

（5）应收账款期后回款情况

截至 2026 年 6 月末，发行人报告期各期末的应收账款期后回款情况如下：

单位：万元

时间	应收账款余额	未回款金额	期后回款金额	回款比例
2025 年 12 月 31 日	38,371.33	667.66	37,703.67	98.26%
2024 年 12 月 31 日	43,935.21	0.89	43,934.32	100.00%
2023 年 12 月 31 日	29,695.23	-	29,695.23	100.00%

截至 2026 年 6 月末，公司 2023 年末的应收账款已全部回款；2024 年末应收账款回款比例接近 100%；2025 年末，公司应收账款回款比例为 98.26%。整体来看，公司应收账款期后回款整体情况良好，应收账款回收风险较小。

4、应收款项融资

公司根据《中国银保监会办公厅关于进一步加强企业集团财务公司票据业务监管的通知》（银保监办发[2019]133 号）《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）等文件的规定，遵照谨慎性原则对票据承兑人的信用等级进行了划分，分为信用等级较高的 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行（6 家大型商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行；9 家上市股份制商业银行分别为招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行，以下简称“6+9”）以及信用等级一般的其他商业银行和财务公司。

对于“6+9”银行承兑的银行承兑汇票，考虑到承兑银行资金实力雄厚，信用风险较低，公司既有对外背书转让又兼有到期承兑收取合同现金流量特征，公司将该等应收票据分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并将其作为一个组合整体列报在“应收款项融资”项目。

报告期各期末，公司应收款项融资余额分别为 8.00 万元、353.48 万元和 610.13 万元，均为银行承兑汇票。其中，2024 年以来，公司向深天马销售规模

大幅增加，深天马采用银行承兑汇票结算，由此导致期末应收款项融资金额较往年有所增长。具体构成如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
银行承兑汇票	610.13	353.48	8.00
合计	**610.13**	**353.48**	**8.00**

5、预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 297.83 万元、434.76 万元和 384.59 万元，占流动资产的比例分别为 0.38%、0.48%和 0.42%，占比较低，主要为预付 1 年以内的材料款。

报告期各期末，公司预付款项的账龄及占比情况如下：

单位：万元

账龄	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1 年以内	384.13	99.88%	432.04	99.38%	295.56	99.24%
1 至 2 年	-	-	2.71	0.62%	1.77	0.60%
2 至 3 年	0.46	0.12%	-	-	0.50	0.16%
合计	**384.59**	**100.00%**	**434.76**	**100.00%**	**297.83**	**100.00%**

报告期各期末，公司预付款项前五名情况如下：

公司名称	金额（万元）	款项性质	账龄	占期末预付款项比例（%）
2025.12.31				
深圳思尼克	88.65	材料款	1 年以内	23.05
青岛海信移动通信技术有限公司	64.44	材料款	1 年以内	16.76
深圳市天时创科技发展有限公司	57.62	材料款	1 年以内	14.98
江苏纽禄美卡智能机器人有限公司	29.02	材料款	1 年以内	7.55
青岛建国门窗幕墙工程有限公司	23.09	材料款	1 年以内	6.00
合计	**262.82**	-	-	**68.34**
2024.12.31				
盟讯科技	200.57	材料款	1 年以内	46.14
上海傲显科技有限公司	109.19	材料款	1 年以内	25.12
苏州宝丽摩赛思高性能材料有限公司	22.05	材料款	1 年以内	5.07

公司名称	金额（万元）	款项性质	账龄	占期末预付款项比例（%）
YOFO INTERNATIONAL LIMITED	15.85	材料款	1 年以内	3.64
合肥市科威家具有限公司	8.32	费用款	1 年以内	1.91
合计	**355.98**	-	-	**81.88**
2023.12.31				
深圳市金泰谊电子有限公司	64.70	材料款	1 年以内	21.72
深圳市天时创科技发展有限公司	28.59	材料款	1 年以内	9.60
上海邵敖电子科技有限公司	20.46	材料款	1 年以内	6.87
希普思（上海）材料有限公司	13.45	材料款	1 年以内	4.51
廊坊宝昂光电科技有限公司	12.60	材料款	1 年以内	4.24
合计	**139.79**	-	-	**46.94**

报告期各期末，公司不存在账龄超过 1 年且金额重大的预付款项，公司无预付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

6、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款分别为 337.19 万元、271.88 万元和 242.72 万元，主要为押金保证金等，具体情况如下：

单位：万元

款项性质	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
押金保证金	173.19	212.64	248.72
其他	70.95	60.45	90.75
账面余额合计	**244.14**	**273.09**	**339.46**
减：坏账准备	1.42	1.21	2.27
账面价值合计	**242.72**	**271.88**	**337.19**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
个人社保公积金	其他	66.26	1 年以内	27.14	1.33
四川金网通电子科技有限公司	押金保证金	41.79	1 年以内；1-2 年；2-3 年	17.12	-
合肥锦畅胶粘制品有限公司	押金保证金	40.00	3 年以上	16.38	-
福建斯泰克科技有限公司	押金保证金	22.41	1-2 年；2-3 年；3 年以上	9.18	-

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
青岛建国门窗幕墙工程有限公司	押金保证金	20.00	2-3 年	8.19	-
小计		**190.46**	**-**	**78.01**	**1.33**

截至报告期末，发行人与四川金网通电子科技有限公司、合肥锦畅胶粘制品有限公司、福建斯泰克科技有限公司和青岛建国门窗幕墙工程有限公司的其他应收款账龄较长，系厂房租赁押金。

截至报告期末，公司其他应收款中不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

（1）存货构成情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
原材料	4,041.31	51.87	3,954.19	55.31	4,339.15	59.07
在产品	333.17	4.28	753.40	10.54	1,403.01	19.10
库存商品	2,748.07	35.27	1,813.46	25.37	930.24	12.66
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
发出商品	668.31	8.58	628.10	8.79	673.30	9.17
合计	**7,790.86**	**100.00**	**7,149.16**	**100.00**	**7,345.71**	**100.00**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,345.71 万元、7,149.16 万元和 7,790.86 万元，占流动资产比例分别为 9.46%、7.94%和 8.53%。

（2）存货跌价准备情况

报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,124.61	1,083.30	4,041.31

在产品	337.92	4.75	333.17
库存商品	3,310.11	562.05	2,748.07
委托加工物资	-	-	-
发出商品	685.32	17.01	668.31
合计	**9,457.95**	**1,667.09**	**7,790.86**
项目	**2024.12.31**		
	账面余额	**存货跌价准备或合同履约成本减值准备**	**账面价值**
原材料	4,695.03	740.84	3,954.19
在产品	766.96	13.56	753.40
库存商品	2,413.57	600.11	1,813.46
委托加工物资	-	-	-
发出商品	635.87	7.77	628.10
合计	**8,511.43**	**1,362.27**	**7,149.16**
项目	**2023.12.31**		
	账面余额	**存货跌价准备或合同履约成本减值准备**	**账面价值**
原材料	5,086.12	746.97	4,339.15
在产品	1,434.32	31.31	1,403.01
库存商品	1,460.11	529.87	930.24
委托加工物资	-	-	-
发出商品	724.05	50.75	673.30
合计	**8,704.61**	**1,358.90**	**7,345.71**

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 1,358.90 万元、1,362.27 万元和 1,667.09 万元，占各期期末存货账面余额的比例为 15.61%、16.01%和 17.63%。

报告期各期末，公司均已按照存货账面余额与可变现净值孰低原则对存货计提跌价准备，存货跌价计提充分。具体情况如下：

单位：万元

项目	**期初数**	**本期增加**	**本期减少**	**期末数**
		计提	**转回/转销**	
2025 年度				
原材料	740.84	472.88	130.42	1,083.30
在产品	13.56	4.75	13.56	4.75
库存商品	600.11	216.96	255.02	562.05

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
		计提	转回/转销	
委托加工物资	-	-	-	-
发出商品	7.77	17.01	7.77	17.01
合计	**1,362.27**	**711.59**	**406.77**	**1,667.09**
2024 年度				
原材料	746.97	340.52	346.66	740.84
在产品	31.31	13.56	31.31	13.56
库存商品	529.87	294.37	224.13	600.11
委托加工物资	-	-	-	-
发出商品	50.75	7.77	50.75	7.77
合计	**1,358.90**	**656.22**	**652.84**	**1,362.27**
2023 年度				
原材料	599.36	600.89	453.28	746.97
在产品	42.50	31.31	42.50	31.31
库存商品	617.90	178.73	266.77	529.87
委托加工物资	1.73	-	1.73	-
发出商品	19.86	50.75	19.86	50.75
合计	**1,281.35**	**861.68**	**784.14**	**1,358.90**

报告期内，公司计提的存货跌价准备主要系因客户项目关闭或订单量未达预期等原因，对预期无法实现销售的少量库存商品及其原材料存货计提减值产生。

（3）存货库龄情况

报告期各期末，公司存货库龄情况如下：

单位：万元

时间	存货科目	1 年以内		1 年以上		合计
		金额	占比	金额	占比	
2025/12/31	原材料	4,220.43	82.36%	904.18	17.64%	5,124.61
	库存商品	2,818.14	85.14%	491.97	14.86%	3,310.11
	在产品	337.92	100.00%	-	-	337.92
	委托加工物资	-	-	-	-	-
	发出商品	685.32	100.00%	-	-	685.32
	合计	**8,061.81**	**85.24%**	**1,396.15**	**14.76%**	**9,457.95**

时间	存货科目	1年以内		1年以上		合计
		金额	占比	金额	占比	
2024/12/31	原材料	4,006.60	85.34%	688.43	14.66%	4,695.03
	库存商品	2,020.67	83.72%	392.90	16.28%	2,413.57
	在产品	766.96	100.00%	-	-	766.96
	委托加工物资	-	-	-	-	-
	发出商品	635.87	100.00%	-	-	635.87
	合计	**7,430.10**	**87.30%**	**1,081.33**	**12.70%**	**8,511.43**
2023/12/31	原材料	4,436.46	87.23%	649.66	12.77%	5,086.12
	库存商品	1,038.50	71.12%	421.61	28.88%	1,460.11
	在产品	1,434.32	100.00%	-	-	1,434.32
	委托加工物资	-	-	-	-	-
	发出商品	724.05	100.00%	-	-	724.05
	合计	**7,633.34**	**87.69%**	**1,071.27**	**12.31%**	**8,704.61**

报告期各期末，发行人存货库龄在一年以内的占比分别为 87.69%、87.30%和 85.24%，库龄主要集中在一年以内，库龄较短，存货结构良好。

发行人库龄一年以上的存货主要为原材料和库存商品，形成原因主要系下游消费电子行业技术迭代和市场需求变化通常较快，导致公司部分客户项目关闭或订单量未达预期，进而造成公司部分存货出现呆滞或滞销的情形。

报告期内，针对库龄 1 年以上的存货，公司已按照可变现净值与存货成本孰低的原则计提存货跌价准备，计提比例充分，符合《企业会计准则》的相关规定。

8、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产明细如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
待抵扣增值税进项税	88.26	15.19	176.74	90.74	268.26	76.13
预缴企业所得税	14.12	2.43	18.04	9.26	84.13	23.87
预付发行费用	478.81	82.38	-	-	-	-
合计	**581.19**	**100.00**	**194.78**	**100.00**	**352.38**	**100.00**

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 352.38 万元、194.78 万元和 581.19

万元。2025 年末，公司其他流动资产大幅增加，主要系公司向 IPO 中介机构预付发行费用所致。

（三）非流动资产构成及其变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成及变动情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他权益工具投资	1,000.00	1.67	1,000.00	1.70	1,000.00	2.07
固定资产	49,075.83	81.78	49,902.66	84.74	18,271.63	37.76
在建工程	3,570.66	5.95	445.38	0.76	21,114.73	43.64
使用权资产	1,451.02	2.42	1,867.92	3.17	2,590.87	5.35
无形资产	3,275.40	5.46	3,381.12	5.74	3,512.61	7.26
长期待摊费用	858.48	1.43	1,257.06	2.13	1,351.41	2.79
递延所得税资产	490.15	0.82	422.59	0.72	453.46	0.94
其他非流动资产	285.93	0.48	609.72	1.04	88.38	0.18
非流动资产合计	**60,007.47**	**100.00**	**58,886.45**	**100.00**	**48,383.09**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动资产分别为 48,383.09 万元、58,886.45 万元和 60,007.47 万元，主要由固定资产、在建工程、使用权资产以及无形资产构成。

1、其他权益工具投资

报告期各期末，公司其他权益工具投资均为 1,000.00 万元，系公司于 2022 年 7 月通过股权受让获得的扬州光洋 1.42%股权，交易作价 1,000.00 万元。

扬州光洋系上市公司光洋股份（002708.SZ）控股子公司，主营业务系电子线路板业务，与公司存在长期战略协同性，公司计划长期持有该部分股权，系公司为长期战略目的持有的非交易性股权投资，计入“其他权益工具投资”核算，以公允价值计量且变动计入其他综合收益。

扬州光洋基本情况介绍详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司情况”之“（二）参股公司情况”相关内容。

2、固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 18,271.63 万元、49,902.66 万

元和 49,075.83 万元，占非流动资产的比重分别为 37.76%、84.74%和 81.78%，主要为房屋及建筑物、机器设备。

（1）固定资产的构成及成新率情况

报告期内，公司固定资产构成及成新率情况如下表所示：

单位：万元

类别	2025.12.31				
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	41,954.51	2,394.80	-	39,559.71	94.29%
机器设备	36,467.07	28,438.35	-	8,028.72	22.02%
运输工具	95.27	72.27	-	23.00	24.14%
电子设备	1,232.26	963.27	-	268.98	21.83%
其他	3,833.48	2,638.06	-	1,195.42	31.18%
合计	**83,582.59**	**34,506.75**	**-**	**49,075.83**	**58.72%**
类别	**2024.12.31**				
	原值	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	39,850.45	1,133.56	-	38,716.89	97.16%
机器设备	34,478.95	24,867.04	-	9,611.91	27.88%
运输工具	77.40	65.14	-	12.25	15.83%
电子设备	1,076.58	890.20	-	186.38	17.31%
其他	3,625.09	2,249.86	-	1,375.23	37.94%
合计	**79,108.46**	**29,205.80**	**-**	**49,902.66**	**63.08%**
类别	**2023.12.31**				
	原值	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**	**成新率**
房屋及建筑物	5,352.24	845.25	-	4,506.99	84.21%
机器设备	33,140.97	20,838.41	-	12,302.57	37.12%
运输工具	77.40	55.93	-	21.47	27.74%
电子设备	1,029.45	767.60	-	261.85	25.44%
其他	2,944.65	1,765.89	-	1,178.76	40.03%
合计	**42,544.71**	**24,273.08**	**-**	**18,271.63**	**42.95%**

2024 年末，公司固定资产同比增长幅度较大，主要系宇隆科技及合肥宇隆的新建生产基地达到预定可使用状态后由在建工程转固所致。

报告期内，公司下游需求情况整体稳步向好，公司经营情况未发生重大不利

变化，主要产品产能利用率、产销情况良好，期末固定资产均不存在减值迹象。

（2）固定资产的变动情况与各期主要产品产能的匹配关系

报告期内，公司固定资产原值分别为 42,544.71 万元、79,108.46 万元和 83,582.59 万元，与公司主营业务收入整体变动趋势基本一致，公司业务规模与固定资产规模相匹配。其中，由于宇隆科技及合肥宇隆生产基地房屋建筑物达到预定可使用状态而完成转固，公司 2024 年末房屋建筑物原值较 2023 年末增加 34,498.21 万元，截至本招股说明书签署日，上述新建项目的产线设施尚未完成建设且尚未投产。

报告期各期末，公司固定资产中的机器设备原值与主要产品产能情况具体如下：

单位：万元、万点、小时

项目	2025 年	2024 年	2023 年
期末机器设备原值	36,467.07	34,478.95	33,140.97
显示用智能控制卡产能	2,966,003.04	2,960,285.33	2,738,523.79
显示用精密功能器件产能	293,635.80	278,720.40	245,123.20

报告期内，公司业务规模稳步扩大，为满足下游客户不断增长的需求，报告期各期公司新增购置机器设备如自动贴片机、自动点胶机、自动锡膏印刷机以及各类模切机用以满足产能扩张的客观需求，并在达到预定可使用状态时转入固定资产，使得固定资产逐年增长，产能随之整体有所提升，具备合理性。

（3）公司各类资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率情况

公司各类资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率情况如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

公司固定资产折旧年限与国内同行业上市公司比较情况如下：

单位：年

公司名称	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	折旧方法
金百泽	30	3-10	4-10	3-10	3-10	年限平均法
深南电路	35	10	5	5	3、5	
光弘科技	20-50	3-10	3-5	3-5	5-8	
雅葆轩	20	10	5	5	5	
易德龙	20	3-10	4	3-5	3-10	
一博科技	30	5-10	4-5	3-5	3-5	
鸿富瀚	10-20	3-10	4	3-5	3-5	
博硕科技	20	5-10	5	3-5	3-5	
可川科技	10、20	10	5	5	5	
达瑞电子	5-20	2-10	5	4-5	4-5	
发行人	**30**	**5-10**	**4-5**	**3**	**3-10**	

数据来源：WIND 资讯

由上表可见，公司固定资产折旧年限与同行业上市公司的折旧年限相比不存在重大差异。

3、在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 21,114.73 万元、445.38 万元和 3,570.66 万元，占非流动资产的比重分别为 43.64%、0.76%和 5.95%。

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
重庆宇隆二期项目	86.61	45.94	10,029.53
合肥宇隆生产基地项目	3,215.50	29.32	10,444.34
零星工程	268.55	370.12	640.85
合计	**3,570.66**	**445.38**	**21,114.73**

报告期内，为满足下游客户订单增长需求，公司分别于宇隆科技和合肥宇隆新增投建生产基地，各期均按照规划投入建设。报告期各期末，公司上述重要在建工程的变动情况如下：

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产/长期待摊费用	本期减少	期末余额
2025.12.31						
重庆宇隆二期项目	45.94	1,767.89	1,727.22	-	-	86.61

项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期转入无形资产/长期待摊费用	本期减少	期末余额
合肥宇隆生产基地项目	29.32	4,906.37	1,720.19	-	-	3,215.50
合计	**75.26**	**6,674.26**	**3,447.41**	**-**	**-**	**3,302.11**
2024.12.31						
重庆宇隆二期项目	10,029.53	4,131.06	14,114.65	-	-	45.94
合肥宇隆生产基地项目	10,444.34	10,091.07	20,506.09	-	-	29.32
合计	**20,473.87**	**14,222.12**	**34,620.74**	**-**	**-**	**75.26**
2023.12.31						
重庆宇隆二期项目	5,292.74	4,736.79	-	-	-	10,029.53
合肥宇隆生产基地项目	1,524.26	8,920.08	-	-	-	10,444.34
合计	**6,817.00**	**13,656.87**	**-**	**-**	**-**	**20,473.87**

报告期内，公司各项在建工程严格按照达到预定可使用状态时进行转固，不存在在建工程延迟转固的情形。其中，2025 年，公司在建工程主要系工程项目产线铺设、厂房装修、机器设备等相关投资，其中部分机器设备安装调试完成、达到预定使用条件后已于当年完成转固。

截至报告期末，公司主要在建项目的项目重庆宇隆二期项目及合肥宇隆生产基地项目的项目周期、建设内容、预计投资金额及预计完工时间情况具体如下：

单位：万元

工程名称	主要建设内容	项目预计剩余完工时间	总预算	已投入金额	预计完工时间
重庆宇隆二期项目	机器设备及房屋建筑物等	2.75 年	47,136.12	15,928.48	房屋建筑物已转固，机器设备预计 2028 年前全部到位
合肥宇隆生产基地项目	机器设备及房屋建筑物等	2.75 年	82,080.34	25,441.78	房屋建筑物已转固，机器设备预计 2028 年前全部到位

截至报告期末，上述在建工程主体房屋建筑物已达到预定可使用状态，公司对上述主体房屋建筑物进行转固，符合《企业会计准则》的相关规定。

报告期内，公司下游需求情况整体稳步向好，公司经营情况未发生重大不利变化，主要产品产能利用率、产销情况良好，期末在建工程均不存在减值迹象。

4、使用权资产

根据《企业会计准则第 21 号——租赁》规定，根据新租赁准则的要求，作为承租人，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。报告期各期末，公司使用权资产构成如下：

单位：万元

类别	2025.12.31			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	3,610.02	2,159.00	-	1,451.02
合计	**3,610.02**	**2,159.00**	**-**	**1,451.02**
类别	**2024.12.31**			
	原值	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**
房屋建筑物	3,609.35	1,741.43	-	1,867.92
合计	**3,609.35**	**1,741.43**	**-**	**1,867.92**
类别	**2023.12.31**			
	原值	**累计折旧**	**减值准备**	**账面价值**
房屋建筑物	4,886.80	2,295.94	-	2,590.87
合计	**4,886.80**	**2,295.94**	**-**	**2,590.87**

报告期各期末，公司使用权资产分别为 2,590.87 万元、1,867.92 万元和 1,451.02 万元，均为公司租赁的厂房及办公场所。

公司租赁房产的具体情况请见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“五、公司的主要固定资产、无形资产情况”之“（一）固定资产”之“1、房屋及建筑物”相关内容。

5、无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,512.61 万元、3,381.12 万元和 3,275.40 万元，占非流动资产的比重分别为 7.26%、5.74%和 5.46%。

报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

类别	2025.12.31			
	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	3,599.22	422.36	-	3,176.86
专利及专利使用权	16.28	14.20	-	2.08

软件	720.46	624.01	-	96.45
合计	**4,335.96**	**1,060.56**	**-**	**3,275.40**
类别	**2024.12.31**			
	原值	**累计摊销**	**减值准备**	**账面价值**
土地使用权	3,599.22	352.98	-	3,246.25
专利及专利使用权	16.28	8.77	-	7.51
软件	690.18	562.81	-	127.36
合计	**4,305.68**	**924.56**	**-**	**3,381.12**
类别	**2023.12.31**			
	原值	**累计摊销**	**减值准备**	**账面价值**
土地使用权	3,599.22	283.60	-	3,315.63
专利及专利使用权	16.28	3.34	-	12.94
软件	676.71	492.67	-	184.05
合计	**4,292.22**	**779.61**	**-**	**3,512.61**

报告期各期末，公司无形资产均正常使用，不存在减值迹象。

公司无形资产具体信息参见本招股说明书“第五节 业务和技术”之“五、公司的主要固定资产、无形资产情况”之“（二）无形资产”相关内容。

6、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 1,351.41 万元、1,257.06 万元和 858.48 万元，占非流动资产的比重分别为 2.79%、2.13%和 1.43%，主要为厂房装修改造费。

7、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产的具体构成如下：

单位：万元

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,446.92	368.69	2,257.81	339.94	1,953.67	296.20
内部交易未实现利润	23.21	3.48	20.43	3.12	29.44	4.42
可抵扣亏损	1,757.28	308.70	1,922.27	336.48	1,964.37	329.83

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债	1,386.12	207.92	1,801.15	270.17	2,509.03	402.55
递延收益	943.01	141.45	269.58	40.44	451.87	67.78
职工薪酬	-	-	386.58	58.95	650.24	105.34
预计负债	-	-	-	-	37.89	5.68
小计	**6,556.54**	**1,030.23**	**6,657.82**	**1,049.10**	**7,596.51**	**1,211.80**

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税资产主要由资产减值准备、可抵扣亏损、递延收益、租赁负债以及职工薪酬等产生可抵扣暂时性差异所致。

（2）未经抵销的递延所得税负债

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债的具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	2,275.16	345.11	3,922.36	593.88	4,967.53	752.35
使用权资产	1,451.02	217.65	1,867.92	280.19	2,590.87	409.78
合计	**3,726.18**	**562.76**	**5,790.28**	**874.07**	**7,558.40**	**1,162.13**

报告期各期末，公司未经抵销的递延所得税负债主要为固定资产一次性税前扣除产生的应纳税暂时性差异和由租赁房屋建筑物、机器设备形成的使用权资产产生的应纳税暂时性差异。

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

报告期各期末，公司以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债的具体情况如下：

单位：万元

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额	互抵金额	抵销后余额
递延所得税资产	540.08	490.15	626.51	422.59	758.34	453.46
递延所得税负债	540.08	22.68	626.51	247.56	758.34	403.79

报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 453.46 万元、422.59 万元和 490.15 万元，占非流动资产的比重分别为 0.94%、0.72%和 0.82%，整体规模

较为稳定且占比较低。

（四）资产周转能力分析

1、主要资产周转能力指标

报告期内，公司主要资产周转能力指标如下：

财务指标	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款周转率（次）	2.82	3.04	2.36
存货周转率（次）	11.68	11.87	7.09
总资产周转率（次）	0.76	0.80	0.59

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.36 次、3.04 次和 2.82 次。2024 年，半导体显示面板及消费电子行业景气度企稳回暖，带动公司下游需求持续增长，公司收入规模随之扩大，全年营业收入的增长幅度高于应收账款余额增长幅度，故 2024 年公司应收账款周转率有所增长。2025 年，公司应收账款周转率保持较高水平。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为 7.09 次、11.87 次和 11.68 次，整体呈上升趋势。2024 年以来，随着下游需求企稳回暖，公司存货周转率逐步提升并保持较高水平。

（3）总资产周转率

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.59 次、0.80 次和 0.76 次。2024 年以来，随着下游需求持续增长，公司总资产周转率保持较高水平。

2、同行业上市公司比较

报告期内，公司资产周转能力指标与可比公司的对比情况如下：

财务指标	公司简称	股票代码	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
应收账款周转率（次）	金百泽	301041.SZ	3.48	3.54	3.26
	深南电路	002916.SZ	5.22	5.19	4.62
	光弘科技	300735.SZ	5.62	4.69	4.20
	雅葆轩	920357.BJ	3.08	2.73	3.10

财务指标	公司简称	股票代码	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
	易德龙	603380.SH	5.47	4.74	4.11
	一博科技	301366.SZ	5.52	5.02	4.60
	鸿富瀚	301086.SZ	2.63	2.12	1.61
	博硕科技	300951.SZ	2.08	1.72	2.15
	可川科技	603052.SH	2.35	1.99	1.83
	达瑞电子	300976.SZ	4.02	4.86	3.32
	平均值		**3.95**	**3.66**	**3.28**
	发行人		**2.82**	**3.04**	**2.36**
存货周转率（次）	金百泽	301041.SZ	8.79	9.29	7.24
	深南电路	002916.SZ	3.97	4.43	4.12
	光弘科技	300735.SZ	13.46	17.56	16.61
	雅葆轩	920357.BJ	4.68	3.68	4.34
	易德龙	603380.SH	2.99	2.73	2.72
	一博科技	301366.SZ	2.95	2.40	2.17
	鸿富瀚	301086.SZ	4.26	5.28	4.26
	博硕科技	300951.SZ	8.22	9.10	16.45
	可川科技	603052.SH	13.94	13.91	13.49
	达瑞电子	300976.SZ	5.64	5.77	4.20
	平均值		**6.89**	**7.41**	**7.56**
	发行人		**11.68**	**11.87**	**7.09**
总资产周转率（次）	金百泽	301041.SZ	0.77	0.76	0.73
	深南电路	002916.SZ	0.85	0.75	0.62
	光弘科技	300735.SZ	0.97	0.87	0.81
	雅葆轩	920357.BJ	0.96	0.75	0.80
	易德龙	603380.SH	1.01	0.93	0.89
	一博科技	301366.SZ	0.40	0.32	0.31
	鸿富瀚	301086.SZ	0.28	0.32	0.28
	博硕科技	300951.SZ	0.46	0.42	0.58
	可川科技	603052.SH	0.55	0.48	0.47
	达瑞电子	300976.SZ	0.73	0.65	0.39
	平均值		**0.70**	**0.63**	**0.59**
	发行人		**0.76**	**0.80**	**0.59**

数据来源：WIND 资讯

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.36 次、3.04 次和 2.82 次，与同行业上市公司均值不存在显著差异。

报告期内，公司存货周转率分别为 7.09 次、11.87 次和 11.68 次，高于同行业平均值，主要系公司主营业务中的显示用智能控制卡业务中的 PCBA 制造服务业务（客供料）占比相对较高，由于该业务系由客户提供主要原材料，公司仅对客户提供的原料进行专项库存管理并提供锡膏、包材等辅耗材，相关业务存货规模较小，可快速响应客户需求，由此导致公司整体存货周转率较高。同行业公司中，光弘科技主营业务收入客供料模式占比较高，其存货周转率亦处于较高水平，与公司情况一致。

报告期内，公司总资产周转率分别为 0.59 次、0.80 次和 0.76 次，与同行业上市公司均值不存在显著差异。

十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债的主要构成及变动分析

报告期各期末，公司负债规模变动及其构成如下所示：

单位：万元、%

项目名称	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	30,704.30	85.56	36,843.55	77.85	23,978.25	65.17
非流动负债	5,183.64	14.44	10,479.94	22.15	12,815.92	34.83
负债总计	**35,887.94**	**100.00**	**47,323.48**	**100.00**	**36,794.17**	**100.00**

报告期各期末，公司负债总计分别为 36,794.17 万元、47,323.48 万元和 35,887.94 万元，主要由流动负债构成，流动负债占各期负债总额的比例分别为 65.17%、77.85%和 85.56%。

1、主要流动负债构成及分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	-	-	3,993.42	10.84	2,846.75	11.87

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	3,105.67	10.11	1,540.10	4.18	-	-
应付账款	19,112.48	62.25	23,273.74	63.17	17,423.37	72.66
合同负债	10.73	0.03	-	-	-	-
应付职工薪酬	1,874.79	6.11	1,820.24	4.94	1,809.54	7.55
应交税费	725.45	2.36	1,062.34	2.88	487.51	2.03
其他应付款	326.17	1.06	240.45	0.65	369.00	1.54
一年内到期的非流动负债	5,531.14	18.01	4,793.60	13.01	1,004.75	4.19
其他流动负债	17.88	0.06	119.65	0.32	37.34	0.16
流动负债合计	**30,704.30**	**100.00**	**36,843.55**	**100**	**23,978.25**	**100**

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费和一年内到期的非流动负债构成，具体情况如下：

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款分别为 2,846.75 万元、3,993.42 万元和 0 万元，占流动负债的比例分别为 11.87%、10.84%和 0.00%。

报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	-	3,990.00	-
质押借款	-	-	2,795.16
保证及质押借款	-	-	51.35
短期借款利息	-	3.42	0.23
合计	**-**	**3,993.42**	**2,846.75**

2023 年及 2024 年末，公司基于日常经营所需的考量，同银行开展应收账款质押借款及保证借款，短期借款规模有所提升。2025 年末，上述短期借款均已偿还。

报告期内，公司资信状况良好，不存在逾期未偿还的短期借款。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 0 万元、1,540.10 万元和 3,105.67

万元，均为银行承兑汇票，占流动负债的比例分别为 0.00%、4.18%和 10.11%。其中，2024 年以来，随着整体经营规模和下游订单需求的增长，为提高资金使用效率、保障公司日常资金周转，公司开始使用部分银行承兑汇票支付供应商账款，期末应付票据余额有所增加。

报告期各期末，公司无已到期未支付的应付票据。

（3）应付账款

公司应付账款主要为应付材料款和应付工程设备款。报告期各期末，公司应付账款余额分别为 17,423.37 万元、23,273.74 万元和 19,112.48 万元，占流动负债的比重分别为 72.66%、63.17%和 62.25%。

报告期各期末，公司应付账款按款项性质分类的明细如下：

单位：万元、%

项目	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付材料款	14,084.46	73.69	16,512.64	70.95	15,561.68	89.31
应付工程设备款	4,876.16	25.51	6,451.52	27.72	1,759.19	10.10
其他	151.86	0.79	309.58	1.33	102.49	0.59
合计	**19,112.48**	**100.00**	**23,273.74**	**100.00**	**17,423.37**	**100.00**

报告期各期末，公司应付账款前五名余额及其占比情况如下：

单位：万元

序号	单位名称	期末余额	款项性质	比例
2025 年 12 月 31 日				
1	安徽省建设集团有限公司	1,824.87	工程设备款	9.55%
2	广州国显	1,799.62	材料款	9.42%
3	江苏博敏电子有限公司	827.80	材料款	4.33%
4	安徽宿州建工集团有限公司	689.49	工程设备款	3.61%
5	上海一实贸易有限公司	638.90	材料款、工程设备款	3.34%
合计		**5,780.69**	**-**	**30.25%**
2024 年 12 月 31 日				
1	安徽省建设集团有限公司	2,465.74	工程设备款	10.59%
2	江苏博敏电子有限公司	1,441.18	材料款	6.19%

序号	单位名称	期末余额	款项性质	比例
3	广州国显	1,292.34	材料款	5.55%
4	四川省第六建筑有限公司	859.46	工程设备款	3.69%
5	华星光电	858.50	材料款	3.69%
合计		**6,917.22**	-	**29.72%**
2023 年 12 月 31 日				
1	广州国显	3,360.89	材料款	19.29%
2	华星光电	2,085.19	材料款	11.97%
3	广东弘擎	512.33	材料款	2.94%
4	景旺电子科技（珠海）有限公司	470.08	材料款	2.70%
5	四川省第六建筑有限公司	360.21	工程设备款	2.07%
合计		**6,788.70**	-	**38.96%**

报告期各期末，公司不存在应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款的情形。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,809.54 万元、1,820.24 万元和 1,874.79 万元，基本保持稳定。报告期各期末，公司应付职工薪酬明细情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
短期薪酬	1,857.59	1,816.21	1,809.54
辞退福利	17.20	4.02	-
合计	**1,874.79**	**1,820.24**	**1,809.54**

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 487.51 万元、1,062.34 万元和 725.45 万元，占流动负债的比重分别为 2.03%、2.88%和 2.36%，主要为应交增值税与应交企业所得税。

报告期各期末，公司应交税费的构成情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
增值税	136.67	318.82	185.80
企业所得税	482.52	662.59	222.08

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
代扣代缴个人所得税	26.27	24.42	21.56
城市维护建设税	6.78	17.97	26.58
房产税	43.00	-	-
土地使用税	6.37	6.37	6.37
教育费附加	2.91	7.70	11.39
地方教育附加	1.94	5.14	7.59
印花税	17.25	17.23	4.39
其他	1.76	2.10	1.77
合计	**725.45**	**1,062.34**	**487.51**

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为 369.00 万元、240.45 万元和 326.17 万元，占流动负债的比重分别为 1.54%、0.65%和 1.06%。

报告期各期末，公司其他应付款主要为押金保证金等，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
押金保证金	242.85	125.00	166.07
其他	83.32	115.45	202.93
合计	**326.17**	**240.45**	**369.00**

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债账面价值分别为 1,004.75 万元、4,793.60 万元和 5,531.14 万元，占流动负债的比重分别为 4.19%、13.01%和 18.01%，主要系一年内到期的长期借款及租赁负债。具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
一年内到期的长期借款	4,850.00	4,100.00	2.00
一年内到期的租赁负债	677.81	690.14	1,002.75
一年内到期的长期借款利息	3.33	3.47	0.00
合计	**5,531.14**	**4,793.60**	**1,004.75**

2024 年末，公司一年内到期的非流动负债较 2023 年增加 3,788.85 万元，主要原因系合肥宇隆长期借款 4,000.00 万元预计于 2025 年内归还，公司将上述长

期借款转列至“一年内到期的非流动负债”列示。上述借款已于 2025 年内归还。

2025 年末，宇隆科技及合肥宇隆长期借款合计 4,850.00 万元预计于 2026 年内归还，公司将上述长期借款转列至“一年内到期的非流动负债”列示。

一年内到期的长期借款具体情况参见本节之“十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（二）偿债能力分析”之“1、最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债项的金额、期限、利率及利息费用等情况”相关内容。

2、主要非流动负债构成及分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元、%

项目名称	2025.12.31		2024.12.31		2023.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	3,509.64	67.71	8,851.78	84.46	10,416.09	81.27
租赁负债	708.31	13.66	1,111.02	10.60	1,506.28	11.75
预计负债	-	-	-	-	37.89	0.30
递延收益	943.01	18.19	269.58	2.57	451.87	3.53
递延所得税负债	22.68	0.44	247.56	2.36	403.79	3.15
非流动负债合计	**5,183.64**	**100.00**	**10,479.94**	**100.00**	**12,815.92**	**100.00**

报告期各期末，公司非流动负债主要由长期借款、租赁负债以及递延收益构成，具体情况如下：

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款余额分别为 10,416.09 万元、8,851.78 万元和 3,509.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
保证借款	800.00	2,650.00	2,998.00
保证及抵押借款	2,707.23	6,194.80	7,409.24
长期借款利息	2.40	6.98	8.85
合计	**3,509.64**	**8,851.78**	**10,416.09**

报告期内，公司长期借款主要为保证借款及保证兼抵押借款，其中保证借款

主要为公司结合资金使用需求进行的流动资金贷款；保证兼抵押借款为公司用于重庆及合肥生产基地项目建设的固定资产抵押贷款。2025 年末，公司长期借款余额较上年末减少 5,342.14 万元，主要系宇隆科技及合肥宇隆长期借款合计 4,850.00 万元预计于 2026 年内归还，公司将上述长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”列示所致。

长期借款具体情况参见本节之“十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（二）偿债能力分析”之“1、最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债项的金额、期限、利率及利息费用等情况”相关内容。

（2）租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债分别为 1,506.28 万元、1,111.02 万元和 708.31 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
租赁付款额	756.25	1,156.14	1,587.79
减：未确认融资费用	47.93	45.12	81.51
合计	**708.31**	**1,111.02**	**1,506.28**

公司自 2021 年起适用新的租赁准则，在租赁期开始日，公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。截至报告期末，公司租赁负债主要为尚未支付的厂房租赁付款额。

报告期内，公司房屋租赁情况参见本招股说明书之“第五节 业务和技术”之“五、公司的主要固定资产、无形资产情况”之“（一）固定资产”之“1、房屋及建筑物”之“（2）租赁房产”的相关内容。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 451.87 万元、269.58 万元和 943.01 万元，占非流动负债的比例分别为 3.53%、2.57%和 18.19%。公司递延收益均为与资产相关的政府补助，具体情况如下：

单位：万元

2025 年					
补助项目	**期初金额**	**本期新增**	**本期计入当期损益**	**期末金额**	**类别**
厂房封顶项目扶持	-	500.00	12.61	487.39	与资产相关
生产基地固投补贴	-	400.00	7.98	392.02	与资产相关
2022 年技术改造财政增量贡献奖励资金（市级）	47.58	-	26.96	20.61	与资产相关
2023 年企业技术改造补贴项目奖补市级资金	35.29	-	19.00	16.29	与资产相关
2023 年工业技改政策支持项目	33.64	-	22.43	11.21	与资产相关
设备贴息补助	14.33	-	5.55	8.79	与资产相关
新站区经贸发展局 2021 年进口贴息	8.73	-	5.24	3.49	与资产相关
设备贴息补助	8.00	-	4.80	3.20	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	5.33	-	5.33	-	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	17.07	-	17.07	-	与资产相关
2020 重庆市年工业和信息化专项资金项目计划补助	4.03	-	4.03	-	与资产相关
2022 年第三批工业和信息化专项资金	84.62	-	84.62	-	与资产相关
合肥新站区经贸发展局-19 年度工业发展补助	6.25	-	6.25	-	与资产相关
2020 上半年固定资产投资补贴	4.70	-	4.70	-	与资产相关
合计	**269.58**	**900.00**	**226.57**	**943.01**	/
2024 年					
补助项目	**期初金额**	**本期新增**	**本期计入当期损益**	**期末金额**	**类别**
2022 年第三批工业和信息化专项资金	176.92	-	92.31	84.62	与资产相关
2022 年技术改造财政增量贡献奖励资金（市级）	-	67.80	20.22	47.58	与资产相关
2023 年企业技术改造补贴项目奖补市级资金	-	35.29	-	35.29	与资产相关
2023 年工业技改政策支持项目	17.42	32.00	15.78	33.64	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	42.67	-	25.60	17.07	与资产相关
设备贴息补助	19.88	-	5.55	14.33	与资产相关
新站区经贸发展局 2021 年进口贴息	13.97	-	5.24	8.73	与资产相关
设备贴息补助	12.81	-	4.80	8.00	与资产相关
合肥新站区经贸发展局-19 年度工业发展补助	19.33	-	13.08	6.25	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	13.33	-	8.00	5.33	与资产相关
2020 上半年固定资产投资补贴	31.97	-	27.26	4.70	与资产相关
2020 重庆市年工业和信息化专项资金项目计划补助	28.23	-	24.20	4.03	与资产相关

2019 年设备投入补助	21.42	-	21.42	-	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	20.00	-	20.00	-	与资产相关
设备贴息补助	3.97	-	3.97	-	与资产相关
借转补项目政府补助	6.18	-	6.18	-	与资产相关
合肥新站区经贸发展局-18 年度工业发展补助	3.82	-	3.82	-	与资产相关
新站区经贸发展局 2020 年进口贴息	0.63	-	0.63	-	与资产相关
2019 年设备投入补助	10.00	-	10.00	-	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	9.32	-	9.32	-	与资产相关
合计	**451.87**	**135.09**	**317.37**	**269.58**	/
2023 年					
补助项目	**期初金额**	**本期新增**	**本期计入当期损益**	**期末金额**	**类别**
2022 年第三批工业和信息化专项资金	269.23	-	92.31	176.92	与资产相关
拨付产业扶持资金（制造业类）-2020 年第 1、11 批	148.24	-	62.92	85.32	与资产相关
设备贴息补助	60.07	-	23.41	36.66	与资产相关
2020 上半年固定资产投资补贴	116.64	-	84.67	31.97	与资产相关
2019 年设备投入补助	106.82	-	75.40	31.42	与资产相关
2020 重庆市年工业和信息化专项资金项目计划补助	52.43	-	24.20	28.23	与资产相关
合肥新站区经贸发展局-19 年度工业发展补助	32.98	-	13.65	19.33	与资产相关
2023 年工业技改政策支持项目	-	18.00	0.58	17.42	与资产相关
新站区经贸发展局 2021 年进口贴息	19.21	-	5.24	13.97	与资产相关
借转补项目政府补助	90.19	-	84.02	6.18	与资产相关
合肥新站区经贸发展局-18 年度工业发展补助	16.90	-	13.09	3.82	与资产相关
新站区经贸发展局 2020 年进口贴息	8.21	-	7.58	0.63	与资产相关
北碚区 2017 年中小企业扶持资金	0.38	-	0.38	-	与资产相关
合计	**921.31**	**18.00**	**487.44**	**451.87**	/

（二）偿债能力分析

1、最近一期末银行借款、关联方借款、合同承诺债务、或有负债等主要债项的金额、期限、利率及利息费用等情况

截至报告期末，公司主要债务融资明细如下：

（1）银行借款

1）短期借款

截至报告期末，公司不存在短期借款。

2）长期借款（含一年内到期）

截至报告期末，公司长期借款（含一年内到期）具体情况如下：

序号	借款银行	借款金额（万元）	借款期限		贷款利率	计入科目
			起始日	还款日		
1、银行借款						
1）	中信银行股份有限公司重庆分行	850.00	2024.03.28	2026.03.27	2.35%	一年内到期的长期借款
2）	中国民生银行股份有限公司重庆分行	800.00	2024.07.22	2027.07.22	2.30%	长期借款
3）	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	2,707.23	2023 年起	2031.02.08	2.45%	长期借款
4）	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	2,000.00	2023 年起	2026.05.20	2.45%	一年内到期的长期借款
5）	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	2,000.00	2023 年起	2026.11.20	2.45%	一年内到期的长期借款
小计		**8,357.23**	-	-	-	-
2、已计提借款利息		5.74	-	-	-	-
其中：一年内到期的长期借款利息		3.33	-	-		一年内到期的长期借款
长期借款利息		2.40	-	-	-	长期借款
合计		**8,362.97**	-	-	-	-

（2）关联方借款

截至报告期末，公司不存在关联方借款余额。

（3）合同承诺债务

截至报告期末，除因经营等原因形成的应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款和租赁负债外，公司不存在其他合同承诺债务。

（4）或有负债

截至报告期末，公司不存在或有负债。

2、逾期未偿还债项的情形

报告期内，公司不存在逾期未偿还债项的情形。

3、借款费用资本化的情形

报告期内，公司存在借款费用资本化的情况，具体如下：

单位：万元

项目	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
利息支出金额	376.64	643.34	439.97
其中：资本化利息	-	287.45	286.15
计入财务费用金额	376.64	355.89	153.82

自 2022 年起，公司开工建设重庆宇隆二期项目及合肥宇隆生产基地项目，并将上述项目符合条件的专项借款费用予以资本化。2024 年末，上述在建工程中的主体房屋建筑物已基本完成转固，公司 2025 年起不再将相关借款费用确认为资本化支出。

4、未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况及偿债能力分析

报告期末，公司未来十二个月内可预见的需偿还负债和利息情况参见本节之“十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（一）负债的主要构成及变动分析”之“1、主要流动负债构成及分析”。

5、偿债能力分析

（1）主要偿债能力指标

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标	2025.12.31/ 2025 年度	2024.12.31/ 2024 年度	2023.12.31/ 2023 年度
流动比率（倍）	2.97	2.44	3.24
速动比率（倍）	2.72	2.25	2.93
资产负债率（合并）（%）	23.71	31.78	29.20
资产负债率（母公司）（%）	31.71	33.11	27.07
息税折旧摊销前利润（万元）	22,313.36	20,659.24	15,344.69
利息保障倍数（倍）	41.21	21.89	19.68

注：上述主要财务指标计算方法如下：

1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债；

2、速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债；

3、资产负债率＝期末总负债／期末总资产；

4、息税折旧摊销前利润＝净利润+所得税+利息费用+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销；

5、利息保障倍数＝（利润总额+费用化利息支出）／（费用化利息支出+资本化利息支

出）。

报告期各期，公司流动比率分别为 3.24、2.44 和 2.97，速动比率分别为 2.93、2.25 和 2.72，保持健康水平。其中，2024 年，公司流动比率和速动比率有所下降，主要系合肥宇隆有 4,000.00 万元长期借款预计于 2025 年内归还，转列一年内到期的长期借款所致。

报告期各期，公司合并口径资产负债率分别为 29.20%、31.78%和 23.71%，资产负债率相对较低，整体维持健康水平。此外，报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 15,344.69 万元、20,659.24 万元和 22,313.36 万元，呈现稳步增长态势；利息保障倍数分别为 19.68、21.89 和 41.21，处于较高水平。

整体来看，公司流动比率、速动比率以及资产负债率均保持在健康水平，流动资产的短期变现能力较强，具有较强的偿债能力。

（2）同行业上市公司比较

报告期内，公司偿债能力指标与可比公司的对比情况如下：

财务指标	公司名称	股票代码	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
流动比率（倍）	金百泽	301041.SZ	2.72	3.22	2.72
	深南电路	002916.SZ	1.36	1.45	1.34
	光弘科技	300735.SZ	1.40	1.89	2.16
	雅葆轩	920357.BJ	1.67	2.59	4.16
	易德龙	603380.SH	2.63	2.00	1.77
	一博科技	301366.SZ	2.85	4.27	3.91
	鸿富瀚	301086.SZ	1.71	2.39	3.43
	博硕科技	300951.SZ	3.92	4.05	2.90
	可川科技	603052.SH	1.65	2.12	3.18
	达瑞电子	300976.SZ	3.44	3.83	5.82
	平均值		**2.34**	**2.78**	**3.14**
	发行人		**2.97**	**2.44**	**3.24**
速动比率（倍）	金百泽	301041.SZ	2.42	2.94	2.47
	深南电路	002916.SZ	0.85	1.00	0.92
	光弘科技	300735.SZ	1.18	1.77	1.99
	雅葆轩	920357.BJ	1.26	2.05	3.39
	易德龙	603380.SH	1.65	1.22	1.06

财务指标	公司名称	股票代码	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
	一博科技	301366.SZ	2.27	3.59	3.39
	鸿富瀚	301086.SZ	1.56	2.19	3.24
	博硕科技	300951.SZ	3.70	3.87	2.80
	可川科技	603052.SH	1.55	2.01	3.09
	达瑞电子	300976.SZ	2.94	3.28	5.22
	平均值		**1.94**	**2.39**	**2.76**
	发行人		**2.72**	**2.25**	**2.93**
资产负债率（合并口径，%）	金百泽	301041.SZ	26.72	22.17	26.20
	深南电路	002916.SZ	43.82	42.12	41.67
	光弘科技	300735.SZ	44.23	33.09	31.21
	雅葆轩	920357.BJ	41.83	30.51	22.23
	易德龙	603380.SH	26.92	34.75	40.85
	一博科技	301366.SZ	25.59	19.79	17.87
	鸿富瀚	301086.SZ	49.80	26.98	22.22
	博硕科技	300951.SZ	22.25	21.66	29.28
	可川科技	603052.SH	38.38	32.59	27.42
	达瑞电子	300976.SZ	20.45	17.91	12.02
	平均值		**34.00**	**28.16**	**27.10**
	发行人		**23.71**	**31.78**	**29.20**

数据来源：WIND 资讯

由上表，报告期内，公司流动比率、速动比率及资产负债率水平与同行业可比公司相比不存在显著差异。

（三）报告期内公司股利分配情况

报告期内，公司不存在股利分配事项。

（四）现金流量分析

报告期内，公司现金流量基本情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
经营活动产生的现金流量净额	25,378.94	8,724.06	14,873.65
投资活动产生的现金流量净额	-10,034.07	-14,894.80	-3,474.87
筹资活动产生的现金流量净额	-10,102.28	2,209.49	9,253.97

项目	2025 年	2024 年	2023 年
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.45	-32.52	-29.90
现金及现金等价物净增加额	**5,221.14**	**-3,993.76**	**20,622.85**
期末现金及现金等价物余额	**29,317.00**	**24,095.86**	**28,089.62**

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流变化情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
销售商品、提供劳务收到的现金	122,793.05	103,708.08	79,988.27
收到其他与经营活动有关的现金	2,340.26	1,651.57	2,315.21
经营活动现金流入小计	**125,133.31**	**105,359.66**	**82,303.48**
购买商品、接受劳务支付的现金	72,994.14	73,153.80	43,300.04
支付给职工以及为职工支付的现金	16,485.11	16,246.75	16,563.43
支付的各项税费	6,944.09	4,642.68	5,423.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,331.04	2,592.37	2,143.32
经营活动现金流出小计	**99,754.37**	**96,635.60**	**67,429.83**
经营活动产生的现金流量净额	**25,378.94**	**8,724.06**	**14,873.65**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 14,873.65 万元、8,724.06 万元和 25,378.94 万元，现金流情况良好。

（1）经营活动现金流入与营业收入比较情况

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入比较，相关情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
销售商品、提供劳务收到的现金（a）	122,793.05	103,708.08	79,988.27
营业收入（b）	113,715.36	109,535.20	69,760.95
销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入（c=a/b）	107.98%	94.68%	114.66%

由上表可知，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 114.66%、94.68%和 107.98%，匹配关系良好。

（2）经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配关系

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的调节关系如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	**13,325.36**	**12,059.78**	**7,572.08**
加：资产减值准备	711.59	656.22	861.68
信用减值准备	-112.19	299.70	-18.19
固定资产折旧、使用权资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,193.49	5,866.49	6,053.42
无形资产摊销	136.00	113.10	116.33
长期待摊费用摊销	464.34	599.31	517.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-38.23	-6.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12.82	3.07	0.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	7.96
财务费用（收益以“-”号填列）	398.09	420.15	183.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-168.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-67.57	30.87	75.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-224.88	-156.23	55.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,353.30	-459.66	-393.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,666.68	-14,915.06	659.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	688.94	3,922.65	-1,195.19
其他	539.56	321.91	551.84
经营活动产生的现金流量净额	**25,378.94**	**8,724.06**	**14,873.65**

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在一定差异，主要原因系：1）报告期内公司机器设备投资金额较大，且合肥宇隆生产基地项目和重庆宇隆二期项目相关的房屋建筑物已于 2024 年末转固，故公司固定资产折旧金额较高；2）2024 年，消费电子及半导体显示面板行业整体回暖，公司新客户持续开拓，经营规模较 2023 年有所提升，公司经营性应收、应付项目余额增加；3）2025 年，公司营业收入较 2024 年保持稳定，经营活动产生的现金流量净额高于净利润，主要原因系公司回款情况良好，经营性应收项目减少所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
收回投资收到的现金	-	-	77,100.00
取得投资收益收到的现金	-	-	168.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.12	0.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	14,000.00	14,000.00	37,000.00
投资活动现金流入小计	**14,001.12**	**14,000.30**	**114,268.75**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,035.19	12,895.10	20,243.62
投资支付的现金	-	-	64,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,000.00	16,000.00	33,000.00
投资活动现金流出小计	**24,035.19**	**28,895.10**	**117,743.62**
投资活动产生的现金流量净额	**-10,034.07**	**-14,894.80**	**-3,474.87**

报告期内，公司收到/支付其他与投资活动有关的现金主要系赎回/购买大额存单产生的现金流。

2023 年，公司收回投资收到现金及投资支付现金主要为赎回/购买理财产品产生的相应款项。

2024 年起，公司基于经营活动开展等因素的考量，未再购赎理财产品，投资活动现金流出主要系重庆宇隆二期项目及合肥宇隆生产基地项目建设的投入。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量构成情况如下：

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	2023 年
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	512.44	17,575.56	15,263.55
收到其他与筹资活动有关的现金	-	17.40	13.45
筹资活动现金流入小计	**512.44**	**17,592.96**	**15,277.00**
偿还债务支付的现金	9,090.00	13,896.52	4,672.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320.75	582.82	338.83

项目	2025 年	2024 年	2023 年
支付其他与筹资活动有关的现金	1,203.97	904.12	1,011.34
筹资活动现金流出小计	**10,614.72**	**15,383.46**	**6,023.03**
筹资活动产生的现金流量净额	**-10,102.28**	**2,209.49**	**9,253.97**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 9,253.97 万元、2,209.49 万元和-10,102.28 万元。其中，2025 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要系当期偿还原有债务所致。

报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金主要系偿还租赁负债。

（五）资本性支出计划情况

截至报告期末，公司可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目，该等投资与公司主营业务密切相关，相关项目支出的决议已经公司董事会、股东会审议通过，项目的具体情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。对于实际募集资金量较募集资金投资项目需求不足的部分，公司将自筹解决。上述资本性支出计划具有可实现性。

（六）流动性变化、风险趋势及具体应对措施

截至报告期末，公司负债主要为流动负债，公司偿债能力指标良好，公司不存在影响现金流量的重要事件或承诺事项，发行人的流动性没有产生重大变化或风险。

公司将继续保持良好的财务及资金管理能力，密切跟踪行业市场动态，加强对客户信用的管理，提高应收账款的回款效率。公司亦将积极拓展外部融资渠道，加强与各大银行的合作与联系，为公司持续发展提供有效的资金保障。

（七）公司在持续经营能力方面是否存在重大不利变化或风险因素

1、持续经营能力方面不存在重大不利变化或风险因素

报告期内，公司坚持积极主动的市场竞争策略，充分发挥公司在以半导体显示面板为核心应用领域的显示用智能控制卡及精密功能器件领域的竞争优势，加大市场开拓力度。依靠卓越的综合服务能力、优异的产品性能、完整的供应体系和及时的产品交付能力，公司目前已与京东方建立了长期稳定的合作关系，实现了对京东方、和辉光电、深天马、维信诺、惠科股份、华星光电等国内头部新型

半导体显示面板企业的广泛覆盖。

我国新型半导体显示面板以及消费电子产业的蓬勃发展带动了上下游产业链的快速增长，作为新型半导体显示面板模组工程的关键零部件，公司主要产品显示用智能控制卡及精密功能器件系半导体显示面板整体技术进步的重要一环，有着广阔的发展前景和巨大的市场空间。

未来，公司将继续巩固、优化与现有优质客户的合作关系，重点开展半导体显示面板领域终端客户的认证和开发，同时加强在新能源汽车、光通信模块、协作机器人等领域的客户开拓和产品布局。公司将通过积极的市场和业务扩大，扩展公司产品应用领域及进行客户多元化战略，进一步深耕和发掘市场需求。

随着公司包括募投项目在内的扩产项目陆续投建完成并生产销售，公司营业收入将相应增加。此外，公司将以市场需求为导向，持续增加研发投入，为公司的持续成长和盈利能力的稳步提升提供强有力的保障。但是，募集资金投资项目的效益实现需要一定周期，效益实现存在一定的滞后性，在募集资金投入初期，受新增固定资产折旧、无形资产摊销等因素的影响，募集资金投资项目业绩存在未能按预期完全达标的风险。项目实际建成后，相关产品的市场推广和销售情况也可能与公司的预测发生差异，致使项目的投资收益率低于预期水平，进而影响到公司业务发展目标的顺利实现。

2、管理层自我评判的依据

结合公司业务、经营策略和未来发展战略规划，管理层对可能影响公司持续经营能力的各要素进行了审慎评估，公司目前不存在以下对持续经营能力构成重大不利影响的情形：

（1）公司的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续经营能力构成重大不利影响；

（2）公司的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续经营能力构成重大不利影响；

（3）公司在用的商标、专利、软件著作权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；

（4）公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；

（5）公司最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；

（6）其他可能对公司持续经营能力构成重大不利影响的情形。

综上，管理层认为从公司目前的业务发展情况等多方面因素考虑，公司能够保持良好的持续经营能力，自身不存在重大的持续经营风险。

十一、重大资本性支出分析

（一）报告期内主要资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为20,243.62 万元、12,895.10 万元和 10,035.19 万元，合计 43,173.91 万元。公司主要资本性支出为重庆宇隆二期项目及合肥宇隆生产基地项目等在建工程项目支出以及宇隆科技、合肥宇隆、武汉宇隆、成都宇隆等各生产基地购置设备的支出。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次发行募集资金投资项目。本次发行募集资金投资项目详细情况请见本招股说明书之“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

十二、报告期内重大资产业务重组或股权收购合并的基本情况

报告期内，公司不存在重大资产业务重组或股权收购合并事项。

十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

（二）或有事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的重要或有事项。

（三）其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的其他重要事项。

（四）重要承诺事项

截至本招股说明书签署日，公司无应披露未披露的重要承诺事项。

（五）重大担保、诉讼等事项

截至本招股说明书签署日，公司及公司实际控制人、子公司，及公司董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员均不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、盈利能力及持续经营产生重大影响的重大担保、诉讼等事项。

十四、审计报告截止日后至招股说明书签署日之间的经营情况

（一）财务报告审计截止日后经营情况

财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间，公司经营状况稳定，主营业务、经营模式、持续盈利能力未发生重大不利变化。发行人的主要采购、技术研发、经营及销售等业务运转正常，主要客户、供应商未发生重大变化，不存在导致发行人业绩异常波动的重大不利因素，也未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

（二）财务报告审计截止日后主要财务信息

公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。天健会计师对公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2026 年 1-6 月的合并及母公司利润表、2026 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审〔2026〕17403 号）。

天健会计师认为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映宇隆科技公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。”

公司财务报告审计截止日后经审阅（未经审计）的主要财务信息及经营状况如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动率
资产总额	165,126.46	151,342.95	9.11%

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动率
负债总额	39,500.57	35,887.94	10.07%
归属于母公司所有者权益合计	123,585.56	115,458.72	7.04%
所有者权益合计	125,625.89	115,455.01	8.81%

截至2026年6月末,公司资产总额为165,126.46万元,较上年末增长9.11%,负债总额为 39,500.57 万元，较上年末增长 10.07%；归属于母公司所有者权益合计为 123,585.56 万元，较上年末增长 7.04%；所有者权益合计为 125,625.89 万元，较上年末增长 8.81%。

公司总资产规模增加主要系随着经营规模的扩大，公司盈利能力持续增强，应收账款等增加所致；所有者权益的增加主要系公司主营业务经营情况良好，生产经营积累所致。总体而言，公司资产负债结构稳定、资产状况良好，未发生重大异常变化。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率
营业收入	65,556.59	59,743.74	9.73%
营业利润	8,799.59	8,036.08	9.50%
利润总额	8,804.52	8,025.91	9.70%
净利润	7,661.48	7,032.80	8.94%
归属于母公司所有者的净利润	7,717.44	7,032.80	9.73%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7,660.90	6,823.38	12.27%

2026 年 1-6 月，公司营业收入为 65,556.59 万元，较上年同期增加 9.73%，归属于母公司所有者的净利润为 7,717.44 万元，较上年同期增加 9.73%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,660.90 万元，较上年同期增加 12.27%，主要原因系：一方面，公司充分发挥竞争优势，深化与主要客户的业务合作关系，持续开拓新增订单，带动主要产品销量稳步提升；另一方面，随着部分设备折旧年限到期，公司制造费用有所降低，产品毛利相应提升。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变动率
经营活动产生的现金流量净额	5,453.79	10,688.10	-48.97%
投资活动产生的现金流量净额	-7,343.46	-4,371.93	-67.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,028.10	-6,953.22	70.83%

2026 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,453.79 万元，但相较 2025 年 1-6 月的经营活动产生的现金流量净额降低 48.97%，主要原因系：公司 2026 年 1-6 月收入同比有所增长，经营性应收项目增长较快，经营性应付项目虽亦有所增长但低于经营性收项目增速，进而导致公司经营活动产生的现金流量净额较 2025 年 1-6 月有所下降，具备合理性。

2026 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,343.46 万元，较去年同期降低 67.97%，主要系公司本期固定资产、在建工程等长期资产投入增加所致。

2026 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,028.10 万元，较去年同期增长 70.83%，主要系子公司隆美卡机器人收到少数股东实缴出资及公司当期偿还债务金额同比减少所致。

4、非经常性损益情况

2026 年 1-6 月，公司非经常性损益主要明细数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-0.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	59.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7.49
小计	65.76
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	9.21
少数股东损益	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	56.54
扣除非经常性损益前归属于公司普通股股东的净利润	7,717.44

项目	2026 年 1-6 月
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,660.90

2026 年 1-6 月，公司扣除所得税影响后归属于母公司股东的非经常性损益净额为 56.54 万元，对净利润影响较小，主要系计入当期损益的政府补助。

5、2026 年 1-9 月经营业绩预计情况

基于目前的经营状况、市场环境及在手订单，公司对 2026 年 1-9 月经营业绩进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动率
营业收入	93,500 至 99,600	88,958.76	5.10%至 11.96%
归属于母公司所有者的净利润	11,100 至 12,000	10,891.86	1.91%至 10.17%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	10,800 至 11,600	10,591.86	1.97%至 9.52%

上述 2026 年 1-9 月预计经营业绩数据为初步测算结果，未经审计或审阅，亦不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

十五、盈利预测

公司在 2025 年度经审计的财务报表及 2026 年 1-6 月未经审计的实际经营数据所反映的经营业绩基础上，以 2026 年 7-12 月经营环境及经营计划等的最佳估计假设为前提，按照一贯采用的主要会计政策和会计估计，遵循谨慎性原则编制了 2026 年度盈利预测报告，天健会计师进行审核并出具了 2026 年度盈利预测审核报告（天健审〔2026〕17399 号）。

公司 2026 年度的盈利预测具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年预测数	2025 年已审数	同比变动比例
营业收入	132,434.09	113,715.36	16.46%
净利润	14,014.65	13,325.36	5.17%
归属于母公司所有者的净利润	14,126.57	13,329.07	5.98%

2026 年，公司预测营业收入为 132,434.09 万元，同比增长 16.46%；预测净利润 14,014.65 万元，同比增长 5.17%；预测归属于母公司所有者的净利润为 14,126.57 万元，同比增长 5.98%。公司预计 2026 年主要产品销量、营业收入、

净利润、归属于母公司所有者的净利润等经营业绩指标均较 2025 年有所上升，公司经营业绩保持稳定增长态势，持续盈利能力未发生重大不利变化。

公司 2026 年度盈利预测报告是公司管理层在最佳估计假设的基础上编制的，遵循了谨慎性原则，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

第七节 募集资金运用与未来发展规划

一、本次募集资金投资项目及其使用计划

（一）本次发行募集资金投资项目

本次募集资金拟投资项目经第二届董事会第五次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过确定。本次募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	实施主体
1	合肥宇隆生产基地项目	96,850.28	45,000.00	合肥宇隆
2	重庆宇隆二期项目	53,571.44	25,000.00	宇隆科技
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	宇隆科技
总计		**180,421.72**	**100,000.00**	-

本次募集资金到位之前，公司将根据实际经营需要，以自有资金及自筹资金对上述项目进行前期投入，待募集资金到位，用募集资金置换预先已投入该项目的自有资金及自筹资金。如募集资金不能满足上述项目的需求，不足部分公司将以自有资金及自筹资金补充；如募集资金满足上述项目需求后尚有剩余，则剩余资金将用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。如募集资金超过上述项目的需求，超过部分将按照国家法律、法规及中国证监会、深交所的相关规定，履行法定程序后适当使用。

上述募投项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，实施后不新增同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

（二）募集资金使用管理制度

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大程度地保障投资者的利益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，经董事会和股东会审议通过，制定了《重庆宇隆光电科技股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《重庆宇隆光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司上市后建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，

并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。公司将严格按照《重庆宇隆光电科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定投入和使用管理募集资金，募集资金投资项目因市场发生变化或其他特殊原因导致可行性发生变化的，应当经董事会审议、股东会决议通过后方可变更募集资金投向。

（三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响和业务创新创造创意性的支持作用

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务发展。本次募集资金投资项目实施后，将进一步提高公司的产能规模，在行业需求持续增加的背景下，有利于公司把握下游行业规模增长所带来的机遇，从而提高公司的综合实力、市场地位和盈利能力，是推进公司未来经营战略的重要举措。

本次募投项目建设的合肥宇隆生产基地项目及重庆宇隆二期项目，体现了公司最新的研发、设计、生产技术水平，能够更高效地满足客户应用需求，有力推动公司的发展壮大，为公司不断提升业务创新、创造、创意性提供支撑，系对公司现有业务的提升和拓展。本次募集资金投资项目的实施，通过工艺技术创新与产品创新，有利于提高公司技术研发水平、实现新产品的研发及产业化，进一步提升主营产品品质把控能力，推动公司整体客户服务能力，进而助力我国新型半导体显示面板产业新质生产力的发展。

综上所述，本次募投项目紧密围绕公司发展目标开展，符合公司整体战略规划，有利于公司发展战略的实现；公司本次募集资金投资项目对发行人的工艺技术创新与产品创新具有较强的支持作用。

（四）募集资金投资项目的确定依据

1、在 AI 技术引领消费电子行业产品、技术高速发展以及国内龙头厂商“出海”需求增加的背景下，公司需要进一步提升生产能力，以匹配下游客户快速增加的配套需求

近年来，随着 OLED、Mini/Micro LED 等新兴显示技术逐步成熟，全球消费趋势和技术水平变化推动了消费电子终端产品加快升级换代。与此同时，2023

年以来，我国逐步出台了诸多消费支持政策，引导扩大国内消费市场的复苏。2023年至今，发行人营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，已呈现稳步增长趋势。随着下游需求持续的增长，报告期内公司产销两旺，产能利用率已企稳回升至 90%以上。

展望未来，一方面，AI 技术已经重塑了消费电子产品的交互方式，AI 手机、AI PC、AI 平板电脑的普及将催生新的换机需求，AI 技术的进步将带来消费电子行业的未来机遇；另一方面，京东方、和辉光电等国内半导体显示面板厂商已具备显著的全球竞争优势，并正通过“出海”战略进一步带动整个显示产业链持续向好。行业的快速发展必将对半导体显示面板产业链配套厂商的研发实力、成本管控、产品品质、交付周期等方面提出了更高的要求。

通过本次发行上市，公司希望能够牢牢把握 AI 技术引领下的新型半导体显示面板产业以及整个消费电子行业的历史性发展机遇，持续扩大自身产能规模以进一步提升向下游我国半导体显示面板产业领先厂商客户的供货能力和自身核心竞争力。

因此，在 AI 技术引领消费电子行业产品、技术高速发展的背景下，公司需要进一步提升生产能力，以匹配下游客户快速增加的配套需求，避免未来因产能不足而制约公司业务的发展、失去强化市场竞争力和提升市场占有率的机会。

2、本次募投项目有利于加强在华东、华中和西南区域的产能布局

华东、华中地区是我国重要的半导体显示面板产业集群，聚集了京东方、华星光电、天马集团、维信诺、和辉光电等众多国内优秀面板厂商及配套供应商。合肥宇隆生产基地项目达产后可新增智能控制卡类产品产能近 10,000 万片/年，新增精密功能器件产品产能超过 30,000 万片/年，可有效满足京东方、和辉光电等现有客户的生产需求，并有利于贴近位于华东和华中的客户生产基地，从而提高响应速度和客户服务能力，是公司在华东、华中地区进一步扩大市场份额的又一重要举措。

西南地区是我国重要的半导体显示面板产业集群，公司主要客户京东方已在重庆、成都、绵阳等地布局了多个生产基地。重庆宇隆二期项目达产后可实现新增各类智能控制卡类产品产能近 5,000 万片/年，公司可有效满足重庆地区客户的

需求，同时辐射成都、绵阳等地，进一步提高响应速度和客户服务能力，是公司在西南地区进一步布局产能的重要举措。

3、补充流动资金从而应对短期流动性压力，提升公司抗风险能力

公司目前已启动本次募投项目的建设，随着项目建设的推进，项目的资金支出逐步扩大。同时，近年来，随着公司所处行业的快速发展，下游客户需求的开拓也对公司的营运资金提出了更高的要求。随着公司产能扩大、业务规模不断增长，公司未来运营资金需求将持续增加。因此，公司本次拟通过募集资金补充部分流动资金，有助于提高公司应对短期流动性压力的能力，提升公司抗风险能力，有利于公司的进一步发展。

综上，本次募集资金投资项目系综合考虑公司主营业务、经营规模、技术水平，并审慎结合公司管理能力和发展目标后确定，具有合理性、必要性。

（五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目，募集资金投资项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。

二、本次募集资金运用情况

（一）本次募集资金投资项目的可行性分析

1、募投项目符合国家产业政策要求

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，通过技术创新、规模效应和产业链协同，不仅成为新质生产力发展的核心引擎，更通过数字化与绿色化转型推动经济“质效双升”，对维护工业稳定、实现制造强国目标具有不可替代的战略意义。根据工业和信息化部、市场监督管理总局于 2025 年 8 月发布的《电子信息制造业 2025－2026 年稳增长行动方案》，“电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域。”

半导体显示面板作为电子信息领域的核心产业，对我国电子信息制造业水平的提升发挥了关键作用，其不仅直接贡献了巨大的产业规模和经济价值，还通过技术突破、产业链协同和创新应用，全面推动了电子信息制造业的高质量发展。

根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型半导体显示行业 2024 年产值规模的同比增速达到 12%，在全球市场中的占比超过 49%；2025 年，我国新型半导体显示行业的产值规模继续保持 5%左右的增长速度，在全球市场进一步提升至约 54%的占比，位居世界第一。这一规模直接拉动了电子信息制造业的产值增长，并带动了上下游产业链的协同发展，包括材料、装备制造和终端应用等领域。

半导体显示面板及消费电子行业的蓬勃发展带动公司所处行业的快速发展。公司本次募投项目的实施将进一步提升公司的生产能力，从而更好地服务下游国内龙头半导体显示面板厂商客户，有利于我国电子制造业新质生产力、新动能的快速发展，符合国家产业政策，受政策鼓励，具有可行性。

2、公司具有良好的客户基础

公司下游客户包括全球半导体显示面板龙头面板厂商京东方及华星光电、OLED 面板龙头和辉光电等全球知名的半导体显示面板企业。公司主要生产地分布于西南地区、华东地区、华北地区、华南地区、华中地区等产业聚集地，毗邻电子制造产业基地，实现最大程度的上述客户覆盖，及时响应需求。

公司凭借与客户的长期合作关系，已经在产品同步开发、质量控制、生产规模、供应保障、售后服务响应等方面形成了较强的竞争力。由于公司下游客户对供应商的前期考核周期长、质量服务要求严格、评审认证体系复杂，因此其供应商更换成本较高，一旦建立合作关系不会轻易变更。公司长期积累的核心客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。公司目前已经进入京东方、和辉光电等厂商的供应链体系，核心客户优质稳定，且能保持长期合作关系，为本次募投项目的实施提供了保障。

3、公司具有深厚的技术积累

公司始终以新型半导体显示面板产品为核心应用领域，深耕 LCD 显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro LED 等显示领域新技术的应用发展，掌握了以显示用智能控制卡、精密功能器件为核心产品的电子互联、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺。

经过多年发展创新及技术积淀，公司的生产经营规模、工艺装备水平、产品

研发能力、质量控制以及产品交付能力等均处在行业领先水平，被认定为国家重点支持专精特新“小巨人”企业、国家智能制造优秀场景、国家级高新技术企业、重庆市“高精度 PCBA 控制板制造数字化车间”、重庆市“高精密 OLED 控制板生产数字化车间”、重庆市知识产权优势企业、中国潜在独角兽企业等，并获得重庆市企业技术中心、重庆市制造业中试平台等资质认定。截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有专利权 306 项，其中包括 12 项发明专利，另有 46 项发明专利正在申请，参与了 3 项国家标准的起草制定。

未来，随着在研项目的推进，公司将持续进行项目储备与技术创新，不断拓展公司的产品种类和应用领域，实现可持续发展，也为公司此次募投项目的实施提供了有力的技术保障。

4、公司具有科学的运营体系和富有经验的管理团队

公司通过规范的运营制度、ERP 管理系统、精益生产的经营理念，已建立起合理、有效的运营调度体系，在满足客户快速交付需求的前提下，能够实现众多品类产品的有效管理和良好的质量控制。上述科学的运营体系为本次募投项目实施提供了体系支撑。

与此同时，公司管理团队多年来专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件领域，积累了丰富的行业技术储备与企业经营经验，并对公司产品下游半导体显示面板行业有着深刻的理解和认知，对市场和技术发展趋势具有前瞻性的把握能力，能够保障公司长期、稳定的快速成长，也为公司此次募投项目的实施提供了有力的支撑。

（二）本次募集资金的具体用途

1、合肥宇隆生产基地项目

（1）项目概况

合肥宇隆生产基地项目实施主体为合肥宇隆，项目总投资 96,850.28 万元，拟使用募集资金 45,000.00 万元。

本项目拟新建智能控制卡和精密功能器件生产线、生产车间、公辅设施、配套辅助用房等，总建筑面积合计 101,648 平方米；项目达产后可年产智能控制卡

产品近 10,000 万片，年产精密功能器件 30,360 万片。

（2）项目投资概算

序号	投资明细	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	34,128.18	35.24%
2	设备及软件购置费	46,653.82	48.17%
3	安装工程费	2,284.17	2.36%
4	工程建设其他费用	3,506.42	3.62%
5	预备费	4,328.63	4.47%
6	铺底流动资金	5,949.06	6.14%
合计		**96,850.28**	**100.00%**

（3）项目实施进度安排

本项目建设期为 72 个月，包括初步设计及审批、施工图设计、土建施工、设备安装、调试、试生产等阶段。项目已于 2022 年启动建设，预计于 2028 年建设完成。

（4）项目履行的审批情况及土地取得情况

本项目已完成合肥市固定资产投资项目备案（登记备案项目代码：2110-340163-04-01-849568），并且已取得环评批复文件（环建审[2022]12078 号）。

本项目位于安徽省合肥市新站高新技术开发区新蚌埠路东、淮下路南、三十头路北，项目用地已取得国有土地权证（皖（2025）合肥市不动产权第 1065381 号至第 1065387 号）。

2、重庆宇隆二期项目

（1）项目概况

重庆宇隆二期项目实施主体为宇隆科技，项目总投资 53,571.44 万元，拟使用募集资金 25,000.00 万元。

本项目拟新建智能控制卡生产线、生产车间、配套辅助用房等，总建筑面积合计 59,287 平方米。项目达产后可实现年产智能控制卡 4,992 万片。

（2）项目投资概算

序号	投资明细	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	18,092.00	33.77%
2	设备及软件购置费	28,311.16	52.85%
3	安装工程费	1,366.31	2.55%
4	工程建设其他费用	1,996.32	3.73%
5	预备费	2,488.29	4.64%
6	铺底流动资金	1,317.35	2.46%
合计		**53,571.44**	**100.00%**

（3）项目实施进度安排

本项目建设期为 78 个月，包括初步设计及审批、施工图设计、土建施工、设备安装、调试、试生产等阶段。项目已于 2022 年启动建设，预计于 2028 年建设完成。

（4）项目履行的审批情况及土地取得情况

本项目已完成重庆市固定资产投资项目备案（登记备案项目代码：2020-500109-39-03-152394），并且已取得环评批复文件（渝（两江）环准[2022]144 号）。

本项目位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号地块，项目用地已取得国有土地权证（渝（2025）两江新区不动产权第 000368158 号）。

3、补充流动资金

公司拟使用募集资金 30,000.00 万元用于主营业务发展所需要的流动资金。

报告期内，公司营业收入分别为 6.98 亿元、10.95 亿元及 11.37 亿元，整体呈增长趋势。随着公司未来业务规模的增长，项目投资、生产经营对流动资金的需求也将不断增长，因此适当补充流动资金符合公司业务发展的需要。本次补充流动资金可根据业务发展的实际需求，适时投入营运资金用于项目铺底流动资金、日常生产经营、研发投入等方面，有助于改善公司财务结构、降低财务风险，以满足公司日常运营资金需求，并提高公司整体的财务稳健性，保证经营活动的顺利进行，保证和提高公司核心竞争力。

本次募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书之“附件五 募集资金具体运用情况”。

（三）本次募集资金投资项目与发行人主要业务、核心技术之间的关系

合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目系公司现有主要产品产能的进一步提升，以匹配下游需求的增长，与主营业务、核心技术密切相关；补充流动资金项目将有利于优化公司的资金状况，有利于公司日常经营业务的开拓与发展，也将有利于公司持续的研发投入并提升公司的核心技术能力，从而促进主营业务的增长。

三、业务发展规划

（一）公司发展战略规划

截至目前，公司通过在显示领域的长期积累，沉淀了深厚的技术实力、丰富的行业经验和持续的创新能力。在此基础上，公司正将业务拓展至汽车电子、光通信模块、协作机器人、低空经济等新兴产业，致力于打造多元化的产业生态，为客户提供全方位、跨领域的解决方案，推动公司持续高质量发展。

展望未来，公司将深刻贯彻执行国家对于战略新兴产业的发展纲要和政策指导，继续以“成为我国智能控制领域最有价值的企业”为目标，积极、深刻把握 AI 技术革命引领的行业历史性机遇。公司将秉承“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，坚持以人才、研发为基础和核心驱动力，以品质服务为根本，质量至上为原则，确保市场份额、产能和技术领先优势，不断吸引更多下游优质客户，继续保持高质量发展。

在新型半导体显示领域，公司将持续为客户提供设计研发、元器件选型、产品试制和测试、批量生产、及时配送、跟踪服务等一体化综合解决方案；同时，公司将积极开拓核心技术、产品在汽车电子、光通信模块、低空经济等多个领域的应用；此外，公司将组建协作机器人新业务体系，扩大丰富自身业务战略布局。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

报告期内，公司不断进行市场开拓，除京东方外，公司已进入和辉光电、深天马、华星光电、惠科股份、维信诺等全球半导体显示面板领先企业的供应商体

系，实现了对半导体显示面板行业主要龙头企业的广泛覆盖。目前，公司现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

在新产品方面，公司已在 Mini/Micro LED 等新型显示领域进入样品开发阶段；与此同时，公司正重点布局汽车电子和光通信模块等领域，实现了对比亚迪、赛力斯等厂商的合格供应商认证和批量供货。2025 年下半年，公司与韩国上市公司纽禄美卡共同成立合资公司，以实现“AI 时代”的全新战略布局为目标，拟在现有业务基础上进一步拓展协作机器人领域。

（三）未来规划采取的措施

1、扩充现有产能匹配下游需求

在 AI 技术革命的引领下，电子信息产业必将迎来蓬勃发展，半导体显示面板及消费电子行业将继续面临良好的发展机遇。公司自成立以来长期深耕于半导体显示面板领域，与我国新型显示产业的发展相互促进，未来将基于长期建立的产供销体系、竞争优势以及核心技术体系，积极向汽车电子、光通信模块等应用领域进行开拓。但随着公司业务规模的稳步增长，仅依靠自身积累的发展模式已逐渐无法满足未来日益扩大的市场需求以把握 AI 技术革命所带来的历史性机遇。

为满足不断扩大的需求，同时开发下游新领域客户，提高供货服务能力，公司将着力推进在西南地区、华东地区、华北地区、华南地区、华中地区等电子产业聚集地的产能布局。本次募集资金将主要运用于合肥宇隆生产基地项目，以及重庆宇隆二期项目的投资建设，通过新建产能，突破公司现有瓶颈，进一步增强公司主营业务，提高主要产品的交付能力。募投项目实施后，公司业务规模将得到有效提升，场地、人员、设备等资源也将进一步实现优化配置，从而提高公司竞争力。

2、加大技术创新投入

公司将通过持续加大研发投入，着力于工艺技术、生产设备、人才梯队的不断优化，保持在技术、生产要素和人力资源等方面的竞争优势。一方面，公司将根据下游客户的需求以及行业发展的趋势，在持续研发新产品的同时，不断优化自身产品工艺以提高产品品质和生产效率；另一方面，公司将持续加大新业务领

域的研发投入，在 AI 人工智能、5G 通讯等新一代信息技术领域蓬勃发展的背景下，抓住市场机遇，挖掘和培养专业人才，持续布局和拓展汽车电子、光通信模块、协作机器人等新方向，持续推出创新产品、新技术，丰富产品矩阵，助推公司规模进一步增长。

3、培养和扩充专业化人才

公司将根据业务发展需求，重点培养和引进技术研发、生产、管理、营销等方面的专业人才，优化员工结构，满足企业长期稳定的发展需求。公司将采取内部培养与外部引进相结合的方式，积极探索与高校联合培养人才的相关制度，为企业发展定向培养人才；加大培训投入，完善培训制度及培训体系，提高员工的工作技能和素质，建立一支能够适应企业现代化管理和公司未来发展需求的高水平、高素质的员工队伍；鼓励员工参与各种职业技术培训和职业技能鉴定，激发员工的学习意识、创新意识和工作能力，发挥员工自身的潜能；进一步健全员工薪酬考核与激励制度，持续提高员工的薪酬待遇，激发员工的工作积极性和价值创造动力。

4、完善和优化现代化科学管理体系

随着各项业务的不断发展，公司各项管理工作都将按照上市公司的要求全面提升，公司将进一步完善法人治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化，按照上市公司的要求建立健全各项管理制度，形成科学、规范、合理、高效的企业运作模式，全面提升公司整体的管理水平。

5、充分合理利用资本市场增强公司融资能力

若本次公开发行股票上市顺利完成，发行人资本结构将有所优化，资本实力将进一步增强。公司将根据经营发展需要，采取多元化的融资方式，以满足不同时期发展规划的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。公司将根据业务发展状况和中长期战略发展规划，结合市场情况拟定后续融资计划，不断完善公司在行业内的资源布局和产能提升，提高公司在行业内的整体竞争能力，同时有效控制经营风险和财务风险，实现股东利益最大化。

第八节 公司治理与独立性

一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范公司运作，建立和完善了现代公司治理结构，搭建了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

公司依法设立并制定了股东会、董事会、监事会（已取消）、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定了相应的工作细则，明确各委员会的权责和议事规则。此外，公司还聘任了 3 名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，增强董事会决策的客观性、科学性。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

二、发行人内部控制情况

（一）公司董事会对内部控制的自我评估意见

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效地执行和实施。

综上所述，根据财政部《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及相关规定，公司内部控制于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

（二）注册会计师对内部控制的评价意见

根据天健会计师出具的《重庆宇隆光电科技股份有限公司内部控制审计报告》（天健审〔2026〕5555 号），天健会计师对公司内部控制设计的合理性和执行的有效性进行了审核，结论意见为：宇隆科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、报告期内重大违法违规行为情况

公司根据现行法律法规要求，按照法定程序审议修订了《公司章程》。自成立至今，公司及其现任董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为。

四、报告期内资金占用及对外担保情况

（一）资金占用情况

公司已建立完善的内部控制、法人治理制度及严格的资金管理制度。报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况

报告期内，除为合并报表范围内的子公司提供担保之外，公司不存在对外担保情况。

五、发行人独立运行情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立完整的资产、业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整情况

公司拥有自身独立完整的经营资产，产权明确，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产有效分离。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的固定资产、流动资产、无形资

产等资产的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。截至本招股说明书签署日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）人员独立情况

公司设置了独立的人力资源部门，制定了有关劳动、人事及工资制度，建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

公司的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书）均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设立有独立的财务会计部门，配置独立的财务人员，该等财务人员均在公司专职工作并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情况。公司依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的要求建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范、完整的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

公司自设立后即独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，未将资金存入控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的银行账户。

公司单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

（四）机构独立情况

公司建立健全了法人治理结构，股东会、董事会等均严格按照《公司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，

制定了完善的岗位职责和内部经营管理制度，各部门按照规定的职责独立运作，拥有独立的经营和办公场所，不存在股东单位、其他任何单位或个人干预公司机构设置的情况。公司独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司独立自主地开展业务，各项业务具有完整的业务流程和独立的经营场所。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（六）主营业务、控制权、管理团队稳定

公司主营业务、控制权和管理团队稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）不存在对持续经营有重大影响的或有事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

六、发行人同业竞争情况

（一）与控股股东、实际控制人及其控制企业的同业竞争情况

1、公司控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的企业

截至 2026 年 6 月 30 日，除发行人及子公司，发行人控股股东、实际控制人及其关系密切的亲属直接或间接控制的企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	莱特光电	王亚龙直接控制、李红燕担任董事的企业
2	莱特电子	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业
3	蒲城莱特	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业
4	北京莱特	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业

序号	关联方名称	关联关系
5	夸石投资	莱特光电持股 77.73%；王亚龙持股 15.55%并通过莱特光电间接控制的企业
6	莱特夸石	莱特光电持股 60.00%，夸石投资持股 23.00%；王亚龙持股 12.00%并间接控制的企业
7	上海特莱晶	王亚龙持股 53.00%且担任执行董事的企业
8	陕西特莱晶	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
9	西安特莱晶	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
10	渭南特莱晶	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
11	蒲城特莱晶	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
12	中鑫光电	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
13	江苏晶辉	上海特莱晶持股 51.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
14	江苏晶泉	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
15	中大石英	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业
16	晓荷智能	王亚龙、李红燕合计持股 100.00%且王亚龙担任执行董事的企业
17	晓荷生物	晓荷智能持股 100.00%；王亚龙通过晓荷智能间接控制的企业
18	鲲鹏半导体	晓荷智能持股 100.00%；王亚龙通过晓荷智能间接控制的企业
19	鄂尔多斯鲲鹏	鲲鹏半导体持股 90.00%且王亚龙担任执行董事的企业
20	鲲鹏半导体西安分公司	鲲鹏半导体的分支机构
21	蒲城鲲鹏	鲲鹏半导体持股 80.00%；王亚龙通过晓荷智能间接控制的企业
22	共青城高展	王亚龙持有 25.96%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业
23	共青城君成	王亚龙持有 30.25%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业[注]
24	共青城晓荷	王亚龙持有 16.27%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业
25	共青城麒麟	王亚龙持有 51.71%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业
26	共青城青荷	王亚龙持有 34.83%的财产份额并担任执行事务合伙人的企业
27	西安麒麟	王亚龙持股 85.00%且担任执行董事的企业
28	宇隆企业管理	王亚龙、李红燕合计持有 100.00%股权且王亚龙担任执行董事的企业
29	共青城瑞麟	王亚龙、李红燕合计持有 100.00%财产份额且王亚龙担任执行事务合伙人的企业
30	龙翔四海	王亚龙、李红燕合计持有 100.00%财产份额且王亚龙担任执行事务合伙人的企业
31	咸阳同辉显示器有限公司	王亚龙担任董事长的企业，2014 年 3 月被吊销，目前处于**强制注销状态**
32	盘石精密	李红燕直接及间接持股 92.00%且担任执行董事的企业
33	陕西磐久	李红燕直接及间接持股 92.00%且担任执行董事的企业
34	海南瑞麟伍号	李红燕持有 80.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业

序号	关联方名称	关联关系
35	海南磐久	李红燕持有 66.67%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
36	海南瑞麟肆号	李红燕持有 80.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
37	海南瑞麟叁号	李红燕持有 80.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
38	海南瑞麟贰号	李红燕持有 80.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
39	海南瑞麟壹号	李红燕持有 80.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
40	海南高展投资	李红燕持有 51.00%的财产份额且担任执行事务合伙人的企业
41	艾利特贸易	李红燕持股 95.00%的企业
42	美辰照明	艾利特贸易持股 60.00%；李红燕通过艾利特贸易间接控制的企业
43	达广商务	李红燕持股 50.00%的企业
44	SUNSHINE	李红燕持股 100.00%且担任总经理的企业
45	西安中翔导航技术有限公司	王书豪持股 70.00%且担任执行董事兼总经理的企业
46	呼伦贝尔伊和乌拉民宿旅游有限公司	李轩铖持股 60.00%且担任执行董事兼经理的企业
47	上海路捷电子科技有限公司	李轩铖持股 51.00%且担任执行董事的企业
48	重庆勤励	李洪宝实际控制的企业，已于 2022 年 9 月注销
49	莱特众成	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业，已于 2023 年 11 月注销
50	城固莱特	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业，已于 2023 年 12 月注销
51	朗晨光电	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业，已于 2023 年 12 月注销
52	苏州富利达电子科技有限公司	盘石精密持股 80.00%；李红燕通过盘石精密间接控制的企业，已于 2024 年 1 月注销
53	西安博纳泽电子科技有限公司	曾继芬持股 95%且担任董事长兼总经理的企业，已于 2024 年 4 月注销
54	合肥鲲鹏	鲲鹏半导体持股 100.00%且王亚龙担任执行董事的企业，已于 2024 年 6 月注销
55	西咸特晶源	陕西特晶源持股 70.00%；王亚龙通过陕西特晶源间接控制的企业，已于 2024 年 12 月注销
56	徐州晶辉	江苏晶辉持股 80.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业，已于 2025 年 4 月注销
57	西安特晶源	陕西特晶源持股 90.00%；王亚龙通过陕西特晶源间接控制的企业，已于 2025 年 5 月注销
58	莱特迈思	莱特光电持股 100.00%；王亚龙通过莱特光电间接控制的企业，已于 2025 年 7 月注销
59	陕西特晶源	王亚龙持股 51.00%且担任执行董事的企业，已于 2025 年 7 月注销
60	渭南优帮新材料有限公司	上海特莱晶持股 100.00%；王亚龙通过上海特莱晶间接控制的企业，已于 2025 年 9 月注销

注：2026 年 7 月，共青城君成 1 名员工离职，王亚龙受让该员工所持有的共青城君成份额。截至 2026 年 7 月末，王亚龙持有共青城君成的出资比例变更为 30.87%。

2、公司与控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业同业竞争情况

截至 2026 年 6 月 30 日，除发行人及子公司外，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属直接或间接控制的 60 家企业中，可分为以下四类：

（1）莱特光电在内的 23 家企业实际从事或拟从事生产经营活动，与发行人不构成同业竞争：

序号	企业名称	实际经营业务	与发行人不存在同业竞争关系的说明
1	莱特光电及其子公司[注1]共 6 家企业	主要从事有机发光材料的研发、生产和销售	莱特光电及其子公司的主要产品为 OLED 终端材料和 OLED 中间体，发行人在主营业务、生产的主要产品、生产工艺等方面均不存在相同或相似之处，相关业务与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突。
2	晓荷智能及其分/子公司[注2]共 6 家企业	电子化学品的研发、生产和销售	晓荷智能目前正处于工程项目建设过程中，尚未进行任何产品的生产或销售活动；其子公司已投产或拟投产的主要产品为应用于光伏行业或半导体行业的电子化学品，与发行人在主营业务、生产的主要产品、生产工艺等方面均不存在相同或相似之处，相关业务与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突。
3	上海特莱晶及其子公司[注3]共 9 家企业	主要从事高纯石英砂、石英坩埚等石英制品的研发、生产、销售	该等公司拟投产的主要产品为应用于光伏行业的高纯石英砂、石英坩埚，与发行人在主营业务、生产的主要产品、生产工艺等方面均不存在相同或相似之处，相关业务与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突。
4	呼伦贝尔伊和乌拉民宿旅游有限公司	主要从事旅游接待	与发行人分属不同的行业大类，与发行人在主营业务、生产的主要产品、生产工艺等方面均不存在相同或相似之处，相关业务与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突。
5	西安中翔导航技术有限公司	主要从事军工用连接器的销售	主要从事军工用连接器的销售，不涉及产品生产及相关的工业技术，其主营业务、主要产品及下游客户等方面与发行人均不存在相同或相似之处，相关业务与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突。

注 1：莱特光电子公司包括莱特电子、蒲城莱特、北京莱特、夸石投资、莱特夸石 5 家企业，其中夸石投资系莱特光电控制的用于投资莱特夸石的持股平台，莱特夸石主要从事石英纤维电子布的研发、生产与销售等相关工作。

注 2：晓荷智能分/子公司包括鲲鹏半导体、鲲鹏半导体西安分公司、鄂尔多斯鲲鹏、晓荷生物、蒲城鲲鹏 5 家企业。

注 3：上海特莱晶子公司为陕西特莱晶、西安特莱晶、渭南特莱晶、蒲城特莱晶、中鑫光电、江苏晶辉、江苏晶泉、中大石英 8 家企业。

（2）宇隆企业管理、西安麒麟、共青城麒麟、共青城青荷、共青城高展、共青城君成、共青城晓荷、龙翔四海、海南瑞麟壹号、海南瑞麟贰号、海南瑞麟

叁号、海南瑞麟肆号、海南瑞麟伍号、海南高展投资、海南磐久、共青城瑞麟在内的 16 家企业，系员工持股或投资持股平台。除发行人和莱特光电外，发行人控股股东、实际控制人及其关系密切的亲属不存在通过上述投资公司投资并控制其他企业的情形，上述投资公司与发行人不具有替代性、竞争性和利益冲突，不存在同业竞争关系。

（3）盘石精密、陕西磐久、美辰照明、SUNSHINE、达广商务、上海路捷电子科技有限公司、艾利特贸易在内的 7 家企业，无实质生产经营活动，与发行人不构成同业竞争。

（4）城固莱特、朗晨光电、莱特众成、莱特迈思、徐州晶辉、陕西特晶源、西安特晶源、西咸特晶源、合肥鲲鹏、苏州富利达电子科技有限公司、重庆勤励、西安博纳泽电子科技有限公司、咸阳同辉显示器有限公司、渭南优帮新材料有限公司在内的 14 家企业，已吊销或注销，与发行人不构成同业竞争。

综上，控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情形。

（二）避免同业竞争的承诺

公司控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕已出具关于避免同业竞争的承诺，具体内容如下：

1、截至本承诺函签署之日，除发行人外，本人及本人控制的其他企业没有以任何形式从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争关系且对发行人构成重大不利影响的业务或活动；

2、自本承诺函签署之日起，本人承诺不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争关系且对发行人构成重大不利影响的业务或活动；

3、若发行人在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人届时控制的其他企业对此已经开展生产、经营，且对发行人构成重大不利影响的，本人届时将对该等企业的控制权进行处置，发行人及其下属企业有权对该等企业的控制权进行优先收购，以避免产生对发行人构成重大不利影响的同业竞争；

4、若发行人在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人届时控制的其

他企业对此尚未开展生产、经营的，本人届时控制的其他企业将不从事对发行人构成重大不利影响的同业竞争业务或活动。

本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。上述承诺在本人作为发行人的控股股东、实际控制人期间持续有效。

七、关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，截至 2026 年 6 月 30 日公司的关联方和关联关系如下：

（一）直接或者间接控制发行人的自然人、法人或其他组织

公司的控股股东为王亚龙，直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织为王亚龙和李红燕。关于直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织具体情况见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人的基本情况”。

（二）控股股东、实际控制人直接或间接控制、施加重大影响的法人或其他组织

1、控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人或其他组织见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“（八）董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员的对外投资情况”之“1、王亚龙与李红燕的对外投资情况”之“（1）王亚龙与李红燕直接或间接控制的其他法人或其他组织”。

2、控股股东、实际控制人施加重大影响的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人施加重大影响的法人或其他组织为达广商务，达广商务为李红燕施加重大影响的企业，李红燕持股 50.00%。

（三）控股股东、实际控制人外其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人

截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人外其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的法人为宇隆企业管理，其直接持有发行人 8.39%的股权。

（四）控股股东、实际控制人外其他直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人直接或者间接控制、施加重大影响的法人或其他组织

截至本招股说明书签署日，宇隆企业管理除持有发行人 8.39%的股权之外，未持有其他法人和组织的股份。

（五）现任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员

公司现任董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”。

（六）发行人的现任董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员直接或间接控制的法人或其他组织及发行人的现任董事（独立董事除外）、取消监事会前在任监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，除在上述“控股股东、实际控制人直接或间接控制、施加重大影响的法人或其他组织”已披露的企业之外，公司其他现任董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员直接或间接控制的法人或其他组织及发行人的现任董事（独立董事除外）、取消监事会前在任监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	西安拓创光芯科技有限公司	独立董事张方晖控制的企业
2	西安时代拓创科技合伙企业（有限合伙）	独立董事张方晖担任执行事务合伙人的企业
3	扬州市欧莱特光电科技有限公司	独立董事张方晖控制的企业
4	陕西新航佳成电子科技有限公司	独立董事张方晖担任执行董事的企业

（七）控股子公司、参股公司

公司控股子公司、参股公司的基本情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人控股子公司、参股公司情况”。

（八）其他关联自然人

公司的其他关联自然人包括控股股东、实际控制人以及公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员（包括：配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。

公司的控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	王书豪	王亚龙之子
2	曾继芬	李红燕之母
3	王林斌	王亚龙之兄
4	侯爱侠	王亚龙之嫂
5	王采林	王亚龙之姐
6	王小玲	王亚龙之姐
7	李红军	李红燕之兄
8	师红丽	李红燕之嫂
9	李洪宝	李红燕之弟
10	李轩铖	李红燕之侄

（九）其他关联自然人直接或间接控制、施加重大影响的法人或其他组织

公司的控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员直接或间接控制、施加重大影响的法人或其他组织情况如下：

序号	关联方	关联关系
1	西安中翔导航技术有限公司	王书豪持股70%且担任执行董事兼总经理的企业
2	呼伦贝尔伊和乌拉民宿旅游有限公司	李轩铖持股60%且担任执行董事、经理的企业
3	上海路捷电子科技有限公司	李轩铖持股51%且担任执行董事的企业

（十）报告期内曾经存在的关联方

1、报告期内曾经存在的关联自然人

序号	关联方	关联关系
1	陈荣川	曾任宇隆科技的董事会秘书、财务总监，于2025年1月离任
2	田冠军	曾任宇隆科技的独立董事，于2025年4月离任
3	张逸飞	曾任宇隆科技的董事，于2025年8月离任

2、报告期内曾经存在的关联法人

序号	关联方	关联关系
1	咸阳同辉显示器有限公司	王亚龙曾担任董事的企业，2014年3月被吊销，目前**处于强制注销状态**
2	湖南天兆景园畜牧业有限公司	陈荣川曾担任董事的企业，已于2023年3月卸任
3	西安宇隆	发行人全资子公司，已于2023年3月注销
4	莱特众成	王亚龙曾通过莱特光电实际控制的企业，已于2023年11月注销
5	城固莱特	王亚龙曾通过莱特光电实际控制的企业，已于2023年12月注销
6	朗晨光电	王亚龙曾通过莱特光电实际控制的企业，已于2023年12月注销
7	苏州富利达电子科技有限公司	李红燕曾通过盘石精密间接控制的企业，已于2024年1月注销
8	西安博纳泽电子科技有限公司	曾继芬曾持股95%且担任董事长兼总经理的企业，已于2024年4月注销
9	合肥鲲鹏	王亚龙曾通过晓荷智能实际控制的企业，已于2024年6月注销
10	西咸特晶源	王亚龙曾通过陕西特晶源间接控制的企业，已于2024年12月注销
11	徐州晶辉	王亚龙曾通过上海特莱晶间接控制的企业，已于2025年4月注销
12	西安特晶源	王亚龙曾通过陕西特晶源间接控制的企业，已于2025年5月注销
13	莱特迈思	王亚龙曾通过莱特光电间接控制的企业，已于2025年7月注销
14	陕西特晶源	王亚龙曾持股51.00%且担任执行董事的企业，已于2025年7月注销
15	渭南优帮新材料有限公司	王亚龙曾通过上海特莱晶间接控制的企业，已于2025年9月注销

（十一）比照关联方披露的情况

2025 年 11 月，发行人、纽禄美卡及王亚龙共同出资设立合资公司隆美卡机器人。纽禄美卡作为发行人控股子公司隆美卡机器人的少数股东，不属于《上市

规则》及企业会计准则所界定的关联方，但鉴于发行人未来拟与纽禄美卡开展业务往来，基于谨慎性原则，将下述单位比照关联方予以披露：

序号	关联方	关联关系
1	纽禄美卡	发行人控股子公司隆美卡机器人的少数股东

八、关联交易情况

（一）关联交易简要汇总表

单位：万元

关联交易性质及频率	内容	金额		
		2025 年度	2024 年度	2023 年度
重大经常性关联交易	报告期内，公司不存在重大经常性关联交易			
重大偶发性关联交易	设立合资公司	详见本节“八、关联交易情况”之“（二）重大关联交易”之“3、重大偶发性关联交易”		
一般经常性关联交易	关键管理人员薪酬	700.13	613.10	600.15
一般偶发性关联交易	关联采购	详见本节“八、关联交易情况”之“（三）一般关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联采购”		
	关联担保	详见本节“八、关联交易情况”之“（三）一般关联交易”之“2、偶发性关联交易”之“（2）关联担保”		

（二）重大关联交易

1、重大关联交易判断标准及依据

公司综合考虑交易内容、交易对发行人经营情况、财务状况产生的影响，并结合《上市规则》及公司治理制度判断是否属于重大关联交易。公司重大关联交易的认定标准为：（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易（关键管理人员薪酬除外）；（2）与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易（公司提供担保除外）。

2、重大经常性关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性关联交易。

3、重大偶发性关联交易

2025 年 9 月，发行人、纽禄美卡及王亚龙共同签署了《股东合作协议》。根据该协议约定，前述三方共同在中国境内设立合资公司，设立时的注册资本为 4,285.7143 万元，其中，发行人与王亚龙分别占比 51%和 19%，均以现金方式认

缴出资；纽禄美卡占比 30%，以现金及无形资产认缴出资。

2025 年 9 月，公司召开第二届第八次董事会及 2025 年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，同意设立合资公司隆美卡机器人。

2025 年 11 月，合资公司隆美卡机器人完成设立。

（三）一般关联交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司向董事、取消监事会前在任监事及高级管理人员等关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
关键管理人员薪酬	700.13	613.10	600.15

报告期内，公司与关联方之间不存在经常性购买商品和接受劳务、销售商品和提供劳务、关联租赁等其他一般经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联采购

如前文所述，2025 年 11 月，发行人、纽禄美卡及王亚龙共同出资设立合资公司隆美卡机器人。2025 年 12 月，隆美卡机器人与纽禄美卡签订采购合同，约定隆美卡机器人向纽禄美卡采购协作机器人、焊接机器人等产品共计 19 套，合同价款折合人民币合计为 360.46 万元。

纽禄美卡作为发行人控股子公司隆美卡机器人的少数股东，不属于《上市规则》及企业会计准则所界定的关联方，故相关交易亦不属于关联交易，但鉴于本次与纽禄美卡合资设立公司及后续向其采购机器人产品属于整体筹划、同步推进的一揽子交易，基于谨慎性原则，将其比照关联交易予以披露。

截至报告期末，隆美卡机器人已按照合同约定向纽禄美卡支付前述产品的预付款项，但纽禄美卡尚未完成产品交付。截至 2026 年 2 月末，纽禄美卡完成产品交付，相关交易执行完毕。

1）关联采购的合理性和必要性

纽禄美卡（348340.KS）系韩国上市公司，专注研究并生产中小制造企业工程自动化所需的核心技术协作机器人，系韩国中小企业部认证的准独角兽企业。发行人及实际控制人王亚龙与纽禄美卡基于对机器人行业未来发展前景的一致看好，经友好协商，共同出资设立隆美卡机器人，并拟以该合资公司为业务载体布局机器人相关业务。

本次交易隆美卡机器人向纽禄美卡采购产品主要为协作机器人，主要用于展厅场景搭建、产品展示演示及对外宣传使用。公司计划以该等展示样机为基础，深入挖掘相关机器人产品等自动化设备的市场需求，逐步搭建协作机器人等业务板块，进一步丰富公司的业务结构与产品体系，实现业务多元化发展的前瞻战略布局，故相关采购具备商业合理性与业务必要性。

2）关联采购的公允性

本次交易涉及的协作机器人等产品定制化程度较高，无第三方公开市场价格，其交易价格系基于纽禄美卡向无关联第三方的产品销售价格，并综合考虑技术参数、功能配置、交付条件等因素，经双方平等协商后确定。具体如下：

卖方	买方	产品类型	合同金额（万元）	数量（套）	单价（万元/套）
纽禄美卡	隆美卡机器人	焊接机器人、协作机器人	360.46	19	18.97
	无关联第三方	焊接机器人、试验机器人	-	-	10.47-86.69

注：合同金额及单价均按照 2025 年末汇率折算为人民币

此外，根据纽禄美卡公开披露的《招股说明书》，其在 2019 年-2022 年上半年开展的机器人产品销售业务单价范围为 13.29-16.48 万元/套（按照其报告期各期期末汇率折算），与公司向其采购的机器人平均价格亦不存在显著差异。

如上表所述，本次交易价格与纽禄美卡向无关联第三方销售产品价格以及其公开披露的机器人产品销售业务单价不存在重大差异，故本次交易定价具备公允性。

（2）关联担保

报告期内，公司发生或曾存在的关联担保及其截至 2025 年 12 月 31 日的履

行情况具体如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	授信/借款期间	是否履行完毕
1	王亚龙、李红燕	宇隆科技	招商银行股份有限公司重庆分行	500.00	保证担保	2021.01.07-2023.12.22	是
2	王亚龙、李红燕	宇隆科技	中信银行股份有限公司重庆分行	19,800.00	保证担保	2022.09.30-2028.09.29	是[注1]
3	王亚龙、李红燕	宇隆科技	招商银行股份有限公司重庆分行	1,500.00	保证担保	2022.10.13-2025.10.12	是
4	王亚龙、李红燕	重庆升越达	招商银行股份有限公司重庆分行	1,500.00	保证担保	2022.04.27-2025.04.26	是
5	王亚龙、李红燕	宇隆科技	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	3,000.00	保证担保	2023.08.08-2026.08.07	否[注2]
6	王亚龙、李红燕	宇隆科技	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	保证担保	2023.05.26-2026.04.24	否[注2]
7	王亚龙、李红燕	宇隆科技	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	保证担保[注3]	2024.02.07-2026.01.10	否[注2]
8	王亚龙、李红燕	合肥宇隆	中国银行股份有限公司瑶海支行	1,000.00	保证担保	2024.04.01-2025.04.01	是
9	王亚龙、李红燕	安徽灿宇	中国银行股份有限公司瑶海支行	1,000.00	保证担保	2024.04.01-2025.04.01	是
10	王亚龙、李红燕	重庆升越达	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	1,990.00	保证担保	2024.04.09-2025.04.08	是
11	王亚龙、李红燕	宇隆科技	中国民生银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	保证担保	2024.07.11-2025.07.10	否[注4]
12	王亚龙、李红燕	安徽灿宇	中国银行股份有限公司瑶海支行	1,000.00	保证担保	2025.07.28-2026.07.28	否[注2]

注 1：截至本招股说明书签署日，该项授信期限尚未届满；但授信协议下的贷款余额已结清，对应该授信协议项下的全部抵押物均已解除抵押登记。

注 2：截至本招股说明书签署日，该项授信期限已届满。

注 3：该授信为综合授信，包含担保方对借款人在该授信项下发生的票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴等承担的担保责任。根据《审计报告》的记载，截至 2025 年 12 月 31 日，王亚龙、李红燕对“银行承兑汇票”尚未履行完毕的担保金额为 12,281,690.99 元。

注 4：截至本招股说明书签署日，该授信协议已到期且未续期。截至报告期期末，该授信项下尚有一笔未清偿贷款，对应贷款合同期限为 2024 年 7 月 22 日至 2027 年 7 月 22 日，相关未清偿借款余额仍受原授信协议约定约束。

（四）关联方往来余额

1、应收关联方款项

报告期各期末，公司与关联方之间的应收往来余额如下：

单位：万元

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
其他应收款：			
周文征	-	-	1.00
郑翔龙	-	-	0.03

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
合计	**-**	**-**	**1.03**
预付款项：			
江苏纽禄美卡	29.02	-	-
合计	**29.02**	**-**	**-**
其他非流动资产：			
纽禄美卡	125.34	-	-
江苏纽禄美卡	25.50	-	-
合计	**150.84**	**-**	**-**

2023 年末，应收关联方款项中其他应收款，主要系员工备用金。截至报告期末，该等其他应收款均已结清。

2025 年末，应收关联方款项中预付款项及其他非流动资产，主要系隆美卡机器人因拟开展机器人相关业务所需，向纽禄美卡及江苏纽禄美卡采购协作机器人等产品而预付相关款项。

2、应付关联方款项

报告期各期末，公司与关联方之间的应付往来余额如下：

单位：万元

关联方名称	2025.12.31	2024.12.31	2023.12.31
其他应付款：			
殷鸿彬	-	-	28.62
徐建伟	-	-	-
张逸飞	-	1.55	0.48
张珺	0.40	2.20	2.70
合计	**0.40**	**3.75**	**31.81**

报告期各期末，公司与关联方的应付往来余额金额均显著较小。

（五）关联方变化情况

报告期内，公司的关联方变化情况参见本节之“七、关联方及关联关系”之“（十）报告期内曾经存在的关联方”。

（六）规范关联交易的制度安排

公司现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等对于关联交易的主要

规定如下：

1、关联交易的决策程序

公司与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元或者与关联法人发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项，由公司董事会审批。

公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过 3,000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事项，由公司股东会审批。

公司下列对外担保行为，须经董事会审议批准后，提交股东会决定：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币；（6）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。（7）法律法规、部门规章及规范性文件等规定应当由股东会审议通过的其他担保。

2、关联交易的审议和回避程序

董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，董事会会议所做决议须经无关联关系董事过半数通过；审议对关联方提供担保或财务资助行为时，还需经出席会议的三分之二以上无关联关系董事同意。

股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

（七）报告期内关联交易的审议程序及独立董事意见

公司召开董事会和股东会，审议通过了《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度 1-6 月关联交易的议案》，关联股东或者董事在审议上述议案时已回避表决。公司独立董事已就公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月

30 日内的关联交易情况发表了独立意见，确认公司上述期间发生的关联交易事项真实、完整，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在严重影响公司独立性的情形。

2025 年 9 月，公司召开第二届第八次董事会及 2025 年第四次临时股东会，审议并通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，同意设立合资公司隆美卡机器人，关联股东或者董事在审议上述议案时已回避表决。公司独立董事已就发行人与王亚龙、纽禄美卡投资设立隆美卡机器人事项发表独立意见，确认上述投资系基于对拟投资主体技术情况、市场前景等进行综合判断，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

报告期内，公司关联交易的审议程序符合现行有效的《公司章程》《关联交易管理制度》等制度安排。

（八）公司减少和规范关联交易的措施

公司根据《公司法》等法律法规的规定，建立了完善的公司治理结构，在《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的决策权力、决策程序、回避表决制度及信息披露义务作出了明确的规定，以保证公司关联交易的公允性，并确保关联交易不损害公司及其他中小股东的利益。

公司控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕，实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号以及公司董事、高级管理人员承诺规范和减少关联交易，详见“附件二 与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”之“十、关于减少和规范关联交易的承诺”。

第九节 投资者保护

一、本次发行前滚存利润分配方案

根据公司 2025 年 6 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议，本次发行完成之后，新老股东按各自所持股份比例分享截至本次发行前公司滚存的未分配利润。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、本次发行后的股利分配政策

（一）公司章程中对公司股利分配政策的约定

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定<重庆宇隆光电科技股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，对公司发行上市后的利润分配政策进行了明确规定，公司有关股利分配的主要规定如下：

1、公司利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司进行现金分红的具体条件：

（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（2）公司累计可供分配利润为正值；

（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；

（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%以上，但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东会

审议通过的，公司可以进行现金分红。

公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础，在计算分红比例时应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

3、现金分红的期间间隔：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东会召开后进行 1 次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即任意 3 个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该 3 年实现的年均可分配利润的 30%。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年现金分红。

在公司满足现金分红条件的情况下，公司将尽量提高现金分红的比例。

4、公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

5、公司发放股票股利的具体条件：

（1）公司经营情况良好；

（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

（4）法律、法规、规范性文件规定的其他条件。

6、公司利润分配方案的审议程序及对股东利益的保护措施：

（1）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露；

（2）董事会审议现金分红具体方案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应经董事会全体

董事过半数以上表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（3）审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数的审计委员会成员通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，审计委员会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

（4）股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过；

（5）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决；

（6）公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东会通过现场及网络投票的方式审议批准；

（7）公司将严格按照有关规定在年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

①是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

②分红标准和比例是否明确和清晰；

③相关的决策程序和机制是否完备；

④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得

到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

7、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80.00%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40.00%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20.00%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（二）董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

为明确公司本次发行上市后对股东的分红回报，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司董事会着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于股利分配政策的规定，制定了《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》。

（三）公司上市后未来三年的现金分红等股东回报规划

1、上市后未来三年的现金分红等股东回报规划制定的依据和可行性

报告期内，发行人营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78

万元和 13,329.07 万元。目前，公司具备稳健、可持续的经营能力，亦具备进行持续、稳定的利润分配的基础。

与此同时，考虑到半导体显示面板行业的良好发展前景也吸引了部分其他制造企业开始涉足公司所处行业，将可能导致未来的行业竞争日益激烈。面对市场竞争不断加剧的局面，行业将可能呈现规模、技术、资金实力等方面的全方位竞争态势。因此，公司仍需要进行持续的产能建设、技术水平提升和人才的培养以更好的迎接和应对行业日益激烈的行业竞争，进而保持自身经营规模、持续盈利能力的稳定、健康发展。

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

整体来看，公司上市后未来三年的现金分红等股东回报规划依据合理，具备较强的可行性。

2、上市后未来三年的现金分红等股东回报规划的具体内容以及未分配利润的使用安排

公司 2025 年第二次临时股东大会会议审议通过了《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内分红回报规划》（以下简称“本规划”），约定了公司上市后未来三年的股东分红回报规划如下：

（1）利润分配规划的制定原则及考虑因素

公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：

1）按法定顺序分配的原则；

2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；

3）同股同权、同股同利的原则；

4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

5）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（2）利润分配政策

利润分配政策参见本节之“二、本次发行后的股利分配政策”之“（一）公司章程中对公司股利分配政策的约定”。

（3）公司利润分配政策的变更

1）公司结合上市后三年的营运状况，制定《未来三年股东回报规划》；公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、审计委员会及股东（特别是公众投资者）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该阶段的股东回报规划。

2）公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东会表决通过后实施。

三、本次发行前后股利分配政策差异情况

本次发行前，公司主要根据《公司法》关于利润分配顺序等方面的规定制定了公司的基本股利分配政策，股利分配政策重点规定了利润的分配顺序及股利分配的前提条件。

本次发行后，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规规定，从利润分配的形式、时间间隔、股利分配的具体条件、利润分配方案的审议程序等方面进行了详细规定，兼顾投资者回报及公司业务发展，股利分配政策更为完善合理。

本次发行前后，股利分配政策不存在重大差异情况。

四、存在特别表决权股份等特殊架构安排、未盈利企业或存在累计未弥补亏损的投资者保护措施

公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排。公司不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况。

第十节 其他重要事项

一、重大合同

（一）采购合同

报告期内，发行人及其子公司与主要供应商签署框架性采购合同，具体采购原材料数量和金额以订单形式确定。结合公司业务特点，重要采购合同选取标准为截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司与报告期各期前五大供应商签署的已履行和正在履行的框架协议如下：

序号	供应商名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间	有效期至	是否履行完毕
1	DAESANG S.T CO.,LTD	安徽灿宇	框架协议	2023-01-01	2025-12-30	是
2	珠海方正印刷电路板发展有限公司	发行人	框架协议	2022-01-01	2023-01-01	是
3			框架协议	2023-12-08	2024-12-31	是
4	北京狄之娇贸易有限公司	安徽灿宇	框架协议	2023-01-01	2025-12-30	是
5	爱思开迈克沃高科技材料（苏州）有限公司	重庆升越达	框架协议	2023-10-11	2025-10-10	是
6	深圳市思尼克技术有限公司	发行人	框架协议	2024-06-12	2027-06-12	否
7	江苏博敏电子有限公司	发行人	框架协议	2024-06-01	2027-05-31	否

（二）销售合同

报告期内，发行人及其子公司与主要客户签署框架性销售合同，具体销售产品数量和金额以订单形式确定。结合公司业务特点，重要销售合同选取标准为截至 2025 年 12 月 31 日，公司及其子公司与报告期各期前五大客户签署的已履行和正在履行的框架协议如下：

序号	客户名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间/履行期起算日	有效期	是否履行完毕
1	北京京东方显示技术有限公司	安徽灿宇	框架协议	2013-03-12	长期有效	否
		河北宇隆	框架协议	2018-03-21	长期有效	是
		青岛宇隆	框架协议	2023-04-14	长期有效	否
2	合肥京东方光电科技有限公司	安徽灿宇	框架协议	2013-05-20	长期有效	否
3	合肥鑫晟光电科技有限公司	安徽灿宇	框架协议	2013-11-20	长期有效	否
			框架协议	2024-06-21	长期有效	否
		合肥宇隆	框架协议	2018-07-01	长期有效	否

序号	客户名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间/履行期起算日	有效期	是否履行完毕
4	重庆京东方光电科技有限公司	发行人	框架协议	2015-01-01	长期有效	否
			框架协议	2023-10-01	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2016-12-05	长期有效	否
			框架协议	2025-01-22	长期有效	否
		安徽灿宇	框架协议	2025-09-05	长期有效	否
5	鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司	安徽灿宇	框架协议	2016-08-20	长期有效	否
6	福州京东方光电科技有限公司	福州宇隆	框架协议	2017-01-01	长期有效	否
		安徽灿宇	框架协议	2017-04-25	长期有效	否
7	重庆京东方显示照明有限公司、重庆京东方智慧电子系统有限公司、京东方光科技有限公司	重庆升越达	框架协议	2017-03-23	长期有效	否
8	合肥京东方视讯科技有限公司	安徽灿宇	框架协议	2017-11-16	长期有效	否
		合肥宇隆	框架协议	2018-07-11	长期有效	否
9	重庆京东方智慧电子系统有限公司	发行人	框架协议	2018-02-27	长期有效	是
			框架协议	2021-09-18	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2020-01-01	长期有效	否
10	北京京东方光电科技有限公司	河北宇隆	框架协议	2019-04-29	长期有效	是
		安徽灿宇	框架协议	2024-01-02	长期有效	否
		青岛宇隆	框架协议	2025-01-23	长期有效	否
11	云南创视界光电科技有限公司	发行人	框架协议	2019-05-08	长期有效	否
			框架协议	2023-07-18	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2020-05-21	长期有效	否
12	重庆京东方电子科技有限公司	发行人	框架协议	2019-06-24	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2019-08-02	长期有效	否
13	绵阳京东方光电科技有限公司	发行人	框架协议	2019-08-20	长期有效	是
			框架协议	2023-04-03	长期有效	否
			框架协议	2023-09-28	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2020-11-03	长期有效	是
14	武汉京东方光电科技有限公司	武汉宇隆	框架协议	2019-12-16	长期有效	否
15	成都京东方光电科技有限公司	发行人	框架协议	2020-01-03	长期有效	是
			框架协议	2023-04-04	长期有效	否
			框架协议	2023-10-07	长期有效	否

序号	客户名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间/履行期起算日	有效期	是否履行完毕
		重庆升越达	框架协议	2020-11-03	长期有效	否
			框架协议	2025-10-13	长期有效	否
		成都宇隆	框架协议	2024-07-11	长期有效	否
16	合肥京东方显示光源有限公司	重庆升越达	框架协议	2020-03-20	长期有效	否
		安徽灿宇	框架协议	2024-01-02	长期有效	否
	合肥京东方显示光源有限公司福州分公司	安徽灿宇	框架协议	2022-06-21	长期有效	否
17	重庆京东方显示技术有限公司	发行人	框架协议	2021-03-11	长期有效	是
			框架协议	2023-04-06	长期有效	否
			框架协议	2023-09-28	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2021-04-09	长期有效	否
18	合肥京东方瑞晟科技有限公司	安徽灿宇	框架协议	2021-03-30	长期有效	否
19	南京京东方显示技术有限公司	安徽灿宇	框架协议	2021-11-17	长期有效	否
20	成都京东方显示科技有限公司	发行人	框架协议	2022-04-14	长期有效	否
		成都宇隆	框架协议	2024-05-16	长期有效	否
21	成都京东方车载显示技术有限公司	发行人	框架协议	2022-04-27	长期有效	否
		成都宇隆	框架协议	2024-01-09	长期有效	否
22	京东方晶芯科技有限公司	河北宇隆	框架协议	2022-06-08	长期有效	是
23	北京京东方茶谷电子有限公司青岛分公司	重庆升越达	框架协议	2022-12-31	长期有效	否
24	青岛京东方光电科技有限公司	青岛宇隆	框架协议	2023-03-23	长期有效	否
		安徽灿宇	框架协议	2024-01-08	长期有效	否
25	高创（苏州）电子有限公司	安徽灿宇	框架协议	2023-07-19	长期有效	否
26	绵阳京东方电子科技有限公司	重庆升越达	框架协议	2024-01-31	长期有效	否
27	北京京东方创元科技有限公司	发行人	框架协议	2024-10-24	长期有效	否
		安徽灿宇	框架协议	2024-12-27	长期有效	否
			框架协议	2025-08-25	长期有效	否
			框架协议	2025-09-08	长期有效	否
28	成都京东方显示技术有限公司	发行人	框架协议	2025-03-17	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2025-04-18	长期有效	否
29	京东方科技集团股份有限公司	安徽灿宇	框架协议	2025-09-19	长期有效	否
		重庆升越达	框架协议	2025-09-29	长期有效	否
30	上海和辉光电股份	发行人	框架协议	2020-10-28	长期有效	是

序号	客户名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间/履行期起算日	有效期	是否履行完毕
	有限公司		框架协议	2023-06-01	长期有效	否
31	重庆博硕光电有限公司	重庆升越达	框架协议	2020-09-20	2年，到期无异议自动顺延1年	否
			框架协议	2023-09-13	5年，到期无异议自动顺延1年	否
32	博晶科技（滁州）有限公司	重庆升越达	框架协议	2024-08-01	5年，到期无异议自动顺延1年	否
33	峻凌电子（苏州）有限公司	安徽灿宇	框架协议	2021-05-25	2年，到期无异议自动顺延	是
			框架协议	2025-04-21	长期有效	否
34	武汉华星光电技术有限公司	武汉宇隆	框架协议	2021-09-15	2024-09-14	是
			框架协议	2025-07-01	2030-07-30	否
	武汉华星光电技术有限公司、武汉华星半导体显示技术有限公司		框架协议	2022-04-11	2025-04-10	是
	TCL华星光电技术有限公司、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、广州华星光电半导体显示技术有限公司、惠州华星光电显示有限公司、武汉华星光电技术有限公司、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、苏州华星光电技术有限公司、苏州华星光电显示有限公司		框架协议	2025-11-05	2030-11-04	否
35	华显光电技术（惠州）有限公司	武汉宇隆	框架协议	2023-09-18	长期有效	否
			框架协议	2023-10-31	长期有效	否
36	广州国显科技有限公司	合肥宇隆	框架协议	2021-12-15	2024-12-14	是
			框架协议	2022-11-25	2025-11-25	是
			框架协议	2024-12-15	2027-12-14	否
			框架协议	2025-12-26	2028-12-25	否
37	惠金（深圳）科技有限公司	北海宇隆	框架协议	2022-08-29	2年，直至被新合同替代	是
			框架协议	2025-04-01	2年，直至被新合同替代	否
		重庆升越达	框架协议	2022-02-14	2024-02-13	是
		发行人	框架协议	2023-04-01	2年，直至被新合同替代	是
			框架协议	2025-04-01	2年，直至被新合同替代	否
38	惠金（深圳）科技有限公司、绵阳惠科光电科技有限公司	重庆升越达	框架协议	2024-02-14	2年，到期无异议自动顺延	否
39	重庆惠科金渝光电科技有限公司	发行人	框架协议	2025-08-01	2027-07-30	否

序号	客户名称	发行人主体名称	合同金额	签约时间/履行期起算日	有效期	是否履行完毕
40	天马微电子（香港）有限公司、Tianma Japan, Ltd.、天马微电子股份有限公司	发行人	框架协议	2023-01-01	未约定有效期	否

（三）重大授信合同、借款合同

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司报告期内签署的金额 500 万元及以上的银行借款合同情况如下：

序号	授信申请人/借款人	授信人/贷款人	授信/借款金额（万元）	授信/借款期限	担保方式	是否履行完毕
1	发行人	中信银行股份有限公司重庆分行	19,800.00	2022.09.30-2028.9.29	（1）王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保；（2）宇隆科技以其拥有的权属证书为“渝（2021）两江新区不动产权第000745836号”、“渝（2021）两江新区不动产权第000745706号”、“渝（2021）两江新区不动产权第000746346号”、“渝（2021）两江新区不动产权第000745978号”、“渝（2021）两江新区不动产权第000745905号”及“渝（2021）两江新区不动产权第000643385号”[注1]的不动产提供抵押担保；（3）宇隆科技以其拥有的 4,162.84 万元设备提供抵押担保；（4）重庆升越达以其拥有的 1,107.94 万元设备提供抵押担保；（5）宇隆科技以其拥有的权属证书为“渝（2023）两江新区不动产权第000019686号”及“渝（2023）两江新区不动产权第000019639号”的不动产提供抵押担保；（6）宇隆科技以其拥有的 175.55 万元设备提供抵押担保。	是[注2]
2	发行人	招商银行股份有限公司重庆分行	500.00	2021.01.07-2023.12.22	（1）王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保；（2）宇隆科技以其拥有的权属证书为“渝（2018）两江新区不动产权第000939171号”、“渝（2018）两江新区不动产权第000933308号”、“渝（2018）两江新区不动产权第000933337号”、“渝（2018）两江新区不动产权第000933385号”（同[注1]）的不动产提供抵押担保。	是
3	重庆升越达	招商银行股份有限公司	900.00	2020.12.23-2023.12.22	（1）宇隆科技、王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保；（2）	是

序号	授信申请人/借款人	授信人/贷款人	授信/借款金额（万元）	授信/借款期限	担保方式	是否履行完毕
		重庆分行			宇隆科技以其拥有的权属证书为“渝（2018）两江新区不动产权第 000939171 号”、“渝（2018）两江新区不动产权第 000933308 号”、“渝（2018）两江新区不动产权第 000933337 号”、“渝（2018）两江新区不动产权第 000933385 号”的不动产提供抵押担保。（同[注1]）	
4	发行人	招商银行股份有限公司重庆分行	1,500.00	2022.10.13-2025.10.12	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	是
5	重庆升越达	招商银行股份有限公司重庆分行	1,500.00	2022.04.27-2025.04.26	宇隆科技、王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	是
6	发行人	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	5,000.00	2023.05.26-2026.04.24	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	否[注3]
7	发行人	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	3,000.00	2023.08.08-2026.08.07	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	否[注3]
8	合肥宇隆	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	40,000.00	2023.02.14-2031.02.08	（1）合肥宇隆以其拥有的权属证书为“皖（2025）合肥市不动产权第 1065383 号”、“皖（2025）合肥市不动产权第 1065385 号”、“皖（2025）合肥市不动产权第 1065384 号”、“皖（2025）合肥市不动产权第 1065382 号”、“皖（2025）合肥市不动产权第 1065387 号”、“皖（2025）合肥市不动产权第 1065381 号”及“皖（2025）合肥市不动产权第 1065386 号”的不动产提供抵押担保；（2）宇隆科技提供连带责任保证担保	否
9	发行人	中信银行股份有限公司重庆分行	10,000.00	2024.02.07-2026.01.10	（1）宇隆光电以其持有的票据、保证金账户以及账户内资金、存单、结构性存款提供资产池业务最高额质押担保；（2）王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	否[注3]
10	重庆升越达	重庆农村商业银行股份有限公司两江分行	1,990.00	2024.04.09-2025.04.08	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	是
11	合肥宇隆	中国银行股份有限公司瑶海支行	1,000.00	2024.03.31-2025.03.30	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	是
12	安徽灿宇	中国银行股份有限公司瑶海支行	1,000.00	2024.03.31-2025.03.30	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	是

序号	授信申请人/借款人	授信人/贷款人	授信/借款金额（万元）	授信/借款期限	担保方式	是否履行完毕
13	发行人	中国民生银行股份有限公司重庆分行	20,000.00	2024.07.11-2025.07.10	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	否注4
14	安徽灿宇	中国银行股份有限公司合肥瑶海支行	1,000.00	2025.07.28-2026.07.28	王亚龙、李红燕提供连带责任保证担保	否注3
15	重庆升越达	中信银行股份有限公司重庆分行	3,000.00	2025.08.06-2026.12.30	由宇隆科技为其全资子公司重庆升越达提供担保	否

注：1、上述产权证书经换证后的不动产权证号分别为“渝（2025）两江新区不动产权第 000368616 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368508 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368610 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368558 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368477 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368406 号”、“渝（2025）两江新区不动产权第 000368568 号”；2、虽然授信协议期限尚未届满，但该授信项下贷款合同均已履行完毕；**3、截至本招股说明书签署日，该合同期限已届满；**4、截至本招股说明书签署日，该授信协议已到期且未续期。截至报告期期末，该授信项下尚有一笔未清偿贷款，对应贷款合同期限为 2024 年 7 月 22 日至 2027 年 7 月 22 日，相关未清偿借款余额仍受原授信协议约定约束。

（四）重大工程合同

截至 2025 年 12 月 31 日，发行人及其子公司报告期内签署的金额 500 万元及以上的建设工程施工合同情况如下：

序号	发包人	承包人	工程内容	合同金额（万元）	合同签署时间	是否履行完毕
1	发行人	重庆新鸿鼎实业有限公司	重庆宇隆二期项目 2#、10#、11#楼铝合金门窗及百叶工程	513.00	2023 年 2 月	是
2	发行人	重庆新鸿鼎实业有限公司	重庆宇隆科技生产基地 11#宿舍楼装饰装修工程	520.00	2023 年 3 月	是
3	合肥宇隆	合肥金安消防工程设备有限公司	合肥宇隆生产基地项目消防工程	1,218.00	2023 年 4 月	是
4	合肥宇隆	安徽宿州建工集团有限公司	合肥宇隆生产基地项目室外工程	1,603.00	2023 年 9 月	是
5	合肥宇隆	安徽兴新电力发展有限公司	合肥宇隆生产基地项目电力工程施工	1,015.21	2023 年 11 月	是
6	合肥宇隆	安徽宿州建工集团有限公司	合肥宇隆生产基地项目室外工程（铺装&绿化）施工	511.00	2024 年 1 月	是
7	合肥宇隆	南京冠福建设工程技术有限公司	高效机房及暖通空调工程施工	1,831.00	2025 年 10 月	否
8	合肥宇隆	深圳市新鹏都装饰工程有限公司	厂房办公装饰施工	506.50	2025 年 10 月	否
9	合肥宇隆	上海荣江建筑工程有限公司	合肥宇隆 2#厂房洁净装饰和 3#厂房动力房改造装饰	2,270.00	2025 年 10 月	否

截至 2025 年 12 月 31 日，上述重大采购合同、重大销售合同、重大借款与担保合同、重大工程合同中已履行完毕的合同不存在纠纷或潜在纠纷；未履行完

毕的上述重大合同均合法有效且不存在影响合同继续履行的重大争议或纠纷；公司上述重大合同的履行不存在重大负面影响或重大风险。

二、对外担保情况

报告期内，除为合并报表范围内的子公司提供担保之外，公司不存在对外担保的情况。

三、重大诉讼与仲裁事项

（一）公司重大诉讼事项

截至本招股说明书签署日，发行人及子公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。

（二）公司控股股东、实际控制人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司控股股东及实际控制人没有涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（三）公司控股股东、实际控制人的重大违法情况

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在重大违法行为。

（四）公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员均没有涉及作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

（五）公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况

公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和核心技术人员最近 3 年不涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

（六）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员涉及刑事诉讼的情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员均没有涉及作为一方当事人的重大刑事诉讼。

第十一节 声明

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签字：

王亚龙　　李红燕　　殷鸿彬

徐建伟　　王剑涛　　郑翔龙

崔斌　　程茂勇　　张方晖

重庆宇隆光电科技股份有限公司

2026 年 8 月 6 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签字：

殷鸿彬　　徐建伟　　王剑涛

张珺　　万超　　郭飞

彭云强

重庆宇隆光电科技股份有限公司

2026年8月6日

发行人全体审计委员会委员声明

本公司及全体审计委员会委员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会委员签字：

程茂勇　　王亚龙　　崔斌

重庆宇隆光电科技股份有限公司

2016 年 8 月 6 日

发行人控股股东、实际控制人声明

本人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东、实际控制人签字：

王亚龙　　李红燕

重庆宇隆光电科技股份有限公司

2016年8月16日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

王珺珑　　戴　顺

项目协办人：

王州杰

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2016 年 8 月 6 日

保荐人董事长声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 6 日

保荐人总经理声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：

邹迎光

中信证券股份有限公司

2026 年 3 月 6 日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京市中伦律师事务所

负 责 人：

张学兵

经办律师：

张 明

许晶迎

2016 年 8 月 6 日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审〔2026〕5466 号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕5555 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆宇隆光电科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

翁志刚

钱晓颖

天健会计师事务所负责人：

李德勇

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年 八月 三 日

资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：

已离职	已离职
张健	杨歌

资产评估机构负责人：

左英浩

上海众华资产评估有限公司

2026 年 2 月 28 日

关于签字资产评估师张健和杨歌离职的说明

2020 年 12 月 27 日，本公司出具的《重庆宇隆光电科技有限公司拟股份制改制涉及的该公司资产和负债价值评估报告》（沪众评报字[2020]第 0454 号）的签字资产评估师为张健、杨歌，其中，签字资产评估师张健和杨歌已从本公司离职，因此无法在本公司出具的资产评估机构声明页中签字，但签字资产评估师的离职不影响本公司已出具的上述资产评估报告的法律效力。

特此说明。

资产评估机构负责人：

左英浩

上海众华资产评估有限公司

2026 年 8 月 5 日

PAN-CHINA 天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

验资复核机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《实收资本复核报告》（天健验〔2025〕383 号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对重庆宇隆光电科技股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：翁志刚 钱晓颖

翁志刚

钱晓颖

天健会计师事务所负责人：李德勇

李德勇

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年八月二日

第十二节 附件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

（一）发行保荐书；

（二）上市保荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报告及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）内部控制鉴证报告；

（七）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间、地点

（一）查阅时间

工作日上午：09:30-11:30 下午：13:30-16:30

（二）查阅地点

发行人：重庆宇隆光电科技股份有限公司

住所：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号

电话：023-63170080

传真：023-67285503

联系人：郭飞

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

电话：010-60836483

传真：010-60836960

三、招股说明书其他附件

除上述“一、备查文件”外，本招股说明书的其他附件具体包括：

（一）落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；

（二）与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；

（三）股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；

（四）审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；

（五）募集资金具体运用情况；

（六）子公司、参股公司简要情况。

附件一 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

一、落实投资者关系管理相关规定的安排

（一）负责信息披露和投资者服务的部门

发行人负责信息披露和投资者关系的部门为公司董事会办公室，联系方式如下：

联系人：郭飞

地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号

电话：023-63170080

传真：023-67285503

电子信箱：ir@e-ong.com.cn

（二）信息披露及投资者关系工作的相关制度

1、《信息披露管理制度》

为了保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，依照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。

2、《投资者关系管理制度》

为了加强对公司投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，依照《公司法》《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。

二、股利分配决策程序

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露；

2、董事会审议现金分红具体方案时，将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应经董事会全体董事过半数以上表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

3、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议，并经过半数的审计委员会成员通过。若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案，审计委员会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

4、股东会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过；

5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、审计委员会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决；

6、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东会通过现场及网络投票的方式审议批准；

7、公司将严格按照有关规定在年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

三、股东投票机制建立情况

根据公司上市后适用的《公司章程（草案）》等制度，公司对股东投票机制进行了进一步完善，具体情况如下：

（一）累积投票制度

根据《公司章程（草案）》的规定，股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应当采用累积投票制。

（二）中小投资者单独计票

根据《公司章程（草案）》的规定，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票相关机制

根据《公司章程（草案）》的规定，股东会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便利。通过网络投票方式参加股东会的公司股东按照深圳证券交易所有关规定确定股东身份。股东通过该等方式参加股东会的，视为出席。通过其他方式参加股东会的，其具体方式和要求按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定执行。

（四）征集投票权的相关机制

根据《公司章程（草案）》的规定，董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保

护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集股东投票权提出最低持股比例限制。

附件二 与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

一、关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺

（一）控股股东、实际控制人王亚龙、李红燕承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该等股份。

2、如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）。

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。

4、上述锁定期满后，在本人担任董事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%，离任后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

5、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、若本人违反前述股份限售承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者由此产生的直接损失。

（二）实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该等股份。

2、如本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）。

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

4、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

5、若本企业违反前述股份限售承诺，本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本企业应获得的现金分红。如本企业违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本企业将依法赔偿发行人、投资者直接损失。

（三）直接或间接持股的董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等，下同），也不由发行人回购该等股份。

2、如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）。

3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人不因

职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。

4、上述锁定期满后，在本人担任董事或高级管理人员期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%，离任后半年内，不转让本人持有的发行人股份。

5、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

6、若本人违反前述股份限售承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者由此产生的直接损失。

（四）自然人股东嵇文、嵇亚明、刘武承诺

1、自本人取得发行人首次公开发行股票前已发行股份之日起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以二者中期限较长的为准），本人不转让或者委托他人管理本人持有的上述首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

3、若本人违反前述股份限售承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者直接损失。

（五）机构股东两江承为股权基金、赟汇股权投资、鼎量弘益、榕数投资、鼎量广隆、潮江春涌承诺

1、自本企业取得发行人首次公开发行股票前已发行股份之日起 36 个月内或发行人股票上市之日起 12 个月内（以二者中期限较长的为准），本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的上述首发前股份，也不由发行人回购该等股份。

2、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管

机构的要求发生变化的，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

3、若本企业违反前述股份限售承诺，本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本企业应获得的现金分红。如本企业违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本企业将依法赔偿发行人、投资者直接损失。

（六）机构股东中金科元、君联景诚、嘉兴华控、青岛华控、两江战新服务基金、两江渝地股权基金、华昆创投、乾升秦瑞、西高投基石基金、西高投凤石基金、盒中滋味、鼎量永益、鸿鹄恒通、华祥智瑞承诺

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该等股份。

2、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

3、若本企业违反前述股份限售承诺，本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本企业应获得的现金分红。如本企业违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本企业将依法赔偿发行人、投资者直接损失。

（七）自然人股东高军、邓卫国、郑锐、李玲芳、张磊承诺

1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该等股份。

2、在持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求发生变化的，本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。

3、若本人违反前述股份限售承诺，本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权扣留本人应获得的现金分红。如本人违反上述承诺，造成发行人、投资者损失的，本人将依法赔偿发行人、投资者直接损失。

二、关于股东持股及减持股份意向的承诺

（一）发行人实际控制人王亚龙、李红燕，以及直接或间接持股的董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、本人拟长期持有发行人股票。对于本次发行上市前持有的发行人股票，本人将严格遵守已作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股票。

2、如在锁定期届满后拟减持股票的，本人将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合发行人稳定股价、经营发展的需要，审慎制定股票减持计划，在锁定期满后逐步减持；如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整，下同）。

3、本人所持发行人股票锁定期届满后，本人将选择通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有的发行人股票。通过集中竞价交易方式减持的，本人将在首次减持的 15 个交易日前公告减持计划；通过其他方式减持的，本人将提前 3 个交易日予以公告。

4、本人如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。

（二）发行人实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、本企业拟长期持有发行人股票。对于本次发行上市前持有的发行人股票，本企业将严格遵守已作出的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股票。

2、如在锁定期届满后拟减持股票的，本企业将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合发行人稳定股价、经营

发展的需要，审慎制定股票减持计划，在锁定期满后逐步减持。

3、本企业所持发行人股票锁定期届满后，本企业将选择通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让持有的发行人股票。通过集中竞价交易方式减持的，本企业将在首次减持的 15 个交易日前公告减持计划；通过其他方式减持的，本企业将提前 3 个交易日予以公告。

4、本企业如违反上述承诺减持发行人股票的，则减持股票所获得的收益（如有）归发行人所有；如未履行上述承诺给发行人或投资者造成直接损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

三、关于稳定股价的措施和承诺

（一）公司上市后三年内稳定公司股价的预案

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）启动条件

在满足法定上市条件的前提下，自公司上市后三年内，公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产值（如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，上述每股净资产值相应进行调整，下同），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、信息披露、增持或回购相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。

（2）停止条件

自稳定股价方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均达到或高于公司最近一年经审计的每股净资产（如遇除权除息事项，上述每股净资产值相应进行调整）；

2）继续实施股价稳定方案将导致公司股权分布不符合上市条件；

3）继续增持股票将触发要约收购义务且有关主体未计划实施要约收购的情

形。

2、稳定公司股价的责任主体

公司采取稳定公司股价措施的责任主体包括公司、公司控股股东/实际控制人以及公司的董事（不包括公司独立董事，下同）和高级管理人员。

应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司本次股票上市时任职的董事、高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。

3、稳定股价的具体措施

公司及公司控股股东/实际控制人、董事和高级管理人员应以定性或定量的方式区别分析资本市场的系统性原因、行业周期的系统性原因、公司业绩波动的影响等不同因素的作用，并按顺序采取以下措施以稳定上市后的公司股价：

（1）公司回购股票

1）在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 15 个交易日内提出稳定股价方案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。

2）公司为稳定股价回购股份，应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式，并符合相关法律、法规和公司章程的规定。

3）公司依照公司章程对回购股份做出决议，公司控股股东/实际控制人承诺就该等回购事宜在股东会中投赞成票，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

4）公司回购股票的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司每股净资产将相应进行除权、除息调整），单一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。

5）公司回购股份后，将按照《公司法》的相关要求，对回购股份予以处置，包括但不限于注销或用于员工奖励。

6）如公司控股股东/实际控制人、董事和高级管理人员主动要求优先增持公司股份的，公司可在控股股东/实际控制人、董事和高级管理人员增持完毕后回

购公司股票。

（2）控股股东/实际控制人增持公司股份

1）当满足下列任一条件时，触发控股股东/实际控制人增持公司股份措施：①控股股东/实际控制人主动要求在公司回购股份前实施增持公司股份的；②公司无法实施回购方案；③公司回购股份方案实施完毕后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均达到或高于公司最近一年经审计的每股净资产”。

2）控股股东/实际控制人将在触发启动股价稳定措施条件之日起 15 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告，增持方案包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。

3）控股股东/实际控制人增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，其增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

4）控股股东/实际控制人增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司每股净资产将相应进行除权、除息调整），其单次增持的资金不低于上一会计年度自公司获得的税后现金分红金额的 10%。

5）控股股东/实际控制人承诺在符合稳定股价预案条件时，控股股东/实际控制人提名的董事及其本人（如任职或持股）将在董事会、股东会（如有）上对回购股份的预案投赞成票。

（3）董事和高级管理人员增持公司股份

1）当满足下列任一条件时，触发董事和高级管理人员增持公司股份措施：①董事或高级管理人员主动要求在公司回购股份前实施增持公司股份的；②公司无法实施股份回购方案且控股股东/实际控制人无法实施股份增持方案；③公司实施股份回购方案且控股股东/实际控制人增持公司股份方案实施完成后，公司股票仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均达到或高于公司最近一年经审计的每股净资产”。

2）董事和高级管理人员将在触发启动股价稳定措施条件之日起 15 个交易日内向公司提交增持公司股份的方案并由公司公告，增持方案包括但不限于拟增持的公司股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息。

3）董事和高级管理人员增持股票的方式为集中竞价交易方式或证券监管部门认可的其他方式，其增持股份的行为应符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所相关业务规则、备忘录的要求。

4）董事和高级管理人员增持公司股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司每股净资产将相应进行除权、除息调整）；董事和高级管理人员单次用于增持的资金不低于上一会计年度自公司取得税后薪酬的 10.00%。

5）董事和高级管理人员承诺在符合稳定股价预案条件时，其就公司股份回购方案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票。

（4）经董事会、股东会审议通过的其他稳定股价方案。

公司及相关主体可以根据公司及市场情况，采取上述措施维护公司股价稳定。在每个自然年度，公司及相关主体履行稳定股价措施的义务仅限一次，公司及相关主体依据本预案第一部分的约定，在方案实施过程中因股价上涨而终止实施稳定股价措施的，视同已履行稳定股价措施的义务。上述具体措施实施时应以维护公司上市地位，保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及交易所的相关规定，并应按照证券交易所《上市规则》及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

4、未履行稳定股价预案的约束措施

（1）对公司的约束措施

若公司公告的股价稳定方案涉及公司回购义务，公司无正当理由未履行稳定股价的方案，公司将在中国证券监督管理委员会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉，并就未能履行承诺导致的投资者损失依法承担赔偿责任。

自公司股票上市之日起三年内，公司新聘任董事、高级管理人员的，将要求其履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（2）对控股股东/实际控制人的约束措施

若公司公告的股价稳定方案涉及公司控股股东/实际控制人增持公司股票，控股股东/实际控制人无正当理由未履行稳定公司股价方案的，则公司控股股东/实际控制人将在中国证券监督管理委员会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权自应付控股股东/实际控制人的税后现金分红中暂时扣留与该控股股东/实际控制人通知的拟增持股份总金额相等的现金分红款（如控股股东/实际控制人未通知公司拟增持股份总金额的，则单一会计年度内公司可扣留的资金不低于上一会计年度其自公司获得的税后现金分红金额的10%），直至控股股东履行其增持义务。

（3）对董事、高级管理人员的约束措施

若公司公告的股价稳定方案涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，董事、高级管理人员无正当理由未履行稳定公司股价方案的，则未履行稳定公司股价方案的董事、高级管理人员将在中国证券监督管理委员会指定披露媒体上向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权自应付董事、高级管理人员的税后薪酬中暂时扣留与该董事、高级管理人员通知的拟增持股份总金额相等的薪酬（如该董事、高级管理人员未通知公司拟增持股份总金额的，则单一会计年度内公司可扣留的资金不低于上一会计年度其自公司获得的税后薪酬的 10%），直至该董事、高级管理人员履行其增持义务。

（二）发行人承诺

自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三年内，公司将严格遵守执行公司股东会审议通过的《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》，包括按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三年内，若公司新聘任董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（三）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

如发行人上市后三年内股价达到《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，本人/本单位将遵守发行人董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持发行人股票或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。稳定股价的实施方案涉及发行人股东会或董事会表决的，本人/本单位将投赞成票。

（四）董事（不包括独立董事）、高级管理人员承诺

本人将严格按照公司股东会审议通过的《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时，本人将敦促公司及其他相关方严格按照《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。

四、关于依法承担赔偿责任的承诺

（一）发行人承诺

1、公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如招股说明书及其他信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次公开发行的全部新股。自证券监督管理机构或其他有权部门认定公司存在欺诈发行情形之日起 5 个工作日内，公司董事会将召集股东会审议关于回购本次公开发行的全部新股股票的议案并公告回购方案。股东会审议通过回购方案后，公司将依法购回本次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上本次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行调整。

如法律、法规、规章、规范性文件另有规定或证券监管机构、证券交易所另

有要求的，公司将按照届时有效的相关法律、法规、规章、规范性文件或证券监管机构、证券交易所的要求履行回购义务。

3、如公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行及交易中遭受损失的，在该等违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，公司将依法赔偿投资者直接损失。

（二）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、本人/本单位承诺公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如证券监督管理机构或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行上市条件构成重大、实质影响的，本人/本单位将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，并在公司召开董事会或股东会对回购股份作出决议时投赞成票。

3、如证券监督管理机构或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行上市条件构成重大、实质影响且本人/本单位负有责任的，本人/本单位承诺将在证券监督管理机构或其他有权部门认定的责任范围内依法买回本次公开发行的股票。

4、如公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行及交易中遭受损失的，在该等违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，本人/本单位将依法赔偿投资者直接损失。

（三）董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、本人承诺公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、如证券监督管理机构或其他有权部门认定公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合发行上市条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，并在公司召开董事会或股东会对回购股份作出决议时投赞成票。

3、如公司本次发行上市的招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行及交易中遭受损失的，在该等违法事实被证券监管机构或其他有权部门认定后，本人将依法赔偿投资者直接损失。

五、关于对欺诈发行上市的股份回购承诺

（一）发行人承诺

1、公司保证本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司及公司控股股东、实际控制人将在证券监督管理机构或其他有权部门认定后的 5 个工作日内启动股份回购程序，依法回购公司本次公开发行的全部新股。

（二）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、本人/本单位保证公司本次公开发行股票并在创业板上市不存在任何欺诈发行的情形。

2、如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人/本单位及公司将在证券监督管理机构或其他有权部门认定后的 5 个工作日内启动股份回购程序，依法回购公司本次公开发行的全部新股。

六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

本次发行完成后，公司的股本和净资产规模较预计将有较大幅度增长，每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。

（一）发行人承诺

本次发行完成后，公司的股本和净资产规模较预计将有较大幅度增长，每股收益和净资产收益率等指标在发行后的一定期间内将可能被摊薄。为充分保护中小投资者利益，降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取以下措施：

1、加强募集资金使用管理，保障使用的合理合法性

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金使用规范、安全、高效，公司制定了相应的内控管理制度。本次发行募集资金到位后，公司董事会将会持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定用途、配合银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理、规范使用，防范募集资金使用风险，充分发挥募集资金效益，切实保护投资者的利益。

2、合理安排募投项目建设进度，争取尽快实现预期效益

本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目预期收益，公司将积极协调资源，争取以自筹资金先行开展募投项目的前期准备及建设工作。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益，提升公司经营业绩及盈利能力，为股东创造更大的回报，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

3、加大市场拓展力度，提升经营业绩

公司将在巩固目前市场竞争地位的基础上，继续提升客户服务水平，加大市场开拓力度，拓展收入增长空间，进一步巩固和提升公司的市场竞争地位，实现公司营业收入的可持续增长。

4、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出高效、科学和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

5、完善利润分配机制，提高投资者回报能力

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司已根据中国证券监督管理委员会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行了详细规定，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的权利，努力提高公司的未来股东回报能力。

（二）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。

2、本人/本单位将切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人/本单位对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。

若本人/本单位违反上述承诺或拒不履行上述承诺，导致公司或投资者遭受直接经济损失的，本人/本单位愿意依法承担赔偿责任。

（三）董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、对本人职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关制度；

5、如公司未来实施股权激励方案，在本人自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守相关股权激励计划（如适用）。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，导致公司遭受直接经济损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。

七、关于利润分配政策的承诺

（一）发行人承诺

公司将严格按照公司股东会审议通过的《重庆宇隆光电科技股份有限公司章程（草案）》《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行公司利润分配决策程序，并实施利润分配。

（二）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

本人/本单位将依法履行本人/本单位职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使发行人按照经股东会审议通过的《重庆宇隆光电科技股份有限公司章程（草案）》《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人/本单位拟采取的措施包括但不限于：

1、根据发行人章程草案中规定的利润分配政策及公司分红回报规划，制定利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的董事会、股东会上，对符合发行人利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、在发行人董事会、股东会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。

（三）董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

本人将依法履行本人职责，采取一切必要的合理措施，以协助并促使发行人按照经股东会审议通过的《重庆宇隆光电科技股份有限公司章程（草案）》《重庆宇隆光电科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人拟采取的措施包括但不限于：

1、根据发行人章程草案中规定的利润分配政策及公司分红回报规划，制定利润分配预案；

2、在审议发行人利润分配预案的董事会、股东会上，对符合发行人利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；

3、在发行人董事会、股东会审议通过有关利润分配方案后，严格予以执行。

如本人违反上述承诺，本人将按照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任并采取后续措施。

八、关于控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺

（一）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、截至本承诺函签署之日，除公司外，本人/本单位及本人/本单位控制的其他企业没有以任何形式从事与公司的主营业务构成或可能构成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动；

2、自本承诺函签署之日起，本人/本单位承诺不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）从事与公司的主营业务构成或可能构成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动；

3、若公司在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人/本单位届时控制的其他企业对此已经开展生产、经营，且对公司构成重大不利影响的，本人/本单位届时将对该等企业的控制权进行处置，公司及其下属企业有权对该等企业的控制权进行优先收购，以避免产生对公司构成重大不利影响的同业竞争；

4、若公司在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人/本单位届时控制的其他企业对此尚未开展生产、经营的，本人/本单位届时控制的其他企业将不从事对公司构成重大不利影响的同业竞争业务或活动。

本人/本单位愿意对违反上述承诺而给公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。上述承诺在本人/本单位作为公司的控股股东、实际控制人/控股股东、实际控制人之一致行动人期间持续有效。

（二）发行人董事及高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、截至本承诺函签署之日，除公司外，本人及本人控制的其他企业没有以任何形式从事与公司的主营业务构成或可能构成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动；

2、自本承诺函签署之日起，本人承诺不会直接或间接的以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）从事与公司的主营业务构成或可能构成竞争关系且对公司构成重大不利影响的业务或活动；

3、若公司在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人届时控制的其他企业对此已经开展生产、经营，且对公司构成重大不利影响的，本人届时将对该等企业的控制权进行处置，公司及其下属企业有权对该等企业的控制权进行优先收购，以避免产生对公司构成重大不利影响的同业竞争；

4、若公司在现有业务基础上进一步拓宽经营范围，而本人届时控制的其他企业对此尚未开展生产、经营的，本人届时控制的其他企业将不从事对公司构成重大不利影响的同业竞争业务或活动。

本人愿意对违反上述承诺而给公司造成的直接经济损失承担赔偿责任。上述承诺在本人作为公司的董事、高级管理人员期间持续有效。

九、关于未能履行承诺时约束措施的承诺

（一）发行人承诺

1、公司将严格履行本次发行上市过程中作出的公开承诺事项。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，公司将及时履行信息披露义务。

3、非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，公司承诺采取以下措施予以约束：

（1）公司将在股东会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉。如承诺可以继续履行且继续履行有利于维护

公司权益的，公司将继续履行承诺；如承诺无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，公司将提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，尽可能保护投资者的权益。

（2）如因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿相关直接损失。

（3）公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施，直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕。

（4）公司作出并在本次发行的招股说明书上披露的其他承诺约束措施。

（二）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕承诺

1、本人/本单位将严格履行本次发行上市过程中作出的公开承诺事项。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，本人/本单位将及时通知公司并履行信息披露义务。

3、非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人/本单位承诺采取以下措施予以约束：

（1）本人/本单位将在股东会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉。如承诺可以继续履行且继续履行有利于维护公司权益的，本人/本单位将继续履行承诺；如承诺无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人/本单位将提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，尽可能保护投资者的权益。

（2）如因本人/本单位未履行相关承诺事项，给公司造成直接损失的，本人/本单位将就该等直接损失予以赔偿。

（3）如因本人/本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人/本单位将依法向投资者赔偿相关直接损失。

（4）本人/本单位不主动转让本人/本单位直接或间接持有的公司股份直至相

关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（但本人/本单位转让股份有利于相关承诺及补救措施的履行或有利于公司及中小投资人利益的除外），涉及赔偿责任的，本人/本单位同意公司扣减本人/本单位所获分配的现金分红用于承担相关赔偿责任。

（三）发行人董事及高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、本人将严格履行本次发行上市过程中作出的公开承诺事项。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，本人将及时通知公司并履行信息披露义务。

3、非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人承诺采取以下措施予以约束：

（1）本人将在股东会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉。如承诺可以继续履行且继续履行有利于维护公司权益的，本人将继续履行承诺；如承诺无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人将提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，尽可能保护投资者的权益；

（2）如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成直接损失的，本人将就该等直接损失予以赔偿；

（3）如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关直接损失；

（4）本人同意公司扣减应向本人发放的薪酬、津贴，以用于执行本人未履行的承诺直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；

（5）本人作出并在本次发行的招股说明书上披露的其他承诺约束措施。

（四）机构股东华祥智瑞、两江承为股权基金、赟汇股权投资、鼎量弘益、榕数投资、鼎量广隆、潮江春涌、中金科元、君联景诚、嘉兴华控、青岛华控、两江战新服务基金、两江渝地股权基金、华昆创投、乾升秦瑞、西高投基石基金、西高投凤石基金、盒中滋味、鼎量永益、鸿鹄恒通承诺

1、本单位将严格履行本次发行上市过程中作出的公开承诺事项。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，本单位将及时通知公司并履行信息披露义务。

3、非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本单位承诺采取以下措施予以约束：

（1）本单位将在股东会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉。如承诺可以继续履行且继续履行有利于维护公司权益的，本单位将继续履行承诺；如承诺无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本单位将提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，尽可能保护投资者的权益。

（2）如因本单位未履行相关承诺事项，给公司造成直接损失的，本单位将就该等直接损失予以赔偿。

（3）如因本单位未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法向投资者赔偿相关直接损失。

（4）本单位不主动转让本单位直接或间接持有的公司股份直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕（但本单位转让股份有利于相关承诺及补救措施的履行或有利于公司及中小投资人利益的除外），涉及赔偿责任的，本单位同意公司扣减本单位所获分配的现金分红用于承担相关赔偿责任。

（5）本单位作出并在本次发行的招股说明书上披露的其他承诺约束措施。

（五）自然人股东嵇文、嵇亚明、刘武、高军、邓卫国、郑锐、李玲芳、张磊承诺

1、本人将严格履行本次发行上市过程中作出的公开承诺事项。

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，本人将及时通知公司并履行信息披露义务。

3、非因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人承诺采取以下措施予以约束：

（1）本人将在股东会及证券监管机构指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和公众投资者道歉。如承诺可以继续履行且继续履行有利于维护公司权益的，本人将继续履行承诺；如承诺无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，本人将提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务，尽可能保护投资者的权益；

（2）如因本人未履行相关承诺事项，给公司造成直接损失的，本人将就该等直接损失予以赔偿；

（3）如因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关直接损失；

（4）本人同意公司扣减应向本人发放的薪酬、津贴，以用于执行本人未履行的承诺直至相关承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；

（5）本人作出并在本次发行的招股说明书上披露的其他承诺约束措施。

十、关于减少和规范关联交易的承诺

（一）控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕承诺

1、自本承诺函签署之日起，本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的其他企业将尽量减少与公司之间的关联交易；

2、本人将尽量避免本人、本人关系密切的家庭成员以及其所控制的其他企业与公司之间发生关联交易，对于不可避免的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

3、本人将严格遵守公司的公司章程及相关规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将合法、合规的履行决策程序，并及时履行信息

披露义务；

4、本人保证不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司行使不正当的股东权利损害公司及其他股东的合法权益。

如本人违反上述承诺，给公司及其子公司造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。上述承诺在本人作为公司关联方期间持续有效。

（二）发行人实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号承诺

1、自本承诺函签署之日起，本单位、本单位关系密切的家庭成员直接或间接控制的其他企业将尽量减少与公司之间的关联交易；

2、本单位将尽量避免本单位、本单位控制的其他企业与公司之间发生关联交易，对于不可避免的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

3、本单位将严格遵守公司的公司章程及相关规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将合法、合规的履行决策程序，并及时履行信息披露义务；

4、本单位保证不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司行使不正当的股东权利损害公司及其他股东的合法权益。

如本单位违反上述承诺，给公司及其子公司造成直接损失的，本单位将依法承担赔偿责任。上述承诺在本单位作为公司关联方期间持续有效。

（三）发行人董事及高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、崔斌、程茂勇、张方晖、张珺、万超、郭飞、彭云强承诺

1、自本承诺函签署之日起，本人、本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的其他企业将尽量减少与公司之间的关联交易；

2、本人将尽量避免本人、本人关系密切的家庭成员以及其所控制的其他企业与公司之间发生关联交易，对于不可避免的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；

3、本人将严格遵守公司的公司章程及相关规章制度中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将合法、合规的履行决策程序，并及时履行信息披露义务；

4、本人保证不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司行使不正当的股东权利损害公司及其他股东的合法权益。

如本人违反上述承诺，给公司及其子公司造成直接损失的，本人将依法承担赔偿责任。上述承诺在本人作为公司关联方期间持续有效。

十一、关于股东信息披露事宜的承诺

发行人出具《重庆宇隆光电科技股份有限公司关于股东信息披露的专项承诺》，作出如下承诺：

1、本公司已在本次发行的申报文件中真实、准确、完整的披露了股东信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、截至本承诺函出具之日，本公司不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

4、本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

5、本公司不存在以本公司的股份进行不当利益输送的情形；

6、本公司不存在证监会系统离职或/及现职人员不当入股公司的情形。

十二、关于社会保险和住房公积金的承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕就公司社会保险和住房公积金相关事宜作出如下承诺：

若公司及其子公司因任何事项经有关主管部门认定需为员工补缴社会保险金和/或住房公积金，或公司及其子公司因任何事项而被社会保险行政部门和/或公积金管理部门处以罚款或其他任何处罚，本人将无条件向公司补偿该等全部补

缴社会保险金和/或公积金金额以及全部处罚金额，以及公司及其子公司因此所支付的相关费用，以使公司及其子公司免受损失。

十三、关于避免资金占用的承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕，以及董事、高级管理人员殷鸿彬、徐建伟、王剑涛、郑翔龙、郭飞、张珺、彭云强、万超作出承诺如下：

1、本人将严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求及规定，确保不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资产和资源；

2、本人将促使本人直接或间接控制的其他企业遵守上述承诺；

3、如本人或本人控制的其他企业违反上述承诺，导致公司或其股东的权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责任。

本承诺函自签署之日起正式生效，在本人作为公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员期间持续有效且不可撤销。

十四、关于保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立的承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕就保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立相关事宜作出如下承诺：

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立、健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东及实际控制人控制的企业完全分开、独立运作，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

发行人具备与其生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发行人拥有与生产经营有关的土地、房屋、机器设备、专利技术、软件著作权、注册商标的所有权或使用权；发行人的资产与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产有明确界定且划分清晰，发行人的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。截至本承诺函出具之日，发行人不存在被控股股东占用资金、资产及其他资源的情形。

（二）人员独立

发行人的高级管理人员以及财务人员均具有独立性。发行人总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员及其他核心人员均为发行人专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务且未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

发行人设立了独立的财务部门，建立了独立、规范的财务核算体系和对子公司的财务管理制度，依法独立进行财务决策；发行人独立地开立了基本存款账户，不存在发行人与控股股东、实际控制人及其他关联企业共用银行账户的情形；发行人依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

（四）机构独立

发行人组织机构健全完整，职责明确，各机构的设置均独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情况。发行人拥有独立的生产经营和办公场所。

（五）业务独立

发行人主营业务突出，拥有独立的生产、供应、销售、研发系统，主营业务产品的生产、技术开发、原材料采购、产品销售均独立进行，发行人拥有自己独立的采购、生产、销售、研发系统、品牌和技术，不依赖于股东和其他任何关联方。发行人与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争且不存在显失公平的关联交易。

十五、关于在审期间不进行现金分红的承诺

发行人拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《监管规则适用指引--发行类第 10 号》的相关规定，特此承诺如下：

在审期间本公司将不进行现金分红。

十六、关于发行人业绩下滑延长股份锁定期限的承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕及实际控制人之一致行动人宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号就关于发行人业绩下滑延长股份锁定期限事宜作出如下承诺：

（一）发行人上市当年较上市前一年净利润（“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）出现下滑，延长本人/本企业届时所持股份（系指上市前持有，上市当年年报披露时仍持有的股份）锁定期限 12 个月；

（二）发行人上市第二年较上市前一年出现净利润下滑，在前项基础上延长本人/本企业届时所持股份（系指上市前持有，上市第二年年报披露时仍持有的股份）锁定期限 12 个月；

（三）发行人上市第三年较上市前一年出现净利润下滑，在前两项基础上延长本人/本企业届时所持股份（系指上市前持有，上市第三年年报披露时仍持有的股份）锁定期限 12 个月。

十七、关于税收优惠的承诺

控股股东王亚龙，实际控制人王亚龙与李红燕就公司税收优惠相关事宜作出如下承诺：

公司及其子公司按照高新技术企业享有税收优惠，并按优惠税率进行了预提，若公司及其子公司经有关主管部门认定不具备享有该等税收优惠政策并被追缴税款，本人将无条件向公司补偿该等税款金额及对应的全部处罚金额（包括滞纳金），以及公司及其子公司因此所支付的相关费用，以使公司及其子公司免受损失。

附件三 股东会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

公司及时根据现行法律法规要求，按照法定程序审议修订了《公司章程》。公司股东会审议通过了上市后适用的《公司章程（草案）》。报告期内，股东会、董事会及监事会等各机构运行规范。

一、股东会制度的建立健全及运行情况

（一）股东会制度的建立健全情况

公司依法设立股东会，股东会为公司的最高权力机构。公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定召开股东会，保证公司股东能够依法行使权利、履行义务，切实发挥股东会的作用。

（二）股东会的运行及履职情况

自公司设立以来，股东会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。自公司设立至本招股说明书签署日，公司历次股东会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

二、董事会制度的建立健全及运行情况

（一）董事会制度的建立健全情况

公司依法设立董事会，向股东会负责。公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召开董事会，保证公司董事能够依法行使权利、履行义务，切实发挥董事会的作用。

根据《公司章程（草案）》及《董事会议事规则》规定，公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人，副董事长 1 人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期不得超过 3 年，任期届满可连选连任。

（二）董事会的运行及履职情况

自公司设立至本招股说明书签署日，公司历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

三、监事会制度的建立健全及运行情况

（一）监事会制度的建立健全情况

公司依法设立监事会，向股东会负责。公司严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定召开监事会，保证公司监事能够依法行使权利、履行义务，切实发挥监事会的作用。

根据《公司章程（草案）》及《监事会议事规则》规定，董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，可以连选连任。

报告期内，公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方式产生。

（二）监事会的运行及履职情况

公司于 2025 年 8 月召开 2025 年第三次临时股东大会，决议调整公司内部监督机构，不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会行使。

自本公司设立至取消监事会之日，公司历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关的通知、召集、主持、议事、表决、决议、记录及档案留存的程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。

四、独立董事制度的建立健全及运行情况

（一）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司依法设立独立董事制度，对公司及公司全体股东负责。公司严格按照《公司法》《独立董事工作制度》等有关规定执行独立董事制度，保证公司独立董事能够依法行使权利、履行义务，切实发挥独立董事的作用。

公司现有独立董事 3 名，独立董事数量、人员构成、任职条件、选举程序等符合《公司章程》《独立董事工作制度》和法律法规的有关规定。

（二）独立董事制度的运行及履职情况

公司自设立独立董事以来，独立董事依据有关法律法规谨慎、认真、勤勉的履行了相关权利和义务，积极参与了公司重大经营决策，发挥了其在财务和法律决策等方面的专业特长，对公司报告期内的关联交易发表了独立公允的意见，维护了全体股东的利益。公司独立董事以独立客观的立场参与了公司经营决策，对公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用。

五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书对公司和董事会负责。董事会秘书严格按照《董事会秘书工作细则》等有关规定执行董事会秘书工作、行使并履行董事会秘书的相关权利和义务，切实发挥董事会秘书的作用。

（二）董事会秘书制度的运行及履职情况

现任董事会秘书自受聘以来，严格按照有关规定开展工作、筹备历次董事会会议及股东会会议，确保公司董事会会议和股东会会议的顺利召开，在公司规范运作方面发挥了重要作用。

附件四 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

一、战略委员会的构成与职责

战略委员会委员由 3 名董事组成，委员为王亚龙、殷鸿彬、李红燕，其中王亚龙为委员会主任。

战略委员会主要职责为：（1）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；（2）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议；（3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交易进行研究并提出建议；（4）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（5）董事会授权的其他事宜。

二、审计委员会的构成与职责

审计委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委员中有 1 名为会计专业人士。委员为程茂勇、王亚龙、崔斌，其中程茂勇为委员会主任。

审计委员会主要职责如下：（1）监督及评估外部审计机构工作；（2）指导内部审计工作；（3）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（4）评估内部控制的有效性；（5）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（6）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

三、提名委员会的构成与职责

提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为王亚龙、崔斌、张方晖，其中张方晖为委员会主任。

提名委员会主要职责如下：（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；（3）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

四、薪酬与考核委员会的构成与职责

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为王亚龙、崔斌、张方晖，其中崔斌为委员会主任。

薪酬与考核委员会主要职责为：（1）研究董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；（2）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；（3）每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否和实际情况一致等进行检查并提交董事会；（4）制定公司股权激励计划的草案。

五、董事会专门委员会的运作情况

公司董事会专门委员会自设立以来，各委员充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，在制定公司战略发展规划、规范关联交易、督促公司完善内部控制制度及执行有效性、制定高管薪酬绩效评价标准等方面为公司出谋划策，发挥了实际作用。

附件五 募集资金具体运用情况

一、合肥宇隆生产基地项目

（一）项目概况

合肥宇隆生产基地项目实施主体为合肥宇隆，项目总投资 96,850.28 万元，拟使用募集资金 45,000.00 万元。

本项目拟新建智能控制卡和精密功能器件生产线、生产车间、公辅设施、配套辅助用房等，总建筑面积合计 101,648 平方米；项目达产后可年产智能控制卡产品近 10,000 万片，年产精密功能器件 30,360 万片。

（二）项目投资规模

项目总投资 96,850.28 万元，拟使用募集资金 45,000.00 万元，投资构成如下：

序号	投资明细	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	34,128.18	35.24%
2	设备及软件购置费	46,653.82	48.17%
3	安装工程费	2,284.17	2.36%
4	工程建设其他费用	3,506.42	3.62%
5	预备费	4,328.63	4.47%
6	铺底流动资金	5,949.06	6.14%
合计		**96,850.28**	**100.00%**

（三）项目实施主体、选址及用地情况

本项目实施主体为合肥宇隆，为发行人全资子公司，发行人拟以借款或增资的方式向合肥宇隆投入募集资金，本项目建设的资金缺口由合肥宇隆通过自有或自筹资金予以解决。

本项目建设地点位于安徽省合肥市新站高新技术开发区新蚌埠路东、淮下路南、三十头路北，总用地面积为 50,950.74 平方米，本项目实施主体已取得相关项目建设用地土地使用权不动产权证（皖（2025）合肥市不动产权第 1065381 号至第 1065387 号），土地性质为工业用地。

（四）项目审批、核准和备案情况

本项目已于 2022 年 9 月 23 日取得安徽合肥新站高新区经济发展局出具的《安徽合肥新站高新区经济发展局项目备案表》，项目编码为 2110-340163-04-01-849568。

（五）项目环保情况

本项目已于 2022 年 10 月 27 日取得合肥市生态环境局出具的《关于合肥宇隆光电科技有限公司 OLED 控制板及液晶模组控制板和精密模切生产基地项目（重新报批）环境影响报告表审批意见的函》（环建审[2022]12078 号）。

本项目的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投入 365.50 万元，用于建设管道、排水设备等，已纳入项目投资概算，发行人将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境影响降到最低限度。

（六）项目实施进度

本项目建设期拟定为 72 个月，项目总体进度计划如下：

序号	建设内容	月份											
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72
1	项目前期准备	△	△										
2	勘察设计		△	△	△								
3	土建施工			△	△	△	△						
4	设备采购、安装及调试					△	△	△	△	△	△		
5	人员招聘与培训						△	△	△	△	△	△	
6	竣工验收												△

（七）项目经济效益分析

本项目财务效益指标数据：

项目	所得税后
新增年营业收入（万元）	225,890.83
新增年利润总额（万元）	28,863.56
税后内部收益率	23.19%

项目	所得税后
税后静态回收期	7.84 年（含建设期）

二、重庆宇隆二期项目

（一）项目概况

重庆宇隆二期项目实施主体为宇隆科技，项目总投资 53,571.44 万元，拟使用募集资金 25,000.00 万元。

本项目拟新建智能控制卡生产线、生产车间、配套辅助用房等，总建筑面积合计 59,287 平方米。项目达产后可实现年产智能控制卡 4,992 万片。

（二）项目投资规模

项目总投资 53,571.44 万元，拟使用募集资金 25,000.00 万元，项目总投资具体构成情况如下：

序号	投资明细	投资金额（万元）	比例
1	建筑工程费	18,092.00	33.77%
2	设备及软件购置费	28,311.16	52.85%
3	安装工程费	1,366.31	2.55%
4	工程建设其他费用	1,996.32	3.73%
5	预备费	2,488.29	4.64%
6	铺底流动资金	1,317.35	2.46%
合计		**53,571.44**	**100.00%**

（三）项目实施主体、选址及用地情况

本项目实施主体为宇隆科技，本项目建设的资金缺口由宇隆科技通过自有或自筹资金予以解决。

本项目建设地点位于重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号地块，二期项目总用地面积为 15,404.55 平方米。本项目实施主体已取得相关项目建设用地土地使用权不动产权证（渝（2025）两江新区不动产权第 000368158 号），土地性质为工业用地。

（四）项目审批、核准和备案情况

本项目已于 2025 年 3 月 5 日取得重庆两江新区经济运行局出具的《重庆市

企业投资项目备案证》，项目编码为 2020-500109-39-03-152394。

（五）项目环保情况

本项目已于 2022 年 11 月 22 日取得重庆市生态环境局两江新区分局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准[2022]144 号）。

本项目的设计严格执行国家现行废水、废气、噪声等污染排放的规范和标准，按照环境保护行政主管部门的要求进行项目建设环境评价，符合国家和地方环保要求。本项目所需环保设备投入 100.00 万元，用于建设管道、排水设备等，已纳入项目投资概算，发行人将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，使项目投产后对环境影响降到最低限度。

（六）项目实施进度

本项目建设期拟定为 78 个月，项目具体进度计划如下：

序号	项目阶段	月份												
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78
1	项目前期准备	△												
2	勘察设计	△	△											
3	土建与装修		△	△	△	△	△	△	△					
4	设备购置、安装与调试					△	△	△	△	△	△	△		
5	人员招聘及培训							△	△	△	△	△	△	
6	竣工验收													△

（七）项目经济效益分析

本项目财务效益指标数据：

项目	所得税后
新增年营业收入（万元）	96,250.62
新增年利润总额（万元）	8,866.85
税后内部收益率	12.87%
税后静态回收期	10.54 年（含建设期）

三、补充流动资金

（一）项目概述

公司拟使用募集资金 30,000.00 万元用于主营业务发展所需要的流动资金。

公司将结合业务经营的实际需求和未来发展战略规划，科学地将流动资金投入到公司日常经营中，合理地制定流动资金补充计划，以便更好地满足公司业务发展和对运营资金的需求。

（二）补充流动资金的必要性

随着国内 LCD、OLED 等多种显示技术的发展，显示用智能控制卡的需求预计将呈快速增长的趋势。报告期内，公司营业收入分别为 6.98 亿元、10.95 亿元和 11.37 亿元，整体呈增长趋势。随着公司未来业务规模的增长，项目投资、生产经营对流动资金的需求也将不断增长，因此适当补充流动资金符合公司业务发展的需要。

本次补充流动资金可根据业务发展的实际需求，适时投入营运资金用于项目铺底流动资金、日常生产经营、研发投入等方面，有助于改善公司财务结构、降低财务风险，以满足公司日常运营资金需求，并提高公司整体的财务稳健性，保证经营活动的顺利进行，保证和提高公司核心竞争力。

（三）流动资金管理安排

公司将严格按照《募集资金管理办法》规定，将流动资金存入董事会决定的专户管理。由公司董事会根据公司的发展规划及实际生产经营需求进行统筹安排。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规定以及公司的《募集资金管理办法》，根据业务发展的需要使用该项流动资金。在具体资金使用过程中，将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行。

公司在进行该项流动资金使用时，将根据业务发展需要，在科学预算和合理调度的基础上，合理安排资金的使用方向、进度和数量，保障募集资金的安全和使用效率，切实保障股东合法权益。

附件六 子公司、参股公司简要情况

截至本招股说明书签署日，公司控股子公司、参股公司情况如下：

序号	公司名称	注册地	主营业务	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	合肥宇隆	安徽省合肥市	显示用智能控制卡业务	12,000.00	12,000.00	100.00
2	福州宇隆	福建省福州市	显示用智能控制卡业务	5,000.00	5,000.00	100.00
3	武汉宇隆	湖北省武汉市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
4	青岛宇隆	山东省青岛市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
5	河北宇隆	河北省廊坊市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
6	成都宇隆	四川省成都市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
7	北海宇隆	广西壮族自治区北海市	显示用智能控制卡业务	3,000.00	3,000.00	100.00
8	安徽灿宇	安徽省合肥市	显示用精密功能器件业务	3,000.00	3,000.00	100.00
9	重庆升越达	重庆市北碚区	显示用精密功能器件业务	3,000.00	3,000.00	100.00
10	宇隆研究院	重庆市北碚区	技术研发	500.00	500.00	100.00
11	隆美卡机器人	重庆市北碚区	拟开展机器人相关业务	4,285.71	4,285.71	51.00
12	香港宇隆	中国香港	海外业务持股平台	1.00 万美元	1.00 万美元	100.00
13	越南宇隆	越南北宁市	拟开展显示用智能控制卡业务	521.46 亿越南盾[注]	-	100.00
14	扬州光洋	江苏省扬州市	柔性电路板、多层软硬结合电路板业务	70,300.00	70,300.00	1.42

注：越南宇隆注册资本 521.46 亿越南盾，折合等值 200 万美元。

（一）控股子公司

截至本招股说明书签署日，公司合计拥有 13 家控股子公司，具体情况如下：

1、合肥宇隆光电科技有限公司

名称	合肥宇隆光电科技有限公司
成立时间	2016 年 12 月 16 日
注册资本	12,000.00 万元
实收资本	12,000.00 万元
注册地址	合肥市新站区玉皇山路与新蚌埠路交口 2 号合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
主要生产经营地	合肥市新站区玉皇山路与新蚌埠路交口 2 号合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙

主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	合肥及周边地区显示用智能控制卡业务

合肥宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	38,224.96
净资产	22,122.04
营业收入	13,453.44
净利润	2,728.52

2、福州宇隆光电科技有限公司

名称	福州宇隆光电科技有限公司
成立时间	2016 年 11 月 30 日
注册资本	5,000.00 万元
实收资本	5,000.00 万元
注册地址	福建省福州市福清融侨经济技术开发区斯泰克工业园 3#楼一二层
主要生产经营地	福建省福州市福清融侨经济技术开发区斯泰克工业园 3#楼一二层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	福州及周边地区显示用智能控制卡业务

福州宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	9,574.12
净资产	7,444.06
营业收入	3,091.12
净利润	413.78

3、武汉宇隆光电科技有限公司

名称	武汉宇隆光电科技有限公司
成立时间	2019 年 7 月 4 日
注册资本	3,000.00 万元

实收资本	3,000.00 万元
注册地址	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号
主要生产经营地	武汉市东西湖区径河办事处通源路 1 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	武汉及周边地区显示用智能控制卡业务

武汉宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,309.08
净资产	3,486.51
营业收入	3,040.38
净利润	125.72

4、青岛宇隆光电科技有限公司

名称	青岛宇隆光电科技有限公司
成立时间	2023 年 1 月 18 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	山东省青岛市黄岛区陡楼山路 777 号 1#车间户
主要生产经营地	山东省青岛市黄岛区陡楼山路 777 号 1#车间户
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	青岛及周边地区显示用智能控制卡业务

青岛宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,908.35
净资产	3,008.65
营业收入	1,998.73
净利润	86.39

5、河北宇隆光电科技有限公司

名称	河北宇隆光电科技有限公司
成立时间	2017 年 12 月 9 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号谊安工业园 A 栋 2 层
主要生产经营地	河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾路西侧潮白大街 10 号谊安工业园 A 栋 2 层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	河北及周边地区显示用智能控制卡业务

河北宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	4,591.82
净资产	4,390.10
营业收入	126.76
净利润	19.89

6、成都宇隆光电有限公司

名称	成都宇隆光电有限公司
成立时间	2023 年 11 月 6 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	成都高新区新创路 28 号 5 幢 2 楼 201 号
主要生产经营地	成都高新区新创路 28 号 5 幢 2 楼 201 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	成都及周边地区显示用智能控制卡业务

成都宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	6,562.20
净资产	2,938.51
营业收入	2,819.04
净利润	319.34

7、北海宇隆光电科技有限公司

名称	北海宇隆光电科技有限公司
成立时间	2022 年 3 月 9 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道 1 号广西惠科智能显示有限公司 A04 栋厂房西面一层
主要生产经营地	广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）东北大道 1 号广西惠科智能显示有限公司 A04 栋厂房西面一层
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用智能控制卡业务
在发行人业务板块中定位	广西北海及周边地区显示用智能控制卡业务

北海宇隆最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	3,400.51
净资产	2,865.84
营业收入	1,367.85
净利润	-48.55

8、安徽灿宇光电科技有限公司

名称	安徽灿宇光电科技有限公司
成立时间	2012 年 12 月 7 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房
主要生产经营地	合肥市新站区玉皇山路以北合肥锦畅胶粘制品有限公司厂房

股东构成及控制情况	重庆升越达持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用精密功能器件业务
在发行人业务板块中定位	合肥及周边地区显示用精密功能器件业务

安徽灿宇最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	24,386.01
净资产	18,920.48
营业收入	24,272.78
净利润	6,411.52

9、重庆升越达光电科技有限公司

名称	重庆升越达光电科技有限公司
成立时间	2016 年 5 月 12 日
注册资本	3,000.00 万元
实收资本	3,000.00 万元
注册地址	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72
主要生产经营地	重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	显示用精密功能器件业务
在发行人业务板块中定位	重庆及周边地区显示用精密功能器件业务

重庆升越达最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	21,818.01
净资产	9,113.73
营业收入	16,613.73
净利润	1,068.38

10、重庆宇隆电子技术研究院有限公司

名称	重庆宇隆电子技术研究院有限公司

成立时间	2020 年 4 月 28 日
注册资本	500.00 万元
实收资本	500.00 万元
注册地址	重庆市北碚区水善路 17 号
主要生产经营地	重庆市北碚区水善路 17 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
法定代表人	王亚龙
主营业务	技术支持和研究开发
在发行人业务板块中定位	为主营业务、主要产品提供研发及技术支持

宇隆研究院最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	1,365.22
净资产	269.40
营业收入	964.00
净利润	344.02

11、重庆隆美卡智能机器人有限公司

名称	重庆隆美卡智能机器人有限公司
成立时间	2025 年 11 月 12 日
注册资本	4,285.7143 万元人民币
实收资本	4,285.7143 万元人民币
注册地址	重庆市北碚区水善路 17 号
主要生产经营地	重庆市北碚区水善路 17 号
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 51%，王亚龙持股 19%，纽禄美卡持股 30%
法定代表人	王亚龙
主营业务	截至 2026 年 6 月 30 日，仍处于前期筹建状态，尚未开展实际生产活动
在发行人业务板块中定位	拟开展机器人相关业务

隆美卡机器人最近一年的主要财务数据如下（以下数据经天健会计师审计）：

单位：万元

项目	2025 年末/2025 年度
总资产	2,185.26
净资产	2,178.14

项目	2025 年末/2025 年度
营业收入	-
净利润	-7.57

12、香港宇隆科技有限公司

名称	香港宇隆科技有限公司
成立时间	2026 年 6 月 4 日
注册资本	1.00 万美元
实收资本	1.00 万美元
注册地址	RM 1602, 16/F Wing On CTR 111 Connaught RD, Central, Hong Kong
主要生产经营地	RM 1602, 16/F Wing On CTR 111 Connaught RD, Central, Hong Kong
股东构成及控制情况	宇隆科技持股 100%
主营业务	海外业务持股平台，截至 2026 年 6 月 30 日，仅持股越南宇隆
在发行人业务板块中定位	拓展海外业务的持股主体

香港宇隆于报告期后设立，作为发行人的海外业务持股平台，截至 2026 年 6 月 30 日，仅持股越南宇隆，最近一年无财务数据。

13、越南宇隆科技有限公司

名称（中文）	越南宇隆科技有限公司
名称（英文）	Vietnam E-ong Technology Company Limited
成立时间	2026 年 6 月 29 日
注册资本	521.46 亿越南盾
实收资本	-
注册地址	越南北宁省南山坊与方柳坊交界处的桂武工业园区（扩建区 O-1 地块）
主要生产经营地	越南北宁省南山坊与方柳坊交界处的桂武工业园区（扩建区 O-1 地块）
股东构成及控制情况	香港宇隆持股 100%
主营业务	截至 2026 年 6 月 30 日，仍处于前期筹建状态，尚未开展实际生产经营活动
在发行人业务板块中定位	越南及周边地区显示用智能控制卡等业务

越南宇隆于报告期后设立，尚未开展实际生产经营活动，最近一年无财务数据。

（二）参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家参股公司，简要情况如下：

名称	扬州光洋世一智能科技有限公司
成立时间	2021 年 1 月 25 日
注册资本	70,300.00 万元
股权结构	光洋股份持股比例为 86.77%；产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）持股比例为 7.11%；李树华持股比例为 1.64%；宇隆科技持股比例为 1.42%；常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 1.28%；张建钢持股比例为 0.50%；郑伟强持股比例为 0.50%；吴朝阳持股比例为 0.36%；陈大平持股比例为 0.28%；王军持股比例为 0.14%
控股方	光洋股份（002708.SZ）
公司出资金额	1,000.00 万元
公司持股比例	宇隆科技持股 1.42%
公司入股时间	2022 年 9 月
主营业务情况	主要从事柔性电路板、多层软硬结合电路板的研发、制造和销售